证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　上市地：上海证券交易所

苏州锴威特半导体股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）

项目	交易对方
发行股份及支付现金购买资产	易坤、成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）、成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）、成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）、成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）、成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）、YA XU、曾鸣、曾岳琦、成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）、成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）、李六军、深圳市融芯科技有限公司、曾浩、凌风、薛峰、陈国栋、苏鹏飞、天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）、天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、陈艺琴、易荣坤、上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）、天水华天电子集团股份有限公司、西安天利投资合伙企业（有限合伙）共 26 名交易对方
募集配套资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者

独立财务顾问

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

签署日期：二〇二六年八月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准

确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目 录

声 明 1

一、上市公司声明 1

二、交易对方声明 1

三、相关证券服务机构及人员声明 2

目 录 3

释 义 9

重大事项提示 13

一、本次交易方案概况 13

二、募集配套资金情况 20

三、本次交易对上市公司的影响 21

四、本次交易已履行及尚需履行的程序 23

五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 24

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 25

七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励 29

八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 33

重大风险提示 34

一、与本次交易相关的风险 34

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 36

第一章 本次交易概况 39

一、本次交易的背景、目的及协同效应 39

二、本次交易的具体方案 46

三、本次交易的性质 54

四、本次交易对上市公司的影响 55

五、本次交易的决策过程和审批情况 55

六、交易各方重要承诺 56

七、业绩承诺与补偿、分期支付安排 73
第二章 上市公司基本情况 74
一、基本信息 74
二、前十大股东情况 74
三、控股股东及实际控制人情况 75
四、最近三十六个月的控股权变动情况 75
五、最近三年的主营业务发展情况 75
六、主要财务数据及财务指标 76
七、最近三年的重大资产重组情况 77
八、上市公司合规经营情况 77
第三章 交易对方基本情况 78
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方 78
二、募集配套资金交易对方 191
三、其他事项说明 191
第四章 交易标的基本情况 195
一、基本情况 195
二、历史沿革 195
三、股权结构及产权控制关系 214
四、下属企业构成 216
五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况 217
六、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况 231
七、最近三年主营业务发展情况 231
八、主要财务数据 253
九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项 254
十、债权债务转移情况 254
十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理 254
第五章 发行股份情况 257
一、发行股份购买资产情况 257
二、募集配套资金所发行普通股股份情况 262

第六章 标的资产评估作价基本情况 267
一、标的资产总体评估情况 267
二、资产基础法评估情况 271
三、市场法评估情况 301
四、引用其他评估机构报告或估值机构报告的内容 326
五、估值特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明 326
六、评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对评估及交易作价的影响 326
七、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析 327
八、董事会对本次股份发行定价合理性的分析 332
九、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的意见 332
十、业绩承诺及可实现性 334
十一、本次交易资产定价的合理性 334
第七章 本次交易主要合同 335
一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容 335
二、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的主要内容 341
三、《业绩补偿协议》的主要内容 353
第八章 本次交易的合规性分析 364
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 364
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定的情形 366
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、四十四条的规定的情形 367
四、本次交易符合《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《重组审核规则》第八条的规定 ... 369
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定 370
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条相关规定 371

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条、第四十八条和《重组审核规则》第十二条的规定 371
八、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定 372
九、本次交易符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的要求 373
十、本次交易符合“并购六条”的相关规定 374
十一、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求 375
十二、相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 376
十三、中介机构对本次交易符合《重组管理办法》等规定发表的明确意见 376
第九章 管理层讨论与分析 378
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析 378
二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 382
三、标的公司的财务状况分析 403
四、标的公司的盈利能力及未来趋势分析 424
五、标的公司现金流量分析 441
六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排 443
七、本次交易对上市公司的影响 445
第十章 财务会计信息 454
一、标的公司财务会计资料 454
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料 464
第十一章 同业竞争和关联交易 469
一、同业竞争的情况及避免同业竞争的措施 469
二、关联交易情况 469
第十二章 风险因素分析 475

一、与本次交易相关的风险 475
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 477
三、其他风险 480
第十三章 其他重要事项 482
一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况 482
二、本次交易对于上市公司负债结构的影响 482
三、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 482
四、本次交易对上市公司治理机制的影响 482
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明 483
六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 487
七、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明 488
八、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 489
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 490
十、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 490
第十四章 对本次交易的结论性意见 491
一、独立董事意见 491
二、独立财务顾问意见 493
三、法律顾问意见 495
第十五章 中介机构及有关经办人员 497
一、独立财务顾问 497
二、法律顾问 497
三、审计机构 497
四、审阅机构 497
五、资产评估机构 498
第十六章 备查文件 499

一、备查文件 499
二、备查地点 499
第十七章 声明与承诺 500
一、上市公司全体董事声明 500
二、上市公司审计委员会声明 501
三、上市公司全体高级管理人员声明 502
四、独立财务顾问声明 503
五、法律顾问声明 504
六、审计机构声明 505
七、审阅机构声明 506
八、资产评估机构声明 507
附件 交易对方穿透核查情况 509

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般名词释义		
本报告书/重组报告书/草案	指	苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
重组预案	指	苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）
锴威特/公司/本公司/上市公司	指	苏州锴威特半导体股份有限公司
港晨芯	指	苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）
港鹰实业	指	张家港市港鹰实业有限公司
本次交易/本次重组/本次发行	指	上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得晶艺半导体100.00%股权，并募集配套资金
标的公司/交易标的/晶艺半导体	指	晶艺半导体有限公司
标的资产	指	晶艺半导体100.00%股权
晶格共智	指	成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）
晶格共创	指	成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）
晶格共赢	指	成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）
晶格顶峰	指	成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）
晶格未来	指	成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）
晶艺求精	指	成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）
晶艺共治	指	成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）
晶艺众合	指	成都晶艺众合科技有限公司
融芯科技	指	深圳市融芯科技有限公司
高鹏翼盛	指	天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）
高鹏联盛	指	天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）
腾元投资	指	嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）
芯联启辰	指	上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）
华天集团	指	天水华天电子集团股份有限公司
天利投资	指	西安天利投资合伙企业（有限合伙）
晶格微	指	成都晶格微科技有限公司，系标的公司历史股东
上海巨鱼	指	上海巨鱼企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司历史股东
一方贸易	指	济南市一方贸易有限责任公司，系标的公司历史股东
益方众诚	指	济南益方众诚投资管理合伙企业（有限合伙），系标的公司历史股东

深圳模数	指	深圳模数半导体有限公司，系标的公司历史股东
美的投资	指	广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙），系标的公司历史股东
润科上海	指	润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系标的公司历史股东
上海芯琏	指	上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司历史股东
香港晶艺	指	香港晶艺半导体有限公司，系晶艺半导体全资子公司
深圳分公司	指	晶艺半导体有限公司深圳分公司
上海分公司	指	晶艺半导体有限公司上海分公司
交易对方	指	易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、YA XU、曾鸣、曾岳琦、晶艺求精、晶艺共治、李六军、融芯科技、曾浩、凌风、薛峰、陈国栋、苏鹏飞、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、陈艺琴、易荣坤、芯联启辰、华天集团、天利投资
各方/交易各方	指	上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方	指	上市公司、交易对方
标的公司实际控制人及其控制的交易对方、易坤及其一致行动人	指	易坤及其控制的晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来
定价基准日	指	上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日
最近两年	指	2024 年度、2025 年度
国务院	指	中华人民共和国国务院
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》	指	上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》
《业绩补偿协议》	指	上市公司与业绩承诺方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导体股份有限公司与易坤等 12 名交易对方的业绩补偿协议》
业绩承诺方	指	易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞
审计报告	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《晶艺半导体有限公司审计报告》（天健审〔2026〕17359 号）
备考审阅报告	指	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州锴威特半导体股份有限公司审阅报告》（德皓核字[2026]00001765 号）
法律意见书	指	北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》
评估报告	指	金证（上海）资产评估有限公司出具的《苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2026】A0554 号）

报告期	指	2024 年、2025 年、2026 年 1-2 月
评估基准日	指	2026 年 2 月 28 日
交割日	指	本次交易的标的资产全部过户至上市公司名下之日
过渡期	指	评估基准日至交割日之间的过渡期间
独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审阅机构/德皓会计师	指	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问/德恒律师	指	北京德恒律师事务所
评估机构/金证评估	指	金证（上海）资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》
《监管指引第 7 号》	指	《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2025 年修订）》
《26 号格式准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 年修订）》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人
PPA	指	Purchase Price Allocation，因本次交易产生的可辨识资产溢价分摊
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词或术语释义		
IC	指	Integrated Circuit，简称为IC，中文为集成电路。是采用特定的工艺流程，将一个电路设计中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元器件通过多层金属线相连，在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上制作出来，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所设计的电路功能的微型结构
芯片	指	集成电路的载体，是集成电路经过设计、制作、封装、测试得到的具有特定功能的器件
晶圆	指	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成IC成品
封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起到安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等

Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计模式，指仅仅从事芯片研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆制造、封装测试厂商的模式
功率半导体	指	用于电能转换、功率控制与电路保护的半导体器件
电机驱动芯片	指	电机驱动芯片是一类专用于控制电机运行状态的功率集成电路，主要功能是接收主控单元发出的控制信号，通过功率放大与逻辑转换，输出适配电机特性的电压、电流与驱动时序，实现对电机的启停、调速、转向、力矩控制及保护等功能
电源管理芯片	指	在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的模拟芯片
IPM 模块	指	Intelligent Power Module的缩写，电机驱动用IPM功率模块，集成功率开关器件、驱动电路、保护电路和控制电路于一体，实现对高功率负载的高效、安全、智能化控制
DC-DC 芯片	指	Direct Current/Direct Current的缩写，DC-DC电源管理芯片，主要用于实现直流电源的升压、降压和升降压
BLDC	指	Brushless Direct Current Motor 的缩写，即无刷直流电机，是采用电子换向替代机械电刷的直流驱动电机
HVIC	指	High-Voltage Integrated Circuit的缩写，是一种将高压器件和低压控制电路集成在同一芯片上的集成电路
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor 的缩写，即金属-氧化物-半导体场效应晶体管，是广泛使用的功率半导体开关器件
LDO	指	Low Dropout Regulator的缩写，即低压差线性稳压器，是一种电源转换芯片
PMIC	指	Power Management Integrated Circuit 的缩写，即电源管理集成电路，是集成多路电源功能的电源管理芯片
POL	指	Point of Load 的缩写，即负载点电源，指靠近用电负载布设的电源转换方案
AC-DC 芯片	指	Alternating Current-Direct Current 的缩写，即交流-直流电源转换，是一类将交流电转换为直流电的电源芯片/电源模块
Load Switch	指	负载开关，是用于控制电路负载通断的电源开关芯片
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写，即绝缘栅双极型晶体管，是兼具 MOSFET 与双极晶体管特性的功率半导体器件
BCD	指	一种单片集成工艺技术，这种技术能够在同一芯片上制作双极器件（Bipolar）、CMOS器件和DMOS器件，称为BCD工艺

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概况

（一）本次重组方案概况

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体 100.00%股份，并募集配套资金。

在全球半导体产业加速整合、国产替代加速的浪潮下，国家产业政策及资本市场政策大力支持集成电路行业创新发展，上市公司明确了实现更多功率半导体产品的国产化替代和自主可控的发展战略，积极运用并购重组工具，聚焦产业链上下游进行要素整合，优化资源配置，推动自身高质量发展。

上市公司采用“功率器件+功率 IC”双轮驱动模式，以可靠的产品品质、优秀的产品性能和服务赢得客户，同时已开始利用高可靠性领域积累的技术向工控应用领域进行产品和市场拓展布局。

标的公司是一家采用 Fabless 经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，已发布并在售 300 余款功率 IC 及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

通过本次交易，上市公司在功率半导体的产品布局将进一步完善，可与标的公司共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综合功率半导体解决方案。本次交易完成后，双方研发资源还将实现互补协同，实现功率器件和功率 IC 联合优化，通过研发、技术方面的协同进一步提升公司核心竞争力。

同时，标的公司是上市公司主要客户之一，双方已建立稳定战略合作关系，本次交易完成后，基于已有的紧密业务关系和资本纽带的链接，双方可以通过渠道与客户共享增加各自产品的潜在客户，快速扩大市场覆盖范围，与行业标杆客户建立深度合作关系，提升整体市场份额及竞争力。

此外，上市公司与标的公司均为 Fabless 模式的半导体设计企业，本次交易完成后双方可在供应链、运营层面深度融合，可以全面提升产品质量与可靠性以及量产交付稳定性，从而实现降本增效与高质量发展。

综上，本次交易双方在业务上高度协同，本次交易后，上市公司与标的公司实现产品品类、研发与技术、客户资源、运营管理协同；本次交易围绕产业链上下游补链强链，有助于上市公司提升关键技术水平、快速补齐产品矩阵、丰富和完善产品线，有助于推动上市公司高质量发展，为打造“中国功率半导体领导者”的共同愿景奠定坚实基础。

本次重组方案具体如下：

交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方合计持有的晶艺半导体 100.00%股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金	
交易价格		165,000 万元	
交易标的	**名称**	晶艺半导体有限公司	
	主营业务	电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块的研发、设计和销售	
	所属行业	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6520 集成电路设计”	
	其他	**符合板块定位**	☑是 ☐否 ☐不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	☑是 ☐否
		与上市公司主营业务具有协同效应	☑是 ☐否
交易性质		**构成关联交易**	☑是 ☐否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	☑是 ☐否
		构成重组上市	☐是 ☑否
本次交易有无业绩补偿承诺			☑是 ☐否
本次交易有无减值补偿承诺			☑是 ☐否
其他需特别说明的事项			本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上

	限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易有关的税费和中介机构费用以及补充上市公司流动资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

（二） 标的资产评估作价情况

单位：万元

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
晶艺半导体	2026 年 2 月 28 日	市场法	165,000.00	304.24%	100%	165,000.00	无

（三）本次重组支付方式

1、差异化定价安排

金证评估以 2026 年 2 月 28 日为评估基准日出具了评估报告，截至评估基准日晶艺半导体 100%股权的评估值为 165,000.00 万元。结合上述评估结果，经交易各方协商确认，晶艺半导体 100%股权的交易价格为 165,000.00 万元。本次交易标的资产交易价格以符合《证券法》相关规定的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，交易定价与晶艺半导体全部股东权益评估值一致，符合上市公司及全体股东利益。

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权。根据交易各方协商结果，结合交易对方初始投资成本、是否承担业绩承诺义务、晶艺半导体整体估值等因素，对晶艺半导体 100%股权交易对方所持有的晶艺半导体股权价格采取差异化定价，具体原则如下：

交易对方类型	具体交易对方	合计持股比例	对应估值（亿元）	差异化对价计算逻辑
外部投资人	YA XU、曾鸣、曾岳琦、融芯科技、曾浩、凌风、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、陈艺琴、易荣坤、芯联启辰、华天集团、天利投资	43.94%	14.85	1、因外部投资人不承担业绩承诺，因此估值统一为晶艺半导体 100%股权的交易价格的九折，即 14.85 亿元； 2、外部投资人中，陈艺琴、易荣坤为夫妻，天利投资为华天集团控制的企业，因此为关联股东，其交易对价经内部协商进行了调整，但关

交易对方类型	具体交易对方	合计持股比例	对应估值（亿元）	差异化对价计算逻辑
				联股东整体估值亦为 14.85 亿元
业绩承诺方	易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞	56.06%	17.79	根据晶艺半导体 100%股权整体交易对价扣除上述所有股权计算的交易对价后的差额，根据各股东的相对持股比例进行分配

本次交易中，各交易对方的现金及股份支付比例由交易各方协商确定，上市公司本次交易支付的交易对价总额不超过标的资产评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、具体支付安排

（1）总体支付安排

上市公司向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	易坤	晶艺半导体 13.68%股权	-	24,345.02	24,345.02
2	晶格共智	晶艺半导体 11.99%股权	13,459.35	7,880.75	21,340.10
3	晶格共创	晶艺半导体 4.50%股权	5,037.24	2,965.30	8,002.54
4	晶格共赢	晶艺半导体 4.30%股权	4,238.71	3,408.15	7,646.87
5	晶格顶峰	晶艺半导体 4.20%股权	4,953.93	2,515.11	7,469.04
6	晶格未来	晶艺半导体 4.00%股权	4,477.86	2,635.50	7,113.37
7	YA XU	晶艺半导体 10.29%股权	15,278.79	-	15,278.79
8	曾鸣	晶艺半导体 4.00%股权	5,936.72	-	5,936.72
9	曾岳琦	晶艺半导体 4.00%股权	-	5,936.72	5,936.72
10	晶艺求精	晶艺半导体 3.97%股权	562.06	6,494.85	7,056.91
11	晶艺共治	晶艺半导体 3.97%股权	1,148.37	5,908.55	7,056.91
12	李六军	晶艺半导体 3.46%股权	-	6,162.86	6,162.86
13	融芯科技	晶艺半导体 1.00%股权	742.09	742.09	1,484.18
14	曾浩	晶艺半导体 1.00%股权	742.83	742.83	1,485.67
15	凌风	晶艺半导体 1.00%股权	1,484.18	-	1,484.18

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
16	薛峰	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
17	陈国栋	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
18	苏鹏飞	晶艺半导体 0.40%股权	-	711.34	711.34
19	高鹏翼盛	晶艺半导体 9.30%股权	6,907.50	6,907.50	13,815.00
20	高鹏联盛	晶艺半导体 2.62%股权	1,948.27	1,948.27	3,896.54
21	腾元投资	晶艺半导体 1.19%股权	885.58	885.58	1,771.16
22	陈艺琴	晶艺半导体 1.68%股权	872.36	1,328.37	2,200.73
23	易荣坤	晶艺半导体 0.11%股权	456.00	-	456.00
24	芯联启辰	晶艺半导体 5.36%股权	3,980.85	3,980.85	7,961.70
25	华天集团	晶艺半导体 2.24%股权	1,163.15	1,771.15	2,934.31
26	天利投资	晶艺半导体 0.15%股权	608.00	-	608.00
合计			**74,883.85**	**90,116.15**	**165,000.00**

（2）股份分期支付安排情况

本次交易标的公司 100%股权整体对价为 165,000 万元，股份支付对价为 90,116.15 万元，现金支付对价为 74,883.85 万元。其中，易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞作为业绩承诺方，在本次交易中获得的总对价为 99,750.30 万元，股份支付对价为 65,872.78 万元，现金支付对价为 33,877.52 万元。

业绩承诺方所获的股份对价中，对应芯片定制化量产业务的对价部分（即 29,600.00 万元）股份对价，拟分两期发行；其余 36,272.78 万元股份对价，拟在本次交易交割后一次性支付。

一次性支付的股份对价及分期支付的股份对价情况具体如下：

序号	交易对方	一次性支付		分期支付		合计	
		股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	易坤	13,405.56	4,126,058	10,939.46	3,367,023	24,345.02	7,493,081
2	晶格共智	4,339.53	1,335,651	3,541.22	1,089,942	7,880.75	2,425,593
3	晶格共创	1,632.84	502,567	1,332.46	410,113	2,965.30	912,680
4	晶格共赢	1,876.70	577,623	1,531.46	471,362	3,408.15	1,048,985
5	晶格顶峰	1,384.94	426,267	1,130.17	347,850	2,515.11	774,117

序号	交易对方	一次性支付		分期支付		合计	
		股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）
6	晶格未来	1,451.24	446,672	1,184.27	364,501	2,635.50	811,173
7	晶艺求精	3,576.38	1,100,765	2,918.47	898,266	6,494.85	1,999,031
8	晶艺共治	3,253.53	1,001,396	2,655.01	817,177	5,908.55	1,818,573
9	李六军	3,393.57	1,044,498	2,769.29	852,350	6,162.86	1,896,848
10	薛峰	783.39	241,119	639.28	196,761	1,422.67	437,880
11	陈国栋	783.39	241,119	639.28	196,761	1,422.67	437,880
12	苏鹏飞	391.70	120,560	319.64	98,380	711.34	218,940
合计		**36,272.78**	**11,164,295**	**29,600.00**	**9,110,486**	**65,872.78**	**20,274,781**

对于分期发行的具体安排，请参见本报告书“重大事项提示”之“七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励”。

（3）分期支付股份的锁定期安排

业绩承诺方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起 12 个月内不得转让。但是，若业绩承诺方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。本次交易完成后，业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

其中，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算。

（四）股份发行情况

股票种类	境内人民币普通股（A 股）	**每股面值**	1.00 元
定价基准日	上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日	**发行价格**	32.49 元/股，该价格不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将

			根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整
发行数量	27,736,570 股		
是否设置发行价格调整方案	□是 ☑否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整）		
锁定期安排	1、交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起 12 个月内不得转让。但是，若交易对方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。若交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 6 个月内不得上市交易或转让。前述“不得转让”包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。 2、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算。 3、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的一次性支付的股份，在协议约定的业绩承诺期内逐年解除锁定，即如标的公司完成协议约定的当年业绩承诺或业绩承诺期届满时履行完毕业绩补偿义务的，则按照协议约定的比例解除上述股份的锁定（业绩承诺方之间以其于本次交易获得的股份对价的相对比例解除锁定），具体安排如下： （1）第一期：标的公司业绩承诺期内第一年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的股份数为业绩补偿锁定股份数的 25% － 因履行业绩承诺期第一年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）； （2）第二期：标的公司业绩承诺期内第二年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 60% － 因履行业绩承诺期第一年及第二年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）； （3）第三期：标的公司业绩承诺期内第三年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 100% － 因履行业绩承诺期第一年、第二年及第三年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）。 4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，各方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。		

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金概况

募集配套资金金额	90,083.85 万元，不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价格的 100%且拟发行的股份数量不超过上市公司本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。		
发行方式	向特定对象发行		
发行对象	不超过 35 名符合条件的特定对象		
募集配套资金用途	**项目名称**	**拟使用募集资金金额（万元）**	**使用金额占全部募集配套资金金额的比例**
	支付交易现金对价	74,883.85	83.13%
	支付中介机构费用及相关税费	7,500.00	8.32%
	补充上市公司流动资金	7,700.00	8.55%
	合计	**90,083.85**	**100.00%**

（二）募集配套资金的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A 股）	**每股面值**	1.00 元
定价基准日	本次募集配套资金的发行期首日	**发行价格**	不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、法规的规定，依据发行对象申报报价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整
发行数量	本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。 本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。		
是否设置发行价格调整方案	□是 ☑否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整）		

锁定期安排	本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

上市公司采用“功率器件+功率 IC”双轮驱动模式，功率器件覆盖硅基功率 MOSFET、集成快恢复的功率 MOSFET（FRMOS）、碳化硅基 MOSFET 和 JFET 等产品，电压等级覆盖 20V-3300V；功率 IC 业务主要系 PWM 控制 IC、栅极驱动 IC、智能开关控制 IC 等产品，重点为高可靠领域客户提供功率器件、功率控制和驱动 IC 的系统化解决方案，已形成 80 余款功率 IC 产品，基于与晶圆代工厂深度合作，根据晶圆代工厂的标准工艺可以调整优化工艺参数和流程，以可靠的产品品质、优秀的产品性能和服务赢得客户，同时已开始利用高可靠性领域积累的技术向工控应用领域进行产品和市场拓展布局。

标的公司也从事功率半导体领域，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，已发布并在售 300 余款功率 IC 及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

上市公司及标的公司同属于功率半导体设计公司，通过本次交易，上市公司在功率半导体的产品布局将进一步完善，可与标的公司共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综合功率半导体解决方案。本次交易完成后，双方研发资源还将实现互补协同，实现功率器件和功率 IC 联合优化，通过研发、技术方面的协同进一步提升公司核心竞争力。同时，标的公司与上市公司已建立稳定战略合作关系，基于已有的紧密业务关系和资本纽带的链接，双方可以有效建立渠道与客户共享机制，并在供应链、运营层面深度融合，快速扩大市场覆盖范围、提升供应链话语权、优化营运效率，全面提升产品质量与可靠性以及量产交付稳定性，进一步提升公司核心竞争力。

因此，本次交易双方在业务上高度协同，本次交易后，上市公司与标的公

司将实现产品品类、研发与技术、客户资源、运营管理协同，本次交易围绕产业链上下游补链强链，有助于上市公司提升关键技术水平，快速补齐产品矩阵、丰富和完善产品线，有助于推动上市公司高质量发展，为双方打造“中国功率半导体领导者”的共同愿景奠定坚实基础。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至本报告书签署日，丁国华先生为上市公司控股股东、实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

截至 2026 年 2 月 28 日，上市公司总股本为 73,684,211 股。经各方协商，本次交易上市公司将新增 27,736,570 股用于向交易对方支付股份对价。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构测算如下表所示：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
上市公司实际控制人及其一致行动人	34,779,797	47.20%	34,779,797	34.29%
上市公司其他原有股东	38,904,414	52.80%	38,904,414	38.36%
易坤及其控制的标的公司员工持股平台	-	-	13,465,629	13.28%
标的公司其他股东	-	-	14,270,941	14.07%
合计	**73,684,211**	**100.00%**	**101,420,781**	**100.00%**

注：易坤及其控制的标的公司员工持股平台指易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后，根据德皓会计师出具的上市公司备考审阅报告以及上市公司合并财务报表，本次交易完成前后，上市公司主要财务数据对比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日/2026 年 1-2 月			2025 年 12 月 31 日/2025 年度		
	交易前	备考数	变动/变动率	交易前	备考数	变动/变动率
总资产	91,695.19	278,371.24	203.58%	93,569.33	304,183.53	225.09%
总负债	12,236.62	108,792.84	789.08%	13,042.82	133,958.18	927.06%
归属于母公司股东的所有者权益	78,408.79	168,528.61	114.94%	79,465.73	169,164.56	112.88%
营业收入	3,408.97	11,407.15	234.62%	25,456.78	57,609.35	126.30%
利润总额	-1,080.23	-10,489.62	/	-9,849.87	-26,032.26	/

净利润	-1,069.68	-10,444.23	/	-9,222.27	-23,688.20	/
归属于母公司股东的净利润	-1,057.83	-10,432.38	/	-9,078.26	-23,544.19	/
归属于母公司股东的净利润（剔除股份支付、PPA 影响）	-1,057.83	1,885.93	/	-9,078.26	2,094.68	/
资产负债率	13.34%	39.08%	增加 25.74 个百分点	13.94%	44.04%	增加 30.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.14	-1.03	/	-1.24	-2.33	/
基本每股收益（元/股）（剔除股份支付、PPA 影响）	-0.14	0.19	/	-1.24	0.21	/

注：剔除股份支付、PPA 影响后归母净利润=归母净利润+标的公司股份支付费用+当期 PPA 折旧摊销金额，其中 PPA 指因本次交易产生的可辨识资产溢价分摊，上表中剔除股份支付、PPA 未考虑相关税务影响。

本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司全资子公司，上市公司在总资产、营业收入等方面均有所提升，归属于母公司股东净利润受标的公司计提股份支付以及本次交易 PPA 折旧摊销的影响有所降低，若剔除上述影响，本次交易完成后上市公司将持续盈利能力将得以增强。从长期来看，随着标的公司的业务发展与业绩释放，标的公司将持续提升其盈利水平；同时随着上市公司与标的公司在产品品类、客户资源、技术积累、供应链等方面的协同效应充分发挥，本次交易后，上市公司将进一步深化在功率半导体领域的竞争力，增强持续经营能力和盈利能力。

四、本次交易已履行及尚需履行的程序

本次交易实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次交易不得实施。本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及批准情况列示如下：

（一）本次交易已履行的决策程序及批准情况

截至本报告书签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：

1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意意见；

2、本次交易已经上市公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第九次会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经交易对方内部有权机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及批准情况

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项，包括但不限于：

1、上市公司股东会审议批准本次交易方案；

2、本次交易经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册；

3、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见

上市公司控股股东、实际控制人丁国华及其一致行动人罗寅、港鹰实业、陈锴，以及丁国华控制的员工持股平台港晨芯已出具《关于本次交易的原则性同意意见》：

“本人/本企业已知悉上市公司本次交易的相关信息和方案，本人/本企业认为，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、抗风险能力和综合竞争实力，有利于维护上市公司及全体股东的利益，本人/本企业原则上同意本次交易。”

（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人丁国华及其一致行动人罗寅、港鹰实业、陈锴，以及丁国华控制的员工持股平台港晨芯已出具《关于本次交易期间减持计划的承诺函》：

“截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在减持计划。若自本次交易预

案披露之日起至本次交易实施完毕期间本人/本企业拟执行相关减持计划，本人/本企业将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。

本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。”

（三）上市公司全体董事、高级管理人员的股份减持计划

上市公司全体董事、高级管理人员已出具《关于本次交易期间减持计划的承诺函》：

“截至本承诺函出具之日，本人不存在减持上市公司股份的计划。自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。

本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。”

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

在本次交易过程中，公司已切实按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《26 号格式准则》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进

行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（三）严格执行相关决策程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批。

（四）网络投票安排和中小股东单独计票

根据有关规定，本次交易将为参加股东会的股东提供便利。上市公司将通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东会投票情况，上市公司将单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（五）股份锁定安排

本次交易发行股份的锁定期安排请参见本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”之“（四）股份发行情况”。

（六）设置业绩承诺及补偿安排

本次交易不存在法定业绩承诺义务。为充分维护上市公司及中小股东的利益，本次交易方案设定了业绩补偿条款。上市公司与作为业绩承诺方的易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞共 12 名交易对方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺及减值测试的补偿的具体安排请参见本报告书 “重大事项提示”之“七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励”之“（一）业绩承诺及补偿安排”。

（七）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形

1、本次交易对上市公司每股收益的影响

根据德皓会计师出具的上市公司备考审阅报告以及上市公司合并财务报表，

本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下：

项目	2026 年 2 月 28 日/2026 年 1-2 月			2025 年 12 月 31 日/2025 年度		
	交易前	备考数	备考数（剔除标的公司股份支付、PPA 折旧摊销）	交易前	备考数	（剔除标的公司股份支付、PPA 折旧摊销）
基本每股收益（元/股）	-0.14	-1.03	0.19	-1.24	-2.33	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-1.03	0.19	-1.24	-2.33	0.21

本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司全资子公司，上市公司在总资产、营业收入、归属于母公司股东的所有者权益等方面均有所提升。本次交易前，上市公司 2025 年度、2026 年 1-2 月基本每股收益分别为-1.24 元/股、-0.14 元/股，本次交易后分别降低至-2.33 元/股、-1.03 元/股，主要系标的公司报告期内计提股份支付以及本次交易 PPA 折旧摊销所致。剔除上述影响后，本次交易后基本每股收益分别为 0.21 元/股、0.19 元/股，每股收益有所增长。

通过本次交易，上市公司在功率半导体领域迈出了坚实的步伐，上市公司将进一步提高在功率器件及功率 IC 领域的竞争力，也有助于上市公司在产品品类、客户资源、技术积累、供应链等方面与标的公司形成积极的互补关系，借助各自已有的研发成果和行业地位，实现业务与技术上的有效整合。

本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的净利润将有所降低，每股收益亦有所降低，本次交易后每股收益有所摊薄，但主要是因标的公司报告期内计提股份支付以及本次交易 PPA 折旧摊销所致。剔除上述影响后，本次交易后每股收益有所增长，但如果本次交易后标的公司盈利能力未达预期，或因宏观经济环境、行业发展周期等因素影响导致标的公司出现利润下滑的情形，上市公司每股收益等即期回报指标面临被摊薄的风险。

2、上市公司拟采取的填补回报并增强上市公司持续回报能力的措施

本次交易后上市公司每股收益有所降低，主要是因标的公司报告期内计提股份支付以及本次交易 PPA 折旧摊销所致。受未来宏观经济、产业政策、市场竞争等多方面未知因素的影响，为防范未来出现摊薄即期回报的风险，上市公司制定了相关措施填补本次交易可能对即期回报造成摊薄的影响，具体如下：

（1）加快完成对标的公司的整合，尽快实现标的公司的预期效益

本次交易完成后，公司将加快对标的公司的整合，充分调动标的公司各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施，公司将争取更好地实现标的公司的预期效益。

（2）加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司治理准则》《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，为公司未来的健康发展提供制度保障，保护公司和投资者的合法权益。同时，公司将进一步加强企业经营管理，提高公司日常运营效率，控制公司运营成本，全面有效地降低公司经营和管理风险，有效提升经营效率。

（3）进一步完善利润分配政策，提高股东回报

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，公司已经在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。公司未来将按照公司章程和相关法律法规的规定继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，维护全体股东利益。

（4）相关方已出具填补回报措施的承诺

公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具摊薄即期回报采取填补措施的承诺，具体情况请参见“第一章 本次交易概况”之“六、交易各方重要承诺”相关内容。

（八）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方承诺，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励

（一）业绩承诺及补偿安排

1、业绩承诺

根据业绩承诺方与上市公司已签署的附条件生效的《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺标的公司芯片定制化量产业务 2026 年度、2027 年度累积实现的净利润不低于 25,500 万元。标的公司芯片自研业务 2026 年度、2027 年度和 2028 年度实现的收入分别不低于 33,500 万元、45,200 万元和 56,600 万元，三年累积实现的收入不低于 135,300 万元。

上述业绩承诺期内芯片定制化量产业务各年的实际净利润以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片定制化量产业务归属于母公司股东的净利润（应剔除股份支付费用及非经常性损失）为准；芯片自研业务的收入数以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片自研业务的营业收入为准。

在业绩承诺期内，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，在业绩承诺期内，原则上将维持标的公司的会计政策、会计估计；除非法律法规规定改变会计政策、会计估计。

2、业绩承诺实现情况及补偿方式

业绩承诺期内，由上市公司及易坤共同认可的具有《中华人民共和国证券法》规定资格的会计师事务所根据约定对标的公司芯片定制化量产业务实际净利润情况、芯片自研业务的实际营业收入进行审核并出具专项审核报告（以下简称“《专项审核报告》”），相关实际业绩数与承诺业绩数的差异情况以该《专项审核报告》载明的数据为准。《专项审核报告》就芯片定制化量产业务和芯片自研业务的会计处理、分拆政策、原则保持与报告期一致，出具时间应不晚于上市公司相应年度审计报告的出具时间，且不晚于当期业绩承诺期各年度次年的 4 月 30 日，无论标的公司是否完成交割。

业绩承诺方进一步承诺，在业绩补偿义务全部履行完毕前，不得在其通过

本次交易取得的尚未解锁的业绩补偿锁定股份之上设置质押权、第三方收益权等他项权利或其他可能对实施业绩补偿安排造成不利影响的其他权利，不通过质押股份或类似方式逃废补偿义务。

（1）芯片定制化量产业务考核的计算及实施

上市公司当期向业绩承诺方发行股份数量 =（本次交易标的公司芯片定制化量产业务当期累计实现的净利润 ÷ 2026 年度和 2027 年度累计承诺的净利润总额）×（全体股东等值芯片定制化量产业务 2.96 亿元对价 ÷ 本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））— 上市公司基于芯片定制化量产业务向业绩承诺方已支付的股数。

为避免歧义，当上述公式中标的公司芯片定制化量产业务当期累计实现的净利润累计超过 25,500 万元时，则按 25,500 万元计算。

各业绩承诺方按其各自在本次交易中获得的总对价的相对比例取得各期实际发行股份。依据上述公式计算的发行股份数量应精确至个位数，不足一股的尾数按零取值。

上市公司应在具有证券业务资格的会计师事务所出具当期《专项审核报告》后 10 个工作日内（且不超过收到中国证监会同意注册文件之日起 48 个月内）向上海证券交易所或届时履行相应职能的有权机构提交关于当期实际发行股份数量的定向发行申请，并于《专项审核报告》出具后 30 日内协助业绩承诺方将对价股份登记至业绩承诺方名下。为避免歧义，双方确认，对价股份登记至业绩承诺方名下应当以标的公司股权完成交割为前提。业绩承诺方应尽最大努力配合发行申请所必要的手续并签署必要的文件。

（2）芯片自研业务业绩补偿方式

根据《专项审核报告》，业绩承诺期内，芯片自研业务如果业绩承诺期内各期标的公司累积实现的实际营业收入数达到该期累积承诺的营业收入数的 90%（含本数），则不触发补偿程序，否则业绩承诺方应对上市公司进行业绩补偿。

业绩承诺期内，若触发补偿，业绩承诺方应进行股份补偿，补偿股份数量的计算公式如下：

①当期应补偿金额＝（业绩承诺期内芯片自研业务各期累积承诺的营业收入数*90%－业绩承诺期内芯片自研业务各期累积实际实现的营业收入数）÷芯片自研业务业绩承诺期内三年累计承诺的营业收入总数 × 业绩承诺方就本次交易获得的税后股份对价×（芯片自研业务板块估值对应对价÷标的公司 100%股权对价）- 芯片自研业务板块累积已补偿金额（如有）

其中，各期是指标的公司累积实现或承诺营业收入为当年及之前业绩承诺年度累积，下同。

应补偿股份数＝应补偿金额÷本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））。

②依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，不足一股的尾数向上取整。

③业绩承诺方为承担《业绩承诺补偿协议》第 3.4.2 条项下补偿义务的主体，业绩承诺方之间以其各自于本次交易获得的芯片自研业务股份对价的相对比例各自承担补偿责任。

④业绩承诺方承诺以其基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价对应的股份应优先用于履行业绩补偿承诺。

⑤业绩承诺方应优先以其基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价进行补偿，若业绩承诺方因其于本次交易中获得的且届时仍持有的股份不足进行股份补偿而需向上市公司进一步进行现金补偿的，业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 30 个工作日内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

（二）减值测试及补偿

在业绩承诺期届满日至业绩承诺期最后一年上市公司的年度报告公告日期间，由上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试专项报告，并在年度报告公告同时出具相应的减值测试结果。

如：标的资产的期末减值额＞已补偿股份总数×本次交易中上市公司向业

绩承诺方发行股份的价格＋已补偿现金（如有），则业绩承诺方应向上市公司另行补偿。另行补偿时，业绩承诺方应优先以其于本次交易中获得的作为交易作价的上市公司新增股份进行补偿，不足部分以现金进行补偿。

另需补偿的股份数＝标的资产期末减值额÷本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格－业绩承诺期内累积已补偿股份总数－业绩承诺期已补偿现金（如有）÷本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格。另行补偿的股份数量不足 1 股的按 1 股计算。

应补偿金额＝（标的资产应补偿股份数－业绩承诺期内累积已补偿股份总数）×本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格－业绩承诺期已补偿现金（如有）。

标的资产期末减值额为标的资产本次交易作价减去标的资产在业绩承诺期末的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产因股东增资、减资、接受赠与、利润分配以及送股、公积金转增股本等除权除息行为的影响。

（三）业绩补偿上限安排

业绩承诺方因标的资产业绩承诺和减值测试补偿合计不超过业绩承诺方于本次交易中取得的股份对价的税后净额，应补偿股份的总数不超过业绩承诺方就本次交易获得税后股份对价对应的股份数，即业绩承诺方就本次交易获得的税后股份对价÷本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））以及该部分股份在业绩承诺期内获得的上市公司送股、转增的股份数（如有）。

（四）业绩奖励安排

若标的公司芯片定制化量产业务对应业绩承诺期累积实现净利润超过累积对应期间承诺净利润且 2027 年度标的公司芯片自研业务实现净利润为正，上市公司同意将按照超额实现净利润部分的 80%给予标的公司员工超额业绩奖励，但奖励的总金额不得超过标的资产本次交易价格的 20%。

超额业绩奖励应于 2028 年 4 月 30 日之前由标的公司以现金方式向标的公司员工发放超额业绩奖励，如 2027 年度标的公司芯片自研业务实现净利润为负，则从下一会计年度开始按季度（一季度、半年度、前三季度、全年）进行考核，

在经审计的财务报告（一季报、半年报、三季报或年度报告）中自研业务实现净利润为正的情况下，方可于相应专项审计报告出具后次月 20 日前发放超额业绩奖励。超额业绩奖励的具体分配方案由标的公司主要管理团队决定。

前款所称净利润系以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片自研业务归属于母公司股东的净利润（应剔除股份支付费用及非经常性损失）为准。

超额业绩奖励相关的纳税义务由实际受益人自行承担。

八、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）本次交易独立财务顾问的证券业务资格

上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格。

（二）信息披露查阅

本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露，投资者应据此作出投资决策。本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示

投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易方案尚需满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，可能导致本次交易暂停、中止或取消，该等因素包括但不限于：

1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕消息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易的内幕消息进行内幕交易而导致本次交易被暂停、中止或取消的可能；

2、在本次交易过程中，市场环境的变化和监管机构的审核要求可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被取消的可能；

3、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。

若本次交易因上述某种原因或几种原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动，则面临交易定价及其他条件可能需要重新调整的风险。提请广大投资者注意相关风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（二）标的公司评估增值较高的风险

根据金证评估出具的《评估报告》，于评估基准日（2026 年 2 月 28 日）经采用市场法和资产基础法评估并最终选取市场法评估结果作为评估结论，晶艺半导体股东全部权益评估值为 165,000.00 万元，较合并报表归属于母公司所有者权益增值 124,182.43 万元，增值率 304.24%。

虽然金证评估在评估过程中严格参照相关评估准则或指引进行评估，但仍可能出现因政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，导致实际情

况与评估假设不一致并最终导致标的资产的评估值与实际情况不符的风险。

（三）标的公司未能实现业绩承诺的风险

根据上市公司与本次交易的业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，业绩承诺方对本次交易完成后晶艺半导体的芯片定制化量产业务的净利润以及芯片自研业务的收入情况分别进行了业绩承诺。标的公司生产经营受宏观经济、市场环境、行业竞争等多方面因素的影响，若业绩承诺期间出现影响标的公司生产经营的不利因素，则本次交易存在业绩承诺无法实现的风险。

（四）业绩补偿无法覆盖全部交易对价的风险

本次交易中标的资产合计交易作价为 165,000.00 万元，其中业绩承诺方因本次交易取得对价金额为 99,750.30 万元，其补偿金额上限不超过业绩承诺方于本次交易中取得的股份对价的税后净额，应补偿股份的总数不超过业绩承诺方就本次交易获得税后股份对价对应的股份数。因此，若标的公司在本次交易后的经营业绩出现波动，存在业绩补偿金额无法覆盖全部交易对方获取交易对价的风险。

（五）未来上市公司商誉减值的风险

本次交易前，截至 2026 年 2 月 28 日，上市公司商誉账面价值为 0 万元。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，上市公司会在合并日就本次交易合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分确认商誉。根据德皓会计师出具的《备考审阅报告》，假设公司在 2025 年 1 月 1 日起将标的资产纳入合并报表范围，截至 2026 年 2 月 28 日上市公司商誉账面价值为 90,353.03 万元，占总资产、净资产的比例分别为 32.46%、53.28%（未考虑募集配套资金）。假定配套募集资金后上市公司净资产增加 9.01 亿元，则本次交易完成后上市公司账面商誉占总资产、净资产的比例约为 24.52%、34.80%。

本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如本次拟收购的标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险；如发生商誉减值，则会减少上市公司当期损益。上市公司将按期进行商誉减值测试，并根据减值测试结果计提商誉减值准备。本次交易完成后，上市公司将与

标的公司进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高标的公司的竞争力，以便尽可能地降低商誉减值风险。

（六）募集配套资金不达预期的风险

作为本次交易的交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否通过交易所审核及证监会注册尚存在不确定性。此外，若公司股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金不能足额募集乃至募集失败的风险，如募集配套资金不达预期，则本次交易的现金对价将由上市公司以自筹或自有资金支付，存在增加上市公司经营压力的风险。

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）市场竞争加剧的风险

标的公司是一家采用 Fabless 经营模式的功率半导体企业，标的公司所在的功率半导体行业受国家政策鼓励影响发展迅速，一方面，行业内企业数量增加迅速，另一方面行业内企业不断结合自身优势拓展市场。国内功率半导体的市场参与者数量不断增多，标的公司面临的市场竞争逐渐加剧。尽管标的公司在技术、市场等方面具有竞争优势，但若未来标的公司无法正确把握市场动态及行业发展态势，无法结合市场需求进行相应产品创新、开发，则标的公司的业务和经营业绩将受到一定影响。

（二）产品和技术迭代升级的风险

标的公司所处行业具有技术产品更新要求高、资金投入大、研发周期长等特点。为保证产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，标的公司在研发方面投入大量资源。如果标的公司未来研发投入不足，或不能紧跟行业的前沿需求或者不能对应用领域和终端市场进行准确的判断，快速识别并响应客户需求的变化，技术及产品升级跟不上技术变革的步伐，标的公司将面临核心竞争力下降的风险，从而对标的公司的生产经营造成重大不利影响。

目前标的公司与授权方合作稳定，但若因授权相关各方自身原因导致授权

被终止，将会影响标的公司定制化量产业务的后续开展，并对标的公司未来业绩产生不利影响。

（三）芯片定制化量产知识产权授权、业务持续性风险

半导体行业属于技术密集型行业，涉及众多知识产权，标的公司在芯片定制化量产业务中涉及使用知识产权授权，标的公司芯片定制化量产业务以相关授权为基础，利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，为服务器、通信等领域的客户提供专业的芯片量产服务。未来，如果受地缘政治、市场变化等因素影响，可能使标的公司芯片定制化量产业务使用的知识产权授权无法继续，从而对相关业务的持续性、稳定性及合规性产生风险，进而对标的公司业绩产生不利影响。

（四）核心技术人员流失的风险

标的公司所处的功率半导体行业属于技术密集型、人才密集型行业，优秀的研发人员团队对标的公司主营业务的可持续发展至关重要。目前标的公司主要管理层及研发团队在芯片设计领域深耕多年，拥有丰富的产品研发经验。随着市场竞争的加剧，集成电路设计人才的竞争也日趋激烈。若标的公司不能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面临核心技术人员流失的风险，并对标的公司生产经营和持续研发能力产生不利影响。

（五）核心技术泄露的风险

标的公司自成立以来始终专注于功率半导体产品的技术研发，组建了专业的研发技术团队，并经过自主研发，形成多项核心技术，在产品生产各环节发挥了关键的作用。标的公司通过申请专利、规范研发过程管理等措施对自主知识产权进行保护，防止核心技术泄露，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露，也不能完全排除未来因员工违反相关协议等因素导致的技术秘密泄露风险。

（六）主要客户集中的风险

报告期内，标的公司对前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入的比例为 63.23%、65.26%和 73.96%，主要为业内知名的电子元器件经销商，终端客户为国内外知名家电、安防、服务器等行业企业。未来若标的公司主要客户

或终端品牌厂商的经营情况和资信状况发生不利变化，主要客户经营、采购战略发生较大变化，部分主要客户需求减少，可能导致标的公司收入增速有所放缓甚至下滑。

（七）主要供应商集中的风险

标的公司采取 Fabless 的运营模式，专注于芯片设计环节，将芯片制造、封装测试委托给专业厂商。标的公司采购主要包括晶圆和封装测试，晶圆制造商以及封装测试供应商较为集中。报告期内，标的公司对前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 84.01%、81.84%和 92.35%。

若突发重大灾害等事件，或者由于晶圆制造商和封装测试厂等供应商产能不足、自身管理水平欠佳等原因影响标的公司产品的正常生产和交付进度，而标的公司未能及时拓展新的供应商进行有效替代，将对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（八）自研业务毛利率下滑的风险

报告期内，标的公司主营业务由自研业务和芯片定制化量产业务两部分构成，其中芯片定制化量产业务采用净额法核算，自研业务采用总额法核算；报告期各期，标的公司自研业务毛利率分别为 33.86%、34.98%和 31.71%，标的公司毛利率波动受市场竞争变化、客户及产品结构变化、原材料价格波动等因素影响。如果未来芯片定制化量产业务受行业及合作伙伴采购策略变动影响发生不利变动，或者标的公司自研业务因市场供需或竞争环境变化增长不及预期，标的公司存在毛利率下滑风险。

（九）存货跌价的风险

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 11,343.59 万元、10,919.02 万元和 10,253.20 万元，占各期末总资产的比例分别为 18.00%、13.95%和 18.16%。报告期各期末，标的公司存货跌价准备金额分别为 460.70 万元、1,895.35 万元和 1,824.41 万元，占存货余额的比例分别为 3.90%、14.79%和 15.11%，存货跌价计提比例较高。如果标的公司无法准确根据市场及客户需求进行合理备货，将增加因市场环境变化或产品无法满足客户需求等情况出现的存货跌价的风险，进而对标的公司业绩产生不利影响。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景、目的及协同效应

（一）本次交易的背景

1、近期国家产业政策及资本市场政策大力支持集成电路行业创新发展

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视集成电路产业的高质量发展，在产业政策层面，出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等多项支持政策，大力优化集成电路产业发展环境。除上述产业政策支持外，资本市场也陆续出台多项支持政策。

2024年以来，中国证监会陆续发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等，支持有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。

2、集成电路行业对国民经济和国家安全具有战略意义

集成电路产业是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一，作为数字经济的核心“基石”，在多个关键领域有着广泛应用，对国民经济和国家安全具有基础性和战略性意义，是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的重要产业之一。但我国集成电路产业的总体发展水平较美欧日韩等国家仍有一定差距，且在关键领域和环节存在“卡脖子”问题。同时，日益频繁的国际贸易摩擦对国产芯片的自主、安全、可控提出了迫切需求，国内半导体供应链国产化进程不断加速。

当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，加快推进集成电路产业发展，对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。

3、国内高性能模拟 IC 自给率低，国产厂商未来增长空间广阔

功率 IC 是一种模拟 IC，模拟 IC 作为连接真实世界与数字世界的“桥梁”，广泛应用于通信基站、汽车电子、工业控制、消费电子、医疗电子等领域，市场需求巨大。近年来，在国内经济发展、国家产业政策的支持下，同时叠加国产替代加速及下游应用的爆发，我国模拟芯片自给率不断提升，但高端模拟 IC 的自给率总体仍处于较低水平，头部企业仍被国外厂商所占据。

目前国内模拟 IC 厂商凭借对本土市场的理解、灵活的定制化服务能力以及不断提升的技术水平正不断地在细分品类上实现单点突破，通过客户导入和寻求增量市场提升市场占有率、有序扩展产品线。模拟 IC 的长生命周期、相对弱周期性、产品设计门槛高、人才培养时间长、制程要求不高等特点，为中国本土模拟集成电路设计企业的发展和并购重组提供了较为有利的市场条件，未来增长空间广阔。

（二）本次交易的目的

1、功率半导体业务精准互补，打造中国功率半导体领先企业

上市公司采用“功率器件+功率 IC”双轮驱动模式，功率器件覆盖硅基功率 MOSFET、集成快恢复的功率 MOSFET（FRMOS）、碳化硅基 MOSFET 和 JFET 等产品，电压等级覆盖 20V-3300V；功率 IC 业务主要系 PWM 控制 IC、栅极驱动 IC、智能开关控制 IC 等产品，重点为高可靠领域客户提供功率器件、功率控制和驱动 IC 的系统化解决方案，已形成 80 余款功率 IC 产品，基于与晶圆代工厂深度合作，根据晶圆代工厂的标准工艺可以调整优化工艺参数和流程，以可靠的产品品质、优秀的产品性能和服务赢得客户，同时已开始利用高可靠性领域积累的技术向工控应用领域进行产品和市场拓展布局。

标的公司是一家采用 Fabless 经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，已发布并在售 300 余款功率 IC 及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

上市公司深耕功率半导体多年，为响应国家政策，上市公司明确了实现更多功率半导体产品的国产化替代和自主可控的发展战略，上市公司与标的公司

同属于功率半导体领域，双方整合后，将完善上市公司在功率半导体的产品布局，共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综合功率半导体解决方案。具体而言，其一，上市公司功率 IC 产品原有的高可靠应用领域，将与标的公司民用市场领域叠加，形成了从高可靠领域到高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等全电子领域市场覆盖，实现该类产品的国产替代；其二，上市公司的功率器件产品与标的公司控制 IC 合封的智能功率模块（IPM）可以精准协同，为上述市场领域提供优质的全系列高低压电机驱动解决方案；其三，上市公司中大功率 AC-DC 电源管理 IC，与标的公司的 DC-DC 电源管理 IC 共同组建完整的电源管理 IC 产品矩阵，可以为上述市场领域提供更加全面的电源解决方案。

2、整合模拟领域研发、技术资源，通过技术协同提升公司核心竞争力

上市公司现有超过 80 人的专业研发团队，在硅基及碳化硅基功率器件研发、隔离拓扑电源管理控制、智能开关控制芯片等领域具有深厚积累，核心技术涵盖高压 MOSFET 寿命控制、短沟道 SiC MOSFET 沟道控制等国际先进技术；标的公司拥有超过 80 人的专业研发团队，具备资深模拟芯片设计、BCD 工艺开发与先进封装专家团队，在 SiP 集成封装、定制化磁器件设计、电机驱动控制、各类型拓扑结构电源管理控制等领域积累深厚。本次交易完成后，上市公司研发技术实力将显著提升，双方研发团队与技术储备将形成强大合力，通过核心技术共享及研发资源整合实现在工艺优化、器件设计、封装技术等方面深度协同，全面提高上市公司产品迭代创新能力。

上市公司专注于高可靠的功率器件和面向高可靠领域应用的功率 IC 的研发，这包含硅基 MOSFET 和第三代 SiC 化合物功率器件，以及大功率驱动和隔离拓扑的 PWM 控制 IC。标的公司擅长定制化功率 IC、功率模块 IPM 及 SiP 封装产品开发、低压电机驱动和非隔离拓扑电源管理 IC 开发。本次交易完成后，双方研发资源将实现互补协同，实现功率器件和功率 IC 联合优化，有助于公司形成更完整的功率半导体系统级解决方案，从而提升公司的核心竞争力。

3、扩宽市场渠道、补强供应链话语权，通过渠道协同提升规模效应与运营效率

（1）市场与客户资源双向赋能

标的公司是上市公司重要客户之一，双方已建立多年稳定战略合作关系，为后续团队及业务整合建立了互信融合的良好基础。客户与渠道方面，标的公司通过从上市公司采购功率器件，并将其和自主研发的功率控制 IC 合封成为智能功率模块 IPM 产品，已经成功导入美的、小米、格力、TCL、海信日立等国内家电行业龙头企业，并成功实现批量量产；标的公司凭借领先的产品技术、稳定的产品品质与完善的技术服务能力，积累了超 500 家量产客户，客户群体广泛分布于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防监控、通信设备、服务器等多个下游应用领域，成功进入这些领域的头部客户供应链并实现批量量产，客户结构优质且多元。

整合后，双方将共享客户资源与销售渠道：在家电领域，深化与美的、格力、小米、海信日立、TCL 等家电头部客户的合作深度，提供成套解决方案；在通信设备与服务器领域，借助标的公司的客户基础，拓展浪潮、中兴等标杆客户，推广上市公司的 SiC MOSFET 及工业电源用产品；标的公司的电源管理产品可以通过上市公司渠道和客户资源打入高可靠性需求市场，助力国产替代；通过渠道与客户共享，快速扩大市场覆盖范围，与行业标杆客户建立深度合作关系，提升整体市场份额及竞争力。

（2）供应链协同与运营效率优化升级

供应链方面，双方均为 Fabless 模式的半导体设计企业，上市公司拥有成熟的晶圆加工与委外封测体系，标的公司亦具备自主可控的优质供应链。本次并购整合完成后，双方可共享工艺平台、优化供应链管理能力，并通过规模化采购提升对供应商的议价能力，降低晶圆及封装测试成本；借助标的公司在民用领域的规模化出货能力与上市公司的高可靠质量保证体系，优化库存管理与产能调配，更好地应对市场需求波动。

运营层面，标的公司完善的数字化管理系统（ERP、CRM、WMS 等）与上市公司的规范管理运营经验深度融合，简化内部交易流程，节省原有的客户

开发、订单对接等交易成本；共享销售渠道与服务网络，减少重复的市场推广与客户维护投入；整合公司各个工种和职能部门资源，优化人力资源配置，提升整体效率；整合质量管控资源，依托标的公司的可靠性实验室、产品开发和量产放行流程和量产可靠性监控流程，与上市公司的高可靠领域质量标准相结合和融合，全面提升产品质量与可靠性以及量产交付稳定性，实现降本增效与高质量发展。

（三）本次交易标的公司科创属性及其与上市公司主营业务的协同效应

1、标的公司具备科创属性

标的公司主要从事电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计与销售，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的行业分类，标的公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（CH39）”中的“电子器件制造（CH397）”。标的公司为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业为“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条中的“（一）新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”，符合科创板行业领域要求。

2、标的公司与上市公司主营业务的协同效应

上市公司通过本次交易，可以在技术、市场、供应链的方面与标的公司实现较好的协同，有助于上市公司长期竞争实力的提升。

在技术层面，上市公司与标的公司同属于功率半导体领域，双方整合后，将完善上市公司在功率半导体的产品布局，上市公司在民用功率 IC 领域的技术储备、实力得以强化，同时，上市公司原电源管理 IC 技术多布局于中大功率 AC-DC 方向，通过本次交易，与标的公司的 DC-DC 电源管理 IC 共同组建完整的电源管理 IC 产品矩阵，上市公司可以为上述市场领域提供更加全面的电源解决方案。

在市场与客户层面，上市公司和标的公司可通过渠道与客户共享，快速扩大市场覆盖范围，与行业标杆客户建立深度合作关系，提升整体市场份额及竞争力。具体来说，标的公司通过从上市公司采购功率器件，并将其和自主研发的功率控制 IC 合封成为智能功率模块 IPM 产品，已经成功导入美的、小米、格力、TCL、海信日立等国内家电行业龙头企业，并成功实现量产；依托标的公司积累的超 500 家量产客户资源，交易整合后，双方将共享客户资源与销售渠道：在家电领域，深化与美的、格力、小米、海信日立、TCL 等家电头部客户的合作深度，提供成套解决方案；在通信设备与服务器领域，借助标的公司的客户基础，拓展浪潮、中兴等标杆客户，推广上市公司的 SiC MOSFET 及工业电源用产品；此外，标的公司的电源管理产品还可以通过上市公司渠道和客户资源打入高可靠性需求市场，助力国产替代。

在供应链方面，双方均为 Fabless 模式的半导体设计企业，本次并购整合完成后，双方可共享工艺平台、优化供应链管理能力，并通过规模化采购提升对供应商的议价能力，降低晶圆及封装测试成本，优化库存管理与产能调配，更好地应对市场需求波动。

在运营层面，双方通过数字化管理系统（ERP、CRM、WMS 等）、运营经验深度融合，简化内部交易流程，可节省原有的客户开发、订单对接等交易成本，减少重复的市场推广与客户维护投入；通过整合公司各个工种和职能部门资源，优化人力资源配置，可提升整体效率；通过整合质量管控资源，可全面提升产品质量与可靠性以及量产交付稳定性，实现降本增效与高质量发展。

（四）本次交易的必要性

1、本次交易具有明确可行的发展战略

上市公司专注于功率器件与功率 IC 的设计、研发与销售，并提供相关技术服务。公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，紧扣行业周期与国产替代趋势，助力高性能功率器件、功率 IC 的国产化替代以及自主可控，将公司打造成高品质功率器件及智能功率 IC 的优秀供应商。本次交易可对上市公司功率半导体业务进行较大程度的补足，完善上市公司在功率半导体的产品布局，形成应用场景更完善、技术规格更全面的功率半导体产品体系，上市公

司产品、技术、客户、运营等盈利能力驱动因素得以有效提升，有利于提升公司的核心竞争力，从而提高公司的持续经营能力。

2、本次交易不存在不当市值管理行为

本次交易双方同属于功率半导体行业，本次交易为典型的产业并购，具备产业基础和商业合理性，不存在不当市值管理行为。

3、本次交易相关主体的减持情况

截至本报告书签署日，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员已就减持计划出具承诺函，前述相关主体尚未有减持上市公司股份的计划。自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，前述相关主体如有减持上市公司股份的计划，将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。

4、本次交易具备商业实质

本次交易的交易对方真实、合法地拥有本次交易的标的资产，交易定价符合市场化原则，参考相关专业机构对标的资产审计、评估的结果，经交易各方充分沟通协商，且获得了必要的批准，交易价格公允合理。

通过本次交易，上市公司将获得电机驱动和电源管理产品的业务布局。本次交易后，上市公司营业收入得到大幅提升，公司的综合实力得以跃升，有利于提升上市公司财务状况、增强持续经营能力，有利于切实提高上市公司质量、提升股东回报水平。因此，本次交易具有商业实质，不存在利益输送的情形。

5、本次交易不违反国家产业政策

上市公司与标的公司同属半导体行业，半导体行业作为国家经济发展的支柱产业之一，国家给予了高度重视和大力支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，半导体产业作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，其核心技术发展和科技创新有助于增强国家在高科技领域的竞争力，因此本次交易不违反国家产业政策。

二、本次交易的具体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（1）定价依据

根据《重组管理办法》，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

（2）定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第六次会议决议公告日。

（3）发行价格

经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
前 20 个交易日	43.50	34.81
前 60 个交易日	41.46	33.18
前 120 个交易日	40.60	32.49

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

4、交易价格及支付方式

（1）差异化定价安排

金证评估以 2026 年 2 月 28 日为评估基准日出具了评估报告，截至评估基准日晶艺半导体 100%股权的评估值为 165,000.00 万元。结合上述评估结果，经交易各方协商确认，晶艺半导体 100%股权的交易价格为 165,000.00 万元。本次交易标的资产交易价格以符合《证券法》相关规定的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，交易定价与晶艺半导体全部股东权益评估值一致，符合上市公司及全体股东利益。

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权。根据交易各方协商结果，结合交易对方初始投资成本、是否承担业绩承诺义务、晶艺半导体整体估值等因素，对晶艺半导体 100%股权交易对方所持有的晶艺半导体股权价格采取差异化定价，具体原则如下：

交易对方类型	具体交易对方	合计持股比例	对应估值（亿元）	差异化对价计算逻辑
外部投资人	YA XU、曾鸣、曾岳琦、融芯科技、曾浩、凌风、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、陈艺琴、易荣坤、芯联启辰、华天集团、天利投资	43.94%	14.85	1、因外部投资人不承担业绩承诺，因此估值统一为晶艺半导体 100%股权的交易价格的九折，即 14.85 亿元； 2、外部投资人中，陈艺琴、易荣坤为夫妻，天利投资为华天集团控制的企业，因此为关联股东，其交易对价经内部协商进行了调整，但关

交易对方类型	具体交易对方	合计持股比例	对应估值（亿元）	差异化对价计算逻辑
				联股东整体估值亦为 14.85 亿元
业绩承诺方	易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞	56.06%	17.79	根据晶艺半导体 100%股权整体交易对价扣除上述所有股权计算的交易对价后的差额，根据各股东的相对持股比例进行分配

本次交易中，各交易对方的现金及股份支付比例由交易各方协商确定，上市公司本次交易支付的交易对价总额不超过标的资产评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

（2）具体支付安排

①总体支付安排

上市公司向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	易坤	晶艺半导体 13.68%股权	-	24,345.02	24,345.02
2	晶格共智	晶艺半导体 11.99%股权	13,459.35	7,880.75	21,340.10
3	晶格共创	晶艺半导体 4.50%股权	5,037.24	2,965.30	8,002.54
4	晶格共赢	晶艺半导体 4.30%股权	4,238.71	3,408.15	7,646.87
5	晶格顶峰	晶艺半导体 4.20%股权	4,953.93	2,515.11	7,469.04
6	晶格未来	晶艺半导体 4.00%股权	4,477.86	2,635.50	7,113.37
7	YA XU	晶艺半导体 10.29%股权	15,278.79	-	15,278.79
8	曾鸣	晶艺半导体 4.00%股权	5,936.72	-	5,936.72
9	曾岳琦	晶艺半导体 4.00%股权	-	5,936.72	5,936.72
10	晶艺求精	晶艺半导体 3.97%股权	562.06	6,494.85	7,056.91
11	晶艺共治	晶艺半导体 3.97%股权	1,148.37	5,908.55	7,056.91
12	李六军	晶艺半导体 3.46%股权	-	6,162.86	6,162.86
13	融芯科技	晶艺半导体 1.00%股权	742.09	742.09	1,484.18
14	曾浩	晶艺半导体 1.00%股权	742.83	742.83	1,485.67
15	凌风	晶艺半导体 1.00%股权	1,484.18	-	1,484.18

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
16	薛峰	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
17	陈国栋	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
18	苏鹏飞	晶艺半导体 0.40%股权	-	711.34	711.34
19	高鹏翼盛	晶艺半导体 9.30%股权	6,907.50	6,907.50	13,815.00
20	高鹏联盛	晶艺半导体 2.62%股权	1,948.27	1,948.27	3,896.54
21	腾元投资	晶艺半导体 1.19%股权	885.58	885.58	1,771.16
22	陈艺琴	晶艺半导体 1.68%股权	872.36	1,328.37	2,200.73
23	易荣坤	晶艺半导体 0.11%股权	456.00	-	456.00
24	芯联启辰	晶艺半导体 5.36%股权	3,980.85	3,980.85	7,961.70
25	华天集团	晶艺半导体 2.24%股权	1,163.15	1,771.15	2,934.31
26	天利投资	晶艺半导体 0.15%股权	608.00	-	608.00
合计			**74,883.85**	**90,116.15**	**165,000.00**

②股份分期支付安排情况

本次交易标的公司 100%股权整体对价为 165,000 万元，股份支付对价为 90,116.15 万元，现金支付对价为 74,883.85 万元。其中，易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞作为业绩承诺方，在本次交易中获得的总对价为 99,750.30 万元，股份支付对价为 65,872.78 万元，现金支付对价为 33,877.52 万元。

业绩承诺方所获的股份对价中，对应芯片定制化量产业务的对价部分（即 29,600.00 万元）股份对价，拟分两期发行；其余 36,272.78 万元股份对价，拟在本次交易交割后一次性支付。

一次性支付的股份对价及分期支付的股份对价情况具体如下：

序号	交易对方	一次性支付		分期支付		合计	
		股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	易坤	13,405.56	4,126,058	10,939.46	3,367,023	24,345.02	7,493,081
2	晶格共智	4,339.53	1,335,651	3,541.22	1,089,942	7,880.75	2,425,593
3	晶格共创	1,632.84	502,567	1,332.46	410,113	2,965.30	912,680
4	晶格共赢	1,876.70	577,623	1,531.46	471,362	3,408.15	1,048,985
5	晶格顶峰	1,384.94	426,267	1,130.17	347,850	2,515.11	774,117

序号	交易对方	一次性支付		分期支付		合计	
		股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）	股份对价（万元）	股份数量（股）
6	晶格未来	1,451.24	446,672	1,184.27	364,501	2,635.50	811,173
7	晶艺求精	3,576.38	1,100,765	2,918.47	898,266	6,494.85	1,999,031
8	晶艺共治	3,253.53	1,001,396	2,655.01	817,177	5,908.55	1,818,573
9	李六军	3,393.57	1,044,498	2,769.29	852,350	6,162.86	1,896,848
10	薛峰	783.39	241,119	639.28	196,761	1,422.67	437,880
11	陈国栋	783.39	241,119	639.28	196,761	1,422.67	437,880
12	苏鹏飞	391.70	120,560	319.64	98,380	711.34	218,940
合计		**36,272.78**	**11,164,295**	**29,600.00**	**9,110,486**	**65,872.78**	**20,274,781**

对于分期发行的具体安排，请参见本报告书“重大事项提示”之“七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励”。

③分期支付股份的锁定期安排

业绩承诺方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起 12 个月内不得转让。但是，若业绩承诺方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。本次交易完成后，业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

其中，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算。

5、发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份的数量之和，其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。按上述公式计算得出的股份数量向下取整精确至股，不足一股的部分相应计入上市公司的资本公积金。

依据上述原则计算发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行数量（股）
1	易坤	24,345.02	7,493,081
2	晶格共智	7,880.75	2,425,593
3	晶格共创	2,965.30	912,680
4	晶格共赢	3,408.15	1,048,985
5	晶格顶峰	2,515.11	774,117
6	晶格未来	2,635.50	811,173
7	YA XU	-	-
8	曾鸣	-	-
9	曾岳琦	5,936.72	1,827,246
10	晶艺求精	6,494.85	1,999,031
11	晶艺共治	5,908.55	1,818,573
12	李六军	6,162.86	1,896,848
13	融芯科技	742.09	228,405
14	曾浩	742.83	228,634
15	凌风	-	-
16	薛峰	1,422.67	437,880
17	陈国栋	1,422.67	437,880
18	苏鹏飞	711.34	218,940
19	高鹏翼盛	6,907.50	2,126,038
20	高鹏联盛	1,948.27	599,652
21	腾元投资	885.58	272,569
22	陈艺琴	1,328.37	408,854
23	易荣坤	-	-
24	芯联启辰	3,980.85	1,225,253
25	华天集团	1,771.15	545,138
26	天利投资	-	-
合计		**90,116.15**	**27,736,570**

在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

6、锁定期安排

本次交易发行股份的锁定期安排请参见本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”之“（四）股份发行情况”。

7、滚存未分配利润安排

上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。

8、过渡期损益

过渡期内，标的公司产生的收益由重组完成后的股东享有，产生的亏损（剔除过渡期内股份支付对标的资产净利润影响）由交易对方按标的公司原有持股比例以现金方式向上市公司补足。具体收益及亏损金额应按收购标的资产的比例计算。

双方同意，在标的资产交割完成日后 60 日内，由上市公司及易坤共同认可的符合《证券法》相关规定的审计机构对标的公司过渡期期间损益进行审计，并出具审计报告予以确认。为避免歧义，双方认可以标的资产交割完成日上一个月的最后一天作为过渡期专项审计的审计基准日。若转让方与上市公司及其他相关方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺期与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》约定的过渡期存在重合，且转让方已根据本条约定对过渡期亏损进行补偿的，则在计算业绩补偿金额时应扣减转让方按本条约定已补偿的亏损金额。

9、业绩承诺及补偿安排

本次交易发行股份的业绩承诺及补偿安排请参见本报告书“重大事项提示”之“七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励”之“（一）业绩承诺及补偿安排”。

（二）募集配套资金具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

3、发行股份的定价方式和价格

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。

最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报报价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

4、发行规模及发行数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 90,083.85 万元，未超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。

本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

5、锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公

司股份因上市公司送股、转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

6、募集配套资金用途

本次交易募集配套资金不超过 90,083.85 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，具体用途如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
支付交易现金对价	74,883.85	83.13%
支付中介机构费用及相关税费	7,500.00	8.32%
补充上市公司流动资金	7,700.00	8.55%
合计	**90,083.85**	**100.00%**

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司及标的公司可以根据募集资金的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

7、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司 100%股权，根据上市公司、标的公司经审计的 2025 年度财务数据以及

本次交易作价情况，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	资产总额及交易金额孰高值	资产净额及交易金额孰高值	营业收入
晶艺半导体 100%股份（A）	165,000.00	165,000.00	34,971.68
锴威特（上市公司，B）	93,569.33	79,465.73	25,456.78
财务指标比例（A/B）	176.34%	207.64%	137.38%

注 1：上表晶艺半导体 100%股份股权的“资产总额及交易金额孰高值”和“资产净额及交易金额孰高值”取相应交易金额，“营业收入”取晶艺半导体营业收入；
注 2：锴威特、晶艺半导体的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2025 年度财务报表，资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。

根据上述计算结果，本次交易标的资产的相关财务指标占上市公司相关财务数据的比例高于 50%。因此，本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，标的公司实际控制人易坤控制的上市公司股份比例将超过 5%，根据《科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司实际控制人均为丁国华先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响请参见本报告书“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。

五、本次交易的决策过程和审批情况

（一）本次交易已履行的决策程序及批准情况

截至本报告书签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：

1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则

性同意意见；

2、本次交易已经上市公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第九次会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经交易对方内部有权机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及批准情况

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项，包括但不限于：

1、上市公司股东会审议批准本次交易方案；

2、本次交易经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册；

3、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

六、交易各方重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

（一）上市公司及其全体董事及高级管理人员作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
上市公司	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本公司继续提供相关资料和信息时，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	一、本公司、本公司的董事、高级管理人员以及前述主体所控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本公司及本公司控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
	关于无违法违规行为及诚信情况的承诺函	一、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应予披露的尚未了结的或可合理预见的重大诉讼或仲裁案件，不存在因证券违法违规被中国证监会采取限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除的情形。 二、本公司最近三年内未受过任何刑事处罚或与证券市场相关的行政处罚，不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况。 三、本公司最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。 四、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
	关于采取的保密措施及保密制度的说明	一、本公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 二、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人信息及筹划过程，制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 三、在公司与交易对方签署的交易协议中设有保密条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。 四、本公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司股票。 五、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
	关于符合向特定对象发行股票条件的承诺函	一、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。 （四）本公司或者现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查。 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害本公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 二、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
上市公司董事、高级管理人员	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本人保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本人保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本人继续提供相关资料和信息时，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所披露或提

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 六、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于不存在参与上市公司重大资产重组情形的说明	一、本人保证不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本人保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于无违法违规及诚信情况的承诺函	一、本人保证不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应予披露的尚未了结的或可合理预见的重大诉讼或仲裁案件，不存在因证券违法违规被中国证监会采取限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除的情形。 二、本人最近三年内未受过任何刑事处罚或与证券市场相关的行政处罚，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况。 三、本人最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。 四、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条至第一百八十一条规定的董事、高级管理人员不得存在之行为。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		五、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于本次交易期间减持计划的承诺函	截至本承诺函出具之日，本人不存在减持上市公司股份的计划。自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。 本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 三、本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 四、本人承诺支持董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 五、未来上市公司如实施股权激励计划，在本人合法权限范围内，促使拟公告的股权激励计划设置的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 六、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 七、本人确认上述内容系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。 八、本承诺函至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再作为上市公司的董事或高级管理人员；（2）上市公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次交易终止。

（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
上市公司控股股东、实际控制人及	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本人/本企业保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
其一致行动人		名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本人/本企业保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本人/本企业继续提供相关资料和信息时，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、本人/本企业保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所披露或提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让本人/本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 六、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于本次交易期间减持计划的承诺函	一、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在减持计划。若自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间本人/本企业拟执行相关减持计划，本人/本企业将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。 二、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于无违法违规行为及诚信情况的承诺函	一、本人/本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应予披露的尚未了结的或可合理预见的重大诉讼或仲裁案件，不存在因证券违法违规被中国证监会采取限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除的情形。 二、本人/本企业最近三年内未受过任何刑事处罚或与证券市场相关的行政处罚，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		权益或者社会公共利益的重大违法行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况。 三、本人/本企业最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。 四、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	一、本人/本企业、本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本人/本企业及本人/本企业控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于保障上市公司独立性的承诺函	一、本次交易前，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，本人/本企业保证上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业之间保持独立，上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面具备独立性。 二、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性和合法利益，在业务、资产、机构、人员和财务方面与上市公司完全分开，并严格遵守证券监管部门关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司为本人/本企业或本人/本企业控制的企业提供担保，不违规占用上市公司资金、资产，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。 三、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于规范和减少关联交	一、在本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业关联企业将尽量避免和减少与上市公司或其子公司发生关联交易，不会谋

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
	易的承诺函	求与上市公司或其子公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利。 二、在本次交易实施完毕后，若本人/本企业及/或本人/本企业关联企业与上市公司或其子公司发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业关联企业将与上市公司或其子公司按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司或其子公司依法签订协议，按市场公认的合理价格确定交易价格，并按相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及中国证券监督管理委员会等证券监管机构的监管要求履行交易审批程序及信息披露义务。 三、本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司或其子公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司或其子公司的资金，亦不要求上市公司和/或其子公司为本人/本企业或本人/本企业的关联企业进行违规担保，保证不损害上市公司及上市公司股东的合法权益。 四、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于避免同业竞争的承诺函	一、本人/本企业及本人/本企业控制的企业不存在直接或间接从事与上市公司或其子公司实际从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。 二、在本次交易实施完毕后，在本人/本企业为上市公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人期间，本人/本企业及本人/本企业控制的企业不会直接或间接地以任何方式参与或进行与上市公司或其子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；凡本人/本企业及本人/本企业控制的企业将来可能获得任何与上市公司或其子公司存在直接或间接竞争的业务机会，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将及时采取措施将前述构成直接或间接竞争的业务机会控制或降低至不对上市公司构成重大不利影响的范围内。 三、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	一、本人/本企业承诺不越权干预上市公司的经营管理活动，也不采用其他方式损害上市公司利益。 二、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 三、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。 四、本承诺函至以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人/本企业不再作为上市公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人；（2）上市公司股票终止在上海证券交易所上市；（3）本次交易终止。
	关于采取的保密措施及保密制度的说明	一、本人/本企业保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 二、本人/本企业保证不泄露本次交易的内幕信息；在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 三、本人/本企业严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度的相关要求进行内幕信息知情人登记。 四、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
丁国华	关于不放弃上市公司控制权的承诺	一、本人承诺，在本次交易完成后 36 个月内，不解除与一致行动人的一致行动关系，本人持续履行《一致行动协议》的约定，不主动放弃对上市公司的控制权。二、如本人在本承诺出具日至本次交易完成后 36 个月内违反本承诺给上市公司或其投资者造成损失的，则依法承担相应的赔偿责任。
罗寅、陈锴、港鹰实业	关于持续履行《一致行动协议》的承诺	一、本人/本企业承诺，在本次交易完成后 36 个月内，不解除与上市公司控股股东、实际控制人的一致行动关系，持续履行《一致行动协议》的约定。二、如本人/本企业在本承诺出具日至本次交易完成后 36 个月内违反本承诺给上市公司或其投资者造成损失的，则依法承担相应的赔偿责任。

（三）本次交易的交易对方

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
全体交易对方	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	一、本人/本企业、本企业的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员以及前述主体所控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本人/本企业、本企业的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员以及前述主体所控制的机构保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本人/本企业确认上述说明系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解。如上述说明存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本人/本企业保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本人/本企业保证向上市公司、参与本次交易的各中介机构充分披露了本次交易所需的全部信息并承诺在本次交易期间及时提供相关信息，所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本人/本企业保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本人/本企业继续提供相关资料和信息时，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、如本次交易因涉嫌所披露或提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。如被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让本人/本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 六、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于无违法违规行为及诚信情况的承诺函	一、本人/本企业如为自然人，本人具备完全民事行为能力；本人/本企业如为公司/合伙企业，本企业为在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限公司/合伙企业，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效，本企业不存在因营业期限届满解散、治理机构决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭或者根据相关法律法规或自身的公司章程/合伙协议需要终止的情形。本人/本企业具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		二、本人/本企业及本企业现任董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 三、本人/本企业及本企业现任董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 四、本人/本企业及本企业现任董事、监事、高级管理人员、主要管理人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情况，最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚的情形，最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 五、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于所持标的公司股权权属的承诺函	一、本人/本企业对所持标的股权拥有合法、完整的所有权，本人/本企业已经依法就标的股权履行法定出资义务且资金来源合法，不存在任何出资不实、虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任的行为。 二、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所持标的股权未被查封、司法冻结、强制执行，不存在质押或其他权利限制，不存在与标的股权有关的现实或潜在争议、行政处罚、诉讼或仲裁，本人/本企业所持标的股权权属清晰、完整，不存在信托持股、委托持股或者其他任何类似安排，不存在委托他人代为持有标的股权或者代他人持有标的公司股权的情形，不存在影响本次交易标的股权权属转移及过户的实质性障碍。 三、在本次交易完成之前，本人/本企业保证不会就所持标的股权设置质押等任何权利限制，亦不会委托他人代为持有标的股权或者代他人持有标的公司股权，保证标的股权不发生诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。 四、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
	关于与上市公司不存在关联关系的承诺函	截至本承诺函出具之日，本人/本企业与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等之间不存在关联关系；本人/本企业不存在向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况。 本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞	关于股份锁定的承诺函	一、本人/本企业通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；若本人/本企业取得新增股份时，本人/本企业对本人/本企业用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。 进一步的，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算；在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的一次性支付的股份，在协议约定的业绩承诺期内逐年解除锁定，即如标的公司完成协议约定的当年业绩承诺或业绩承诺期届满时履行完毕业绩补偿义务的，则按照协议约定的比例解除上述股份的锁定（业绩承诺方之间以其于本次交易获得的股份对价的相对比例解除锁定），具体安排如下： （1）第一期：标的公司业绩承诺期内第一年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按业绩补偿协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据业绩补偿协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的股份数为业绩补偿锁定股份数的 25%－因履行业绩承诺期第一年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）； （2）第二期：标的公司业绩承诺期内第二年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按业绩补偿协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据业绩补偿协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 60%－因履行业绩承诺期第一年及第二年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）； （3）第三期：标的公司业绩承诺期内第三年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按业绩补偿协议的约定履行完毕业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据业绩补偿协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 100%－因履行业绩承诺期第一年、第二年及第三年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）。 二、本次交易实施完毕后，本人/本企业所持新增股份由于上市公司派息、送股、转增股本或配股等原因而增加的，该等增加的股份亦应遵守上述股份限售安排。 三、如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关监管意见进行相应调整。 四、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
曾岳琦、融芯科技、曾浩、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投	关于股份锁定的承诺函	一、本人/本企业通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；但是，（1）若本人/本企业取得新增股份时，本人/本企业对本人/本企业用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
资、陈艺琴、芯联启辰、华天集团		的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；（2）若本企业属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时本企业对本企业用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至本企业名下之日起 6 个月内不得上市交易或转让。前述“不得转让”包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 二、本次交易实施完毕后，本人/本企业所持新增股份由于上市公司派息、送股、转增股本或配股等原因而增加的，该等增加的股份亦应遵守上述股份限售安排。 三、如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，本人/本企业将根据相关监管意见进行相应调整。 四、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
标的公司实际控制人及其控制的交易对方	关于不谋求上市公司控制权的承诺函	一、截至本承诺函出具日，除因本次交易将取得的锴威特股份外，本人/本企业及本人/本企业的一致行动人不存在增持锴威特股份的计划，不存在以任何方式谋求锴威特控制权的计划。 二、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 36 个月内，不以任何方式谋求锴威特控制权。除本次交易外，本人/本企业及本人/本企业的一致行动人承诺不通过包括但不限于增持锴威特股份、接受委托、征集投票权、一致行动协议等任何方式增加在锴威特的表决权，不以任何方式直接或间接增持锴威特股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持锴威特股份（但因上市公司以资本公积金转增、回购、股权激励等原因增加的除外）。 三、本人/本企业及本人/本企业的一致行动人与锴威特及其控股股东、实际控制人、一致行动人之间不存在关联关系或一致行动关系。 四、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
标的公司实际控制人及其控制的交易对方	关于规范和减少关联交易的承诺函	一、在本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业关联企业将尽量避免和减少与上市公司或其子公司发生关联交易，不会谋求与上市公司或其子公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利。 二、在本次交易实施完毕后，若本人/本企业及本人/本企业关联企业与上市公司或其子公司发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业关联企业将与上市公司或其子公司按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司或其子公司依法签订协议，按市场公认的合理价格确定交易价格，并按相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及中国证券监督管理委员会等证券监管机构的监管要求履行交易审批程序及信息披露义务。 三、本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司或其子

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司或其子公司的资金，亦不要求上市公司或其子公司为本人/本企业或本人/本企业的关联企业进行违规担保，保证不损害上市公司及上市公司股东的合法权益。 四、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
标的公司	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本公司保证本公司及本公司控制的企业为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本公司保证本公司及本公司控制的企业向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司保证本公司及本公司控制的企业已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本公司及/或本公司控制的企业继续提供相关资料和信息时，本公司及本公司控制的企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	一、本公司及本公司控制的企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本公司及本公司控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，本公司对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
	无违法违规行为及诚信情况的承诺函	一、本公司及本公司控制的企业均为依法设立并合法存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效，本公司及本公司控制的企业不存在因营业期限届满解散、公司治理机构决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭或者根据相关法律法规或其各自的公司章程需要终止的情形，本公司具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。 二、本公司及本公司控制的企业、本公司的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。 三、本公司及本公司控制的企业、本公司的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或任何行政处罚，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 四、本公司及本公司控制的企业、本公司的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 五、本公司及本公司控制的企业、本公司的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。 六、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，本公司对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。
标的公司董监高	关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函	一、本人保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本人保证本人向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料；该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本人保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 四、根据本次交易的进程，需要本人继续提供相关资料和信息时，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
		不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	一、本人及本人控制的企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、本人及本人控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 三、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
	关于无违法违规行为及诚信情况的承诺函	一、本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。 二、本人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 三、本人最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被列入失信联合惩戒对象、失信被执行人名单的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 四、本人最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。 五、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。

（五）标的公司交易对方的上层股东

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶	关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函	一、在晶格共智/晶格共创/晶格共赢/晶格顶峰/晶格未来/晶艺求精/晶艺共治承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治取得股份对价的上层自然人合伙人		二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。 三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。 五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
融芯科技上层股东王丹荔、刘群英	关于所持上市公司股份锁定的承诺函	一、本人保证，采取一切必要措施确保本人持有的融芯科技的股权锁定期与融芯科技因本次重组持有的上市公司股票锁定期保持一致。在融芯科技因本次重组持有的上市公司股票锁定期间，本人所持融芯科技股权不得转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。 二、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 三、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
高鹏联盛上层合伙人陈森、宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司	关于所持上市公司股份锁定的承诺函	一、本人/本企业保证，采取一切必要措施确保本人/本企业持有的高鹏联盛的合伙份额锁定期与高鹏联盛因本次重组持有的上市公司股票锁定期保持一致。在高鹏联盛因本次重组持有的上市公司股票锁定期间，本人/本企业所持高鹏联盛合伙份额不得转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。 二、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人/本企业将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。 三、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

七、业绩承诺与补偿、分期支付安排

本次交易业绩承诺与补偿安排具体内容请参见本报告书“重大事项提示”之“七、本次交易业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励”。

本次交易分期支付安排具体内容请参见本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”之“（三）本次重组支付方式”。

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

中文名称	苏州锴威特半导体股份有限公司
英文名称	Suzhou Convert Semiconductor Co., Ltd.
成立日期	2015 年 1 月 22 日
上市日期	2023 年 8 月 18 日
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	688693.SH
股票简称	锴威特
注册资本	73,684,211 元
法定代表人	罗寅
注册地址	张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室
联系电话	0512-58979950
联系传真	/
公司网站	www.convertsemi.com
统一社会信用代码	913205823237703256
经营范围	半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；软件设计、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、前十大股东情况

截至 2026 年 3 月 31 日，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	丁国华	11,198,042	15.20%
2	罗寅	9,445,671	12.82%
3	甘化科工	8,344,816	11.33%
4	港鹰实业	5,587,234	7.58%
5	港晨芯	4,545,500	6.17%
6	陈锴	4,003,350	5.43%
7	支绍环	720,035	0.98%
8	郑志钱	661,760	0.90%
9	江苏聿泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	607,327	0.82%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
10	任远	575,814	0.78%
合计		**45,689,549**	**62.01%**

三、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至本报告书签署日，上市公司控股股东为丁国华。

（二）实际控制人及其一致行动人情况

截至本报告书签署日，上市公司的实际控制人为丁国华。丁国华直接持有上市公司 15.20%的股份，丁国华通过担任港晨芯执行事务合伙人间接控制上市公司 6.17%的股份，通过与罗寅、港鹰实业、陈锴签订《一致行动人协议》控制公司 25.83%股份对应的表决权，合计控制公司 47.20%股份对应的表决权。丁国华所控制的表决权已足以对上市公司董事会、股东会决议产生重大影响，并能够实际支配公司行为。

四、最近三十六个月的控股权变动情况

截至本报告书签署日，上市公司控股股东、实际控制人为丁国华，最近三十六个月控制权未发生变更。

五、最近三年的主营业务发展情况

上市公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。上市公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，通过自主创新和技术沉淀，已同时具备功率器件和功率 IC 的设计、研发能力。在产品布局上，上市公司主要产品包含功率器件及功率 IC 两大类，同时也为部分客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务。基于上述业务的协同效应，上市公司积极推进“功率器件+功率 IC 融合”战略，针对高可靠功率电源模块及电机驱动模块应用场景，提供覆盖各功率段的系统化芯片解决方案。

最近三年，上市公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

六、主要财务数据及财务指标

上市公司 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	92,939.14	93,569.33	96,476.80	106,631.48
总负债	14,226.51	13,042.82	5,956.15	4,399.67
净资产	78,712.62	80,526.52	90,520.65	102,231.81
归属母公司股东的净资产	77,665.53	79,465.73	90,523.41	102,231.81

注：2023 年至 2025 年数据业经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	6,479.77	25,456.78	13,013.44	21,374.33
营业利润	-1,835.66	-9,850.12	-10,510.97	1,693.35
利润总额	-1,835.69	-9,849.87	-10,512.62	1,693.53
净利润	-1,816.51	-9,222.27	-9,721.68	1,779.50
归属于母公司股东的净利润	-1,801.53	-9,078.26	-9,718.93	1,779.50

注：2023 年至 2025 年数据业经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,829.90	-9,523.73	-5,167.49	-3,614.92
投资活动产生的现金流量净额	3,236.74	22,706.10	-14,968.33	-30,785.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,594.46	-2,439.03	-2,234.74	64,281.78
现金及现金等价物净增加额	1.31	10,743.20	-22,370.00	29,881.33

注：2023 年至 2025 年数据业经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计

（四）主要财务指标

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产负债率（%）	15.31	13.94	6.17	4.13

项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
毛利率（%）	32.74	32.92	35.98	45.14
基本每股收益（元/股）	-0.25	-1.24	-1.32	0.29
加权平均净资产收益率（%）	-2.29	-10.65	-10.08	3.12

注：2023年至2025年数据业经审计，2026年1-3月数据未经审计

七、最近三年的重大资产重组情况

最近三年，上市公司未发生《重组管理办法》认定的重大资产重组事项。

八、上市公司合规经营情况

截至本报告书签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

第三章 交易对方基本情况

一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

本次发行股份及支付现金购买晶艺半导体100%股权的交易对方为易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名股东，其中包括14名非自然人及12名自然人。各交易对方具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	易坤	684.49	13.68%
2	晶格共智	600.00	11.99%
3	晶格共创	225.00	4.50%
4	晶格共赢	215.00	4.30%
5	晶格顶峰	210.00	4.20%
6	晶格未来	200.00	4.00%
7	YAXU	514.72	10.29%
8	曾鸣	200.00	4.00%
9	曾岳琦	200.00	4.00%
10	晶艺求精	198.41	3.97%
11	晶艺共治	198.41	3.97%
12	李六军	173.28	3.46%
13	融芯科技	50.00	1.00%
14	曾浩	50.05	1.00%
15	凌风	50.00	1.00%
16	薛峰	40.00	0.80%
17	陈国栋	40.00	0.80%
18	苏鹏飞	20.00	0.40%
19	高鹏翼盛	465.41	9.30%
20	高鹏联盛	131.27	2.62%
21	腾元投资	59.67	1.19%
22	陈艺琴	84.04	1.68%
23	易荣坤	5.47	0.11%
24	芯联启辰	268.22	5.36%
25	华天集团	112.05	2.24%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
26	天利投资	7.29	0.15%
合计		**5,002.76**	**100.00%**

（一）易坤

1、基本情况

姓名	易坤
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	422128198112******
住所	成都市成华区******
通讯地址	成都市建业路******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

易坤最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体	2025年12月至今	董事长	是
2	晶艺半导体	2019年1月至今	总经理、董事	是
3	晶格未来	2018年8月至今	执行事务合伙人委派代表	是
4	晶格共智	2025年12月至今	普通合伙人	是
5	晶格顶峰	2020年11月至今	执行事务合伙人委派代表	是
6	晶格共赢	2021年1月至今	执行事务合伙人委派代表	是
7	晶格共创	2021年2月至今	执行事务合伙人委派代表	是
8	晶艺众合	2018年7月至今	法定代表人、总经理	是
9	成都晶格微科技有限公司	2018年9月至2023年3月23日（公司注销）	法定代表人、总经理	是
10	香港晶艺	2019年12月至2023年9月	董事	是

注：2023 年 4 月，晶艺半导体吸收合并晶格微，详情参见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）历次增减资或股权转让情况”之“5、2023 年 4 月，晶艺半导体吸收合并晶格微”。

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，易坤其他直接控制的企业和关联企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	晶格未来	200.00	晶艺半导体员工持股平台，易坤直接持有74.00%出资份额并担任执行事务合伙人委派代表	企业管理
2	晶格共智	600.00	晶艺半导体员工持股平台，易坤直接持有57.21%出资份额并担任普通合伙人	企业管理
3	晶格顶峰	210.00	晶艺半导体员工持股平台，易坤直接持有37.60%出资份额并担任执行事务合伙人委派代表	企业管理
4	晶格共赢	215.00	晶艺半导体员工持股平台，易坤直接持有13.44%出资份额并担任执行事务合伙人委派代表	企业管理
5	晶格共创	225.00	晶艺半导体员工持股平台，易坤直接持有25.10%出资份额并担任执行事务合伙人委派代表	企业管理
6	晶艺众合	14.50	晶艺半导体员工持股管理平台，担任晶格未来、晶格顶峰、晶格共赢、晶格共创的执行事务合伙人，易坤直接持有100%股份并担任法人、总经理	企业管理

（二）晶格共智

1、基本情况

企业名称	成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2383 号（自编号）
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	易坤
出资额	600 万元
统一社会信用代码	91510104MA69CMQU2N
成立时间	2021 年 4 月 16 日
营业期限	2021 年 4 月 16 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2021 年 4 月，设立

2021 年 4 月，晶格共智由普通合伙人成都晶艺众力科技有限公司（以下简称“晶艺众力”）以及有限合伙人曹红出资设立，设立时出资总额为 600 万元，晶艺众力、曹红分别认缴出资额 6 万元、594 万元。2021 年 4 月 15 日，合伙人晶艺众力、曹红签署《成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶格共智成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众力	6.00	1.00%	普通合伙人
2	曹红	594.00	99.00%	有限合伙人
合计		**600.00**	**100.00%**	--

（2）2021 年 6 月，合伙人及出资额变更

2021 年 6 月 21 日，合伙人签署《变更决定书》，合伙人由晶艺众力和曹红变更为李伊珂和易坤，其中李伊珂为普通合伙人；原有限合伙人曹红退出晶格共智，并将其所持晶格共智 594 万元的出资额转让给李伊珂；原普通合伙人晶艺众力退出晶格共智，并将其所持晶格共智 2.04 万元的出资额、3.96 万元的出资额分别转让给李伊珂、易坤；执行事务合伙人由晶艺众力变更为李伊珂。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	596.04	99.34%	普通合伙人
2	易坤	3.96	0.66%	有限合伙人
合计		**600.00**	**100.00%**	--

（3）2021 年 9 月，出资额变更

2021 年 9 月 29 日，全体合伙人签署《变更决定书》，李伊珂将其所持晶格共智的 96.04 万元出资额转让给易坤。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	500.00	83.33%	普通合伙人
2	易坤	100.00	16.67%	有限合伙人
合计		**600.00**	**100.00%**	--

（4）2023 年 7 月，合伙人及出资额变更

2023 年 7 月 12 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增吴健南、曹剑峰等 37 名有限合伙人合计认缴晶格共智 164.2179 万元出资额；有限合伙人李伊珂出资额由 500 万元减少至 335.7821 万元。

2023 年 7 月 12 日，李伊珂、易坤与 37 名新合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	335.7821	55.96%	普通合伙人
2	易坤	100.0000	16.67%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	吴健南	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
8	杨力	6.0000	1.00%	有限合伙人
9	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
10	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
11	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
12	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
13	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
14	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
15	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
16	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
17	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
18	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
19	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
20	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
21	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
22	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
23	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
24	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
25	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
26	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
27	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
28	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
31	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
32	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
33	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
34	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
35	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
36	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
37	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
38	赵树树	0.1000	0.02%	有限合伙人
39	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	

（5）2023 年 9 月，合伙人及出资额变更

2023 年 9 月 20 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人薛峰认缴晶格共智 40 万元出资额，普通合伙人李伊珂出资额由 335.7821 万元减少至 295.7821 万元。

2023 年 9 月 20 日，新合伙人薛峰与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	295.7821	49.30%	普通合伙人
2	易坤	100.0000	16.67%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
4	吴健南	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
6	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
7	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
8	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
9	杨力	6.0000	1.00%	有限合伙人
10	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
11	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
12	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
13	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
14	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
15	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
16	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
17	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
18	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
19	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
20	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
21	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
22	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
23	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
24	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
25	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
26	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
27	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
28	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
31	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
32	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
33	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
34	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
35	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
36	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
37	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
38	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
39	赵树树	0.1000	0.02%	有限合伙人
40	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（6）2023 年 10 月，合伙人及出资额变更

2023 年 10 月 17 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人杨力退出晶格共智，出资额由 6 万元减少至 0 元；普通合伙人李伊珂出资额由 295.7821 增加至 301.7821 万元。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	301.7821	50.30%	普通合伙人
2	易坤	100.0000	16.67%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	吴健南	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
6	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
7	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
8	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
9	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
10	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
11	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
12	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
13	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
14	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
15	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
16	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
17	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
18	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
19	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
20	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
21	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
22	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
23	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
24	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
25	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
26	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
27	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
28	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
31	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
32	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
33	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
34	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
35	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
36	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
37	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
38	赵树树	0.1000	0.02%	有限合伙人
39	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（7）2024 年 10 月，合伙人及出资额变更

2024 年 10 月 18 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人吴健南退出晶格共智，出资额由 40 万元减少至 0 元；普通合伙人李伊珂出资额由 301.7821 万元增加至 341.7821 万元。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	341.7821	56.96%	普通合伙人
2	易坤	100.0000	16.67%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
8	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
9	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
10	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
11	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
12	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
13	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
14	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
15	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
16	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
17	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
18	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
19	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
20	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
21	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
22	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
23	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
24	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
25	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
26	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
27	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
28	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
30	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
31	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
32	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
33	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
34	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
35	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
36	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
37	赵树树	0.1000	0.02%	有限合伙人
38	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（8）2024 年 12 月，合伙人及出资额变更

2024 年 12 月 27 日，全体合伙人签署《变更决定书》，同意新增陈志超、王志豪、车骋宇、陈昊、乔文虎、李炜、袁丕根 7 名有限合伙人，合计认缴晶格共智 13 万元出资额，普通合伙人李伊珂出资额由 341.7821 万元减少至 328.7821 万元。

2024 年 12 月 27 日，7 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	李伊珂	328.7821	54.80%	普通合伙人
2	易坤	100.0000	16.67%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
8	陈志超	7.0000	1.17%	有限合伙人
9	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
10	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
11	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
12	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
13	车骋宇	1.5000	0.25%	有限合伙人
14	陈昊	1.2000	0.20%	有限合伙人
15	乔文虎	1.0000	0.17%	有限合伙人
16	李炜	1.0000	0.17%	有限合伙人
17	袁丕根	1.0000	0.17%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
18	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
19	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
20	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
21	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
22	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
23	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
24	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
25	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
26	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
27	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
28	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
31	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
32	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
33	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
34	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
35	王志豪	0.3000	0.05%	有限合伙人
36	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
37	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
38	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
39	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
40	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
41	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
42	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
43	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
44	赵树树	0.1000	0.02%	有限合伙人
45	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（9）2025 年 12 月，合伙人及出资额变更

2025 年 12 月 22 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人赵树树、陈志超、陈昊退出晶格共智，赵树树出资额由 0.1 万元减少至 0 元，陈志超出

资额由 7 万元减少至 0 元，陈昊出资额由 1.2 万元减少至 0 元；普通合伙人李伊珂出资额由 328.7821 万元减少至 66 万元，李伊珂由普通合伙人、执行事务合伙人变更为有限合伙人；易坤由有限合伙人变更为普通合伙人、执行事务合伙人，其出资额由 100 万元增加至 371.0821 万元。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	易坤	371.0821	61.85%	普通合伙人
2	李伊珂	66.0000	11.00%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	魏荷坪	7.0000	1.17%	有限合伙人
8	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
9	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
10	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
11	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
12	车骋宇	1.5000	0.25%	有限合伙人
13	乔文虎	1.0000	0.17%	有限合伙人
14	李炜	1.0000	0.17%	有限合伙人
15	袁丕根	1.0000	0.17%	有限合伙人
16	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
17	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
18	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
19	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
20	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
21	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
22	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
23	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
24	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
25	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
26	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
27	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
28	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
29	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
31	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
32	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
33	王志豪	0.3000	0.05%	有限合伙人
34	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
35	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
36	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
37	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
38	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
39	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
40	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
41	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
42	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（10）2026 年 3 月，合伙人及出资额变更

2026 年 3 月 13 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 5 名有限合伙人，同意张旭东入伙，出资额为 3.54 万元；同意谢攀入伙，出资额 5.8 万元；同意李冬入伙，出资额 3.5 万元；同意周枭入伙，出资额 6 万元；同意郑儒富入伙，出资额 10 万元。有限合伙人魏荷坪出资额由 7 万元增至 11 万元；普通合伙人易坤出资额由 371.0821 万元减少至 338.2421 万元。

2026 年 3 月 13 日，5 名新有限合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	易坤	338.2421	56.37%	普通合伙人
2	李伊珂	66.0000	11.00%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	魏荷坪	11.0000	1.83%	有限合伙人
7	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
8	郑儒富	10.0000	1.67%	有限合伙人
9	周枭	6.0000	1.00%	有限合伙人
10	谢攀	5.8000	0.97%	有限合伙人
11	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
12	张旭东	3.5400	0.59%	有限合伙人
13	李冬	3.5000	0.58%	有限合伙人
14	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
15	谢锦红	2.0000	0.33%	有限合伙人
16	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
17	车骋宇	1.5000	0.25%	有限合伙人
18	乔文虎	1.0000	0.17%	有限合伙人
19	李炜	1.0000	0.17%	有限合伙人
20	袁丕根	1.0000	0.17%	有限合伙人
21	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
22	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
23	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
24	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
25	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
26	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
27	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
28	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
29	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
30	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
31	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
32	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
33	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
34	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
35	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
36	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
37	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
38	王志豪	0.3000	0.05%	有限合伙人
39	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
40	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
41	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
42	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
43	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
44	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
45	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
46	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
47	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（11）2026 年 6 月，合伙人及出资额变更

2026 年 6 月 26 日，全体合伙人签署《变更决定书》，同意有限合伙人魏荷坪因个人原因退出，退出后魏荷坪出资额由 11 万元减少至 0 万元；同意普通合伙人易坤出资额由 338.2421 万元增加至 341.7421 万元，有限合伙人谢锦红出资额由 2 万元增加至 4 万元；有限合伙人乔文虎出资额由 1 万元增加至 2.5 万元，有限合伙人李炜出资额由 1 万元增加至 2.5 万元，有限合伙人袁丕根出资额由 1 万元增加至 2.5 万元，有限合伙人郑儒富出资额由 10 万元增加至 11 万元。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	易坤	341.7421	56.96%	普通合伙人
2	李伊珂	66.0000	11.00%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	郑儒富	11.0000	1.83%	有限合伙人
8	周枭	6.0000	1.00%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
9	谢攀	5.8000	0.97%	有限合伙人
10	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
11	张旭东	3.5400	0.59%	有限合伙人
12	李冬	3.5000	0.58%	有限合伙人
13	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
14	谢锦红	4.0000	0.67%	有限合伙人
15	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
16	车骋宇	1.5000	0.25%	有限合伙人
17	乔文虎	2.5000	0.42%	有限合伙人
18	李炜	2.5000	0.42%	有限合伙人
19	袁丕根	2.5000	0.42%	有限合伙人
20	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
21	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
22	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
23	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
24	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
25	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
26	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
27	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
28	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
29	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
30	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
31	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
32	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
33	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
34	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
35	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
36	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
37	王志豪	0.3000	0.05%	有限合伙人
38	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
39	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
40	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
41	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
42	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
43	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
44	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
45	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
46	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

（12）2026 年 7 月，合伙人及出资额变更

2026 年 7 月，全体合伙人签署《变更决定书》，同意有限合伙人车骋宇因个人原因退出，退出后车骋宇出资额由 1.5 万元减少至 0 万元；同意普通合伙人易坤出资额由 341.7421 万元增加至 343.2421 万元。

本次变更完成后晶格共智合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	易坤	343.2421	57.21%	普通合伙人
2	李伊珂	66.0000	11.00%	有限合伙人
3	李六军	60.0000	10.00%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	6.67%	有限合伙人
5	陈国栋	20.0000	3.33%	有限合伙人
6	曹红	10.0000	1.67%	有限合伙人
7	郑儒富	11.0000	1.83%	有限合伙人
8	周枭	6.0000	1.00%	有限合伙人
9	谢攀	5.8000	0.97%	有限合伙人
10	罗君轶	4.5000	0.75%	有限合伙人
11	张旭东	3.5400	0.59%	有限合伙人
12	李冬	3.5000	0.58%	有限合伙人
13	朱赫	2.5700	0.43%	有限合伙人
14	谢锦红	4.0000	0.67%	有限合伙人
15	陈坤	1.8000	0.30%	有限合伙人
16	乔文虎	2.5000	0.42%	有限合伙人
17	李炜	2.5000	0.42%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
18	袁丕根	2.5000	0.42%	有限合伙人
19	康少硕	0.9000	0.15%	有限合伙人
20	廖先强	0.9000	0.15%	有限合伙人
21	杨艺	0.9000	0.15%	有限合伙人
22	邓涛	0.7500	0.13%	有限合伙人
23	冉滔	0.7500	0.13%	有限合伙人
24	曹剑峰	0.7479	0.12%	有限合伙人
25	谢金才	0.5000	0.08%	有限合伙人
26	张德华	0.4000	0.07%	有限合伙人
27	刘玉娇	0.3500	0.06%	有限合伙人
28	肖安静	0.3500	0.06%	有限合伙人
29	邹敏	0.3000	0.05%	有限合伙人
30	赵书琴	0.3000	0.05%	有限合伙人
31	宋鹏	0.3000	0.05%	有限合伙人
32	胡丽娜	0.3000	0.05%	有限合伙人
33	詹磊	0.3000	0.05%	有限合伙人
34	唐杨	0.3000	0.05%	有限合伙人
35	李艳秋	0.3000	0.05%	有限合伙人
36	王志豪	0.3000	0.05%	有限合伙人
37	雷雪	0.2500	0.04%	有限合伙人
38	辜巧阳	0.2500	0.04%	有限合伙人
39	李文平	0.2500	0.04%	有限合伙人
40	邓清风	0.2000	0.03%	有限合伙人
41	郭雨来	0.2000	0.03%	有限合伙人
42	唐俊菲	0.1500	0.03%	有限合伙人
43	赵巧凤	0.1000	0.02%	有限合伙人
44	廖燕	0.1000	0.02%	有限合伙人
45	郁中秋	0.1000	0.02%	有限合伙人
合计		**600.0000**	**100%**	**-**

3、主营业务情况

晶格共智为员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶格共智最近两年的主要财务数据如下：

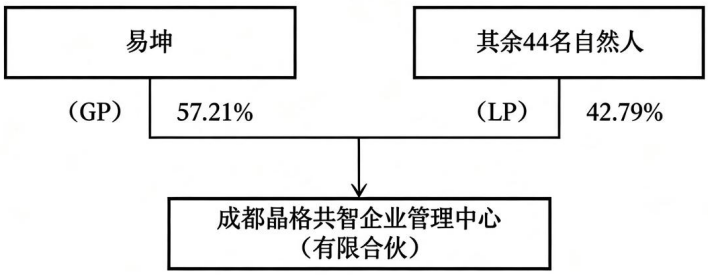
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	602.38	602.40
负债总额	7.70	7.70
净资产	594.68	594.70
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-0.02

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶格共智的执行事务合伙人及实际控制人为易坤，易坤的具体情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）易坤”。晶格共智的产权控制关系如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶格共智无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶格共智为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶格共智为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（三）晶格共创

1、基本情况

企业名称	成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2352 号（自编号）

主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	成都晶艺众合科技有限公司
出资额	225 万元
统一社会信用代码	91510104MAACFR0CX7
成立时间	2021 年 2 月 23 日
营业期限	2021 年 2 月 23 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2021 年 2 月，设立

2021 年 2 月，晶格共创由普通合伙人晶艺众合以及有限合伙人李伊珂出资设立，设立时出资总额为 225 万元，晶艺众合、李伊珂分别认缴出资额 2.25 万元、222.75 万元。2021 年 2 月 22 日，合伙人晶艺众合、李伊珂签署《成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶格共创成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.25	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	222.75	99.00%	有限合伙人
合计		**225.00**	**100.00%**	--

（2）2021 年 8 月，合伙人及出资额变更

2021 年 8 月 31 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 38 名有限合伙人，原有限合伙人李伊珂退出晶格共创，并将其所持晶格共创 222.75 万元出资额分别转让给 38 名新合伙人。

2021 年 8 月 31 日，38 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.25	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	107.33	47.70%	有限合伙人
3	周小波	7.57	3.36%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
4	赵方麟	7.42	3.30%	有限合伙人
5	彭波	6.12	2.72%	有限合伙人
6	杨斯龙	6.12	2.72%	有限合伙人
7	廖雷	5.00	2.22%	有限合伙人
8	杨方涵	4.76	2.12%	有限合伙人
9	李喆	3.96	1.76%	有限合伙人
10	吴春燕	3.90	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.77	1.68%	有限合伙人
12	江时龙	3.72	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.25	1.44%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.20	1.42%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.12	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.12	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.10	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.08	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.02	1.34%	有限合伙人
20	谢宇	2.98	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.98	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.76	1.23%	有限合伙人
23	李明军	2.60	1.16%	有限合伙人
24	张林	2.57	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.55	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.55	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.41	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.26	1.00%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.23	0.99%	有限合伙人
30	苏凤英	2.23	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.09	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.04	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.04	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.66	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.51	0.67%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
36	黄瑶	1.28	0.57%	有限合伙人
37	曲天博	0.86	0.38%	有限合伙人
38	唐鑫	0.86	0.38%	有限合伙人
39	王钰	0.73	0.32%	有限合伙人
合计		**225.00**	**100.00%**	**-**

（3）2022 年 2 月，合伙人及出资额变更

2022 年 2 月 17 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人曲天博退出晶格共创，并将其所持晶格共创 0.86 万元出资额转让给曹剑峰。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.25	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	108.19	48.08%	有限合伙人
3	周小波	7.57	3.36%	有限合伙人
4	赵方麟	7.42	3.30%	有限合伙人
5	彭波	6.12	2.72%	有限合伙人
6	杨斯龙	6.12	2.72%	有限合伙人
7	廖雷	5.00	2.22%	有限合伙人
8	杨方涵	4.76	2.12%	有限合伙人
9	李喆	3.96	1.76%	有限合伙人
10	吴春燕	3.90	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.77	1.68%	有限合伙人
12	江时龙	3.72	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.25	1.44%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.20	1.42%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.12	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.12	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.10	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.08	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.02	1.34%	有限合伙人
20	谢宇	2.98	1.32%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
21	张远军	2.98	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.76	1.23%	有限合伙人
23	李明军	2.60	1.16%	有限合伙人
24	张林	2.57	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.55	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.55	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.41	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.26	1.00%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.23	0.99%	有限合伙人
30	苏凤英	2.23	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.09	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.04	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.04	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.66	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.51	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.28	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.86	0.38%	有限合伙人
38	王钰	0.73	0.32%	有限合伙人
合计		**225.00**	**100.00%**	**-**

（4）2023 年 3 月，合伙人及出资额变更

2023 年 3 月，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人王珏退出晶格共创，并将其所持晶格共创 0.73 万元出资额转让给曹剑峰。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.25	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	108.92	48.41%	有限合伙人
3	周小波	7.57	3.36%	有限合伙人
4	赵方麟	7.42	3.30%	有限合伙人
5	彭波	6.12	2.72%	有限合伙人
6	杨斯龙	6.12	2.72%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
7	廖雷	5.00	2.22%	有限合伙人
8	杨方涵	4.76	2.12%	有限合伙人
9	李喆	3.96	1.76%	有限合伙人
10	吴春燕	3.90	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.77	1.68%	有限合伙人
12	江时龙	3.72	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.25	1.44%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.20	1.42%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.12	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.12	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.10	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.08	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.02	1.34%	有限合伙人
20	谢宇	2.98	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.98	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.76	1.23%	有限合伙人
23	李明军	2.60	1.16%	有限合伙人
24	张林	2.57	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.55	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.55	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.41	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.26	1.00%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.23	0.99%	有限合伙人
30	苏凤英	2.23	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.09	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.04	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.04	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.66	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.51	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.28	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.86	0.38%	有限合伙人
合计		**225.00**	**100.00%**	**-**

（5）2023 年 7 月，合伙人及出资额变更

2023 年 7 月 12 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 13 名有限合伙人杨童、陆文翠、乐天意、李长城、李俊海、罗皓寰、张旭东、周华东、杨静、苏鹏飞、吴刚、陈国栋、李六军；曹剑峰出资额由 108.92 万元减少至 6.2049 万元，曹剑峰将其所持晶格共创 102.7151 万元出资额转让给 13 名新有限合伙人以及杨斯龙、彭波等 13 名现有合伙人，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让比例
1	曹剑峰	杨斯龙	0.8800	0.39%
2		彭波	0.8800	0.39%
3		岳佳乐	0.1280	0.06%
4		李喆	0.1000	0.04%
5		王雪梅	0.1000	0.04%
6		廖雷	0.3000	0.13%
7		杨方涵	0.2856	0.13%
8		李金	0.1100	0.05%
9		黄晓梅	0.2700	0.12%
10		胡磊	0.1885	0.08%
11		谭漫思	0.1380	0.06%
12		李明军	0.4000	0.18%
13		李玉波	0.1000	0.04%
14		陆文翠	2.5200	1.12%
15		乐天意	1.9000	0.84%
16		杨童	2.4150	1.07%
17		李长城	2.5000	1.11%
18		李俊海	2.0000	0.89%
19		罗皓寰	1.5000	0.67%
20		张旭东	14.0000	6.22%
21		周华东	1.0000	0.44%
22		杨静	4.5000	2.00%
23		苏鹏飞	20.0000	8.89%
24		吴刚	6.5000	2.89%
25		陈国栋	20.0000	8.89%

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让比例
26		李六军	20.0000	8.89%
合 计			**102.7151**	**45.65%**

2023 年 7 月 12 日，13 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
3	周小波	7.5700	3.36%	有限合伙人
4	赵方麟	7.4200	3.30%	有限合伙人
5	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
7	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
8	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
9	李喆	4.0600	1.80%	有限合伙人
10	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
12	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.3500	1.49%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.1200	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.0800	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
20	谢宇	2.9800	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.8980	1.29%	有限合伙人
23	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
24	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
27	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
30	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
38	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
39	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
40	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
41	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
42	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
43	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
44	张旭东	14.0000	6.22%	有限合伙人
45	周华东	1.0000	0.44%	有限合伙人
46	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
47	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
48	吴刚	6.5000	2.89%	有限合伙人
49	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
50	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

（6）2024 年 3 月，合伙人及出资额变更

2024 年 3 月 20 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人李伊珂，有限合伙人周小波退出晶格共创，并将其所持晶格共创出资额 7.57 万元转让给新有限合伙人李伊珂。

2024 年 3 月 20 日，新合伙人李伊珂与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
3	李伊珂	7.5700	3.36%	有限合伙人
4	赵方麟	7.4200	3.30%	有限合伙人
5	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
7	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
8	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
9	李喆	4.0600	1.80%	有限合伙人
10	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
12	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.3500	1.49%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.1200	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.0800	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
20	谢宇	2.9800	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.8980	1.29%	有限合伙人
23	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
24	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
30	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
33	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
38	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
39	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
40	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
41	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
42	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
43	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
44	张旭东	14.0000	6.22%	有限合伙人
45	周华东	1.0000	0.44%	有限合伙人
46	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
47	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
48	吴刚	6.5000	2.89%	有限合伙人
49	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
50	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

（7）2025 年 1 月，合伙人及出资额变更

2025 年 1 月 3 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人周华东退出晶格共创，并将其所持晶格共创出资额 1 万元转让给有限合伙人李伊珂。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
3	李伊珂	8.5700	3.81%	有限合伙人
4	赵方麟	7.4200	3.30%	有限合伙人
5	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
7	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
8	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
9	李喆	4.0600	1.80%	有限合伙人
10	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
12	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
13	王雪梅	3.3500	1.49%	有限合伙人
14	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
15	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
16	王娜娜	3.1200	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.0800	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
20	谢宇	2.9800	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.8980	1.29%	有限合伙人
23	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
24	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
30	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
38	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
39	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
40	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
41	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
42	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
43	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
44	张旭东	14.0000	6.22%	有限合伙人
45	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
46	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
47	吴刚	6.5000	2.89%	有限合伙人
48	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
49	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

（8）2025 年 5 月，合伙人及出资额变更

2025 年 5 月 21 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人易坤，原有限合伙人王娜娜、张旭东、吴刚退出晶格共创，并将其所持出资额 3.12 万元、14 万元、6.5 万元转让给新合伙人易坤。

2025 年 5 月 21 日，新合伙人易坤与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	易坤	23.6200	10.50%	有限合伙人
3	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
4	李伊珂	8.5700	3.81%	有限合伙人
5	赵方麟	7.4200	3.30%	有限合伙人
6	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
7	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
8	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
9	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
10	李喆	4.0600	1.80%	有限合伙人
11	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
12	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
13	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
14	王雪梅	3.3500	1.49%	有限合伙人
15	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
16	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
17	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
18	严思敏	3.0800	1.37%	有限合伙人
19	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
20	谢宇	2.9800	1.32%	有限合伙人
21	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
22	谭漫思	2.8980	1.29%	有限合伙人
23	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
24	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
25	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
26	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
27	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
28	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
29	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
30	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
31	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
32	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
33	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
34	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
35	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
36	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
37	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
38	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
39	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
40	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
41	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
42	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
43	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
44	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
45	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
46	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
47	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

（9）2025 年 12 月，合伙人及出资额变更

2025 年 12 月 30 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人李伊珂、王雪梅、谭漫思、谢宇退出晶格共创，并将其所持出资额 8.57 万元、3.35 万元、2.898 万元、2.98 万元转让给有限合伙人易坤。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	易坤	41.4180	18.41%	有限合伙人
3	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
4	赵方麟	7.4200	3.30%	有限合伙人
5	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
7	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
8	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
9	李喆	4.0600	1.80%	有限合伙人
10	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
11	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
12	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
13	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
14	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
15	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
16	严思敏	3.0800	1.37%	有限合伙人
17	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
18	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
19	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
20	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
21	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
22	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
23	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
24	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
25	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
26	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
27	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
28	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
29	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
30	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
31	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
32	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
33	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
34	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
35	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
36	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
37	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
38	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
39	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
40	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
41	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
42	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
43	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	-

（10）2026 年 3 月，合伙人及出资额变更

2026 年 3 月，全体合伙人签署《变更决定书》，原有限合伙人李喆、严思敏、赵方麟退出晶格共创，李喆出资额由 4.06 万元减少至 0 元、严思敏出资额由 3.08 万元减少至 0 元、赵方麟出资额由 7.42 万元减少至 0 元；新增有限合伙人包涵，认缴 2 万元出资额；有限合伙人易坤出资额由 41.418 万元变更为 53.978 万元。

2026 年 3 月 18 日，新合伙人包涵与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	易坤	53.9780	23.99%	有限合伙人
3	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
4	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
5	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
7	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
8	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
9	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
10	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
11	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
12	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人
13	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
14	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
15	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
16	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
17	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
18	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
19	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
20	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
21	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
22	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
23	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
24	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
25	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
26	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
27	包涵	2.0000	0.89%	有限合伙人
28	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
29	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
30	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
31	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
32	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
33	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
34	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
35	李长城	2.5000	1.11%	有限合伙人
36	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
37	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
38	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
39	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
40	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
41	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

（11）2026 年 6 月，合伙人及出资额变更

2026 年 6 月，晶格共创全体合伙人签署《变更决定书》，同意有限合伙人李长城因个人原因退出晶格共创，退出后李长城出资额由 2.5 万元减少至 0 元；同意有限合伙人易坤出资额由 53.978 增加至 56.478 万元。

本次变更完成后晶格共创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.2500	1.00%	普通合伙人
2	易坤	56.4780	25.10%	有限合伙人
3	曹剑峰	6.2049	2.76%	有限合伙人
4	彭波	7.0000	3.11%	有限合伙人
5	杨斯龙	7.0000	3.11%	有限合伙人
6	廖雷	5.3000	2.36%	有限合伙人
7	杨方涵	5.0456	2.24%	有限合伙人
8	吴春燕	3.9000	1.73%	有限合伙人
9	胡磊	3.9585	1.76%	有限合伙人
10	江时龙	3.7200	1.65%	有限合伙人
11	岳佳乐	3.3280	1.48%	有限合伙人
12	刘晓勇	3.1200	1.39%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
13	许世松	3.1000	1.38%	有限合伙人
14	李玉波	3.1200	1.39%	有限合伙人
15	张远军	2.9800	1.32%	有限合伙人
16	李明军	3.0000	1.33%	有限合伙人
17	张林	2.5700	1.14%	有限合伙人
18	王华美	2.5500	1.13%	有限合伙人
19	杨森	2.5500	1.13%	有限合伙人
20	罗利群	2.4100	1.07%	有限合伙人
21	李金	2.3700	1.05%	有限合伙人
22	黄晓梅	2.5000	1.11%	有限合伙人
23	苏凤英	2.2300	0.99%	有限合伙人
24	周晓瑜	2.0900	0.93%	有限合伙人
25	彭万诚	2.0400	0.91%	有限合伙人
26	周艳玲	2.0400	0.91%	有限合伙人
27	包涵	2.0000	0.89%	有限合伙人
28	杨银	1.6600	0.74%	有限合伙人
29	郭瑞	1.5100	0.67%	有限合伙人
30	黄瑶	1.2800	0.57%	有限合伙人
31	唐鑫	0.8600	0.38%	有限合伙人
32	陆文翠	2.5200	1.12%	有限合伙人
33	乐天意	1.9000	0.84%	有限合伙人
34	杨童	2.4150	1.07%	有限合伙人
35	李俊海	2.0000	0.89%	有限合伙人
36	罗皓寰	1.5000	0.67%	有限合伙人
37	杨静	4.5000	2.00%	有限合伙人
38	苏鹏飞	20.0000	8.89%	有限合伙人
39	陈国栋	20.0000	8.89%	有限合伙人
40	李六军	20.0000	8.89%	有限合伙人
合计		**225.0000**	**100.00%**	**-**

3、主营业务情况

晶格共创为员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶格共创最近两年的主要财务数据如下：

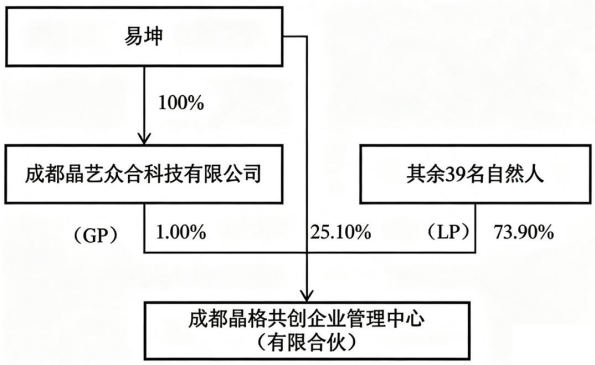
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	225.89	225.89
负债总额	6.52	6.50
净资产	219.37	219.39
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-0.02

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶格共创的执行事务合伙人为晶艺众合，晶格共创的执行事务合伙人委托代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）易坤”，晶格共创的产权控制关系如下：



易坤持有晶艺众合 100%股权，晶艺众合的基本情况如下：

企业名称	成都晶艺众合科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
主要经营场所	成都市锦江区年丰巷 52 号 1 幢 5 层 5-7 号附 155 号（自编号）
执行事务合伙人	易坤
出资额	14.50 万元
统一社会信用代码	91510104MA63AHQ159
成立时间	2018 年 7 月 16 日

营业期限	无固定期限
经营范围	计算机软硬件技术研究、技术服务、技术转让；电子产品的销售；货物进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶格共创无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶格共创为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶格共创为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、

期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（四）晶格共赢

1、基本情况

企业名称	成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2351 号（自编号）
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	成都晶艺众合科技有限公司
出资额	215 万元
统一社会信用代码	91510104MA68ETAX4G
成立时间	2021 年 2 月 23 日
营业期限	2021 年 2 月 23 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2021 年 2 月，设立

2021 年 2 月，晶格共赢由普通合伙人晶艺众合以及有限合伙人李伊珂出资设立，设立时出资总额为 215 万元，晶艺众合、李伊珂分别认缴出资额 2.15 万元、212.85 万元。2021 年 2 月 22 日，合伙人晶艺众合、李伊珂签署《成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶格共赢成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	认缴出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	212.8500	99.00%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	认缴出资比例	合伙人类型
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（2）2021 年 8 月，合伙人及出资额变更

2021 年 8 月 30 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 16 名有限合伙人，李伊珂退出晶格共赢，并将其所持晶格共赢 212.85 万元出资额分别转让给 16 名新合伙人。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让比例
1	李伊珂	曹剑峰	51.0400	23.74%
2		喻尊	15.0000	6.98%
3		曾亮	15.0000	6.98%
4		王兴蔚	14.9900	6.97%
5		李涅	14.8000	6.88%
6		万亮	14.0000	6.51%
7		张桂蓉	13.8000	6.42%
8		唐锐	12.7800	5.94%
9		李建明	10.9600	5.10%
10		包涵	9.9200	4.61%
11		赵怡	8.7900	4.09%
12		汤川洋	8.3500	3.88%
13		张旭东	7.4600	3.47%
14		李莉双	6.0000	2.79%
15		谢攀	5.2000	2.42%
16		李冬	4.7600	2.21%
合计			**212.8500**	**98.89%**

2021 年 8 月 30 日，16 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	认缴出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	51.0400	23.74%	有限合伙人
3	喻尊	15.0000	6.98%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	认缴出资比例	合伙人类型
4	曾亮	15.0000	6.98%	有限合伙人
5	王兴蔚	14.9900	6.97%	有限合伙人
6	李涅	14.8000	6.88%	有限合伙人
7	万亮	14.0000	6.51%	有限合伙人
8	张桂蓉	13.8000	6.42%	有限合伙人
9	唐锐	12.7800	5.94%	有限合伙人
10	李建明	10.9600	5.10%	有限合伙人
11	包涵	9.9200	4.61%	有限合伙人
12	赵怡	8.7900	4.09%	有限合伙人
13	汤川洋	8.3500	3.88%	有限合伙人
14	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
15	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人
16	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
17	李冬	4.7600	2.21%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（3）2021 年 12 月，合伙人及出资额变更

2021 年 12 月 27 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人吴杰，有限合伙人曹剑峰将其所持晶格共赢的出资额 14 万元转让给吴杰。

2021 年 12 月 27 日，新合伙人吴杰与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	37.0400	17.23%	有限合伙人
3	喻尊	15.0000	6.98%	有限合伙人
4	曾亮	15.0000	6.98%	有限合伙人
5	吴杰	14.0000	6.51%	有限合伙人
6	王兴蔚	14.9900	6.97%	有限合伙人
7	李涅	14.8000	6.88%	有限合伙人
8	万亮	14.0000	6.51%	有限合伙人
9	张桂蓉	13.8000	6.42%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
10	唐锐	12.7800	5.94%	有限合伙人
11	李建明	10.9600	5.10%	有限合伙人
12	包涵	9.9200	4.61%	有限合伙人
13	赵怡	8.7900	4.09%	有限合伙人
14	汤川洋	8.3500	3.88%	有限合伙人
15	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
16	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人
17	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
18	李冬	4.7600	2.21%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（4）2022 年 8 月，合伙人及出资额变更

2022 年 8 月 2 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人曾亮退出晶格共赢，并将其所持晶格共赢 15 万元出资额转让给曹剑峰。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	曹剑峰	52.0400	24.20%	有限合伙人
3	喻尊	15.0000	6.98%	有限合伙人
4	吴杰	14.0000	6.51%	有限合伙人
5	王兴蔚	14.9900	6.97%	有限合伙人
6	李涅	14.8000	6.88%	有限合伙人
7	万亮	14.0000	6.51%	有限合伙人
8	张桂蓉	13.8000	6.42%	有限合伙人
9	唐锐	12.7800	5.94%	有限合伙人
10	李建明	10.9600	5.10%	有限合伙人
11	包涵	9.9200	4.61%	有限合伙人
12	赵怡	8.7900	4.09%	有限合伙人
13	汤川洋	8.3500	3.88%	有限合伙人
14	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
15	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
16	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
17	李冬	4.7600	2.21%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（5）2023 年 7 月，合伙人及出资额变更

2023 年 7 月 12 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 9 名有限合伙人，曹剑峰出资额由 52.04 万元减少至 1.5472 万元，曹剑峰将其所持晶格共赢的 50.4928 万元出资额转让给 9 名新有限合伙人及 11 名现有合伙人。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让比例
1	曹剑峰	李涅	1.1840	0.55%
2		喻尊	1.3000	0.60%
3		张桂蓉	1.1040	0.51%
4		唐锐	1.0224	0.48%
5		王兴蔚	1.1992	0.56%
6		李建明	1.5000	0.70%
7		包涵	3.5800	1.67%
8		汤川洋	0.5000	0.23%
9		赵怡	0.7032	0.33%
10		万亮	1.5000	0.70%
11		李冬	0.7400	0.34%
12		韩晓波	5.0000	2.33%
13		周枭	5.0000	2.33%
14		周强	1.3000	0.60%
15		杨晓霞	0.8300	0.39%
16		崔涛	0.8300	0.39%
17		何倩	1.0000	0.47%
18		陈星朋	1.3000	0.60%
19		陈锐	0.9000	0.42%
20		李六军	20.0000	9.30%
合 计			**50.4928**	**23.49%**

2023 年 7 月，9 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	李六军	20.0000	9.30%	有限合伙人
3	喻尊	16.3000	7.58%	有限合伙人
4	王兴蔚	16.1892	7.53%	有限合伙人
5	李涅	15.9840	7.43%	有限合伙人
6	万亮	15.5000	7.21%	有限合伙人
7	张桂蓉	14.9040	6.93%	有限合伙人
8	吴杰	14.0000	6.51%	有限合伙人
9	唐锐	13.8024	6.42%	有限合伙人
10	包涵	13.5000	6.28%	有限合伙人
11	李建明	12.4600	5.80%	有限合伙人
12	赵怡	9.4932	4.42%	有限合伙人
13	汤川洋	8.8500	4.12%	有限合伙人
14	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
15	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人
16	李冬	5.5000	2.56%	有限合伙人
17	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
18	韩晓波	5.0000	2.33%	有限合伙人
19	周枭	5.0000	2.33%	有限合伙人
20	曹剑峰	1.5472	0.72%	有限合伙人
21	周强	1.3000	0.60%	有限合伙人
22	陈星朋	1.3000	0.60%	有限合伙人
23	何倩	1.0000	0.47%	有限合伙人
24	陈锐	0.9000	0.42%	有限合伙人
25	杨晓霞	0.8300	0.39%	有限合伙人
26	崔涛	0.8300	0.39%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（6）2023 年 9 月，合伙人及出资额变更

2023 年 9 月 14 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人王倩，

曹剑峰将其所持晶格共赢 0.9 万元出资额转让给王倩。

2023 年 9 月 14 日，新合伙人王倩与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	李六军	20.0000	9.30%	有限合伙人
3	喻尊	16.3000	7.58%	有限合伙人
4	王兴蔚	16.1892	7.53%	有限合伙人
5	李涅	15.9840	7.43%	有限合伙人
6	万亮	15.5000	7.21%	有限合伙人
7	张桂蓉	14.9040	6.93%	有限合伙人
8	吴杰	14.0000	6.51%	有限合伙人
9	唐锐	13.8024	6.42%	有限合伙人
10	包涵	13.5000	6.28%	有限合伙人
11	李建明	12.4600	5.80%	有限合伙人
12	赵怡	9.4932	4.42%	有限合伙人
13	汤川洋	8.8500	4.12%	有限合伙人
14	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
15	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人
16	李冬	5.5000	2.56%	有限合伙人
17	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
18	韩晓波	5.0000	2.33%	有限合伙人
19	周枭	5.0000	2.33%	有限合伙人
20	周强	1.3000	0.60%	有限合伙人
21	陈星朋	1.3000	0.60%	有限合伙人
22	何倩	1.0000	0.47%	有限合伙人
23	陈锐	0.9000	0.42%	有限合伙人
24	王倩	0.9000	0.42%	有限合伙人
25	曹剑峰	0.6472	0.30%	有限合伙人
26	杨晓霞	0.8300	0.39%	有限合伙人
27	崔涛	0.8300	0.39%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

（7）2026 年 3 月，合伙人及出资额变更

2026 年 3 月，全体合伙人签署《变更决定书》，新增有限合伙人易坤；有限合伙人吴杰、李涅、王兴蔚、汤川洋、万亮、张桂蓉退出晶格共赢，并将其所持晶格共赢的出资额转让给原合伙人李六军及新合伙人易坤。

2026 年 3 月，新合伙人易坤与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后，晶格共赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1500	1.00%	普通合伙人
2	李六军	76.5232	35.59%	有限合伙人
3	易坤	28.9040	13.44%	有限合伙人
4	喻尊	16.3000	7.58%	有限合伙人
5	唐锐	13.8024	6.42%	有限合伙人
6	包涵	13.5000	6.28%	有限合伙人
7	李建明	12.4600	5.80%	有限合伙人
8	赵怡	9.4932	4.42%	有限合伙人
9	张旭东	7.4600	3.47%	有限合伙人
10	李莉双	6.0000	2.79%	有限合伙人
11	李冬	5.5000	2.56%	有限合伙人
12	谢攀	5.2000	2.42%	有限合伙人
13	韩晓波	5.0000	2.33%	有限合伙人
14	周枭	5.0000	2.33%	有限合伙人
15	周强	1.3000	0.60%	有限合伙人
16	陈星朋	1.3000	0.60%	有限合伙人
17	何倩	1.0000	0.47%	有限合伙人
18	陈锐	0.9000	0.42%	有限合伙人
19	王倩	0.9000	0.42%	有限合伙人
20	杨晓霞	0.8300	0.39%	有限合伙人
21	崔涛	0.8300	0.39%	有限合伙人
22	曹剑峰	0.6472	0.30%	有限合伙人
合计		**215.0000**	**100.00%**	--

3、主营业务情况

晶格共赢为员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶格共赢最近两年的主要财务数据如下：

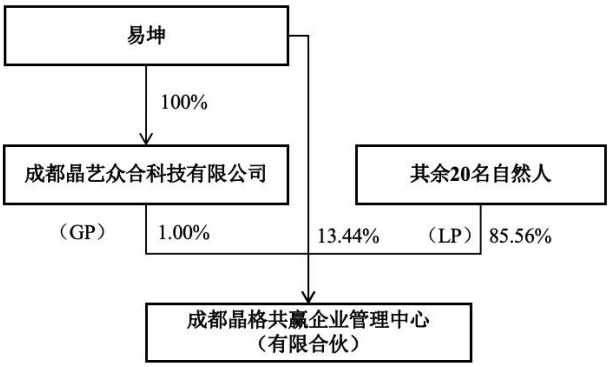
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	216.04	216.04
负债总额	6.72	6.70
净资产	209.32	209.34
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-0.02

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶格共赢的执行事务合伙人为晶艺众合，晶格共赢的执行事务合伙人委托代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）易坤”，晶格共赢的执行事务合伙人情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（三）晶格共创”之“5、产权及控制关系、股东基本情况”，晶格共赢的产权控制关系如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶格共赢无其他

对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶格共赢为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶格共赢为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责

任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（五）晶格顶峰

1、基本情况

企业名称	成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2261 号
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	成都晶艺众合科技有限公司
出资额	210 万元
统一社会信用代码	91510104MAAFAETB64
成立时间	2020 年 11 月 18 日
营业期限	2020 年 11 月 18 日至 2070 年 11 月 17 日
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术咨询服务（不含培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2020 年 11 月，设立

2020 年 11 月，晶格顶峰由普通合伙人晶艺众合以及有限合伙人李伊珂出资设立，设立时出资总额为 350 万元，晶艺众合、李伊珂分别认缴出资额 3.5 万元、346.5 万元。2020 年 11 月 18 日，合伙人晶艺众合、李伊珂签署《成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶格顶峰成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	3.50	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	346.50	99.00%	有限合伙人
合计		**350.00**	**100.00%**	--

（2）2021 年 6 月，出资额变更

2021 年 6 月 18 日，全体合伙人签署《变更决定书》，同意晶格顶峰的注册资本由 350 万元减少至 210 万元，普通合伙人晶艺众合出资额由 3.5 万元减少至 2.1 万元，有限合伙人李伊珂出资额由 346.5 万元减少至 207.9 万元。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.10	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	207.90	99.00%	有限合伙人
合计		**210.00**	**100.00%**	--

（3）2023 年 12 月，合伙人及出资额变更

2023 年 12 月 20 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增 34 名有限合伙人，原有限合伙人李伊珂出资额由 207.9 万元减少至 33.5590 万元，李伊珂将其所持晶格顶峰 174.341 万元出资额转让给新合伙人。

2023 年 12 月 20 日，34 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
3	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
4	李伊珂	33.5590	15.98%	有限合伙人
5	易坤	27.2410	12.97%	有限合伙人
6	郭海金	11.0000	5.24%	有限合伙人
7	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
8	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
9	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
10	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
11	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
12	艾虹娇	3.0000	1.43%	有限合伙人
13	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
14	董发文	1.7000	0.81%	有限合伙人
15	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
16	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
17	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
18	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
19	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
20	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
21	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
22	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
23	杨叶	0.5500	0.26%	有限合伙人
24	陈永志	0.5500	0.26%	有限合伙人
25	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
26	高艳梅	0.5500	0.26%	有限合伙人
27	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
28	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
29	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
30	邢万里	0.5000	0.24%	有限合伙人
31	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
32	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
33	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
34	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
35	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
36	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（4）2024 年 4 月，合伙人及出资额变更

2024 年 4 月 9 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人董发文退出晶格顶峰，并将其所持晶格顶峰的 1.7 万元出资额转让给李伊珂。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
3	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
4	李伊珂	35.2590	16.79%	有限合伙人
5	易坤	27.2410	12.97%	有限合伙人
6	郭海金	11.0000	5.24%	有限合伙人
7	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
8	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
9	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
10	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
11	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
12	艾虹娇	3.0000	1.43%	有限合伙人
13	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
14	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
15	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
16	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
17	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
18	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
19	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
20	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
21	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
22	杨叶	0.5500	0.26%	有限合伙人
23	陈永志	0.5500	0.26%	有限合伙人
24	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
25	高艳梅	0.5500	0.26%	有限合伙人
26	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
27	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
28	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
29	邢万里	0.5000	0.24%	有限合伙人
30	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
31	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
32	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
33	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
34	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
35	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（5）2024 年 6 月，合伙人及出资额变更

2024 年 6 月 24 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人郭海金退出晶格顶峰，并将其所持晶格顶峰 11 万元出资额转让给李伊珂。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
3	李伊珂	46.2590	22.03%	有限合伙人
4	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
5	易坤	27.2410	12.97%	有限合伙人
6	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
7	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
8	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
9	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
10	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
11	艾虹娇	3.0000	1.43%	有限合伙人
12	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
13	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
14	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
15	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
16	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
17	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
18	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
19	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
20	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
21	杨叶	0.5500	0.26%	有限合伙人
22	陈永志	0.5500	0.26%	有限合伙人
23	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
24	高艳梅	0.5500	0.26%	有限合伙人
25	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
26	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
27	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
28	邢万里	0.5000	0.24%	有限合伙人
29	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
30	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
31	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
32	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
33	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
34	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（6）2024 年 12 月，合伙人及出资额变更

2024 年 12 月 27 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增罗嘉宏、陈旺平、颜祺源、邓洪伟四名有限合伙人；原有限合伙人邢万里退出晶格顶峰，其出资额由 0.5 万元减少至 0 元；李伊珂出资额由 46.259 万元减少至 42.759 万元。

2024 年 12 月 27 日，4 名新合伙人与现有合伙人签署《入伙协议》。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	42.7590	20.36%	有限合伙人
3	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
4	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
5	易坤	27.2410	12.97%	有限合伙人
6	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
7	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
8	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
9	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
10	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
11	艾虹娇	3.0000	1.43%	有限合伙人
12	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
13	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
14	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
15	罗嘉宏	1.0000	0.48%	有限合伙人
16	陈旺平	1.0000	0.48%	有限合伙人
17	颜祺源	1.0000	0.48%	有限合伙人
18	邓洪伟	1.0000	0.48%	有限合伙人
19	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
20	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
21	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
22	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
23	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
24	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
25	杨叶	0.5500	0.26%	有限合伙人
26	陈永志	0.5500	0.26%	有限合伙人
27	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
28	高艳梅	0.5500	0.26%	有限合伙人
29	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
30	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
31	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
32	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
33	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
34	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
35	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
36	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
37	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（7）2025 年 5 月，合伙人及出资额变更

2025 年 5 月 21 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人艾虹娇、罗嘉宏、颜祺源退出晶格顶峰，并将其所持出资额转让给易坤。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	42.7590	20.36%	有限合伙人
3	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
4	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
5	易坤	32.2410	15.35%	有限合伙人
6	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
7	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
8	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
9	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
10	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
11	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
12	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
13	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
14	陈旺平	1.0000	0.48%	有限合伙人
15	邓洪伟	1.0000	0.48%	有限合伙人
16	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
17	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
18	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
19	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
20	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
21	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
22	杨叶	0.5500	0.26%	有限合伙人
23	陈永志	0.5500	0.26%	有限合伙人
24	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
25	高艳梅	0.5500	0.26%	有限合伙人
26	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
27	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
28	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
29	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
30	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
31	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
32	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
33	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
34	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（8）2025 年 12 月，合伙人及出资额变更

2025 年 12 月 30 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人李伊珂、杨叶、陈永志、高艳梅退出晶格顶峰，并将其所持出资额 42.759 万元、0.55 万

元、0.55 万元、0.55 万元转让给有限合伙人易坤。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	易坤	76.6500	36.50%	有限合伙人
3	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
4	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
5	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
6	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
7	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
8	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
9	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
10	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
11	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
12	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
13	陈旺平	1.0000	0.48%	有限合伙人
14	邓洪伟	1.0000	0.48%	有限合伙人
15	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
16	张爱博	0.8000	0.38%	有限合伙人
17	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
18	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
19	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
20	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
21	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
22	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
23	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
24	王宜文	0.5000	0.24%	有限合伙人
25	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
26	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
27	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
28	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
29	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
30	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（9）2026 年 3 月，合伙人及出资额变更

2026 年 3 月 18 日，全体合伙人签署《变更决定书》，有限合伙人王宜文、张爱博退出晶格顶峰，并将其所持晶格顶峰 0.5 万元出资额、0.8 万元出资额转让给易坤。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	易坤	77.9500	37.12%	有限合伙人
3	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
4	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
5	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
6	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
7	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
8	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
9	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
10	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
11	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
12	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人
13	陈旺平	1.0000	0.48%	有限合伙人
14	邓洪伟	1.0000	0.48%	有限合伙人
15	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
16	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
17	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
18	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
19	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
20	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
21	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
22	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
23	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
24	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
25	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
26	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
27	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
28	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

（10）2026 年 6 月，合伙人及出资额变更

2026 年 6 月，全体合伙人签署《变更决定书》，同意有限合伙人陈旺平、邓洪伟退出晶格顶峰，退出后陈旺平出资额由 1 万元减少至 0 元，邓洪伟出资额由 1 万元减少至 0 元；同意韩晓波加入合伙，出资额为 1 万元；同意有限合伙人易坤出资额由 77.95 万元增加至 78.95 万元。

本次变更完成后晶格顶峰合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.1000	1.00%	普通合伙人
2	易坤	78.9500	37.60%	有限合伙人
3	李六军	34.8000	16.57%	有限合伙人
4	薛峰	40.0000	19.05%	有限合伙人
5	苏鹏飞	5.0000	2.38%	有限合伙人
6	张斌	10.0000	4.76%	有限合伙人
7	李铭驹	10.0000	4.76%	有限合伙人
8	徐勇	8.5000	4.05%	有限合伙人
9	刘烁	7.5000	3.57%	有限合伙人
10	魏超	0.5000	0.24%	有限合伙人
11	许江华	0.7500	0.36%	有限合伙人
12	张德华	0.4000	0.19%	有限合伙人
13	郁中秋	0.7000	0.33%	有限合伙人
14	李翠	0.8000	0.38%	有限合伙人
15	陈玉曦	0.3000	0.14%	有限合伙人
16	高鹏杰	2.0000	0.95%	有限合伙人
17	李祖勇	1.3000	0.62%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
18	王梦瑶	0.3000	0.14%	有限合伙人
19	孙载略	0.5500	0.26%	有限合伙人
20	刁希森	0.5500	0.26%	有限合伙人
21	杨述添	0.3000	0.14%	有限合伙人
22	伊嘉爽	0.3000	0.14%	有限合伙人
23	阳静	0.5000	0.24%	有限合伙人
24	江威	0.8000	0.38%	有限合伙人
25	罗茂林	0.6000	0.29%	有限合伙人
26	于海伟	1.5000	0.71%	有限合伙人
27	韩晓波	1.0000	0.48%	有限合伙人
合计		**210.0000**	**100.00%**	--

3、主营业务情况

晶格顶峰为员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶格顶峰最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

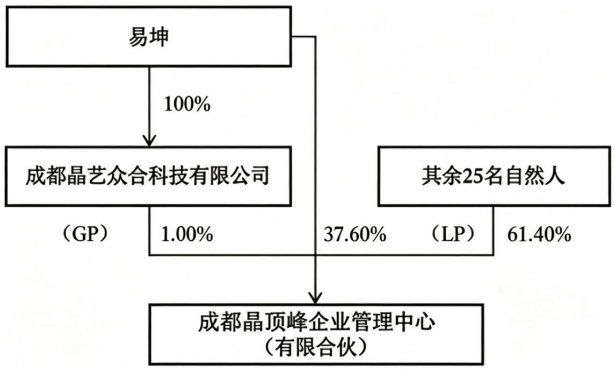
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	212.30	212.30
负债总额	8.52	8.50
净资产	203.78	203.80
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-0.02

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶格顶峰的执行事务合伙人为晶艺众合，晶格顶峰的执行事务合伙人委托代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）易坤”，晶格顶峰的执行事务合伙人情况请参见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”

之“（三）晶格共创”之“5、产权及控制关系、股东基本情况”，晶格顶峰的产权控制关系如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶格顶峰无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶格顶峰为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶格顶峰为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有

不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（六）晶格未来

1、基本情况

企业名称	成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 933 号（自编号）
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	成都晶艺众合科技有限公司
出资额	200 万元
统一社会信用代码	91510104MA67ABLX25
成立时间	2018 年 8 月 8 日
营业期限	2018 年 8 月 8 日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术咨询服务（不含培训）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018 年 8 月，设立

2018 年 8 月，晶格未来由普通合伙人晶艺众合以及有限合伙人李伊珂出资设立，设立时出资总额为 1,450 万元，晶艺众合、李伊珂分别认缴出资额 14.5 万元、1,435.5 万元。2018 年 8 月 7 日，合伙人晶艺众合、李伊珂签署《成都晶

格未来企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶格未来成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	14.50	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	1,435.50	99.00%	有限合伙人
合计		**1,450.00**	**100.00%**	--

（2）2021 年 6 月，合伙人及出资额变更

2021 年 6 月 18 日，全体合伙人签署《变更决定书》，晶格未来的出资额由 1,450 万元减少至 200 万元，有限合伙人李伊珂出资额由 1,435.5 万元减少至 198 万元，普通合伙人晶艺众合出资额由 14.5 万元减少至 2 万元。

本次变更完成后晶格未来合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.00	1.00%	普通合伙人
2	李伊珂	198.00	99.00%	有限合伙人
合计		**200.00**	**100.00%**	--

（3）2021 年 11 月，合伙人及出资额变更

2021 年 11 月 22 日，全体合伙人签署《变更决定书》，新增易坤、凌风两名有限合伙人；有限合伙人李伊珂退出晶格未来，并将其所持晶格未来的出资额 198 万元分别转让给易坤、凌风。

本次变更完成后晶格未来合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	晶艺众合	2.00	1.00%	普通合伙人
2	易坤	148.00	74.00%	有限合伙人
3	凌风	50.00	25.00%	有限合伙人
合计		**200.00**	**100.00%**	--

3、主营业务情况

晶格未来为员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶格未来最近两年的主要财务数据如下：

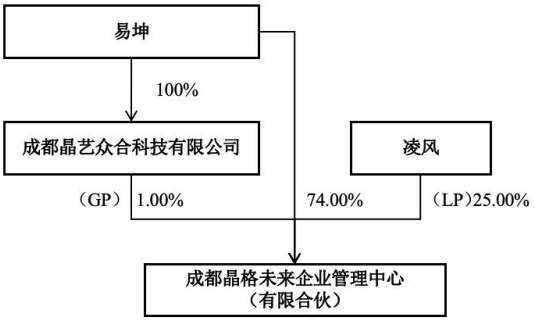
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	202.39	202.45
负债总额	14.68	14.66
净资产	187.71	187.79
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	-0.08	-0.07

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶格未来的执行事务合伙人为晶艺众合，晶格未来的执行事务合伙人委托代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本章“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）易坤”，晶格未来的执行事务合伙人情况参见本章“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（三）晶格共创”之“5、产权及控制关系、股东基本情况”，实际控制人为易坤，晶格未来的产权控制关系如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶格未来无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶格未来为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情

形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶格未来为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（七）YA XU

1、基本情况

姓名	YA XU
曾用名	许亚
性别	女
国籍	加拿大
护照号码	AG91****
住所	******, AB T3A 5R5, Canada
通讯地址	******, AB T3A 5R5, Canada
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

YA XU 最近三年无任职的企业。

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，YA XU 无其他对外投资企业。

（八）曾鸣

1、基本情况

姓名	曾鸣
曾用名	无
性别	男
国籍	中国澳门
通行证号码	M3008****
住所	****, Kingsville, Taipa, Macau
通讯地址	****, Kingsville, Taipa, Macau
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

曾鸣最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	医渡科技有限公司 Yidu Tech Inc（02158.HK）	2021年6月-至今	非执行董事	是

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，曾鸣其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）	1,146,025.42	直接持有 0.25%合伙份额	股权投资及咨询服务
2	北京今创君联投资管理中心（有限合伙）	716.20	直接持有 7.00%合伙份额	资产管理；投资咨询
3	上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	129,870.00	直接持有 0.77%合伙份额	创业投资，实业投资

（九）曾岳琦

1、基本情况

姓名	曾岳琦
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	360102200106******
住所	北京市朝阳区******
通讯地址	上海市黄浦区******
是否取得其他国家或地区的居留权	是，美国

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

曾岳琦最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	浙江清越科技有限公司	2021年10月-2024年1月	董事	是

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，曾岳琦其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	长兴清露智能科技合伙企业（有限合伙）	60.00	直接持有 42.84%合伙份额	工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售
2	深圳市茶生活文化产业有限公司	828.95	直接持有 1.88%股权	经营电子商务、投资兴办实业
3	北京为无和他的朋友们投资管理中心（有限合伙）	194.92	直接持有 7.07%股权	投资管理、资产管理
4	安义承树七期医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	11,415.00	直接持有 35.04%合伙份额	医疗产业投资，股权投资，创业投资

（十）晶艺求精

1、基本情况

企业名称	成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区银木街 675 号 2 栋 22 层 2214 号
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	喻尊
出资额	1,500.000012 万元
统一社会信用代码	91510104MAK7RDGL6L
成立时间	2026 年 2 月 28 日
营业期限	2026 年 2 月 28 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2026 年 2 月，设立

2026 年 2 月，晶艺求精由普通合伙人喻尊以及 24 名有限合伙人出资设立，设立时出资总额为 1,500.000012 万元。2026 年 2 月，普通合伙人喻尊及 24 名有限合伙人签署《成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶艺求精成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	喻尊	151.200000	10.08%	普通合伙人
2	郑儒富	290.000088	19.33%	有限合伙人
3	李铭驹	180.000576	12.00%	有限合伙人
4	李冬	151.200000	10.08%	有限合伙人
5	周枭	128.520000	8.57%	有限合伙人
6	李建明	100.018800	6.67%	有限合伙人
7	赵怡	80.136000	5.34%	有限合伙人
8	刘玉娇	50.000328	3.33%	有限合伙人
9	廖雷	35.002800	2.33%	有限合伙人
10	周宗辉	35.001288	2.33%	有限合伙人
11	李六军	30.276288	2.02%	有限合伙人
12	李金	30.000348	2.00%	有限合伙人
13	曹剑峰	22.680000	1.51%	有限合伙人
14	包涵	22.680000	1.51%	有限合伙人
15	朱赫	22.680000	1.51%	有限合伙人
16	杨斯龙	20.000736	1.33%	有限合伙人
17	廖先强	20.000736	1.33%	有限合伙人
18	张旭东	20.000736	1.33%	有限合伙人
19	黄瑶	20.000736	1.33%	有限合伙人
20	杨婷婷	15.120000	1.01%	有限合伙人
21	杨静	15.120000	1.01%	有限合伙人
22	于海伟	15.120000	1.01%	有限合伙人
23	张林	15.120000	1.01%	有限合伙人
24	许世松	15.120000	1.01%	有限合伙人
25	胡丽娜	15.000552	1.00%	有限合伙人
合计		**1,500.000012**	**100.00%**	--

（2）2026 年 6 月，合伙人及出资额变更

2026 年 6 月，晶艺求精完成合伙人变更，有限合伙人周宗辉变更为周重甫，出资额为 35.001288 万元。

本次变更完成后晶艺求精合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	喻尊	151.200000	10.08%	普通合伙人
2	郑儒富	290.000088	19.33%	有限合伙人
3	李铭驹	180.000576	12.00%	有限合伙人
4	李冬	151.200000	10.08%	有限合伙人
5	周枭	128.520000	8.57%	有限合伙人
6	李建明	100.018800	6.67%	有限合伙人
7	赵怡	80.136000	5.34%	有限合伙人
8	刘玉娇	50.000328	3.33%	有限合伙人
9	廖雷	35.002800	2.33%	有限合伙人
10	周重甫	35.001288	2.33%	有限合伙人
11	李六军	30.276288	2.02%	有限合伙人
12	李金	30.000348	2.00%	有限合伙人
13	曹剑峰	22.680000	1.51%	有限合伙人
14	包涵	22.680000	1.51%	有限合伙人
15	朱赫	22.680000	1.51%	有限合伙人
16	杨斯龙	20.000736	1.33%	有限合伙人
17	廖先强	20.000736	1.33%	有限合伙人
18	张旭东	20.000736	1.33%	有限合伙人
19	黄瑶	20.000736	1.33%	有限合伙人
20	杨婷婷	15.120000	1.01%	有限合伙人
21	杨静	15.120000	1.01%	有限合伙人
22	于海伟	15.120000	1.01%	有限合伙人
23	张林	15.120000	1.01%	有限合伙人
24	许世松	15.120000	1.01%	有限合伙人
25	胡丽娜	15.000552	1.00%	有限合伙人
合计		**1,500.000012**	**100.00%**	--

3、主营业务情况

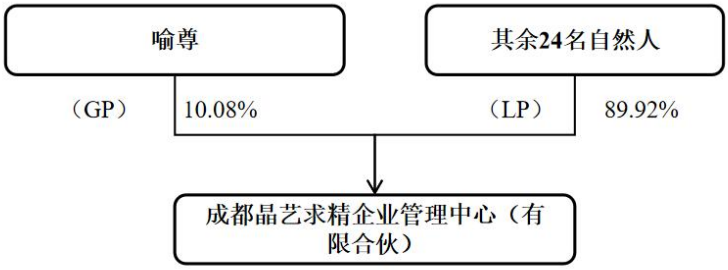
晶艺求精为员工持股平台，于 2026 年 2 月设立，自设立以来主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶艺求精于 2026 年 2 月设立，无最近两年简要财务报表。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶艺求精的执行事务合伙人及实际控制人为喻尊，晶艺求精的产权控制关系如下：



晶艺求精执行事务合伙人喻尊的基本情况如下：

姓名	喻尊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	360426198310******
住所	成都市武侯区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶艺求精无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶艺求精为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶艺求精为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（十一）晶艺共治

1、基本情况

企业名称	成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	四川省成都市锦江区经天路 1 号 1 栋 25 楼 4 号
主要办公地点	四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
执行事务合伙人	唐锐
出资额	1,500.000012 万元
统一社会信用代码	91510104MAK78R226M
成立时间	2026 年 2 月 28 日

营业期限	2026 年 2 月 28 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2026 年 2 月，晶艺共治由普通合伙人唐锐以及 25 名有限合伙人出资设立，设立时出资总额为 1,500.000012 万元。2026 年 2 月，普通合伙人唐锐及 25 名有限合伙人签署《成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）合伙协议》。晶艺共治成立时的合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	唐锐	80.1360000	5.34%	普通合伙人
2	徐勇	200.000556	13.33%	有限合伙人
3	周宗辉	180.000576	12.00%	有限合伙人
4	张斌	151.200000	10.08%	有限合伙人
5	黄晓梅	150.000228	10.00%	有限合伙人
6	刘烁	113.400000	7.56%	有限合伙人
7	许江华	100.000656	6.67%	有限合伙人
8	李明军	100.000656	6.67%	有限合伙人
9	江时龙	50.000328	3.33%	有限合伙人
10	李佩遥	45.360000	3.02%	有限合伙人
11	彭波	35.001288	2.33%	有限合伙人
12	林秦仪	30.240000	2.02%	有限合伙人
13	胡磊	25.000920	1.67%	有限合伙人
14	李六军	23.164596	1.54%	有限合伙人
15	陆文翠	22.680000	1.51%	有限合伙人
16	吴春燕	22.680000	1.51%	有限合伙人
17	张德华	20.412000	1.36%	有限合伙人
18	肖安静	20.000736	1.33%	有限合伙人
19	谢攀	20.000736	1.33%	有限合伙人
20	谢金才	20.000736	1.33%	有限合伙人
21	唐杨	15.120000	1.01%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
22	苏凤英	15.120000	1.01%	有限合伙人
23	魏超	15.120000	1.01%	有限合伙人
24	江威	15.120000	1.01%	有限合伙人
25	罗君轶	15.120000	1.01%	有限合伙人
26	罗利群	15.120000	1.01%	有限合伙人
合计		**1,500.000012**	**100.00%**	--

3、主营业务情况

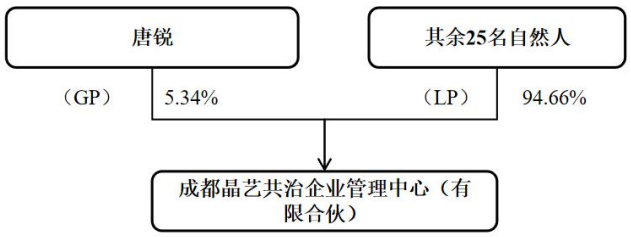
晶艺共治为员工持股平台，为员工持股平台，于 2026 年 2 月设立，自设立以来主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

晶艺共治于 2026 年 2 月设立，无最近两年简要财务报表。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至本报告书签署日，晶艺共治的执行事务合伙人及实际控制人为唐锐，晶艺共治的产权控制关系如下：



晶艺共治执行事务合伙人唐锐的基本情况如下：

姓名	唐锐
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	510121198709******
住所	四川省成都市双流区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，晶艺共治无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

晶艺共治为员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，晶艺共治为标的公司员工持股平台，上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益均进行了穿透锁定。并出具了《关于所持上市公司股份穿透锁定的承诺函》：

“一、在成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）承诺的锁定期内，本人根据全体合伙人决议确定的本人通过本次交易间接持有的上市公司股份对应的合伙份额，本人承诺不会以任何方式进行转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、根据本人与标的公司股权激励相关管理制度/协议约定，本人有义务转让持有的合伙企业财产份额的，不受前述第一项限制。如发生前述转让情形的，本人所持合伙企业财产份额的受让方应继续遵守本承诺函承诺的锁定期的要求。

三、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

四、本人承诺对本人所直接/间接持有标的公司股权权属清晰，本人向合伙企业实缴出资及/或向转让方支付的对价均来自于本人自有或自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。本人所持合伙企业财产份额的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利。

五、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（十二）李六军

1、基本情况

姓名	李六军
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	511121197205******
住所	广东省深圳市南山区******
通讯地址	四川省成都市双流区******
是否取得其他国家或地区的居留权	是，美国

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

李六军最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体有限公司	2023年5月-至今	副总经理	有
2	晶艺半导体有限公司	2023年9月-至今	董事	有
3	香港晶艺半导体有限公司	2023年9月-至今	董事	有
4	天水华天科技股份有限公司	2012年5月-2023年5月	副总裁、总经理	有

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，李六军其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	上海圆取创业投资合伙企业（有限合伙）	1,475.586000	直接持有16.27%合伙份额	投资
2	华天集团	4,953.482000	直接持有2.02%股份	半导体行业投资
3	晶格共智	600.000000	直接持有10.00%合伙份额	标的公司员工持股平台
4	晶格共创	225.000000	直接持有8.89%合伙份	标的公司员工持股

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
			额	平台
5	晶格共赢	215.000000	直接持有35.59%合伙份额	标的公司员工持股平台
6	晶格顶峰	210.000000	直接持有16.57%合伙份额	标的公司员工持股平台
7	晶艺求精	1,500.000012	直接持有2.02%合伙份额	标的公司员工持股平台
8	晶艺共治	1,500.000012	直接持有1.54%合伙份额	标的公司员工持股平台

（十三）融芯科技

1、基本情况

企业名称	深圳市融芯科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	深圳市龙华区民治街道民强社区向南三区东美大厦 517
主要办公地点	深圳市龙华区民治街道民强社区向南三区东美大厦 517
法定代表人	王丹荔
注册资本	100 万元
统一社会信用代码	91440300MA5DPF603U
成立时间	2016 年 11 月 21 日
营业期限	2016 年 11 月 21 日至无固定期限
经营范围	机器设备、设备配件、软件及辅助设备的设计、研发与销售；有机材料和无机材料设计与研发，计算机以及化工领域内的技术服务、技术咨询；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 11 月，设立

2016 年 11 月，袁浩出资设立深圳市融芯科技有限公司。

设立时，融芯科技股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	袁浩	100.00	100.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

（2）2019 年 1 月，股权转让

2019 年 1 月，袁浩将其持有 99%融芯科技股权转让给王丹荔，将其持有

1.00%融芯科技股权转让给刘群英。

本次变更完成后，融芯科技股权结构如下；

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	王丹荔	99.00	99.00%
2	刘群英	1.00	1.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

3、主营业务发展情况

融芯科技主营业务为设备配件及相关材料的设计、研发与销售，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

融芯科技最近两年的主要财务数据如下：

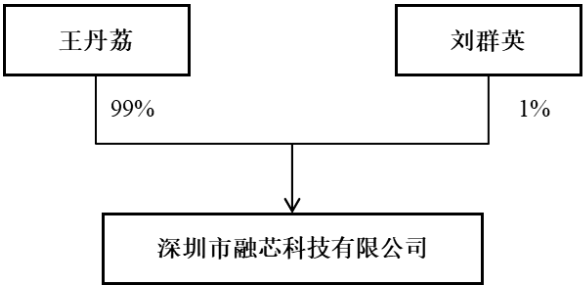
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	73.57	102.48
负债总额	-62.73	-87.66
净资产	136.29	190.13
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	5.11	9.75
净利润	-53.89	-21.46

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，融芯科技实际控制人为王丹荔，融芯科技的产权控制关系如下：



6、交易对方下属企业情况

截至 2026 年 2 月 28 日，融芯科技无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

融芯科技不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除晶艺半导体外，融芯科技无其他对外投资，但融芯科技不属于专为本次交易设立的主体。基于谨慎性考虑，融芯科技的上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的公司股权为目的的主体。

基于前述穿透锁定安排，融芯科技全体股东已出具《关于所持上市公司股份锁定的承诺函》：

“一、本人保证，采取一切必要措施确保本人持有的深圳融芯的股权锁定期与深圳融芯因本次重组持有的上市公司股票锁定期保持一致。在深圳融芯因本次重组持有的上市公司股票锁定期间，本人所持深圳融芯股权不得转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

三、本人确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

（十四）曾浩

1、基本情况

姓名	曾浩
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
身份证号码	510102197309******
住所	四川省成都市高新区******
通讯地址	四川省成都市锦江区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

曾浩最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	微旭商贸（上海）有限公司	2007年1月-2025年5月	经理	否
2	深圳市嘉合劲威电子科技有限公司	2025年9月-至今	销售总监	否

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，曾浩无其他对外投资企业。

（十五）凌风

1、基本情况

姓名	凌风
曾用名	无
性别	女
国籍	中国香港
港澳居民往来内地通行证号码	H00******
住所	中国香港港岛南区******
通讯地址	中国香港港岛南区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

凌风最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体有限公司	2024年9月-至今	董事	是
2	香港晶艺半导体有限公司	2021年8月-2024年7月	行政总监	是

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，凌风其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	出资额	持股情况	主营业务
1	成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）	200.00	直接持有25%合伙份额	标的公司员工持股平台

（十六）薛峰

1、基本情况

姓名	薛峰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	321002198405******
住所	上海市浦东新区******
通讯地址	上海市浦东新区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

薛峰最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体有限公司	2025年12月至今	董事	是
2	晶艺半导体有限公司	2023年9月至今	副总经理兼董秘	是
3	华泰联合证券有限责任公司	2010年8月至2023年9月	总监	否

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，薛峰其他直接对

外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	出资额	持股情况	主营业务
1	晶格共智	600.00	直接持有6.67%合伙份额	标的公司员工持股平台
2	晶格顶峰	210.00	直接持有19.05%合伙份额	标的公司员工持股平台

（十七）陈国栋

1、基本情况

姓名	陈国栋
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	430525198006******
住所	深圳市福田区******
通讯地址	深圳市龙岗区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

陈国栋最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体有限公司	2023年5月至今	销售副总	有
2	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	2022年4月至2023年5月	市场总监	无

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，陈国栋其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	珠海悦展鸿投资合伙企业（有限合伙）	300.00	直接持有16.67%合伙份额	对外投资
2	共青城龙芯创壹创业投资合伙企	4,901.00	直接持有2.04%合伙份额	对外投资

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
	业（有限合伙）			
3	晶格共智	600.00	直接持有3.33%合伙份额	标的公司员工持股平台
4	晶格共创	225.00	直接持有8.89%合伙份额	标的公司员工持股平台

（十八）苏鹏飞

1、基本情况

姓名	苏鹏飞
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	612723198204******
住所	四川省成都市青羊区******
通讯地址	四川省成都市青羊区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

苏鹏飞最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	晶艺半导体	2023年2月至今	高级财务总监	是

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，苏鹏飞直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	晶格共创	225.00	直接持有8.89%合伙份额	标的公司员工持股平台
2	晶格顶峰	210.00	直接持有2.38%合伙份额	标的公司员工持股平台

（十九）高鹏翼盛

1、基本情况

企业名称	天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室（天津锦信商务秘书有限公司托管第 0305 号）
主要办公地点	北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 601
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司
出资额	50,000.00 万元
统一社会信用代码	91120116MA07GD7E5J
成立时间	2021 年 11 月 11 日
营业期限	2021 年 11 月 11 日至 2041 年 11 月 10 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2021 年 11 月，设立

高鹏翼盛成立于 2021 年 11 月 11 日，由普通合伙人成都赛富高鹏投资管理有限公司与有限合伙人天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立，设立时全体合伙人的总认缴出资额为人民币 50,000 万元。

设立时，高鹏翼盛各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	成都赛富高鹏投资管理有限公司	1.00	0.002
有限合伙人	天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）	49,999.00	99.998
合计		**50,000.00**	**100.00**

（2）2022 年 12 月，合伙人变更

2022 年 12 月，高鹏翼盛作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本次变更后，高鹏翼盛各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	宁波梅山港保税区君信启瑞投资合伙企业（有限合伙）	1.00	0.002

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
有限合伙人	天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）	49,999.00	99.998
合计		**50,000.00**	**100.00**

（3）2023 年 10 月，合伙人变更

2023 年 10 月，高鹏翼盛作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本次变更后，高鹏翼盛各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	宁波梅山港保税区瑞信高鹏投资有限公司	1.00	0.002
有限合伙人	天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）	49,999.00	99.998
合计		**50,000.00**	**100.00**

3、主营业务情况

高鹏翼盛主要从事对外投资业务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

高鹏翼盛最近两年的主要财务数据如下：

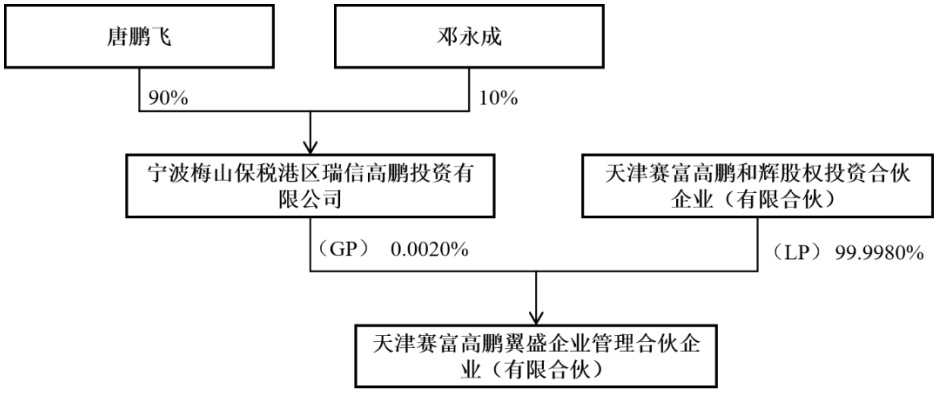
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	41,158.89	32,307.91
负债总额	8,853.59	-
净资产	32,305.29	32,307.91
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	-	-
净利润	-288.00	-

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，高鹏翼盛的执行事务合伙人为宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司，实际控制人为唐鹏飞，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，高鹏翼盛其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	上海陛通半导体能源科技股份有限公司	5,344.808	直接持有 1.44%股份	主要从事薄膜沉积设备的研发、制造与销售
2	英诺赛科（苏州）科技股份有限公司	91,510.07	直接持有 0.53%股份	主要从事各类氮化镓功率半导体产品的设计、研发及制造
3	上海晶丰明源半导体股份有限公司	12,885.29	直接持有 1.29%股份	电源管理芯片、驱动控制芯片研发与销售
4	新余高鹏瑞弘投资合伙企业（有限合伙）	30,000.00	直接持有 99.9967%有限合伙份额	无实际经营业务
5	珠海横琴高鹏瑞元投资控股合伙企业（有限合伙）	50,000.00	直接持有 15.00%有限合伙份额	无实际经营业务

7、私募投资基金备案情况

高鹏翼盛不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

（二十）高鹏联盛

1、基本情况

企业名称	天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室

	（天津锦信商务秘书有限公司托管第 0625 号）
主要办公地点	北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 601
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司
出资额	2,501.00 万元
统一社会信用代码	91120116MA827RQ35D
成立时间	2023 年 8 月 16 日
营业期限	2023 年 8 月 16 日至 2073 年 8 月 15 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2023 年 8 月，设立

高鹏联盛成立于 2023 年 8 月 16 日，由普通合伙人天津高鹏翼盛加泓企业管理有限公司与有限合伙人潘苑共同投资设立，设立时全体合伙人的总认缴出资额为人民币 3,000 万元。

设立时，高鹏联盛各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	天津高鹏翼盛加泓企业管理有限公司	1.00	0.03
有限合伙人	潘苑	2,999.00	99.96
合计		**3,000.00**	**100.00**

（2）2023 年 12 月，合伙人及出资额变更

2023 年 12 月，高鹏联盛作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本次变更后，高鹏联盛各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	宁波梅山港保税区瑞信高鹏投资有限公司	1.00	0.04
有限合伙人	陈森	2,500.00	99.96
合计		**2,501.00**	**100.00**

3、主营业务情况

高鹏联盛主要从事对外投资业务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

高鹏联盛最近两年的主要财务数据如下：

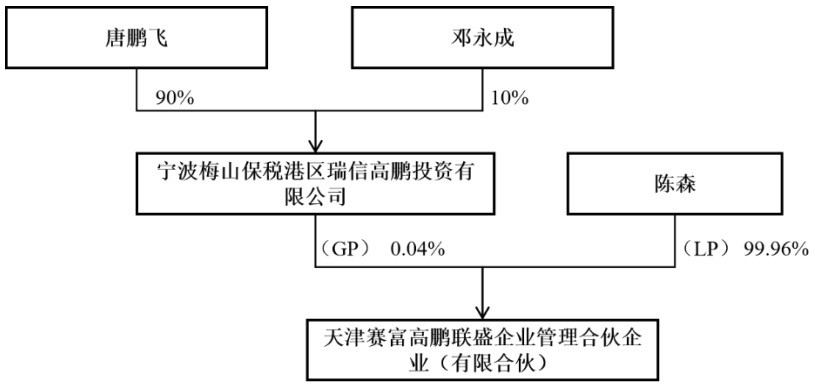
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,701.05	2,437.73
负债总额	2,301.53	-
净资产	2,399.52	2,437.73
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	-38.21	-49.80

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，高鹏联盛的执行事务合伙人为宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司，实际控制人为唐鹏飞，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除持有晶艺半导体股权外，高鹏联盛无其他对外投资企业。

7、私募投资基金备案情况

高鹏联盛不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除晶艺半导体外，高鹏联盛无其他对外投资，但高

鹏联盛不属于专为本次交易设立的主体。基于谨慎性考虑，高鹏联盛的上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的公司股权为目的的主体。

基于前述穿透锁定安排，高鹏联盛的上层权益持有人陈森、宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司已出具《关于所持上市公司股份锁定的承诺函》：

“一、本人/本企业保证，采取一切必要措施确保本人/本企业持有的高鹏联盛的合伙份额锁定期与高鹏联盛因本次重组持有的上市公司股票锁定期保持一致。在高鹏联盛因本次重组持有的上市公司股票锁定期间，本人/本企业所持高鹏联盛合伙份额不得转让，亦不会委托他人管理该等权益，或在该等权益上设置任何质押、担保等权利负担。

二、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人/本企业将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

三、本人/本企业确认上述声明和承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如违反上述声明和承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。”

（二十一）腾元投资

1、基本情况

企业名称	嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 102 室-46
主要办公地点	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心大厦 D 座 1001
执行事务合伙人	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）
出资额	9,473.9738 万元
统一社会信用代码	91330402MA28AJ2T4U
成立时间	2016 年 7 月 25 日
营业期限	2016 年 7 月 25 日至 2036 年 7 月 24 日
经营范围	实业投资、投资管理。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 7 月，设立

2016 年 7 月，合伙人天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）、阎安生共同出资设立嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）。

设立时，腾元投资出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	类型	认缴出资额	出资比例
1	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	1.43%
2	阎安生	有限合伙人	6,900.00	98.57%
合计			**7,000.00**	**100.00%**

（2）2019 年 3 月，出资额变更

2019 年 3 月，经合伙人决议，腾元投资完成出资额变更事宜。

本次变更完成后，腾元投资出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	类型	认缴出资额	出资比例
1	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.71%
2	阎安生	有限合伙人	13,900.00	99.29%
合计			**14,000.00**	**100.00%**

（3）2024 年 10 月，合伙人及出资额变更

2024 年 9 月，经合伙人决议，腾元投资完成合伙人及出资额变更事宜。

本次变更完成后，腾元投资出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人	类型	认缴出资额	出资比例
1	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100.00	1.06%
2	阎焱	有限合伙人	9,373.97	98.94%
合计			**9,473.97**	**100.00%**

3、主营业务情况

腾元投资主要从事对外投资业务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

腾元投资最近两年的主要财务数据如下：

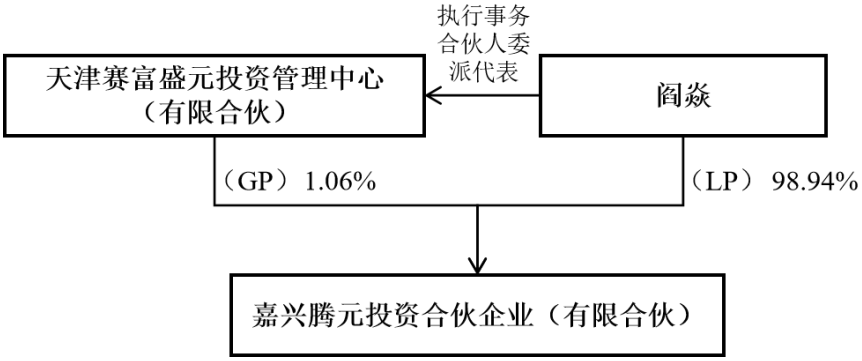
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	47,539.51	60,136.00
负债总额	33,621.94	37,050.95
净资产	13,917.57	23,085.05
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	-	-
净利润	3,024.35	-6,021.31

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，腾元投资的执行事务合伙人为天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙），实际控制人为阎焱，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除持有晶艺半导体股权外，腾元投资其他直接对外投资企业（直接持股比例超过 5%）情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	宁波泓淳企业管理合伙企业（有限合伙）	3,351.00	直接持有 29.84%合伙份额	投资管理
2	苏州鲸愈沪宁智能科技有限公司	1,061.48	直接持股 5.00%股权	医疗健康咨询
3	北京碳和新材未来科技有限公司	114.94	直接持股 8.69%股权	新材料研发
4	盛嘉华生物科技（上海）有限公司	1,600.00	直接持有 16.25%股权	生物科技与医疗器械

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
5	南京赛富股权投资管理中心（有限合伙）	3,000.00	直接持有 89%合伙份额	管理私募股权投资基金
6	北京沣元企业管理中心（有限合伙）	2,000.00	直接持有 40.00%合伙份额	企业管理咨询
7	上海皓冕企业管理合伙企业（有限合伙）	84.55	直接持有 73.33%合伙份额	企业管理咨询
8	北京赛富皓创咨询管理中心（有限合伙）	1,000.00	直接持有 34.40%合伙份额	投资管理
9	未名电池科技（深圳）有限公司	9,647.65	直接持有 6.15%股权	新能源电池开发与销售
10	成都赛富高鹏投资管理有限公司	1,000.00	直接持有 30.00%股权	投资管理
11	朗润赛富（深圳）投资中心（有限合伙）	1,000.00	直接持有 30.00%合伙份额	投资管理
12	深圳市思坦慧邦管理合伙企业（有限合伙）	2,500.00	直接持有 6.67%合伙份额	投资管理

7、私募投资基金备案情况

腾元投资已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为 SR0274。

（二十二）陈艺琴

1、基本情况

姓名	陈艺琴
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	350524197512******
住所	福建省厦门市思明区******
通讯地址	福建省厦门市思明区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

陈艺琴最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	2004年10月至今	行政专员	否

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，陈艺琴其他直接对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	深圳市佳炫科技有限公司	500.00	直接持有 15.00%股权	计算机软硬件的技术咨询、技术转让、技术服务
2	厦门万人资产管理有限公司	2,000.00	直接持有 10.00%股权	投资管理
3	上海天鎏绿建投资中心（有限合伙）	1,732.00	直接持有 3.125%合伙份额	投资管理

（二十三）易荣坤

1、基本情况

姓名	易荣坤
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350524197106******
住所	福建省厦门市思明区******
通讯地址	福建省厦门市思明区******
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及与任职单位存在的产权关系

易荣坤最近三年的职业和职务情况如下：

序号	任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	2014 年 1 月至今	董事长兼总经理	是
2	大连恒坤新材料有限公司	2024 年 10 月至今	经理	是
3	厦门恒坤新材创研有限公司	2025 年 9 月至今	董事	是
4	福建恒坤投资有限公司	2017 年 1 月至今	监事	是

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，易荣坤其他直接

对外投资企业情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	44,931.96	直接持有16.59%股份	光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售
2	福建恒坤投资有限公司	1,667.00	直接持有94.00%股权	投资管理
3	厦门神剑投资合伙企业（有限合伙）	704.22	直接持有12.58%普通合伙份额	投资管理
4	厦门晟临芯投资合伙企业（有限合伙）	2,772.00	直接持有92.86%普通合伙份额	投资管理
5	厦门晟临坤投资合伙企业（有限合伙）	896.15	直接持有3.31%普通合伙份额	投资管理
6	厦门兆莅恒投资合伙企业（有限合伙）	604.11	直接持有45.61%普通合伙份额	投资管理

（二十四）芯联启辰

1、基本情况

企业名称	上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
主要办公地点	上海市黄浦区太仓路 233 号 2207 室
执行事务合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
出资额	125,000 万元
统一社会信用代码	91310000MAE8TWWA07
成立时间	2024 年 12 月 23 日
营业期限	2024 年 12 月 23 日至 2044 年 12 月 22 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2024 年 12 月，设立

芯联启辰成立于 2024 年 12 月 23 日，由普通合伙人芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）与有限合伙人芯联股权投资（杭州）有限公司共同

投资设立，设立时全体合伙人的总认缴出资额为人民币 40,000 万元。

设立时，芯联启辰各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	200.00	0.50
有限合伙人	芯联股权投资（杭州）有限公司	39,800.00	99.50
合计		**40,000.00**	**100.00**

（2）2024 年 12 月，合伙人变更

2024 年 12 月，芯联启辰作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本次变更后，芯联启辰各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	200.00	0.44
有限合伙人	芯联股权投资（杭州）有限公司	39,800.00	88.44
有限合伙人	上海临港新片区私募基金管理有限公司	5,000.00	11.11
合计		**45,000.00**	**100.00**

（3）2025 年 5 月，合伙人变更

2025 年 4 月，芯联启辰作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本次变更后，芯联启辰各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	400.00	0.50
有限合伙人	芯联股权投资（杭州）有限公司	62,600.00	78.25
有限合伙人	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	12.50
有限合伙人	上海临港新片区私募基金管理有限公司	5,000.00	6.25
有限合伙人	宁波江丰电子材料股份有限公司	2,000.00	2.50
合计		**80,000.00**	**100.00**

（4）2026 年 1 月，合伙人变更

2025 年 12 月，芯联启辰作出合伙人决定，通过合伙人变更相关事宜。本

次变更后，芯联启辰各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
普通合伙人	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	400.00	0.32
有限合伙人	芯联股权投资（杭州）有限公司	62,600.00	50.08
有限合伙人	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000.00	12.00
有限合伙人	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	8.00
有限合伙人	厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合伙企业（有限合伙）	10,000.00	8.00
有限合伙人	无锡芯朋微电子股份有限公司	10,000.00	8.00
有限合伙人	嘉兴嘉国叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.00
有限合伙人	上海临港新片区私募基金管理有限公司	5,000.00	4.00
有限合伙人	安徽富乐德科技发展股份有限公司	3,000.00	2.40
有限合伙人	宁波江丰电子材料股份有限公司	2,000.00	1.60
有限合伙人	江苏鑫智股权投资管理有限公司	2,000.00	1.60
合计		**125,000.00**	**100.00**

3、主营业务情况

芯联启辰主要从事对外投资业务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

芯联启辰最近两年的主要财务数据如下：

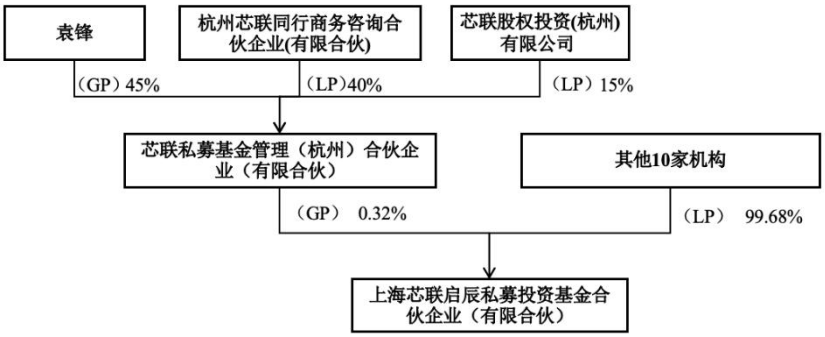
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	111,052.94	-
负债总额	4,196.54	-
净资产	106,856.40	-
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	9,745.08	-
净利润	6,856.40	-

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，芯联启辰的执行事务合伙人为芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙），实际控制人为袁锋，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，芯联启辰其他直接对外投资企业（直接持股比例超过 5%）情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙）	36,201.00	100.00%	投资管理
2	杭州碧澄能源发展有限公司	105,180.23	6.81%	光伏设备制造
3	苏州芯联芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）	10,141.00	39.52%	投资管理
4	上海芯联芯光创业投资合伙企业（有限合伙）	2,001.00	99.95%	投资管理
5	上海芯联焕新创业投资合伙企业（有限合伙）	11,000.00	18.09%	投资管理
6	晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司	13,000.00	9.00%	半导体材料研发
7	上海朔集半导体科技有限公司	1,390.28	9.22%	集成电路设计服务
8	无锡祥瑞微电子科技有限公司	1,490.33	6.25%	电子元器件制造

7、私募投资基金备案情况

芯联启辰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为 SAXC36。

（二十五）华天集团

1、基本情况

公司名称	天水华天电子集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层
主要办公地点	甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号
法定代表人	肖胜利
注册资本	4,953.482 万元
统一社会信用代码	916205007396098183
成立时间	2002 年 7 月 25 日
营业期限	2002 年 7 月 25 日至无固定期限
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2002 年 7 月，设立

2002 年 7 月，吉林华微电子股份有限公司和天水永红器材厂工会签署投资协议，投资组建华天电子集团。设立时注册资本金为 1,680.00 万元。

设立时，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	吉林华微电子股份有限公司	856.80	51.00%
2	天水永红器材厂工会	823.20	49.00%
合计		**1,680.00**	**100.00%**

（2）2003 年 4 月，股东变更

2003 年 4 月，华天集团召开 2003 年第一次股东大会，会议决议：原股东吉林华微电子股份有限公司和天水永红器材厂工会将持有的公司股份转让给肖胜利、张玉明、刘建军、宋勇、韩承真、常文瑛、边席科、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、杜忠鹏、徐元斌、张兴安等 14 人。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利	403.20	24.00%
2	刘建军	235.20	14.00%
3	张玉明	134.40	8.00%
4	宋勇	100.80	6.00%
5	韩承真	100.80	6.00%
6	常文瑛	84.00	5.00%
7	薛延童	84.00	5.00%
8	陈建军	84.00	5.00%
9	崔卫兵	84.00	5.00%
10	杨前进	84.00	5.00%
11	杜忠鹏	84.00	5.00%
12	边席科	67.20	4.00%
13	徐元斌	67.20	4.00%
14	张兴安	67.20	4.00%
合计		**1,680.00**	**100.00%**

（3）2003 年 8 月，增资及股东变更

2003 年 8 月，华天集团召开 2003 年第六次股东大会，会议决议：新增注册资本 1,000 万元；徐元斌将其持有的 67.20 万元出资份额全部转让给新股东周永寿并退出。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利	643.20	24.00%
2	刘建军	375.20	14.00%
3	张玉明	214.40	8.00%
4	宋勇	160.80	6.00%
5	韩承真	160.80	6.00%
6	常文瑛	134.00	5.00%
7	薛延童	134.00	5.00%
8	陈建军	134.00	5.00%
9	崔卫兵	134.00	5.00%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
10	杨前进	134.00	5.00%
11	杜忠鹏	134.00	5.00%
12	边席科	107.20	4.00%
13	周永寿	107.20	4.00%
14	张兴安	107.20	4.00%
合计		**2,680.00**	**100.00%**

（4）2005 年 12 月，增资

2005 年 12 月，华天集团召开 2005 年第二次股东大会，会议决议：将资本公积金 1,380 万元转增注册资本，注册资本增加为 4,060 万元，所增加的注册资本由原股东按出资比例持有。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利	974.40	24.00%
2	刘建军	568.40	14.00%
3	张玉明	324.80	8.00%
4	宋勇	243.60	6.00%
5	韩承真	243.60	6.00%
6	常文瑛	203.00	5.00%
7	薛延童	203.00	5.00%
8	陈建军	203.00	5.00%
9	崔卫兵	203.00	5.00%
10	杨前进	203.00	5.00%
11	杜忠鹏	203.00	5.00%
12	边席科	162.40	4.00%
13	周永寿	162.40	4.00%
14	张兴安	162.40	4.00%
合计		**4,060.00**	**100.00%**

（5）2006 年 2 月，股东变更

2006 年 2 月，华天集团召开 2006 年第二次股东大会，会议决议：原股东韩承真将其持有的 6%的股权分别转让给周永寿 1%，新股东乔少华 5%。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利	974.40	24.00%
2	刘建军	568.40	14.00%
3	张玉明	324.80	8.00%
4	宋勇	243.60	6.00%
5	常文瑛	203.00	5.00%
6	薛延童	203.00	5.00%
7	陈建军	203.00	5.00%
8	崔卫兵	203.00	5.00%
9	杨前进	203.00	5.00%
10	杜忠鹏	203.00	5.00%
11	周永寿	203.00	5.00%
12	乔少华	203.00	5.00%
13	边席科	162.40	4.00%
14	张兴安	162.40	4.00%
合计		**4,060.00**	**100.00%**

（6）2006 年 10 月，减资及公司分立

2006 年 10 月，华天集团全体股东一致同意减少注册资本并进行公司分立，采取存续分立方式，分立出存续公司天水华天微电子有限公司。该次减资和分立后，注册资本变更为 2,213.61 万元。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利	531.27	24.00%
2	刘建军	309.91	14.00%
3	张玉明	177.09	8.00%
4	宋勇	132.82	6.00%
5	常文瑛	110.68	5.00%
6	薛延童	110.68	5.00%
7	陈建军	110.68	5.00%
8	崔卫兵	110.68	5.00%
9	杨前进	110.68	5.00%

10	杜忠鹏	110.68	5.00%
11	周永寿	110.68	5.00%
12	乔少华	110.68	5.00%
13	边席科	88.54	4.00%
14	张兴安	88.54	4.00%
合计		**2,213.61**	**100.00%**

（7）2006 年 12 月，股东变更及组织形式变更

2006 年 12 月，华天集团召开股东会会议，全体股东一致同意：肖胜利将其持有公司 258.58 万元的股权分别转让给耿树坤等 20 名自然人；刘建军将其持有公司 97.82 万元的股权分别转让给任江林等 13 名自然人；张玉明将其持有公司 55.89 万元的股权分别转让给谢宏安等 11 名自然人；宋勇将其持有公司 41.92 万元的股权分别转让给宋勤福等 10 名自然人；崔卫兵将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给施长立等 14 名自然人；常文瑛将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给张武等 17 名自然人；乔少华将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给姜永刚等 11 名自然人；薛延童将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给李双龙等 11 名自然人；陈建军将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给谈光宗等 12 名自然人；杨前进将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给杨向东等 9 名自然人；杜忠鹏将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给丁福林等 11 名自然人；周永寿将其持有公司 34.93 万元的股权分别转让给孙启中等 9 名自然人；边席科将其持有公司 27.95 万元的股权分别转让给陈庆伟等 17 名自然人；张兴安将其持有公司 27.95 万元的股权分别转让给耿树坤等 17 名自然人。

同时，天水华天微电子有限公司变更为天水华天微电子股份有限公司，现有注册资本按 1:1 的折股比例折股为 2,213.61 万股。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利等 16 名自然人	1,551.29	70.08%
2	其他自然人股东	662.32	29.92%
合计		**2,213.61**	**100.00%**

（8）2013 年 4 月，增资

2013 年 4 月，华天集团召开 2013 年第一次临时股东大会，会议决议：根据增资扩股和股权激励以及实际情况，同意总股本由 2,213.61 万股增加至 4,684.61 万股，注册资本由 2,213.61 万元增加至 4,684.61 万元。

同时，在原 183 个自然人股东的基础上，同意新增自然人股东李六军，持有 100 万股，占总股本的 2.13%。同意新增非法人企业股东 6 个，持有 745 万股，占总股本的 15.90%，该次增资后，华天集团股东共计 190 个，其中自然人股东 184 个，非法人企业股东 6 个。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利等 16 名自然人	2,676.29	57.13%
2	其他自然人股东	1,263.32	26.97%
3	天水天资微电子产业发展中心（有限合伙）	162.00	3.46%
4	天水华辉文化创意产业发展中心（有限合伙）	137.00	2.92%
5	天水华资集成电路产业发展中心（有限合伙）	123.00	2.63%
6	天水飞泰互联网产业发展中心（有限合伙）	118.00	2.52%
7	天水天鑫半导体产业发展中心（有限合伙）	113.00	2.41%
8	天水优润电子产业发展中心（有限合伙）	92.00	1.96%
合计		**4,684.61**	**100.00%**

（9）2014 年 1 月，股份回购及减资

2014 年 1 月，华天集团召开 2013 年年度股东大会，会议决议：根据华天集团回购股份情况相应减少注册资本，回购减资后公司注册资本变更为 4,446.53 万股。

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利等 13 名自然人	2,418.44	54.39%
2	其他自然人股东	1,283.09	28.86%
3	天水天资微电子产业发展中心（有限合伙）	162.00	3.64%
4	天水华辉文化创意产业发展中心（有限合伙）	137.00	3.08%

5	天水华资集成电路产业发展中心（有限合伙）	123.00	2.77%
6	天水飞泰互联网产业发展中心（有限合伙）	118.00	2.65%
7	天水天鑫半导体产业发展中心（有限合伙）	113.00	2.54%
8	天水优润电子产业发展中心（有限合伙）	92.00	2.07%
合计		**4,446.53**	**100.00%**

（10）2015 年 11 月，名称变更

2015 年 11 月，华天集团召开第四届董事会第二十五次会议，会议决议同意公司名称由“天水华天微电子集团股份有限公司”变更为“天水华天电子集团股份有限公司”。

（11）2017 年 10 月，增资

2017 年 10 月，华天集团召开 2017 年第一次临时股东大会，会议决议：新增股本 875 万股，该次新增股本由肖智成全额人民币现金认购。该次增资扩股完成后，公司的注册资本变更为 5,321.53 万元，总股本变更为 5,321.53 万股。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利等 13 名自然人	3,150.19	59.20%
2	其他自然人股东	1,426.34	26.80%
3	天水天资微电子产业发展中心（有限合伙）	162.00	3.04%
4	天水华辉文化创意产业发展中心（有限合伙）	137.00	2.57%
5	天水华资集成电路产业发展中心（有限合伙）	123.00	2.31%
6	天水飞泰互联网产业发展中心（有限合伙）	118.00	2.22%
7	天水天鑫半导体产业发展中心（有限合伙）	113.00	2.12%
8	天水优润电子产业发展中心（有限合伙）	92.00	1.73%
合计		**5,321.53**	**100.00%**

（12）2021 年 6 月，减资

2021 年 6 月，华天集团召开 2020 年年度股东大会，会议决议：公司共回购了 44 名自然人股东持有的 368.05 万股股份。会议同意就此次股份回购情况，公司减少注册资本 368.05 万元。减资后公司的注册资本由 5,321.53 万元变更为 4,953.48 万元，股份总数由 5,321.53 万股变更为 4,953.48 万股。

本次变更完成后，华天集团的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	肖胜利等 13 名自然人	3,150.19	63.60%
2	其他自然人股东	1,058.29	21.36%
3	天水天资微电子产业发展中心（有限合伙）	162.00	3.27%
4	天水华辉文化创意产业发展中心（有限合伙）	137.00	2.77%
5	天水华资集成电路产业发展中心（有限合伙）	123.00	2.48%
6	天水飞泰互联网产业发展中心（有限合伙）	118.00	2.38%
7	天水天鑫半导体产业发展中心（有限合伙）	113.00	2.28%
8	天水优润电子产业发展中心（有限合伙）	92.00	1.86%
合计		**4,953.48**	**100.00%**

3、主营业务发展情况

华天集团为投资控股公司，主要持有华天科技、华羿微电等公司的股权并对外进行投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

华天集团最近两年的主要财务数据如下：

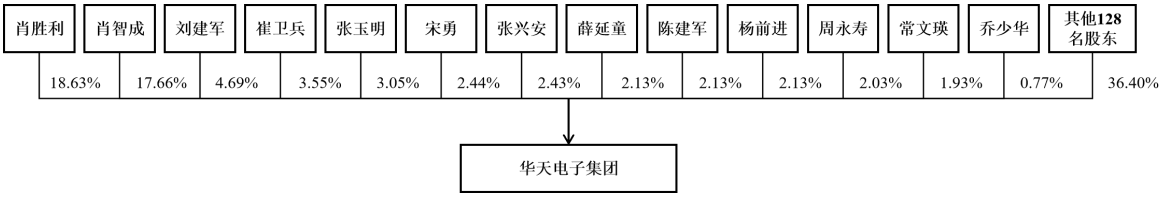
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,904,422.72	4,334,600.74
负债总额	2,567,329.62	2,136,960.64
净资产	2,337,093.10	2,197,640.10
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	1,950,131.55	1,641,839.84
净利润	100,952.27	81,239.43

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，华天集团的实际控制人为肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、崔卫兵、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安等 13 名自然人形成的一致行动人，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业情况

截至 2026 年 2 月 28 日，除持有晶艺半导体股权外，华天集团其他直接对外投资企业（直接持股比例超过 5%）情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	天水华天科技股份有限公司	325,888.17	直接持有 22.30%股份	半导体集成电路封装测试
2	华羿微电子股份有限公司	41,509.58	直接持有 64.95%股份	半导体功率器件研发、生产、销售
3	天水华天传感器有限公司	1,000.00	直接持有 84.55%股权	传感器研发、生产、销售
4	天水华天电子宾馆有限公司	500.00	直接持有 100.00%股权	酒店与餐饮服务
5	成都观岩科技有限公司	1,342.89	直接持有 6.79%股权	集成电路设计与销售
6	西安华泰集成电路产业发展有限公司	16,632.00	直接持有 51.00%股权	集成电路产业孵化
7	甘肃微电子工程研究院有限公司	600	直接持有 55.00%股权	微电子技术和工程咨询服务
8	昆山启村投资中心（有限合伙）	40,000.00	直接持有 40.83%股权	股权投资与企业管理
9	天水市兴业融资担保有限责任公司	10,000.00	直接持有 10.00%股权	融资担保业务
10	江苏华智天成科技有限公司	1,176.47	直接持有 68.00%股权	工业软件和工业互联网技术开发
11	南京华天芯城置业有限公司	5,000.00	直接持有 100.00%股权	房地产开发与销售
12	西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）	2,605.00	直接持有 6.91%股权	股权投资与企业管理
13	深圳市芯港通企业管理合伙企业（有限合伙）	15,384.97	直接持有 99.19%股权	股权投资与企业管理
14	安徽华智天成科技有限公司	1,176.47	直接持有 73.00%股权	工业软件和工业互联网技术开发

7、私募投资基金备案情况

华天集团不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募

投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

（二十六）天利投资

1、基本情况

企业名称	西安天利投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	西安经济技术开发区凤城五路 105 号 2 号厂房西侧二层
主要办公地点	西安经济技术开发区凤城五路 105 号
执行事务合伙人	西安天启企业管理有限公司
出资额	50,000.00 万元
统一社会信用代码	91610132MA6TXNTH0G
成立时间	2016 年 3 月 18 日
营业期限	2016 年 3 月 18 日至无固定期限
经营范围	企业并购、投资管理（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、投资咨询（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 3 月，设立

2016 年 3 月，普通合伙人西安天启企业管理有限公司及有限合伙人华天科技（西安）有限公司、天水华天科技股份有限公司共同出资设立天利投资。设立时全体合伙人的总认缴出资额为人民币 30,000.0000 万元。

设立时，天利投资各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	西安天启企业管理有限公司	90.00	0.30%
有限合伙人	华天科技（西安）有限公司	20,000.00	66.67%
有限合伙人	天水华天科技股份有限公司	9,910.00	33.03%
合计		**30,000.00**	**100.00%**

（2）2019 年 8 月，合伙人份额变更

2019 年 8 月，经天利投资全体合伙人决议，通过合伙人天水华天科技股份有限公司向合伙人西安天启企业管理有限公司转让合伙份额事宜。

本次变更完成后，天利投资各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	西安天启企业管理有限公司	1,090.00	3.63%
有限合伙人	华天科技（西安）有限公司	20,000.00	66.67%
有限合伙人	天水华天科技股份有限公司	8,910.00	29.70%
合计		**30,000.00**	**100.00%**

（3）2021 年 11 月，合伙人份额变更及出资额变更

2021 年 11 月，经天利投资全体合伙人决议，通过合伙人华天科技（西安）有限公司和天水华天科技股份有限公司新增合伙份额事宜。

本次变更完成后，天利投资各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	西安天启企业管理有限公司	1,090.00	3.03%
有限合伙人	华天科技（西安）有限公司	24,000.00	66.67%
有限合伙人	天水华天科技股份有限公司	10,910.00	30.31%
合计		**36,000.00**	**100.00%**

（4）2023 年 12 月，合伙人份额变更及出资额变更

2023 年 12 月，经天利投资全体合伙人决议，通过合伙人天水华天科技股份有限公司新增合伙份额事宜。

本次变更完成后，天利投资各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	西安天启企业管理有限公司	1,090.00	2.73%
有限合伙人	华天科技（西安）有限公司	24,000.00	60.00%
有限合伙人	天水华天科技股份有限公司	14,910.00	37.28%
合计		**40,000.00**	**100.00%**

（5）2025 年 9 月，合伙人份额变更及出资额变更

2025 年 9 月，经天利投资全体合伙人决议，通过合伙人华天科技（西安）有限公司和天水华天科技股份有限公司新增合伙份额事宜。

本次变更完成后，天利投资各合伙人的出资情况如下：

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例

合伙人类型	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	西安天启企业管理有限公司	1,090.00	2.18%
有限合伙人	华天科技（西安）有限公司	30,000.00	60.00%
有限合伙人	天水华天科技股份有限公司	18,910.00	37.82%
合计		**50,000.00**	**100.00%**

3、主营业务情况

天利投资主要从事企业并购、投资管理业务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标

天利投资最近两年的主要财务数据如下：

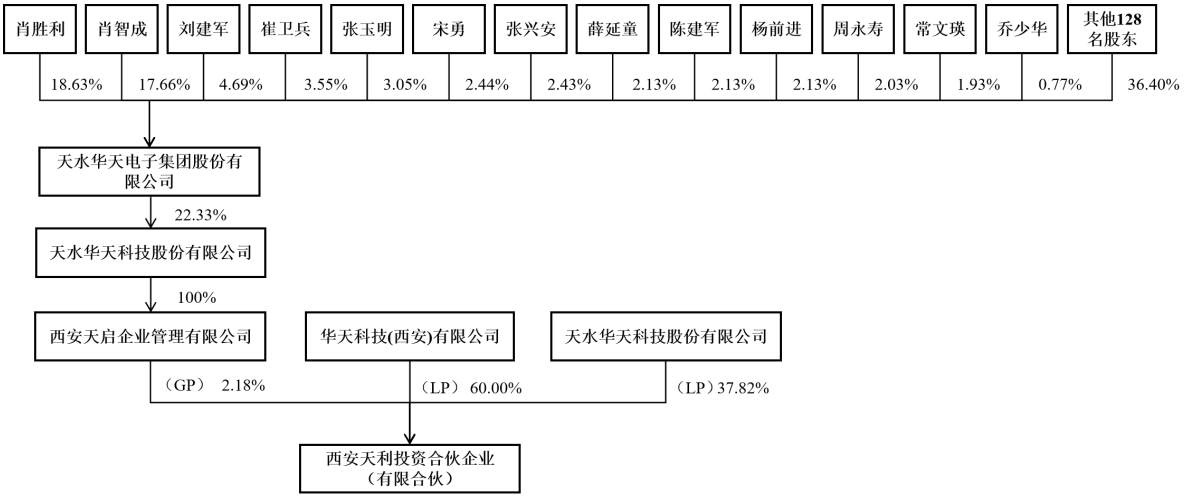
单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	69,147.58	57,582.28
负债总额	24.85	771.04
净资产	69,122.73	56,811.24
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	-	59.41
净利润	2,304.84	682.81

注：以上数据未经审计。

5、产权及控制关系、股东基本情况

截至 2026 年 2 月 28 日，天利投资的实际控制人为肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、崔卫兵、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安等 13 名自然人形成的一致行动人，产权及控制关系结构图如下：



6、交易对方下属企业

截至 2026 年 2 月 28 日，除晶艺半导体及其下属企业外，天利投资其他直接对外投资企业（直接持股比例超过 5%）情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本/出资额	持股情况	主营业务
1	昆山启村投资中心（有限合伙）	40,000.00	直接持有 8.66%合伙份额	股权投资
2	江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000.00	直接持有 10.00%合伙份额	股权投资
3	南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	直接持有 20.00%合伙份额	企业管理咨询
4	江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）	63,600.00	直接持有 11.79%合伙份额	股权投资
5	芯聚德科技（安徽）有限责任公司	5,416.67	直接持有 8.31%股权	基板生产业务
6	广东傲来科技有限公司	705.28	直接持有 7.44%股权	精密光学成像质量检测设备、半导体精密探针台
7	安徽大河半导体有限公司	1,896.66	直接持有 25.00%股权	固晶机研发和生产
8	江苏华天盛宇产业投资基金（有限合伙）	20,000.00	直接持有 40.00%合伙份额	股权投资
9	江苏华天盛宇创新成长产业投资基金（有限合伙）	20,600.00	直接持有 14.56%合伙份额	股权投资

7、私募投资基金备案情况

天利投资不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

二、募集配套资金交易对方

上市公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的特定投资者发行股票募集配套资金。发行对象应符合法律、 法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

三、其他事项说明

（一）交易对方之间的关系

交易对方之间的关联关系情况如下：

1、晶格共智、晶格未来、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰均为易坤控制的主体，晶格共智的执行事务合伙人为易坤；晶格未来、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰的执行事务合伙人均为晶艺众合，晶艺众合系易坤持有 100%股权的企业。

2、曾鸣与曾岳琦系父子关系。高鹏翼盛的上层有限合伙人谭清（间接持有高鹏翼盛约 50%份额）与曾鸣系夫妻关系、与曾岳琦系母子关系。

3、高鹏翼盛、高鹏联盛的执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司。

4、阎焱系嘉兴腾元有限合伙人并持有 98.9445%财产份额；高鹏翼盛 LP 天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）LP 为 SAIF Eagle Fund Group Ltd.，SAIF Eagle Fund Group Ltd.上层股东 SAIF Eagle Fund L.P.之 GP（持有 0%权益）为 SAIF Eagle View Ltd.，持有 SAIF Eagle View Ltd.30%股权的 Luna Harvest Limited 系阎焱持有 95%股权的企业。

5、天利投资系天水华天科技股份有限公司直接和间接持有 100%财产份额的企业，华天集团系天水华天科技股份有限公司控股股东。

6、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞为标的公司管理层。其中李六军持有晶格共赢 35.5922%财产份额、晶格顶峰 16.5714%财产份额、晶格共智 10%财产份额、晶格共创 8.8889%财产份额、晶艺求精 2.0184%财产份额、晶艺共治 1.5443%财产份额、华天集团 2.0188%股权。薛峰持有晶格共智 6.6667%财产份额、晶格顶峰 19.0476%财产份额。陈国栋持有晶格共智 3.3333%财产份额、晶格共创 8.8889%财产份额。苏鹏飞持有晶格共创 8.8889%财产份额、晶格顶峰 2.3810%财产份额。

7、凌风持有晶格未来 25%财产份额。

8、易荣坤与陈艺琴系夫妻关系。

（二）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，易坤及其控制的主体合计持有上市公司股份预计超过 5%。因此，根据《科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，本次交易对方均不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日，本次交易的交易对方及其主要管理人员近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

截至本报告书签署日，本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或

受到证券交易所纪律处分的情形。

（六）标的资产股东人数穿透计算

本次发行股份购买资产交易的交易对方为共计 26 名。参照相关规定及案例，本次交易的穿透标准如下：（1）若交易对方为本次交易首次披露前 6 个月前入股标的公司，则穿透至自然人、非专为本次交易设立（入股标的公司时间早于本次交易停牌前 6 个月，或成立时间早于报告期期初）且非以持有标的公司股权为目的（除标的公司外，还存在其他对外投资）的法人或已备案私募基金；（2）若交易对方为本次交易首次披露前 6 个月内入股标的公司，将本次交易的全部发行对象穿透至最终出资人，即自然人、上市公司、新三板挂牌公司、非专为本次交易设立且非以持有标的公司股权为目的的国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）或已备案私募基金。按照前述标准，标的公司股东穿透计算后的合计人数未超过 200 人，具体如下：

序号	交易对方姓名/名称	股东类型	穿透计算人数	说明
1	易坤	自然人	1	-
2	李六军	自然人	1	-
3	YA XU	自然人	1	-
4	曾鸣	自然人	1	-
5	曾岳琦	自然人	1	-
6	曾浩	自然人	1	-
7	凌风	自然人	1	-
8	薛峰	自然人	1	-
9	陈国栋	自然人	1	-
10	苏鹏飞	自然人	1	-
11	陈艺琴	自然人	1	-
12	易荣坤	自然人	1	-
13	晶格共智	员工持股平台	1	员工持股平台，按 1 人计算
14	晶格共创	员工持股平台	1	员工持股平台，按 1 人计算
15	晶格共赢	员工持股平台	1	员工持股平台，按 1 人计算
16	晶格顶峰	员工持股平台	1	员工持股平台，按 1 人计算
17	晶格未来	员工持股平台	1	员工持股平台，按 1 人计算
18	晶艺求精	员工持股平台	24	停牌前 6 个月内入股的员工持股平台，穿透后新增 24 人

序号	交易对方姓名/名称	股东类型	穿透计算人数	说明
19	晶艺共治	员工持股平台	25	停牌前 6 个月内入股的员工持股平台，穿透后新增 25 人
20	融芯科技	有限公司	2	穿透后为 2 名自然人股东
21	高鹏翼盛	合伙企业	2	非专设有限合伙企业穿透至非专设法人主体及自然人
22	高鹏联盛	合伙企业	3	穿透后为 3 名自然人股东
23	腾元投资	私募基金	1	备案的私募基金，按 1 人计算
24	芯联启辰	私募基金	1	备案的私募基金，按 1 人计算
25	华天集团	股份公司	1	非专设法人股东，按 1 人计算
26	天利投资	合伙企业	3	非专设有限合伙企业穿透至非专设法人主体及自然人
合计			**79**	

（七）交易对方穿透锁定情况

交易对方中晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治为标的公司员工持股平台，根据全体合伙人决议取得股份对价的上层自然人合伙人均进行了穿透锁定。

交易对方中融芯科技、高鹏联盛除持有标的公司股权外无其他对外投资，不属于以持有标的公司股权为目的而设立的主体，也非专为本次交易设立的主体。但基于审慎性考虑，本次交易前述交易对方的上层权益持有人所持有的标的公司股权间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的公司股权为目的的主体。

前述需穿透锁定的各层出资人均已出具了穿透锁定的承诺函。

第四章 交易标的基本情况

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100.00%股权。

一、基本情况

公司名称	晶艺半导体有限公司
统一社会信用代码	91510100MA64PH581M
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本	5,002.7596 万元
法定代表人	易坤
成立日期	2019 年 1 月 3 日
营业期限	2019 年 1 月 3 日至无固定期限
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层 1501 号
经营范围	计算机系统集成；集成电路及模块、半导体器件专用设备、电子产品设计、研发、销售并提供技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、历史沿革

（一）设立情况

2018 年 12 月 18 日，晶格微、晶格未来、上海巨鱼、一方贸易、YA XU、谭清、凌风、深圳模数共同签署《晶艺半导体有限公司章程》，约定共同以货币方式出资设立晶艺半导体，设立时注册资本为 5,000 万元。《公司章程》约定董事会为公司最高权力机构。

2019 年 1 月 3 日，国家工商管理总局下发（国）名称预核外字第[2018]2589 号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“晶艺半导体有限公司”。

2019 年 1 月 3 日，晶艺半导体取得成都高新区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510100MA64PH581M 的《营业执照》。

晶艺半导体成立时的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	晶格未来	1,450.00	29.00

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	晶格微	1,100.00	22.00
3	上海巨鱼	900.00	18.00
4	一方贸易	700.00	14.00
5	YA XU	525.00	10.50
6	谭清	250.00	5.00
7	凌风	50.00	1.00
8	深圳模数	25.00	0.50
合　计		**5,000.00**	**100.00**

注：根据《晶艺半导体有限公司投资协议》，上述股东中，除晶格未来、晶格微外的其他股东均为投资方股东。其中，一方贸易持有的 8%股权系为新的投资人进入预留的股权。

（二）历次增减资或股权转让情况

1、2019 年 7 月，第一次股权转让

2019 年 6 月 25 日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意：原股东一方贸易将其所持标的公司注册资本 50 万元（占比 1%，未实缴）以 0 元的价格转让给融芯科技，并约定相应股权的出资义务由融芯科技履行。其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，一方贸易与融芯科技签署《股权转让协议》。

2019 年 7 月 5 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	晶格未来	1,450.00	29.00
2	晶格微	1,100.00	22.00
3	上海巨鱼	900.00	18.00
4	一方贸易	650.00	13.00
5	YA XU	525.00	10.50
6	谭清	250.00	5.00
7	凌风	50.00	1.00
8	融芯科技	50.00	1.00
9	深圳模数	25.00	0.50
合　计		**5,000.00**	**100.00**

注：一方贸易持有的 7%股权系为新的投资人进入预留的股权。

2、2021 年 7 月，第二次股权转让

2021 年 7 月 14 日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意下述股权转让事项，其他股东一致同意放弃优先购买权。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让对价（万元）
一方贸易	益方众诚	300.00（已实缴）	300.00
	谭清	150.00（未实缴）	0.00
	上海巨鱼	200.00（未实缴）	0.00
晶格未来	晶格共智	600.00（实缴 306.84）	306.84
	晶格共创	225.00（已实缴）	225.00
	晶格共赢	215.00（已实缴）	215.00
	晶格顶峰	210.00（已实缴）	210.00

同日，相关股权转让双方签署了《股权转让协议》。本次晶格未来与晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰之间的股权转让系增加晶艺半导体员工持股平台。一方贸易与益方众诚之间的股权转让系同一控制下的内部调整。一方贸易与谭清、上海巨鱼之间的股权转让系预留给投资人的股权的再次分配，因未实缴出资，故相关方未实际支付对价，由受让方承继实缴出资义务。本次股权转让完成后，一方贸易设立时预留的投资人股权均分配完毕。

2021 年 7 月 16 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	晶格微	1,100.00	22.00
2	上海巨鱼	1,100.00	22.00
3	晶格共智	600.00	12.00
4	YA XU	525.00	10.50
5	谭清	400.00	8.00
6	益方众诚	300.00	6.00
7	晶格共创	225.00	4.50
8	晶格共赢	215.00	4.30
9	晶格顶峰	210.00	4.20
10	晶格未来	200.00	4.00

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
11	凌风	50.00	1.00
12	融芯科技	50.00	1.00
13	深圳模数	25.00	0.50
合计		**5,000.00**	**100.00**

3、2021 年 8 月，第三次股权转让

2021 年 8 月 30 日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意：原股东谭清将其所持标的公司注册资本 400 万元出资额（占比 8%，实缴 249.820779 万元，150.179221 万元未实缴）以 0 元的价格转让给其丈夫曾鸣。其他股东放弃优先购买权。同日，谭清与曾鸣签署了《股权转让协议》。

2021 年 8 月 30 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	晶格微	1,100.00	22.00
2	上海巨鱼	1,100.00	22.00
3	晶格共智	600.00	12.00
4	YA XU	525.00	10.50
5	曾鸣	400.00	8.00
6	益方众诚	300.00	6.00
7	晶格共创	225.00	4.50
8	晶格共赢	215.00	4.30
9	晶格顶峰	210.00	4.20
10	晶格未来	200.00	4.00
11	凌风	50.00	1.00
12	融芯科技	50.00	1.00
13	深圳模数	25.00	0.50
合计		**5,000.00**	**100.00**

4、2022 年 5 月，第一次增资

2022 年 4 月 19 日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意：（1）公司注册资本由 5,000 万元增加至 5,102.0408 万元，新增的 102.0408 万元注册资本由新股东美的投资投资 6,000 万元以货币形式认缴；（2）公司最高权力机构

变更为股东会。同日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意本次增资事项，其他股东一致同意放弃优先认购权。本次增资价格为 58.80 元/1 元注册资本。

2022 年 5 月 18 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次增资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	晶格微	1,100.0000	21.5600
2	上海巨鱼	1,100.0000	21.5600
3	晶格共智	600.0000	11.7600
4	YA XU	525.0000	10.2900
5	曾鸣	400.0000	7.8400
6	益方众诚	300.0000	5.8800
7	晶格共创	225.0000	4.4100
8	晶格共赢	215.0000	4.2140
9	晶格顶峰	210.0000	4.1160
10	晶格未来	200.0000	3.9200
11	美的投资	102.0408	2.0000
12	凌风	50.0000	0.9800
13	融芯科技	50.0000	0.9800
14	深圳模数	25.0000	0.4900
合计		**5,102.0408**	**100.0000**

5、2023 年 4 月，晶艺半导体吸收合并晶格微

2022 年 12 月 9 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意：晶艺半导体吸收合并晶格微，合并后晶艺半导体为存续公司，晶格微注销。晶艺半导体和晶格微的债权债务由合并后存续的晶艺半导体承担。同日，晶艺半导体与晶格微签署《合并协议》。晶格微被吸收合并前注册资本为 1,100 万元，股东易坤、李伊珂、曾浩分别持有其 63.63%、31.82%、4.55%的股权。

根据晶艺半导体出具的《债务清偿及债务担保说明》，晶艺半导体与晶格微于 2022 年 12 月 9 日在《四川经济日报》刊登了吸收合并公告，公告期限自

2022 年 12 月 9 日至 2023 年 1 月 23 日。

2023 年 4 月 6 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。晶格微于 2023 年 3 月 23 日注销。

本次吸收合并完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海巨鱼	1,100.0000	21.5600
2	易坤	699.9300	13.7186
3	晶格共智	600.0000	11.7600
4	YA XU	525.0000	10.2900
5	曾鸣	400.0000	7.8400
6	李伊珂	350.0200	6.8604
7	益方众诚	300.0000	5.8800
8	晶格共创	225.0000	4.4100
9	晶格共赢	215.0000	4.2140
10	晶格顶峰	210.0000	4.1160
11	晶格未来	200.0000	3.9200
12	美的投资	102.0408	2.0000
13	曾浩	50.0500	0.9810
14	凌风	50.0000	0.9800
15	融芯科技	50.0000	0.9800
16	深圳模数	25.0000	0.4900
合计		**5,102.0408**	**100.0000**

6、2023 年 10 月，第二次增资

2023 年 10 月 11 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 5,102.0408 万元增加至 5,386.2974 万元，新增的 284.2566 万元注册资本由 6 名新股东以货币形式认缴，其中高鹏翼盛投资 7,800 万元认缴 113.7026 万元注册资本；高鹏联盛投资 2,200 万元认缴 32.07 万元注册资本；腾元投资投资 1,000 万元认缴 14.5773 万元注册资本；天利投资投资 2,000 万元认缴 29.1545 万元注册资本；易荣坤投资 1,500 万元认缴 21.8659 万元注册资本；润科上海投资 5,000 万元认缴 72.8863 万元注册资本。本次增资价格为 68.60 元/1 元注册资本。

2023 年 10 月 12 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次增资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.4222
2	易坤	699.9300	12.9946
3	晶格共智	600.0000	11.1394
4	YA XU	525.0000	9.7470
5	曾鸣	400.0000	7.4263
6	李伊珂	350.0200	6.4983
7	益方众诚	300.0000	5.5697
8	晶格共创	225.0000	4.1773
9	晶格共赢	215.0000	3.9916
10	晶格顶峰	210.0000	3.8988
11	晶格未来	200.0000	3.7131
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1110
13	美的投资	102.0408	1.8945
14	润科上海	72.8863	1.3532
15	曾浩	50.0500	0.9292
16	凌风	50.0000	0.9283
17	融芯科技	50.0000	0.9283
18	高鹏联盛	32.0700	0.5954
19	天利投资	29.1545	0.5413
20	深圳模数	25.00	0.4641
21	易荣坤	21.8659	0.4060
22	腾元投资	14.5773	0.2706
合计		**5,386.2974**	**100.0000**

7、2024 年 6 月，第四次股权转让

2024 年 7 月 18 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意：原股东易坤、李伊珂、YA XU 将其合计所持晶艺半导体注册资本 93.4439 万元出资额（占比 1.7348%）以合计 5,000 万元的价格转让给上海芯琏。其他股东一致同意放弃优先购买权。

2024 年 6 月 12 日，易坤、李伊珂、YA XU 与上海芯琏共同签署了《关于晶艺半导体有限公司之股权转让协议》。

2024 年 8 月 15 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.4222
2	易坤	644.4866	11.9653
3	晶格共智	600.0000	11.1394
4	YA XU	514.7212	9.5561
5	曾鸣	400.0000	7.4263
6	李伊珂	322.2983	5.9837
7	益方众诚	300.0000	5.5697
8	晶格共创	225.0000	4.1773
9	晶格共赢	215.0000	3.9916
10	晶格顶峰	210.0000	3.8988
11	晶格未来	200.0000	3.7131
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1110
13	美的投资	102.0408	1.8945
14	上海芯琏	93.4439	1.7348
15	润科上海	72.8863	1.3532
16	曾浩	50.0500	0.9292
17	凌风	50.0000	0.9283
18	融芯科技	50.0000	0.9283
19	高鹏联盛	32.0700	0.5954
20	天利投资	29.1545	0.5413
21	深圳模数	25.0000	0.4641
22	易荣坤	21.8659	0.4060
23	腾元投资	14.5773	0.2706
合计		**5,386.2974**	**100.0000**

8、2024 年 12 月，第一次减资

2024 年 10 月 31 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意晶艺半导

体注册资本由 5,386.2974 万元减少至 5,313.4111 万元，润科上海减少 72.8863 万元注册资本并退出晶艺半导体。

2024 年 11 月 1 日，晶艺半导体与润科上海签署了《减资协议》。

根据晶艺半导体出具的《有关债务清偿及担保情况说明》，晶艺半导体于 2024 年 10 月 31 日在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，公告期限自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 16 日。

2024 年 12 月 18 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次减资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.7023
2	易坤	644.4866	12.1294
3	晶格共智	600.0000	11.2922
4	YA XU	514.7212	9.6872
5	曾鸣	400.0000	7.5281
6	李伊珂	322.2983	6.0658
7	益方众诚	300.0000	5.6461
8	晶格共创	225.0000	4.2346
9	晶格共赢	215.0000	4.0464
10	晶格顶峰	210.0000	3.9523
11	晶格未来	200.0000	3.7641
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1399
13	美的投资	102.0408	1.9204
14	上海芯琏	93.4439	1.7586
15	曾浩	50.0500	0.9420
16	凌风	50.0000	0.9410
17	融芯科技	50.0000	0.9410
18	高鹏联盛	32.0700	0.6036
19	天利投资	29.1545	0.5487
20	深圳模数	25.0000	0.4705
21	易荣坤	21.8659	0.4115

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
22	腾元投资	14.5773	0.2743
合计		**5,313.4111**	**100.0000**

9、2025 年 12 月，第五次股权转让

2025 年 12 月 16 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意如下股权转让事项，其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，股权转让双方签署了《关于晶艺半导体有限公司之股权转让协议》，具体转让情况如下：

转让方	受让方	出资额（万元）	股权比例（%）	转让对价（万元）
李伊珂	高鹏翼盛	322.2983	6.0658	3,948.8041
益方众诚	高鹏翼盛	300.0000	5.6461	3,675.6049
深圳模数	高鹏翼盛	25.0000	0.4705	306.3004
上海巨鱼	高鹏翼盛	74.9309	1.4102	918.0546
	高鹏联盛	203.7059	3.8338	2,495.8080
	腾元投资	92.5938	1.7426	1,134.4608
	华天集团	185.1871	3.4853	2,268.9154
	芯联启辰	404.6920	7.6164	4,958.2930
	陈艺琴	138.8903	2.6140	1,701.6862
合计		**1,747.2983**	**32.8847**	**21,407.9274**

2025 年 12 月 25 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	高鹏翼盛	835.9318	15.7325
2	易坤	644.4866	12.1294
3	晶格共智	600.0000	11.2922
4	YA XU	514.7212	9.6872
5	芯联启辰	404.6920	7.6164
6	曾鸣	400.0000	7.5281
7	高鹏联盛	235.7759	4.4374
8	晶格共创	225.0000	4.2346
9	晶格共赢	215.0000	4.0464

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
10	晶格顶峰	210.0000	3.9523
11	晶格未来	200.0000	3.7641
12	华天集团	185.1871	3.4853
13	陈艺琴	138.8903	2.6140
14	腾元投资	107.1711	2.0170
15	美的投资	102.0408	1.9204
16	上海芯琏	93.4439	1.7586
17	曾浩	50.0500	0.9420
18	凌风	50.0000	0.9410
19	融芯科技	50.0000	0.9410
20	天利投资	29.1545	0.5487
21	易荣坤	21.8659	0.4115
合计		**5,313.4111**	**100.0000**

10、2026 年 1 月，第三次增资

2025 年 12 月 26 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,313.4111 万元增加至 5,333.4111 万元，新增的 20 万元注册资本由原股东易坤投资 151.2 万元以货币形式认缴 20 万元。

2026 年 1 月 5 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次增资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	高鹏翼盛	835.9318	15.6735
2	易坤	664.4866	12.4589
3	晶格共智	600.0000	11.2498
4	YA XU	514.7212	9.6509
5	芯联启辰	404.6920	7.5879
6	曾鸣	400.0000	7.4999
7	高鹏联盛	235.7759	4.4207
8	晶格共创	225.0000	4.2187
9	晶格共赢	215.0000	4.0312

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
10	晶格顶峰	210.0000	3.9374
11	晶格未来	200.0000	3.7499
12	华天集团	185.1871	3.4722
13	陈艺琴	138.8903	2.6042
14	腾元投资	107.1711	2.0094
15	美的投资	102.0408	1.9132
16	上海芯琏	93.4439	1.7520
17	曾浩	50.0500	0.9384
18	融芯科技	50.0000	0.9375
19	凌风	50.0000	0.9375
20	天利投资	29.1545	0.5466
21	易荣坤	21.8659	0.4100
合计		**5,333.4111**	**100.0000**

11、2026 年 3 月，第二次减资

2026 年 1 月 6 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,333.4111 万元减少至 5,002.7596 万元，其中：美的投资减少 102.0408 万元注册资本并退出晶艺半导体；天利投资减少 21.8659 万元注册资本；高鹏翼盛减少 85.2770 万元注册资本；高鹏联盛减少 24.0525 万元注册资本；腾元投资减少 10.9330 万元注册资本；易荣坤减少 16.3994 万元注册资本；上海芯琏减少 70.0829 万元注册资本。

根据晶艺半导体出具的《有关债务清偿及担保的情况说明》，晶艺半导体于 2026 年 1 月 6 日在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，公告期限自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 2 月 21 日。

2026 年 3 月 4 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次减资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	高鹏翼盛	750.6548	15.0048
2	高鹏联盛	211.7234	4.2321

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
3	易坤	664.4866	13.2824
4	晶格共智	600.0000	11.9934
5	YA XU	514.7212	10.2888
6	芯联启辰	404.6920	8.0894
7	上海芯琏	23.3610	0.4670
8	曾鸣	400.0000	7.9956
9	晶格共创	225.0000	4.4975
10	晶格共赢	215.0000	4.2976
11	晶格顶峰	210.0000	4.1977
12	晶格未来	200.0000	3.9978
13	华天集团	185.1871	3.7017
14	天利投资	7.2886	0.1457
15	陈艺琴	138.8903	2.7763
16	腾元投资	96.2381	1.9237
17	曾浩	50.0500	1.0004
18	融芯科技	50.0000	0.9994
19	凌风	50.0000	0.9994
20	易荣坤	5.4665	0.1093
合计		**5,002.7596**	**100.0000**

12、2026 年 3 月，第六次股权转让

2026 年 3 月 4 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意如下股权转让事项，其他股东一致同意放弃优先购买权。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	出资额（万元）	转让对价（万元）
高鹏翼盛	晶艺求精	140.8023	1,064.4653
	李六军	144.4444	1,091.9997
高鹏联盛	晶艺求精	51.6232	390.2714
	李六军	28.8311	217.9631
腾元投资	晶艺共治	36.5702	276.470712
芯联启辰	晶艺共治	39.8344	301.148064
	易坤	20.0000	151.2000
	薛峰	40.0000	302.4000
	陈国栋	40.0000	302.4000

转让方	受让方	出资额（万元）	转让对价（万元）
	苏鹏飞	20.0000	151.2000
华天集团	晶艺共治	67.1530	507.67668
	晶艺求精	5.9872	45.263232
陈艺琴	晶艺共治	54.8551	414.704556

2026 年 3 月 10 日，上述股权转让双方签署了《关于晶艺半导体之股权转让协议》。

2026 年 3 月 19 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	晶格共智	600.0000	11.9934
3	晶格共创	225.0000	4.4975
4	晶格共赢	215.0000	4.2976
5	晶格顶峰	210.0000	4.1977
6	晶格未来	200.0000	3.9978
7	YA XU	514.7212	10.2888
8	曾鸣	400.0000	7.9956
9	晶艺求精	198.4127	3.9661
10	晶艺共治	198.4127	3.9661
11	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
12	高鹏联盛	131.2691	2.6239
13	腾元投资	59.6679	1.1927
14	芯联启辰	244.8576	4.8945
15	上海芯琏	23.3610	0.4670
16	华天集团	112.0469	2.2397
17	天利投资	7.2886	0.1457
18	李六军	173.2755	3.4636
19	融芯科技	50.0000	0.9994
20	曾浩	50.0500	1.0004
21	凌风	50.0000	0.9994

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
22	薛峰	40.0000	0.7996
23	陈国栋	40.0000	0.7996
24	苏鹏飞	20.0000	0.3998
25	陈艺琴	84.0352	1.6798
26	易荣坤	5.4665	0.1093
合计		**5,002.7596**	**100.0000**

13、2026 年 3 月，第七次股权转让

2026 年 3 月 18 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意：原股东上海芯琏将其所持公司注册资本 23.3610 万元出资额（占比 0.4670%）转让给芯联启辰。上海芯琏与芯联启辰签署了《股权转让协议》。

2026 年 3 月 24 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	YA XU	514.7212	10.2888
3	曾鸣	400.0000	7.9956
4	晶格共智	600.0000	11.9934
5	晶格共创	225.0000	4.4975
6	晶格共赢	215.0000	4.2976
7	晶格顶峰	210.0000	4.1977
8	晶格未来	200.0000	3.9978
9	晶艺求精	198.4127	3.9661
10	晶艺共治	198.4127	3.9661
11	李六军	173.2755	3.4636
12	融芯科技	50.0000	0.9994
13	曾浩	50.0500	1.0004
14	凌风	50.0000	0.9994
15	薛峰	40.0000	0.7995
16	陈国栋	40.0000	0.7995

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
17	苏鹏飞	20.0000	0.3998
18	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
19	高鹏联盛	131.2691	2.6239
20	腾元投资	59.6679	1.1927
21	陈艺琴	84.0352	1.6798
22	易荣坤	5.4665	0.1093
23	芯联启辰	268.2186	5.3615
24	华天集团	112.0469	2.2397
25	天利投资	7.2886	0.1457
合计		**5,002.7596**	**100.0000**

14、2026 年 3 月，第八次股权转让

2026 年 3 月 18 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意：原股东曾鸣将其所持公司注册资本 200 万元出资额（占比 3.9978%）以 0 元的价格转让给其子曾岳琦。同日，曾鸣与曾岳琦签署了《股权转让协议》。

2026 年 5 月 15 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	YA XU	514.7212	10.2888
3	曾鸣	200.0000	3.9978
4	曾岳琦	200.0000	3.9978
5	晶格共智	600.0000	11.9934
6	晶格共创	225.0000	4.4975
7	晶格共赢	215.0000	4.2976
8	晶格顶峰	210.0000	4.1977
9	晶格未来	200.0000	3.9978
10	晶艺求精	198.4127	3.9661
11	晶艺共治	198.4127	3.9661
12	李六军	173.2755	3.4636

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
13	融芯科技	50.0000	0.9994
14	曾浩	50.0500	1.0004
15	凌风	50.0000	0.9994
16	薛峰	40.0000	0.7995
17	陈国栋	40.0000	0.7995
18	苏鹏飞	20.0000	0.3998
19	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
20	高鹏联盛	131.2691	2.6239
21	腾元投资	59.6679	1.1927
22	陈艺琴	84.0352	1.6798
23	易荣坤	5.4665	0.1093
24	芯联启辰	268.2186	5.3615
25	华天集团	112.0469	2.2397
26	天利投资	7.2886	0.1457
合计		**5,002.7596**	**100.0000**

（三）最近三年增减资、股权转让及改制、评估情况，与本次重组评估情况的差异原因

最近三年，标的公司增减资、股权转让具体情况详见本章“二、历史沿革”之“（二）历次增减资或股权转让情况”，标的公司最近三年增减资、股权转让背景及定价合理性具体如下：

1、增资情况如下：

时间	增资方	增资份额（万元）	增资对价（万元）	单价（元/1 元注册资本）	增资背景及定价合理性
2023 年 10 月	高鹏翼盛	113.70	7,800.00	68.60	标的公司进行 B 轮股权融资，根据一级市场融资情况谈判定价
	高鹏联盛	32.07	2,200.00	68.60	
	腾元投资	14.58	1,000.00	68.60	
	天利投资	29.15	2,000.00	68.60	
	易荣坤	21.87	1,500.00	68.60	
	润科上海	72.89	5,000.00	68.60	
2026 年 1 月	易坤	20.00	151.20	7.56	股权激励，参考标的公司

时间	增资方	增资份额（万元）	增资对价（万元）	单价（元/1 元注册资本）	增资背景及定价合理性
					当时净资产定价

2、减资情况如下：

时间	减资方	减资份额（万元）	减资金额（万元）	单价（元/1 元注册资本）	减资背景及定价合理性
2024 年 12 月	润科上海	72.89	5,448.00	74.75	股东基于自身原因退出，以投资成本为基础协商定价
2026 年 3 月	美的投资	102.04	7,563.33	74.12	股东基于自身原因退出，以投资成本为基础协商定价
	天利投资	21.87	1,770.00	80.95	
	高鹏翼盛	85.28	6,903.00	80.95	
	高鹏联盛	24.05	1,947.00	80.95	
	腾元投资	10.93	885.00	80.95	
	易荣坤	16.40	1,327.50	80.95	
	上海芯琏	70.08	3,750.00	53.51	

3、股权转让情况如下：

时间	转让方	受让方	转让份额（万元）	转让对价（万元）	单价（元/1 元注册资本）	转让背景及定价合理性
2024 年 6 月	易坤	上海芯琏	55.44	2,966.67	53.51	上海芯琏通过受让老股投资标的公司，参考 B 轮融资估值水平的基础上定价
	李伊珂	上海芯琏	27.72	1,483.33	53.51	
	YA XU	上海芯琏	10.28	550.00	53.51	
2025 年 12 月	李伊珂	高鹏翼盛	322.30	3,948.80	12.25	李伊珂及关联方决定退出标的公司，因本次股权转让方投资成本较低，经
	益方众诚	高鹏翼盛	300.00	3,675.60	12.25	
	深圳模数	高鹏翼盛	25.00	306.30	12.25	
	上海巨鱼	高鹏翼盛	74.93	918.05	12.25	
	上海巨鱼	高鹏联盛	203.71	2,495.81	12.25	
	上海巨鱼	腾元投资	92.59	1,134.46	12.25	

时间	转让方	受让方	转让份额（万元）	转让对价（万元）	单价（元/1元注册资本）	转让背景及定价合理性
	上海巨鱼	华天集团	185.19	2,268.92	12.25	各方协商一致确定价格
	上海巨鱼	芯联启辰	404.69	4,958.29	12.25	
	上海巨鱼	陈艺琴	138.89	1,701.69	12.25	
2026 年 3 月	高鹏翼盛	晶艺求精	140.80	1,064.47	7.56	外部投资人对标的公司管理层及核心员工的股权激励，参考标的公司当时净资产确定转让价格
	高鹏翼盛	李六军	144.44	1,092.00	7.56	
	高鹏联盛	晶艺求精	51.62	390.27	7.56	
	高鹏联盛	李六军	28.83	217.96	7.56	
	腾元投资	晶艺共治	36.57	276.47	7.56	
	芯联启辰	晶艺共治	39.83	301.15	7.56	
	芯联启辰	易坤	20.00	151.20	7.56	
	芯联启辰	薛峰	40.00	302.40	7.56	
	芯联启辰	陈国栋	40.00	302.40	7.56	
	芯联启辰	苏鹏飞	20.00	151.20	7.56	
	华天集团	晶艺共治	67.15	507.68	7.56	
	华天集团	晶艺求精	5.99	45.26	7.56	
	陈艺琴	晶艺共治	54.86	414.70	7.56	
2026 年 3 月	上海芯琏	芯联启辰	23.36	1,250.00	53.51	上海芯琏转让给同控主体，按照上海芯琏投资成本定价
2026 年 3 月	曾鸣	曾岳琦	200.00	-	-	曾鸣系曾岳琦父亲，0 元转让

最近三年内历次增减资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。除前述情况外，标的公司最近三年不存在其他增减资、股权转让及改制、评估情况。

标的公司近三年增资或股权转让对应作价均为市场化交易定价结果。根据金证评估出具的评估报告（金证评报字【2026】A0554 号），以 2026 年 2 月 28 日为基准日，标的公司截至 2026 年 2 月 28 日股东全部权益的账面值为 124,182.43 万元，评估值为 165,000.00 万元，增值率 304.24%。根据交易各方分

别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，经交易各方参考评估值协商确定，晶艺半导体 100.00%股权的交易价格为 165,000.00 万元，较最近三年股权变更的估值有所变化，主要系结合市场变化情况并以金证评估出具的评估报告为基础，经上市公司与全部交易对方磋商确认的结果。

（四）最近三年申请首次公开发行股票并上市或申请新三板挂牌或作为重大资产重组交易标的的情况

除本次交易外，标的公司最近三年内不存在申请首次公开发行股票并上市或申请新三板挂牌或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况。

三、股权结构及产权控制关系

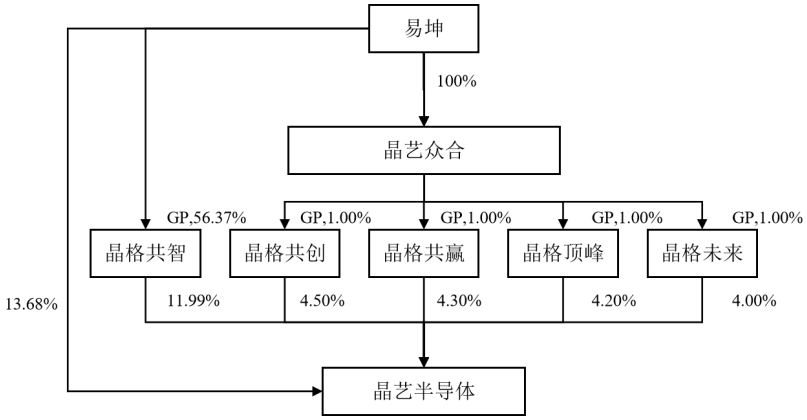
（一）股权结构图

截至本报告书签署日，晶艺半导体的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	晶格共智	600.0000	11.9934
3	晶格共创	225.0000	4.4975
4	晶格共赢	215.0000	4.2976
5	晶格顶峰	210.0000	4.1977
6	晶格未来	200.0000	3.9978
7	YA XU	514.7212	10.2888
8	曾鸣	200.0000	3.9978
9	曾岳琦	200.0000	3.9978
10	晶艺求精	198.4127	3.9661
11	晶艺共治	198.4127	3.9661
12	李六军	173.2755	3.4636
13	融芯科技	50.0000	0.9994
14	曾浩	50.0500	1.0004
15	凌风	50.0000	0.9994
16	薛峰	40.0000	0.7995
17	陈国栋	40.0000	0.7995
18	苏鹏飞	20.0000	0.3998

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
19	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
20	高鹏联盛	131.2691	2.6239
21	腾元投资	59.6679	1.1927
22	陈艺琴	84.0352	1.6798
23	易荣坤	5.4665	0.1093
24	芯联启辰	268.2186	5.3615
25	华天集团	112.0469	2.2397
26	天利投资	7.2886	0.1457
合计		**5,002.7596**	**100.0000**

标的公司的产权控制关系如下图所示：



（二）控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，易坤直接持有晶艺半导体 13.68%股权，并通过控制晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等主体控制晶艺半导体 28.98%股权，合计控制晶艺半导体 42.67%股权，为晶艺半导体实际控制人。

（三）标的公司股权是否清晰，是否涉及抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况

截至本报告书签署日，标的公司股权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，标的公司股权不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排、是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

晶艺半导体在引入高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、天利投资、易荣坤等投资者（合称“特殊权利投资者”）时，晶艺半导体与特殊权利投资者签署的相关投资协议，约定了回购、优先清算等特殊权利条款（以下简称“特殊权利安排”）。

2026 年 4 月 22 日，晶艺半导体与特殊权利投资者已签署《关于晶艺半导体有限公司之股东协议之补充协议二》，约定自该协议生效之日起原存在的股东特殊权利条款终止，其中标的公司承担义务的优先清算权、回购权终止且自始无效；各方确认不存在其它股东特殊权利、业绩对赌与承诺履行相关的书面或口头约定，投资方不存在其他特殊权利，各方对此不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本报告书签署日，标的公司章程及相关投资协议中不存在可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议，不存在高级管理人员的特殊安排，不存在影响资产独立性的协议或其他安排。

（五）本次拟购买资产为标的公司控股权

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权，本次交易完成后上市公司将直接持有晶艺半导体 100%的股权，标的公司将成为上市公司的全资子公司。

四、下属企业构成

截至本报告书签署日，晶艺半导体拥有 1 家全资子公司、2 家分公司，不存在构成标的公司最近一期经审计的资产总额、净资产、营业收入或净利润来源百分之二十以上且有重大影响的子公司。相关下属企业具体情况如下：

（一）香港晶艺

名称	香港晶艺半导体有限公司 HONG KONG LATTICE ART SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
注册办事处	Unit 221, 2/F Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong
商业登记号码	71491278
股本总额	100 万港元
成立日期	2019 年 12 月 23 日

持股情况	晶艺半导体持股 100%
主营业务	半导体销售推广业务

（二）晶艺半导体有限公司深圳分公司

企业名称	晶艺半导体有限公司深圳分公司
统一社会信用代码	91440300MA5H0MYR94
企业类型	外商投资企业分公司
负责人	易坤
成立日期	2021 年 9 月 24 日
经营期限	2021 年 9 月 24 日至无固定期限
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋大厦 2101-01B
经营范围	一般经营项目是：信息系统集成服务；集成电路销售；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

（三）晶艺半导体有限公司上海分公司

企业名称	晶艺半导体有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310000MABXW51U72
企业类型	分公司
负责人	易坤
成立日期	2022 年 9 月 23 日
经营期限	2022 年 9 月 23 日无固定期限
注册地址	上海市闵行区闵虹路 166 弄 1 号 807 室
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；半导体分立器件销售；专业设计服务；机械设备研发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产情况

根据天健会计师出具的《审计报告》，截至 2026 年 2 月 28 日，晶艺半导体主要资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日
货币资金	24,352.74
应收账款	8,760.98
预付款项	787.25
其他应收款	352.80
存货	10,253.20
一年内到期的非流动资产	3,257.97
其他流动资产	5,751.13
流动资产合计	**53,516.07**
固定资产	1,068.10
在建工程	1.29
使用权资产	1,182.99
无形资产	129.78
长期待摊费用	45.50
递延所得税资产	508.02
其他非流动资产	4.01
非流动资产合计	**2,939.69**
资产总计	**56,455.75**

1、土地使用权及房屋所有权

截至本报告书签署日，晶艺半导体及其子公司无土地使用权及房屋所有权。

2、租赁资产

截至报告期末，晶艺半导体及其子公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	租赁期限	租赁面积（㎡）	用途
1	晶艺半导体	四川龙天物业管理有限公司	成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层 1501 号（自编号）	2026.02.01-2031.01.31	2,444.07	办公
2	晶艺半导体	成都天河中西医科技保育有限公司	成都生物与医药产业孵化园项目 1 号楼 A 座 1 层 5、6 号	2026.01.01-2026.12.31	413.37	办公
3	晶艺半导体	四川兴盛皮革制品有限公司	成都市金牛区高科技产业园信息园西路 81 号 1 栋 14 层 1402 号	2025.05.20-2026.05.19（注）	104.50	办公
4	晶艺半导体	成都景浩物流有限公司	成都双流物流园 A1 号库 7 分区	2024.05.01-2027.04.30	1,040.09	仓储

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	租赁期限	租赁面积（㎡）	用途
5	晶艺半导体	上海诚二德装饰设计工程有限公司	上海市闵行区闵虹路 166 弄 T1 号楼	2024.11.01-2026.10.31	143.78	办公
6	晶艺半导体	深圳市星河雅兴投资发展有限公司	深圳市龙岗区雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋大厦 21F 层 5-F2101B 号	2023.10.20-2026.10.19	240.98	办公
7	晶艺半导体	佛山市韵得物业管理有限公司	佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 9 号云谷广场 D5 栋 306 室	2025.06.10-2026.07.08（注）	88.30	办公

注：截至本报告书签署日，上述 3、7 租赁房产已经退租。

晶艺半导体上述房屋租赁均已取得房屋产权证书、第 2-7 项房产租赁未办理租赁备案，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同效力”。因此上述未办理租赁备案情形不影响租赁合同的效力，晶艺半导体及其子公司与相关出租方签订的租赁合同合法有效。未办理租赁房屋登记备案手续的房屋可替代性较强，不会对标的公司生产经营造成重大不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

3、知识产权

（1）商标

截至报告期末，晶艺半导体及其子公司拥有的注册商标共 2 项，具体情况如下：

序号	权利人	商标名称	注册号	类别	注册有效期	取得方式	他项权利
1	晶艺半导体		69541878	9 类 科学仪器	2024.11.28-2034.11.27	原始取得	无
2	晶艺半导体	LASemi	43408288	35 类 广告销售	2020.11.28-2030.11.27	原始取得	无

（2）专利

截至报告期末，晶艺半导体及其子公司拥有的已授权专利共 62 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	期限	取得方式	他项权利
1	晶艺半导体	发明	电压转换集成电路、高压 BUCK 变换器及控制方法	201910140949.4	2019.02.26	20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	期限	取得方式	他项权利
2	晶艺半导体	发明	主动式假性负载、开关电源变换器及控制方法	201910447677.2	2019.05.27	20 年	原始取得	无
3	晶艺半导体	发明	准谐振控制电路及其谷底开通方法	201910795474.2	2019.08.27	20 年	原始取得	无
4	晶艺半导体	发明	用于高压 BUCK 开关变换器的控制电路及方法	201910886049.4	2019.09.19	20 年	原始取得	无
5	晶艺半导体	发明	无刷电机电流调节器、电机系统和控制方法	201910898755.0	2019.09.23	20 年	原始取得	无
6	晶艺半导体	发明	短路检测电路及检测方法	201910899174.9	2019.09.23	20 年	原始取得	无
7	晶艺半导体	发明	关断时间补偿电路、补偿方法及开关变换器	201910898759.9	2019.09.23	20 年	原始取得	无
8	晶艺半导体	发明	一种准谷底控制电路和方法及其开关变换器	202010831423.3	2020.08.18	20 年	原始取得	无
9	晶艺半导体	发明	一种高电源抑制比负载开关电路及其控制方法	202110586319.7	2021.05.27	20 年	原始取得	无
10	晶艺半导体	发明	多相开关变换器级联系统及其电压变换电路	202111434737.0	2021.11.29	20 年	原始取得	无
11	晶艺半导体	发明	用于功率因数校正的控制方法和电路	202111572004.3	2021.12.21	20 年	原始取得	无
12	晶艺半导体	发明	具有斜坡补偿的控制电路及方法	202210141818.X	2022.02.16	20 年	原始取得	无
13	晶艺半导体	发明	COT 控制电路和方法	202210277078.2	2022.03.21	20 年	原始取得	无
14	晶艺半导体	发明	采样保持刷新电路、方法及电子装置	202210306639.7	2022.03.25	20 年	原始取得	无
15	晶艺半导体	发明	COT 控制电路、方法以及相关集成电路	202210425274.X	2022.04.21	20 年	原始取得	无
16	晶艺半导体	发明	BUCK-BOOST 的控制电路、方法及变换器	202210473442.2	2022.04.29	20 年	原始取得	无
17	晶艺半导体	发明	基于 FLYBACK 的功率因数校正电路的控制电路和方法	202210619410.9	2022.06.01	20 年	原始取得	有，详见附注
18	晶艺半导体	发明	双电压定频控制电路、变换器及方法	202210692478.X	2022.06.17	20 年	原始取得	无
19	晶艺半导体	发明	LED 调光系统及其控制电路和方法	202210873656.9	2022.07.21	20 年	原始取得	无
20	晶艺半导体	发明	一种乘法器电路	202210871567.0	2022.07.22	20 年	原始取得	无
21	晶艺半导体	发明	开关集成电路、开关电源系统以及控制方法	202211060309.0	2022.08.31	20 年	原始取得	无
22	晶艺半导体	发明	电源系统的控制电路、供电电压产生电路及刷新方法	202211535297.2	2022.11.30	20 年	原始取得	无
23	晶艺半导体	发明	负载开关电路及其控制电路和自举电压产生方法	202211597404.4	2022.12.12	20 年	原始取得	无
24	晶艺半导体	发明	开关变换器的驱动控制电路及驱动方法	202211698414.7	2022.12.28	20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	期限	取得方式	他项权利
25	晶艺半导体	发明	斜坡补偿电路及相关控制电路和方法	202310026665.9	2023.01.09	20 年	原始取得	无
26	晶艺半导体	发明	一种温度检测模块和过温保护电路	202310107296.6	2023.02.14	20 年	原始取得	无
27	晶艺半导体	发明	电压电流双环控制电路、方法以及开关变换器	202310256477.5	2023.03.16	20 年	原始取得	无
28	晶艺半导体	发明	用于开关变换器的控制电路、系统及方法	202310409445.4	2023.04.18	20 年	原始取得	无
29	晶艺半导体	发明	半导体合封器件及其过温保护电路和方法	202311387952.9	2023.10.25	20 年	原始取得	无
30	晶艺半导体	发明	用于合封器件的过温保护电路、方法及半导体器件	202311387951.4	2023.10.25	20 年	原始取得	无
31	晶艺半导体	发明	应用于功率开关的驱动电路及电源管理芯片	202311416086.1	2023.10.30	20 年	原始取得	无
32	晶艺半导体	发明	带欠压保护的启动电路和控制电路	202311423137.3	2023.10.31	20 年	原始取得	无
33	晶艺半导体	发明	直流无刷电机的启动电路、驱动装置及方法	202311597199.6	2023.11.28	20 年	原始取得	无
34	晶艺半导体	发明	用于 Boost 电路的过零检测电路、启动电路及过零检测方法	202311642414.X	2023.12.04	20 年	原始取得	无
35	晶艺半导体	发明	一种应用于 POE 系统的通信握手电路及方法	202311737831.2	2023.12.18	20 年	原始取得	无
36	晶艺半导体	发明	钳位电路、模拟光耦电路及隔离驱动电路	202311763395.6	2023.12.21	20 年	原始取得	无
37	晶艺半导体	发明	一种斜坡信号产生电路及产生方法	202311849202.9	2023.12.29	20 年	原始取得	无
38	晶艺半导体	发明	驱动电路及其驱动方法、控制电路以及电源芯片	202310225123.4	2023.03.10	20 年	原始取得	无
39	晶艺半导体	发明	电源系统的控制电路和控制方法	202310318123.9	2023.03.29	20 年	原始取得	无
40	晶艺半导体	发明	高精度电流控制的负载开关电路及其修调方法	202310584648.7	2023.05.23	20 年	原始取得	无
41	晶艺半导体	发明	芯片均压测试系统	202310487185.2	2023.05.04	20 年	原始取得	无
42	晶艺半导体	发明	直流无刷电机折线调速控制电路和方法	202310653474.5	2023.06.03	20 年	原始取得	无
43	晶艺半导体	发明	具有超前角的换相控制电路、电机系统及换相控制方法	202310848693.9	2023.07.12	20 年	原始取得	无
44	晶艺半导体	发明	一种用于步进电机系统的微步驱动电路和方法	202310906436.6	2023.07.24	20 年	原始取得	无
45	晶艺半导体	发明	用于电机驱动的软换相控制电路、方法及电机驱动系统	202410199684.6	2024.02.23	20 年	原始取得	无
46	晶艺半导体	发明	电压比较电路、控制方法及 BOOST 开关变换器	202410496916.4	2024.04.24	20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	期限	取得方式	他项权利
47	晶艺半导体	发明	开关电源系统及其控制电路和方法	202410670114.0	2024.05.28	20 年	原始取得	无
48	晶艺半导体	发明	一种电平转换电路及其抗干扰方法	202410004155.6	2024.01.03	20 年	原始取得	无
49	晶艺半导体	发明	低压差线性稳压电路	202411873247.4	2024.12.18	20 年	原始取得	无
50	晶艺半导体	实用新型	功率模块的封装框架，封装框架阵列及封装体	201921189699.5	2019.07.26	10 年	原始取得	无
51	晶艺半导体	实用新型	用于开关变换器的集成电路和 SOP 封装结构	202222959189.X	2022.11.07	10 年	原始取得	无
52	晶艺半导体	实用新型	一种用于高压 BUCK 开关电源芯片的封装体	202223111700.7	2022.11.17	10 年	原始取得	无
53	晶艺半导体	实用新型	一种电平转换电路	202223594990.5	2022.12.30	10 年	原始取得	无
54	晶艺半导体	实用新型	一种用于芯片测试的继电器扩容电路	202321683989.1	2023.06.30	10 年	原始取得	无
55	晶艺半导体	实用新型	芯片封装结构	202323669774.7	2023.12.29	10 年	原始取得	无
56	晶艺半导体	实用新型	一种应用于开关变换器的自举电压充电电路	202420870578.1	2024.04.24	10 年	原始取得	无
57	晶艺半导体	实用新型	封装结构及半导体器件	202421246466.5	2024.06.03	10 年	原始取得	无
58	晶艺半导体	实用新型	多端口充电系统	202422155992.7	2024.09.03	10 年	原始取得	无
59	晶艺半导体	实用新型	芯片封装结构和 PCB 线路板布线结构	202422513639.1	2024.10.17	10 年	原始取得	无
60	晶艺半导体	实用新型	双向 ESD 保护电路	202422604565.2	2024.10.28	10 年	原始取得	无
61	晶艺半导体	实用新型	一种芯片的等效阻抗测试电路	202423097833.2	2024.12.16	10 年	原始取得	无
62	晶艺半导体	实用新型	RC-IGBT 半导体器件及其版图结构	202423206389.3	2024.12.25	10 年	原始取得	无

注：2025 年 7 月 8 日，晶艺半导体与成都农村商业银行股份有限公司金牛支行签署《权利质押合同》（合同编号：成农商金公权质 20250014），将上表中第 17 项专利质押给成都农村商业银行股份有限公司金牛支行。

晶艺半导体的上述境内专利均合法、有效，除第 17 项专利外未设定质押，晶艺半导体及其子公司拥有的上述专利不存在重大权属争议、纠纷或潜在纠纷的情形。

（3）软件著作权

截至报告期末，晶艺半导体无软件著作权。

（4）集成电路布图设计专有权

截至报告期末，晶艺半导体及其子公司目前拥有的集成电路布图设计专有

权共 137 项，具体情况如下：

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
1	晶艺半导体	一种同步控制模式高输入宽范围 Buck 芯片	BS.195605071	2019.08.14	10 年	原始取得	无
2	晶艺半导体	一种最大 5 节低功耗低漏电锂电池保护芯片	BS.19560508X	2019.08.14	10 年	原始取得	无
3	晶艺半导体	一种 1.2A 电流能力、超高电源抑制比、固定压差、高精度限流的负载开关芯片	BS.205602010	2020.11.16	10 年	原始取得	无
4	晶艺半导体	一种可变速单相宽输入范围直流无刷电机驱动芯片	BS.205602053	2020.11.16	10 年	原始取得	无
5	晶艺半导体	一种采用 CRM 和 DCM 相结合控制模式，以实现全电压范围的电流失真低、功率因数接近 1 的功率矫正芯片	BS.205602037	2020.11.16	10 年	原始取得	无
6	晶艺半导体	一种超低静态功耗 Buck 芯片	BS.215656024	2021.11.16	10 年	原始取得	无
7	晶艺半导体	一种调速曲线可调的单相直流无刷电机驱动芯片	BS.215655990	2021.11.16	10 年	原始取得	无
8	晶艺半导体	一种带有可调恒流充电功能的 3A 同步 Buck 芯片	BS.215657500	2021.11.18	10 年	原始取得	无
9	晶艺半导体	一种用于 30A/650V IPM 的低侧 IGBT 驱动芯片	BS.215657608	2021.11.18	10 年	原始取得	无
10	晶艺半导体	一种 100V 高压 1A 异步 Buck 芯片	BS.215657535	2021.11.18	10 年	原始取得	无
11	晶艺半导体	一种 3A 频率可调的 Cot 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657519	2021.11.18	10 年	原始取得	无
12	晶艺半导体	一种原边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657659	2021.11.18	10 年	原始取得	无
13	晶艺半导体	一种用于低功率 IPM 的高压半桥驱动芯片	BS.215657616	2021.11.18	10 年	原始取得	无
14	晶艺半导体	一种副边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657551	2021.11.18	10 年	原始取得	无
15	晶艺半导体	一种高侧 Buck 控制芯片	BS.215657667	2021.11.18	10 年	原始取得	无
16	晶艺半导体	一种 3A COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657640	2021.11.18	10 年	原始取得	无
17	晶艺半导体	一种双通道 1A 负载开关芯片	BS.215657543	2021.11.18	10 年	原始取得	无
18	晶艺半导体	一种用于舞台灯/POS 机应用的步进电机驱动芯片	BS.215657586	2021.11.18	10 年	原始取得	无
19	晶艺半	一种带自举功能的高压	BS.21565756X	2021.11.18	10 年	原始	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
	导体	半桥驱动芯片				取得	
20	晶艺半导体	一种用于投影仪应用的步进电机驱动芯片	BS.215657594	2021.11.18	10 年	原始取得	无
21	晶艺半导体	一种带有低 THD 功能的原边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657675	2021.11.18	10 年	原始取得	无
22	晶艺半导体	一种 2A COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657624	2021.11.18	10 年	原始取得	无
23	晶艺半导体	一种 30A/650V IPM 的高侧驱动芯片	BS.215657578	2021.11.18	10 年	原始取得	无
24	晶艺半导体	一种 4A 1.6V~32V 宽输入范围高占空比 COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.225575183	2022.07.12	10 年	原始取得	无
25	晶艺半导体	一种最高输入 6V 输出 1A 电流 COT 控制模式 BUCK 芯片	BS.22559725X	2022.09.14	10 年	原始取得	无
26	晶艺半导体	LA26S30217	BS.235510955	2023.02.24	10 年	原始取得	无
27	晶艺半导体	LA21M20217	BS.235513156	2023.03.06	10 年	原始取得	无
28	晶艺半导体	LA25S20220	BS.235513172	2023.03.06	10 年	原始取得	无
29	晶艺半导体	LA26S20217	BS.235513210	2023.03.06	10 年	原始取得	无
30	晶艺半导体	LA26S10217	BS.235513237	2023.03.06	10 年	原始取得	无
31	晶艺半导体	LA16S40221	BS.235513253	2023.03.06	10 年	原始取得	无
32	晶艺半导体	LA13S20216	BS.235513164	2023.03.06	10 年	原始取得	无
33	晶艺半导体	LA25S10220	BS.235513180	2023.03.06	10 年	原始取得	无
34	晶艺半导体	LA16S50221	BS.235513245	2023.03.06	10 年	原始取得	无
35	晶艺半导体	LA00S10217	BS.235513423	2023.03.07	10 年	原始取得	无
36	晶艺半导体	LA25M10220	BS.235513393	2023.03.07	10 年	原始取得	无
37	晶艺半导体	LA16S30221	BS.235513458	2023.03.07	10 年	原始取得	无
38	晶艺半导体	RN14S10217	BS.235513431	2023.03.07	10 年	原始取得	无
39	晶艺半导体	LA16S20221	BS.235513415	2023.03.07	10 年	原始取得	无
40	晶艺半导体	LA00S10217	BS.23551344X	2023.03.07	10 年	原始取得	无
41	晶艺半	RN21S10220	BS.235513466	2023.03.07	10 年	原始	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
	导体					取得	
42	晶艺半导体	LA12M30220	BS.235513385	2023.03.07	10 年	原始取得	无
43	晶艺半导体	一种最高输入 18V 输出 5A 电流 COT 控制模式同步 BUCK 芯片	BS.225597268	2023.06.05	10 年	原始取得	无
44	晶艺半导体	LA23M10721	BS.235565024	2023.08.11	10 年	原始取得	无
45	晶艺半导体	LA31S10724	BS.235565113	2023.08.11	10 年	原始取得	无
46	晶艺半导体	LA23M30724	BS.235565016	2023.08.11	10 年	原始取得	无
47	晶艺半导体	LA61S10725	BS.235564850	2023.08.11	10 年	原始取得	无
48	晶艺半导体	LA10S20720	BS.23556480X	2023.08.11	10 年	原始取得	无
49	晶艺半导体	LA12S10724	BS.23556513X	2023.08.11	10 年	原始取得	无
50	晶艺半导体	LA23M20724	BS.235564982	2023.08.11	10 年	原始取得	无
51	晶艺半导体	LA10C20719	BS.23556561X	2023.08.14	10 年	原始取得	无
52	晶艺半导体	LA23S20721	BS.23556544X	2023.08.14	10 年	原始取得	无
53	晶艺半导体	LA28S20720	BS.23556558X	2023.08.14	10 年	原始取得	无
54	晶艺半导体	LA90C20721	BS.235565520	2023.08.14	10 年	原始取得	无
55	晶艺半导体	LA10S10719	BS.235565636	2023.08.14	10 年	原始取得	无
56	晶艺半导体	LA00C20719	BS.235565628	2023.08.14	10 年	原始取得	无
57	晶艺半导体	LA23S30721	BS.235565431	2023.08.14	10 年	原始取得	无
58	晶艺半导体	LA30S10720	BS.235565598	2023.08.14	10 年	原始取得	无
59	晶艺半导体	LA32M10719	BS.235565652	2023.08.14	10 年	原始取得	无
60	晶艺半导体	LA23S10721	BS.235565458	2023.08.14	10 年	原始取得	无
61	晶艺半导体	LA16S30721	BS.235565482	2023.08.14	10 年	原始取得	无
62	晶艺半导体	RN15S10719	BS.235565660	2023.08.14	10 年	原始取得	无
63	晶艺半导体	LA16S20721	BS.235565490	2023.08.14	10 年	原始取得	无
64	晶艺半	LA28S10720	BS.235565555	2023.08.14	10 年	原始	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
	导体					取得	
65	晶艺半导体	LA65S11121	BS.23560691X	2023.12.13	10 年	原始取得	无
66	晶艺半导体	LA03S11121	BS.235614092	2023.12.28	10 年	原始取得	无
67	晶艺半导体	LA20S11120	BS.235614033	2023.12.28	10 年	原始取得	无
68	晶艺半导体	LA03S21120	BS.235614114	2023.12.28	10 年	原始取得	无
69	晶艺半导体	LA20M11120	BS.235614106	2023.12.28	10 年	原始取得	无
70	晶艺半导体	LA12M41116	BS.235614076	2023.12.28	10 年	原始取得	无
71	晶艺半导体	LA18S51121	BS.235614238	2023.12.29	10 年	原始取得	无
72	晶艺半导体	LA10S11117	BS.235614300	2023.12.29	10 年	原始取得	无
73	晶艺半导体	LA01M11120	BS.235614254	2023.12.29	10 年	原始取得	无
74	晶艺半导体	LA18S31121	BS.235614173	2023.12.29	10 年	原始取得	无
75	晶艺半导体	LA18S41121	BS.235614181	2023.12.29	10 年	原始取得	无
76	晶艺半导体	LA18S11121	BS.235614149	2023.12.29	10 年	原始取得	无
77	晶艺半导体	LA18S21121	BS.235614157	2023.12.29	10 年	原始取得	无
78	晶艺半导体	LA125AL 系列	BS.24552150X	2024.04.02	10 年	原始取得	无
79	晶艺半导体	LA26S50408	BS.245536035	2024.05.22	10 年	原始取得	无
80	晶艺半导体	LA29S20409	BS.245536248	2024.05.22	10 年	原始取得	无
81	晶艺半导体	LA29S10409	BS.245536213	2024.05.22	10 年	原始取得	无
82	晶艺半导体	LA36S10409	BS.245536159	2024.05.22	10 年	原始取得	无
83	晶艺半导体	LA10C40411	BS.245536280	2024.05.22	10 年	原始取得	无
84	晶艺半导体	LA71S10408	BS.245536051	2024.05.22	10 年	原始取得	无
85	晶艺半导体	LA16S60411	BS.245536116	2024.05.22	10 年	原始取得	无
86	晶艺半导体	LA91C40409	BS.245536183	2024.05.22	10 年	原始取得	无
87	晶艺半导体	LA36S20409	BS.245536167	2024.05.22	10 年	原始取得	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
88	晶艺半导体	LA01H10415	BS.245536620	2024.05.23	10 年	原始取得	无
89	晶艺半导体	LA12C10411	BS.245536590	2024.05.23	10 年	原始取得	无
90	晶艺半导体	LA01H20416	BS.245536647	2024.05.23	10 年	原始取得	无
91	晶艺半导体	LA15C10415	BS.245536612	2024.05.23	10 年	原始取得	无
92	晶艺半导体	LA23S11101	BS.245599339	2024.12.09	10 年	原始取得	无
93	晶艺半导体	LA00C31031	BS.245599215	2024.12.09	10 年	原始取得	无
94	晶艺半导体	LA65S71120	BS.245599703	2024.12.10	10 年	原始取得	无
95	晶艺半导体	LA65S41120	BS.245599665	2024.12.10	10 年	原始取得	无
96	晶艺半导体	LA61S51119	BS.245599525	2024.12.10	10 年	原始取得	无
97	晶艺半导体	LA16S71120	BS.245600183	2024.12.10	10 年	原始取得	无
98	晶艺半导体	LA16S61120	BS.245599711	2024.12.10	10 年	原始取得	无
99	晶艺半导体	LA61S21119	BS.245599487	2024.12.10	10 年	原始取得	无
100	晶艺半导体	LA65S31120	BS.245599649	2024.12.10	10 年	原始取得	无
101	晶艺半导体	LA61S41119	BS.245599509	2024.12.10	10 年	原始取得	无
102	晶艺半导体	LA23S31106	BS.245599452	2024.12.10	10 年	原始取得	无
103	晶艺半导体	LA65S51120	BS.245599673	2024.12.10	10 年	原始取得	无
104	晶艺半导体	LA23S21106	BS.245599444	2024.12.10	10 年	原始取得	无
105	晶艺半导体	LA23S41106	BS.245599479	2024.12.10	10 年	原始取得	无
106	晶艺半导体	LA65S61120	BS.24559969X	2024.12.10	10 年	原始取得	无
107	晶艺半导体	LA65S21120	BS.245599614	2024.12.10	10 年	原始取得	无
108	晶艺半导体	LA61S31119	BS.245599495	2024.12.10	10 年	原始取得	无
109	晶艺半导体	LA16S81120	BS.24560023X	2024.12.10	10 年	原始取得	无
110	晶艺半导体	LA12S21112	BS.245600485	2024.12.11	10 年	原始取得	无
111	晶艺半导体	LA28S31114	BS.245600728	2024.12.11	10 年	原始取得	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
112	晶艺半导体	LA10C41115	BS.245600744	2024.12.11	10 年	原始取得	无
113	晶艺半导体	LA16S21113	BS.245600574	2024.12.11	10 年	原始取得	无
114	晶艺半导体	LA20S21108	BS.245600310	2024.12.11	10 年	原始取得	无
115	晶艺半导体	LA33M11111	BS.245600418	2024.12.11	10 年	原始取得	无
116	晶艺半导体	LA16S11113	BS.245600558	2024.12.11	10 年	原始取得	无
117	晶艺半导体	LA12C31115	BS.245600752	2024.12.11	10 年	原始取得	无
118	晶艺半导体	LA31U21108	BS.24560040X	2024.12.11	10 年	原始取得	无
119	晶艺半导体	LA00U21126	BS.245600817	2024.12.11	10 年	原始取得	无
120	晶艺半导体	LA16S31113	BS.245600582	2024.12.11	10 年	原始取得	无
121	晶艺半导体	LA91C51125	BS.245600701	2024.12.11	10 年	原始取得	无
122	晶艺半导体	LA63M11113	BS.24560068X	2024.12.11	10 年	原始取得	无
123	晶艺半导体	LA12S31113	BS.245600515	2024.12.11	10 年	原始取得	无
124	晶艺半导体	LA25S11125	BS.245600647	2024.12.11	10 年	原始取得	无
125	晶艺半导体	LA33S11112	BS.245600469	2024.12.11	10 年	原始取得	无
126	晶艺半导体	LA33S41125	BS.245600396	2024.12.11	10 年	原始取得	无
127	晶艺半导体	LA25S21125	BS.245600663	2024.12.11	10 年	原始取得	无
128	晶艺半导体	LA33S21122	BS.245600337	2024.12.11	10 年	原始取得	无
129	晶艺半导体	LA33S31122	BS.245600361	2024.12.11	10 年	原始取得	无
130	晶艺半导体	LA33S11120	BS.245600329	2024.12.11	10 年	原始取得	无
131	晶艺半导体	LA63M21113	BS.245600698	2024.12.11	10 年	原始取得	无
132	晶艺半导体	LA31U21125	BS.245600620	2024.12.11	10 年	原始取得	无
133	晶艺半导体	LA10H11118	BS.245600779	2024.12.11	10 年	原始取得	无
134	晶艺半导体	LA31U11125	BS.245600604	2024.12.11	10 年	原始取得	无
135	晶艺半导体	LA00U11126	BS.245600795	2024.12.11	10 年	原始取得	无

序号	权利人	名称	登记号	申请日	期限	取得方式	他项权利
136	晶艺半导体	LA26S61219	BS.24560345X	2024.12.19	10 年	原始取得	无
137	晶艺半导体	LA12C31219	BS.245603468	2024.12.19	10 年	原始取得	无

（5）域名

截至报告期末，晶艺半导体及其子公司拥有 2 项域名，具体情况如下：

序号	权利人	域名	网站备案许可证号	域名有效期
1	晶艺半导体	lasemi.cn	蜀 ICP 备 19017128 号-2	2022.02.18-2027.02.18
2	晶艺半导体	latticeart.com	蜀 ICP 备 19017128 号-1	2018.11.08-2026.11.08

4、固定资产

截至报告期末，标的公司的固定资产主要为机器设备、电子设备和办公设备。截至报告期末，标的公司固定资产原值 2,487.61 万元，账面价值 1,068.10 万元，成新率 42.94%，该等固定资产使用状况良好，不存在产权纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
机器设备	2,381.93	1,358.96	-	1,022.97	42.95%
电子设备	23.77	19.99	-	3.79	15.92%
办公设备	81.90	40.56	-	41.34	50.48%
合计	**2,487.61**	**1,419.51**	**-**	**1,068.10**	42.94%

（二）主要负债及或有负债情况

根据天健会计师出具的《审计报告》，截至 2026 年 2 月 28 日，晶艺半导体的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日
短期借款	5,543.50
应付票据	2,953.13
应付账款	3,322.18
合同负债	134.33
应付职工薪酬	799.54

项目	2026 年 2 月 28 日
应交税费	477.99
其他应付款	54.42
一年内到期的非流动负债	1,136.53
其他流动负债	16.06
流动负债合计	**14,437.67**
租赁负债	913.21
递延收益	287.30
非流动负债合计	**1,200.51**
负债合计	**15,638.18**

1、主要负债情况

截至 2026 年 2 月 28 日，晶艺半导体负债主要由短期借款、应付票据和应付账款构成。

2、或有负债情况

截至 2026 年 2 月 28 日，晶艺半导体不存在或有负债。

（三）对外担保情况

截至本报告书签署日，标的公司及其子公司不存在为标的公司或其子公司以外的第三方提供担保的情况。

（四）涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告书签署日，标的公司芯片定制化量产业务中涉及的知识产权授权基于商业秘密和商业敏感信息已申请豁免披露，其他许可他人使用或作为被许可方使用他人资产的情况如下：

授权合同	授权方	被授权方	授权内容	授权期限	许可费用情况
《LasESOP11 封装合作协议》	标的公司	锴威特	LasESOP11 封装技术合作	2026 年 3 月 19 日至 2029 年 3 月 19 日	授权费按“只”收费，价格为 0.15 元/只
《License Agreement》及其补充修订	标的公司	C 公司	LA1631、LA1165 和 LA1123 掩膜版	2020 年 1 月 20 日至长期有效	2025 年收取授权费 11.25 万美元

（1）锴威特拟在 IPM 模块产品中采用标的公司的 LasESOP11 封装技术，标的公司授权锴威特使用标的公司独家与封测厂合作开发的 LasESOP 封装产线来完成相关产品的封装测试；

（2）标的公司授权 C 公司使用 3 款 DC-DC 产品的掩模版，用于生产相关产品并对外出售。

截至本报告书签署日，标的公司的上述授权协议均在正常履行过程中，标的公司与许可方/被许可方之间不存在就上述合同履行或知识产权归属等事项产生争议或纠纷的情形。

六、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况

（一）诉讼、仲裁

截至 2026 年 2 月 28 日，标的公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件。

（二）行政处罚

报告期内，标的公司不存在重大违法违规而受到行政处罚或存在刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七、最近三年主营业务发展情况

（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、所属行业及行业主管部门及监管体制

标的公司主要从事电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计与销售，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

标的公司所属行业主管部门主要为工业和信息化部，该部门主要职责为：制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化。

半导体协会是标的公司所属行业的行业自律组织，主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工业和信息化部、半导体协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、法律、法规及规范性文件

近年来，我国在政策上给予了集成电路行业税收、资金、人才等方面的优惠，从多方面对集成电路行业进行扶持，鼓励行业的发展。标的公司拥有良好的政策环境，标的公司所处行业主要法律法规及产业政策如下表所示：

序号	时间	颁布部门	文件名称	内容摘要
1	2025	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》	制定了2025-2026年电子信息制造业的主要目标和工作举措，旨在坚持高质量发展与高水平安全相结合，提升高端供给能力，优化重点领域产业布局，提升产业链供应链韧性和安全水平。坚持自立自强与开放合作相结合，强化自主创新能力建设，坚持高水平对外开放，深度嵌入全球电子信息制造业分工体系
2	2025	国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	对符合条件的集成电路企业或项目、软件企业清单给予税收优惠或减免
3	2023	财政部、国家税务总局	《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》	自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额
4	2022	发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局	《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	对符合条件的集成电路企业或项目、软件企业清单给予税收优惠或减免
5	2021	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展
6	2020	财政部、国	《关于促进集成电路	国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米

序号	时间	颁布部门	文件名称	内容摘要
		家税务总局、发改委、工信部	产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	（含），且经营期 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税
7	2020	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境
8	2019	财政部、国家税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止
9	2017	国务院	《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》	大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等事关国家战略、国家安全等学科专业建设。适应新一轮科技革命和产业变革及新经济发展，促进学科专业交叉融合，加快推进新工科建设
10	2017	国务院	《国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知》	优先在北京、上海、武汉等地建设一批集成电路实训基地，构建我国集成电路人才培养学科专业集群，加快人才培养和产业关键技术研发
11	2017	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录

标的公司境外一共有 1 家子公司香港晶艺，位于中国香港。目前，香港晶艺主要承担海外销售职责。

标的公司境外子公司不属于限制性行业，并不涉及特别的行业监管许可，境外子公司在满足当地公司法律等一般性公司经营法规后即可自主经营，具体情况参见本章“四、下属企业构成”。

（二）主要产品及用途

1、标的公司主营业务概况

标的公司是国内领先的电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售企业，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等，已发布并在售 300 余款功率 IC 及模块产品。标的公司产品广泛应用于家电、高端消费电子、

智能电表、光模块、固态硬盘、安防、服务器、通信等市场领域，得到下游客户普遍认可，客户结构优质且多元。同时，标的公司利用电源管理芯片研发形成的技术积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，向客户提供芯片定制化量产服务业务，产品主要应用于服务器、通信等领域。

标的公司持续加大 DC-DC 芯片产品研发投入，丰富产品矩阵，在中低压 DC-DC 芯片及部分中高端应用中形成较强竞争力，根据弗若斯特沙利文测算数据，2025 年，标的公司跻身国内 DC-DC 市场本土厂商出货量前五。其中，智能电表领域，标的公司超低纹波、高抗干扰、高效率降压的 DC-DC 芯片市占率位居行业前列，应用于国家电网、南方电网等核心终端客户；安防领域，标的公司为客户提供外围器件极简化、成本最优化的解决方案，已成功导入海康威视、大华股份等安防行业龙头企业；光模块领域，公司为少数可实现多品类芯片量产、提供较为全面电源管理解决方案的国产芯片供应商，已成功导入华工科技、光迅科技、联特科技等头部客户。

标的公司围绕空调风机用半桥 IPM 持续布局，在白色家电半桥 IPM 领域最早实现产品导入及规模化出货，并与下游客户建立了相对稳定的合作关系。标的公司半桥 IPM 模块在白色家电等终端场景细分领域已占据较高市场份额。根据弗若斯特沙利文测算数据，2025 年标的公司产品在国内 IPM 半桥模块市场份额达 53.5%。

报告期内，标的公司主营业务未发生变更。

2、标的公司主要产品及用途

（1）自研业务

标的公司专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块领域，主要产品包含半桥/全桥 IPM、DC-DC 芯片等多个系列产品，其中 IPM 模块、DC-DC 芯片是公司主要的产品系列。

类别	产品系列	主要功能	产品类型	应用领域
电机驱动类	IPM 模块	集成功率开关器件、驱动电路、保护电路和控制电路于一体，实现对高功率负载的高效、	半桥/全桥 IPM	主要适用于变频家电、风机驱动等

类别	产品系列	主要功能	产品类型	应用领域
		安全、智能化控制		
	驱动 IC	过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能	微电机驱动 IC 芯片	适用于电机驱动的各类应用领域场景，可以与电机主控芯片、功率器件共同构成电机驱动控制系统
电源管理类	DC-DC 芯片	实现直流电源的升压、降压和升降压	Buck 降压型芯片	家电、网络通信、安防监控、智能电表、服务器、通信、光模块、固态存储、高端消费电子等
			Boost 升压型芯片	
			Buck-Boost 升降压型芯片	
	其他产品	-	包括 AC-DC 芯片、POL、PMIC、Load Switch 等产品	

1）电机驱动类产品

①智能功率模块（IPM）

智能功率模块（Intelligent Power Module，IPM）是将功率器件（MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 等）与驱动电路、保护电路等功能集成于一体的电力电子模块。相比传统分立器件方案，IPM 通过高度集成化设计，在实现对功率器件的驱动与控制功能的同时，集成过流、过压、过温等多重保护功能，从而提升系统的安全性、可靠性及运行效率。随着电力电子系统向高功率密度、小型化及高可靠性方向发展，IPM 逐步由传统分立方案，演进为电机驱动及功率控制系统中的关键组件，在提升电机驱动性能、提高系统效率方面发挥关键作用，系变频家电不可或缺的关键组件之一，广泛应用于变频空调、冰箱、洗衣机等白色家电行业以及工业变频器、伺服器、车用空调、机器人等领域。

在结构形式上，IPM 方案逐渐从传统的三相全桥集成模块，向更加灵活的半桥模块组合方案演进。其中，三相全桥 IPM 以高集成度和成熟度为特点，广泛应用于中高功率场景；而以三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案，则在布局灵活性、散热性能及生产工艺等方面展现出优势，逐步在家电及中低功率应用中得到推广。标的公司主要深耕 IPM 领域的半桥模块技术路线，凭借自主研发的特色封装技术、高可靠性高压半桥驱动 IC（HVIC）设计技术等核心技术，采用半桥技术路线开发的产品可高效适配变频家电电机驱动的应用场景；此外，

标的公司兼顾开发三相全桥 IPM 产品，储备全桥 IPM 产品相关研发技术，实现智能功率模块全产品路线的布局。

相较于三相全桥 IPM 方案，三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案采用模块化设计思路，即每颗 IPM 负责一个桥臂，通过三颗独立模块组合实现完整的三相驱动功能。该方案在结构上将原本集中于单一模块的功率器件进行物理分散，使系统在布局上具备更高灵活性，特别适用于空间结构复杂或对布线对称性要求较高的应用场景。

从技术角度来看，半桥 IPM 方案在多个方面展现出优势。在布局方面，半桥 IPM 模块可根据系统结构进行分散布置，有助于缩短功率回路路径并降低寄生参数；在热管理方面，热源分布更加均匀，可有效降低局部热点，提高整体散热效率，相比全桥 IPM 方案无需单独配置散热器件，节省客户方案成本；由于每个桥臂独立运行，系统能够实现更精细的温度监测与保护，提高运行安全性。此外，半桥 IPM 产品通常采用标准化封装，适用于自动化贴片工艺，在大批量生产中具备较好的制造效率及成本优势。另一方面，由于半桥 IPM 产品在行业应用时间较短，技术优化仍在验证迭代过程中，目前半桥 IPM 方案在高功率场景适配性、规模化应用成熟度等方面相比全桥 IPM 方案存在劣势。不同技术路线 IPM 产品实现效果具体对比情况如下：

比较维度	具体维度侧重	不同路线实现效果	
		三相全桥 IPM 路线	半桥 IPM 路线
系统集成度	功率器件及驱动电路在单一模块中的集成水平	强	较强
结构布局灵活性	模块在 PCB 及系统中的布局自由度及对不同电机结构（如环形/分布式结构）的适配能力	弱	强
热管理与温度控制能力	热量分布均匀性及温度监测与保护的精细化程度	弱	强
制造工艺适配性	模块对自动化生产及贴片工艺的适配程度及量产效率	弱	较强
成本结构与应用匹配度	在不同功率场景下的综合成本表现及适配能力	中等	强
高功率适配能力	在高功率及大电流场景下的适用能力及系统实现复杂度	强	弱

资料来源：公开资料，弗若斯特沙利文

②驱动 IC 产品

功率驱动芯片（HVIC）是用于控制和驱动功率器件（MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET）的专用集成电路，通过提供栅极驱动信号、电压及电流控制以及多种保护功能，实现对电能转换与执行单元的精准控制。该类芯片通常不直接参与电压转换过程，而是连接控制系统与功率器件，在电力电子系统中承担关键的驱动与控制功能。

标的公司拥有自主设计研发驱动 IC 产品的能力，主要 HVIC 产品技术应用于智能功率模块（IPM）产品的集成驱动，少量产品作为 BLDC 电机驱动芯片或门驱动集成电路（Gate Driver IC）对外独立进行销售。

2）电源管理类产品

标的公司电源管理类产品主要为 DC-DC 芯片，主要作用是将外部直流输入电压，转换成数字芯片、电子产品执行装置中适用的工作电压，并实现稳定供电，保障电子产品的平稳运行。DC-DC 芯片产品应用领域广泛，覆盖计算、通信电子、存储、工业应用、消费电子等众多应用场景，具体细分市场包括通信、服务器、安防、智能电表、光模块、固态硬盘等。

标的公司根据不同电压等级转换需求，基于与所需转换电压相匹配的自有工艺，针对性进行电路设计，DC-DC 芯片涵盖了 Buck 降压型芯片、Boost 升压型芯片和升降压转换器产品；同时标的公司结合下游终端设备的系统应用特点进行优化，并基于自有 DC-DC 控制技术，实现产品的高效率、高可靠性和良好电源特性。

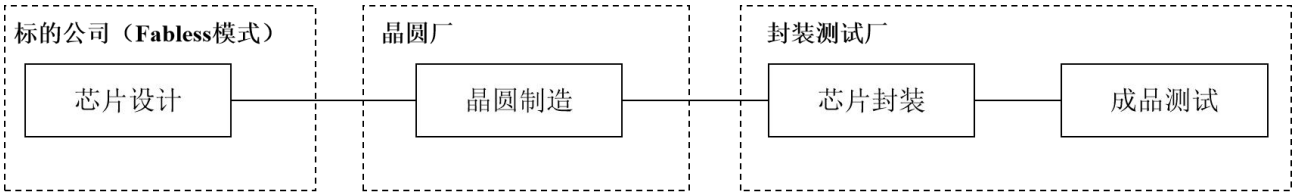
（2）芯片定制化量产业务

标的公司芯片定制服务主要为利用电源管理芯片研发形成的技术积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，为客户提供芯片定制服务业务，产品主要应用于服务器、通信等领域。标的公司协助客户开发芯片测试程序、委托封装测试厂对芯片裸片进行封装测试，及时跟踪芯片封装良率，进行反馈沟通，最终向客户交付经过封装测试的合格芯片，并提供产品的应用技术支持。

（三）主要产品的工艺流程图或主要服务的流程图

标的公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式，即无晶圆生产线集成电路设计模式，标的公司专注于集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装

测试等生产环节外包给晶圆厂、封测厂完成。标的公司总体业务流程图如下：



（四）主要经营模式

1、盈利模式

报告期内，标的公司采用 Fabless 经营模式，专注于产品的研发设计与市场销售环节。标的公司的收入主要来源于电机驱动产品和电源管理芯片的销售。

2、采购及生产模式

标的公司采用 Fabless 经营模式，主要负责芯片的设计、工艺调试及产品质量管控，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给专业的晶圆代工、封测厂商完成。具体而言，标的公司完成集成电路版图设计后，委托晶圆厂商开展晶圆生产；晶圆成品交付后，再交由合作封装测试厂商完成产品的封装、测试工序，最终形成合格成品。标的公司的晶圆代工厂和封装测试服务供应商多为行业知名企业。

3、销售模式

与模拟芯片设计行业的其他公司相似，标的公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，标的公司向直销客户与经销客户销售均属于买断式销售，即在标的公司将产品销售给经销商客户或直销客户后，商品的所有权转移至下游客户。

（1）经销模式

标的公司经销商客户主要为芯片分销商或贸易商。经销模式下，经销商结合市场情况及终端客户需求将订单下达至标的公司，后续的出货、对账、开票、结算等事项标的公司均与经销商沟通，部分大型终端客户的技术服务工作由标的公司应用工程师（FAE）对接。

标的公司已建立了《经销商渠道操作制度》《经销商配合度考核标准》《订单操作规则》等经销商开发及管理制度，对经销商的导入、日常管理进行

规范化运作。标的公司在选择经销商时主要考虑其资金实力、市场销售网络、技术服务能力、合作稳定性、商业信用等因素。

（2）直销模式

直销模式下，标的公司直接接收终端客户订单并完成产品交付，并直接为其提供相应的技术支持。报告期内，标的公司直销模式合作客户情况较少。

4、研发模式

在 Fabless 经营模式下，产品设计及研发是标的公司经营的核心。标的公司具体研发流程包括立项、设计、验证、风险量产四个阶段，并由芯片开发部、工程与生产经营部、产品与市场事业部、技术支持与销售部等各职能部门合作完成。

（1）立项阶段

标的公司管理层及产品与市场事业部初步提出新产品的开发需求，联合芯片开发部、工程与生产经营部代表对产品可行性进行研究，组织立项会议，共同参与风险分析及评审决策，对项目基本需求、目标应用市场、市场竞争力、项目可行性、项目成本等方面进行综合评判，评审通过后项目正式立项。

（2）研发设计阶段

标的公司芯片开发部门主要包括芯片设计部、版图设计部、器件与工艺开发部、封装设计部等四条业务线。项目立项后，产品与市场事业部相关人员根据需求撰写工程研发文档，详细规划出产品规格定义和性能指标，芯片设计部成员根据产品定义规划、拆分设计方案、完成电路原理设计、设计验证与仿真，并交由版图设计部。如相关产品涉及器件开发集成及先进封装工艺设计，相应器件与工艺开发部、封装设计部成员同步参与上述产品开发过程。

（3）工程送样阶段

设计阶段完成后，工程与生产经营部团队将向晶圆厂和封测厂下达工程样品生产和封测的指令。工程样品生产完成后，测试部及产品与市场事业部的应用工程师对该产品进行各场景功能、性能测试验证和可靠性验证。样品通过所有验证环节并经过各部门评审后，可进入风险量产阶段。

（4）风险量产阶段

工程送样阶段，产品工程团队将安排产品的风险量产，并由产品工程、测试工程团队在收集分析测试数据以优化测试方法，形成量产管控的具体要求，以确保产品的可生产性。新产品通过风险量产评审后，将进入规模量产阶段。

5、结算模式

标的公司按照客户的订单完成产品交付，开具发票完成后，按照双方所签订合同约定方式收取相应货款，客户一般采用银行转账的方式支付货款。

（五）销售情况和主要客户

1、主要产品销售收入

报告期内，标的公司主营业务收入按产品类别分类情况如下表所示：

单位：万元

产品大类	具体产品	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
电机驱动类	IPM 模块	3,042.45	37.53%	10,654.61	30.49%	5,161.22	20.24%
	驱动 IC	224.04	2.76%	902.66	2.58%	545.31	2.14%
	其他	3.85	0.05%	80.01	0.23%	49.56	0.19%
	小计	**3,270.34**	**40.34%**	**11,637.28**	**33.30%**	**5,756.09**	**22.58%**
电源管理类	DC-DC 芯片	1,320.13	16.28%	7,290.44	20.86%	6,569.86	25.77%
	其他	338.60	4.18%	1,225.43	3.51%	828.09	3.25%
	小计	**1,658.73**	**20.46%**	**8,515.87**	**24.37%**	**7,397.94**	**29.02%**
芯片定制化量产		3,177.67	39.20%	14,796.18	42.34%	12,339.78	48.40%
合计		**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务收入主要包括自研业务和芯片定制化量产业务，其中芯片定制化量产业务采用净额法进行核算。报告期内，自研业务由电机驱动产品收入和电源管理产品构成，两类产品收入报告期内均呈现增长趋势，其中电机驱动产品得益于 IPM 模块产品的收入快速增长，在整体收入中的占比逐年提高。标的公司芯片定制化量产业务收入占比逐期下降。

报告期内，标的公司主营业务收入按应用领域分类情况如下表所示：

单位：万元

应用领域	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研业务	4,929.07	60.80%	20,153.15	57.66%	13,154.03	51.60%
-家电行业	3,088.67	38.10%	10,808.13	30.93%	5,047.80	19.80%
-安防行业	229.06	2.83%	2,351.73	6.73%	2,423.07	9.50%
-智能电表行业	293.48	3.62%	1,248.16	3.57%	1,836.73	7.20%
-其他	1,317.85	16.26%	5,745.13	16.44%	3,846.43	15.09%
芯片定制化量产业务	3,177.67	39.20%	14,796.18	42.34%	12,339.78	48.40%
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司自研业务主要覆盖应用领域包括家电、安防和智能电表行业，其中得益于 IPM 产品在白色家电领域的快速渗透，应用于家电行业的产品收入规模及占比呈现快速增长趋势。

报告期内，标的公司主营业务收入按销售模式分类情况如下表所示：

单位：万元

销售模式	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	7,728.97	95.34%	33,614.30	96.18%	24,580.25	96.42%
直销模式	377.77	4.66%	1,335.03	3.82%	913.56	3.58%
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司销售模式以经销为主，经销模式收入占主营业务收入比例分别为 96.42%、96.18%和 95.34%。

报告期内，标的公司主营业务收入按销售区域分类情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华南	7,064.44	87.14%	26,524.12	75.89%	16,975.78	66.59%
华东	696.05	8.59%	5,891.53	16.86%	4,956.31	19.44%
海外	193.50	2.39%	2,113.09	6.05%	3,435.05	13.47%
其他	152.75	1.88%	420.59	1.20%	126.68	0.50%
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务收入的区域分布较为稳定，以华南地区和华

东地区为主，来自于华南和华东的主营业务收入合计占比分别为 86.03%、92.75%和 95.73%。

2、主要产品的产销情况

标的公司采用 Fabless 模式，不直接负责生产，因此以当期采购入库数量作为产量，报告期内，标的公司自研产品产销量情况如下表所示：

单位：万颗

期间	产品类型	产量	销量	产销率
2026 年 1-2 月	电机驱动	1,795.50	2,059.99	114.73%
	电源管理	5,212.36	5,159.98	98.99%
2025 年	电机驱动	9,268.71	7,711.73	83.20%
	电源管理	28,951.32	27,115.81	93.66%
2024 年	电机驱动	4,933.47	3,651.34	74.01%
	电源管理	25,653.31	22,812.59	88.93%

2024 年，标的公司自研业务电机驱动相关产品产销率相对较低，主要系标的公司部分 IPM 新产品尚处于前期导入阶段，销量尚处于爬坡阶段。2025 年-2026 年 2 月，随着标的公司下游客户需求扩张，新产品持续导入爬坡，产销率逐步提升。

3、主要产品销售价格及变动情况

单位：元/颗

产品大类	具体产品	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年
		价格	变动幅度	价格	变动幅度	价格
电机驱动类	IPM 模块	1.82	-0.03%	1.82	-9.81%	2.02
	驱动 IC	0.58	15.35%	0.51	-7.70%	0.55
电源管理类	DC-DC 芯片	0.35	2.31%	0.35	3.54%	0.33
芯片定制化量产业务		1.32	24.17%	1.06	-1.81%	1.08

注：芯片定制化量产业务单价根据总额法收入口径测算

标的公司自研业务的电机驱动产品业务中，IPM 模块 2025 年单价同比下降 9.81%，主要系产品结构变化，单价相对较低的 IPM 产品收入规模随着导入推进而有所增加。驱动 IC 产品 2025 年单价同比下降 7.70%，主要系标的公司基于下游客户推广需求，小幅下调部分产品单价；2026 年 1-2 月单价环比上涨 15.73%，系产品单价较高的新产品逐步导入放量，单价有所上升。

标的公司自研业务的电源管理类芯片业务中，DC-DC 芯片报告期内单价小幅提升，主要系标的公司根据上游晶圆及封测采购价格及行业供需格局小幅提高销售产品单价。

标的公司芯片定制化量产业务中，2026 年 1-2 月单价环比提高 32.55%，主要系根据定制客户量产需要，较高单价的定制芯片量产规模增加所致。

4、主要客户情况

报告期内，标的公司向前五名客户的主营业务销售情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售收入	占主营业务收入比例	销售模式
2026 年 1-2 月				
1	D 公司	2,968.78	36.62%	经销
2	中山市智驰微电子有限公司	1,351.39	16.67%	经销
3	深圳市安世通科技有限公司	1,062.64	13.11%	经销
4	厦门信和达电子有限公司	309.85	3.82%	经销
5	中印云端（深圳）科技有限公司	303.03	3.74%	经销
合计		**5,995.69**	**73.96%**	**-**
2025 年				
1	D 公司	11,841.68	33.88%	经销
2	深圳市安世通科技有限公司	5,966.07	17.07%	经销
3	大联大	2,043.52	5.85%	经销
4	深圳市仁天芯科技有限公司	1,793.14	5.13%	经销
5	苏州芯欣微电子有限公司	1,162.83	3.33%	经销
合计		**22,807.23**	**65.26%**	**-**
2024 年				
1	D 公司	10,148.16	39.81%	经销
2	大联大	2,359.84	9.26%	经销
3	WT Microelectronics Co., Ltd.	1,557.53	6.11%	经销
4	积顶（上海）科技有限公司	1,046.31	4.10%	经销
5	厦门信和达电子有限公司	1,008.13	3.95%	经销
合计		**16,119.97**	**63.23%**	**-**

注：同一控制下客户合并计算。
其中：

1、大联大：包括大联大商贸（深圳）有限公司、大联大商贸有限公司、诠鼎科技股份有限公司、世平国际（香港）有限公司；
2、WT Microelectronics Co., Ltd.：包括 WT Microelectronics Co., Ltd.、文晔领科（上海）投资有限公司；
3、厦门信和达电子有限公司：包括厦门信和达电子有限公司、环阳科技香港有限公司、深圳市胜达威电子有限公司。

报告期内，标的公司董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东在上述客户中未持有权益。

（六）采购情况和主要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，标的公司主要采购原材料为晶圆和封装测试，标的公司主要原材料的采购金额及占总采购额比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆	4,034.47	62.39%	16,173.64	50.63%	13,756.30	50.07%
封装测试	2,096.16	32.41%	10,615.21	33.23%	10,109.78	36.80%
其他	336.12	5.20%	5,154.07	16.14%	3,608.34	13.13%
合计	**6,466.76**	**100.00%**	**31,942.92**	**100.00%**	**27,474.42**	**100.00%**

其中，其他原材料采购主要包括采购 MOSFET 等辅芯产品，用于 IPM 模块等电机驱动产品，2024 年、2025 年电机驱动业务快速增长，带动其他类原材料采购占比提高。

2、主要原材料采购的价格变动趋势

报告期内，标的公司主要原材料采购的均价情况如下：

单位：元/片，元/颗

项目	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年
	价格	变动幅度	价格	变动幅度	金额
晶圆	3,296.05	-0.98%	3,328.66	-3.27%	3,441.14
封装测试	0.08	-11.69%	0.10	0.11%	0.10

注：晶圆销售单价由折合 8 英寸计算数量后测算

报告期内，标的公司晶圆采购价格整体稳定，2025 年晶圆采购单价小幅下滑，主要系行业内成熟制程晶圆代工产能提升，采购均价下降。2024-2025 年封测业务采购价格整体稳定，2026 年 1-2 月采购价格有所下降，主要系年初标的公司根据下游市场客户产品需求情况，阶段性调整封装测试采购品类组合结构

所致。

3、能源采购情况及价格变动趋势

标的公司采用 Fabless 经营模式，主要采用委外的方式进行产品生产，耗用的能源主要为办公用水、用电，价格稳定，且消耗量较小，占标的公司成本和费用的比例较低。

4、主要供应商情况

报告期内，标的公司向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额	占原材料采购总额比例	采购内容
2026 年 1-2 月				
1	A 公司	1,947.27	30.11%	晶圆
2	F 公司	1,512.81	23.39%	晶圆
3	华天科技	1,244.09	19.24%	封装测试
4	E 公司	673.39	10.41%	晶圆、封装测试
5	长电科技	594.22	9.19%	封装测试
合计		**5,971.79**	**92.35%**	**-**
2025 年				
1	A 公司	10,061.46	31.50%	晶圆
2	华天科技	6,198.75	19.41%	封装测试
3	F 公司	4,049.40	12.68%	晶圆
4	E 公司	2,917.43	9.13%	晶圆、封装测试
5	长电科技	2,914.95	9.13%	封装测试
合计		**26,142.00**	**81.84%**	**-**
2024 年				
1	A 公司	8,487.42	30.89%	晶圆
2	华天科技	5,021.67	18.28%	封装测试
3	长电科技	3,582.19	13.04%	封装测试
4	F 公司	3,502.31	12.75%	晶圆
5	E 公司	2,488.52	9.06%	晶圆、封装测试
合计		**23,082.11**	**84.01%**	**-**

注：同一控制下供应商合并计算。
其中：

1、华天科技：华天科技（昆山）有限公司、华天科技（南京）有限公司、华天科技（西安）有限公司、上海华天集成电路有限公司、天水华天科技股份有限公司、江苏盘古半导体科技股份有限公司、宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司；
2、长电科技：包括江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电科技（宿迁）有限公司。

标的公司董事李六军曾于华天科技（昆山）有限公司、天水华天科技股份有限公司担任董事，华天科技在报告期内曾为标的公司关联方。除此外，标的公司董事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上的股东在上述供应商中未持有权益。

（七）境外经营及境外资产情况

标的公司境外一共有 1 家子公司香港晶艺，位于中国香港。目前，香港晶艺主要承担海外销售职责。具体情况参见本章“四、下属企业构成”。

（八）核心技术及核心技术人员情况

1、主要核心技术情况

标的公司的核心技术情况具体如下表所示：

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段	技术来源
1	单相半桥 IPM 模块封装技术和器件开发	1、满足高集成度要求的前提下，研发了一系列单相半桥 IPM 产品，集成驱动芯片和开关芯片 2、提供业内领先的贴片封装类型，通过机贴模式有效降低贴片成本和工艺难度，兼顾优异的散热性能 3、持续改善封装工艺，实现导电性再布线层的平整化，提高晶粒表面焊线密度；新一代产品封装进一步优化散热性能，增加外露基岛、电气间隙和爬电距离 4、为 IPM 模块开发 IGBT 器件，自行开发 SiC-MOS 器件，集成第三代半导体 SiC-MOS 5、设计的驱动电路可克服电机在转动时受反电动势的影响而导致的电机转速与 MCU 输出的 PWM 信号成非线性关系 6、新一代产品进行隔离驱动设计，针对驱动电路中供	电机驱动产品	是 已经取得专利： 1.ZL2019211896995 2.ZL2024212464665 3.ZL2023236697747 4.ZL2024232063893	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段	自研

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段	技术来源
		电电路进行特别设计，保证驱动电路内部电源快速建立以及时给系统内部提供供电电压并快速建立相关控制环路				
2	电机驱动中的控制技术	1、硬件化微步细分，有效降低对 MCU 算力的依赖，使得低成本的 MCU 也能驱动高精度的步进电机； 2、采用固定占空比实现微步驱动控制，不需要额外调整占空比，电机在低速运行时电流波形平滑，消除了因 MCU 算力时延导致的低频振荡和噪音，实现更高的定位精度和抗干扰能力，提升系统运行的平稳性 3、纯硬件电路实现超前角控制，摆脱 MCU 依赖，兼顾精度与灵活性，保证换相逻辑的准确性和稳定性； 4、通过电流波形重构的控制方法，实现全周期的电流精确跟随，显著降低了转矩脉动，实现较高的转速精度； 5、提出电机软换相控制方案，实现电机在不同驱动速度下的性能调节，提高电机的转速控制精度，降低了噪音	电机驱动产品	是 已经取得专利： 1.ZL2023108486939 2.ZL2024101996846 3.ZL2023115971996 4.ZL2023109064366	大批量产	自研
3	AC-DC 电压转换器的控制和封装技术	1、首款实现 1500V 全集成 flyback 解决方案，在强磁环境下扩大了安全工作区，提高系统的带载能力和过载保护可靠性； 2.提出新的功率因数校正方案，有效提高功率因数值，降低了总谐波畸变值； 3、提出多种高压 BUCK 控制方案，提高系统在轻载或空载条件下的瞬态响应速度和效率； 4.提出简单高效的准谐振控制方案，可实现在不同参数条件下的高效控制； 5、开发转换器中的 MOS 器件，新一代产品集成第三代	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2024106701140 2.ZL2021115720043 3.ZL202222959189X 4.ZL2022231117007 5.ZL2022106194109 6.ZL2023103181239 7.ZL2022108736569	大批量产	自研

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段	技术来源
		半导体 SiC-MOS，保障产品优秀的功率密度和高应用可靠性				
4	电压转换器中可靠性和稳定性设计	1、提出多种针对提升芯片可靠性的设计，如稳定供电电压、过欠压保护、短路检测、过流保护、ESD 保护等； 2、针对开关变换器稳定性，提出多种设计方案	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2019108991749 2.ZL2022115352972 3.ZL2023114231373 4.ZL2023118492029 5.ZL2023101072966 6.ZL2023104094454 7.ZL2023100266659 8.ZL2024226045652	大批量产	自研
5	电压转换器中的驱动技术	1、设计多种自举电路，避免自举电容充电后电压不足的问题； 2、提供多种减小开关公共节点正负压过冲和开关应力的设计方案，有效提高了芯片的稳定性和可靠性； 3、提出多种电平转换电路，避免因干扰出现误触发，保证其输出端的电位始终处于正确状态不受功率转换点的变化影响； 4、创新实现 nF 级别自举电容设计，减少了驱动电路对芯片面积占用 5、提出多种电流采样方法，实现对电感电流任一时段的快速电流采样；同时设计采样保持电路，延长了采样保持时间	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2024208705781 2.ZL2023102251234 3.ZL2022116984147 4.ZL2024100041556 5.ZL2023114160861 6.ZL2022235949905 7.ZL2023114160861 8.ZL2022103066397 9.ZL2022108715670	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段	自研
6	降压转换器的控制技术	1、弥补高压超低功耗 DC-DC 的市场空缺，实现 23V 最高输入，450nA 的超低功耗； 2、通过关断时间补偿设计，实现较小的占空比，用于高频率下拓展开关变换器的稳定工作范围； 3、根据电流过流值的大小自适应调整主开关管的延时时长，达到限流的目的； 4、在 COT 控制中实现了开关变换器频率与外部时钟频率的同步，简化锁相环设计； 5、提出多种双环控制策	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2022115352972 2.ZL202210425274X 3.ZL2022102770782 4.ZL2023102564775 5.ZL202210692478X 6.ZL2024221559927 7.ZL2019108987599 8.ZL2020108314233 9.ZL2023113879514 10.ZL2023113879529	大批量产	自研

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段	技术来源
		略，有效提高了转换器的响应速度，且能够有效处理噪声干扰，提升整个转换器的稳定性 6、设计准谷底电流控制，实现在异步解决方案中有效监控和控制续流电流，确保电流在谷底值范围内，避免电流过大对系统造成损坏 7、设计多种异步合封器件中的过温保护方案，防止分离开关器件因发热而烧毁				
7	升压转换器中的控制技术	1、设计 300nA 超低功耗的升压转换器，通过对开关变换器休眠状态的准确判断，消除失调电压的影响，可准确判断开关变换器进入休眠或退出休眠的时机，提高功耗控制的准确性，实现超低功耗； 2、提出升压转换器中电流过零检测技术，有效提高电流过零检测的准确性，避免 Boost 电路输出端的电流返流，增强系统的控制精度和效率； 3、提出新的升降压转换器控制方法，提高 BUCK-BOOST 开关变换器在不同模式下的效率和稳定性	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2024104969164 2.ZL202311642414X 3.ZL2022104734422	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段	自研
8	多相电压转换器的控制技术	1、实现了每个电压转换器的独立工作和均流控制，提高了电压转换器的动态响应速度，确保了输出电流的均匀性和系统的稳定性； 2、在多相电压转换器中，补偿电路采用下降斜率随电压变换电路的相数值和电感电流采样信号的值变化而变化的斜坡信号，以对控制环路进行斜坡补偿，有效提高多相电压转换器的稳定性； 3、采用创新设计结构将多个电压转换器设置为主从配置系统，可根据具体应用的需要调节变换器级联系统的总相数； 4、设计专有的多相电路适	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2022110603090 2.ZL202210141818X 3.ZL2021114347370 4.ZL2024225136391	基础研发为主，部分产品大批量产	自研

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段	技术来源
		用的芯片封装结构和 PCB 线路板布线结构，降低多相电路之间连接设计的复杂度，节约 PCB 线路板空间，利于电路集成化和产品小型化				
9	POE 模块通信供电	1、提出双闭环平滑切换机制，将 POE 握手逻辑从开环状态响应提升为闭环主动控制，解决握手信号抖动，避免传统方案在 PSE 电压下降瞬间导致的误判； 2、适合应用于对连接可靠性要求极高的工业以太网交换机、恶劣环境下的 POE 受电设备，以及要求通过严格兼容性测试的 POE 电源管理芯片设计	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2023117378312	大批量产	自研
10	负载开关以及低压差线性调节器（LDO）控制技术	1、针对负载开关提供适配的驱动方案，可实现在不同负载条件下维持稳定的自举电压，降低功耗，提高可靠性； 2、提出多种负载开关和低压差线性调节器设计方案，具有较好的动态响应速度和输出电压稳定性	电源管理芯片	是 已经取得专利： 1.ZL2021105863197 2.ZL2022115974044 3.ZL2024118732474 4.ZL2023105846487	大批量产	自研
11	芯片测试硬件开发	1、开发多种测试硬件，简化控制程序设计，降低测试开发复杂度，同时实现高精度、高可靠性测试； 2、节约测试机资源，降低设备采购成本，支持更大规模的并行测试，提升测试产能； 3、形成从实验室特性分析到量产测试的完整测试技术体系，为芯片产品的质量保障和交付能力提供技术支撑 4、基于汽车电子标准指导，自行开发多种测试算法，对芯片测试参数分析、处理，将正态分布以外的芯片剔除，提升产品品质； 5、持续迭代更新算法，保证产品质量进一步提升	芯片测试技术	是 已经取得专利： 1.ZL2024230978332 2.ZL2023216839891 3.ZL2023104871852	大批量产	自研

2、报告期内研发投入情况

报告期内，标的公司的研发投入主要为支付的研发人员薪酬、股份支付费用、模具物料费用等，研发投入全部费用化。

报告期各期，标的公司研发投入占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
研发投入金额	926.78	8,452.32	8,844.17
研发投入占营业收入的比重	11.43%	24.17%	34.69%

3、研发人员情况

报告期各期末，标的公司的研发人员数量及占比情况如下：

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
研发人员数量（人）	89	90	103
研发人员数量占比	56.33%	56.96%	59.88%

4、核心技术人员情况

报告期内，标的公司的核心技术人员为易坤、唐锐、杨斯龙、包涵、周枭。

核心技术人员	工作履历	对标的公司研发的具体贡献
易坤	硕士学历，25 年以上功率半导体研发、产品线组建经验，曾为全球电源管理 IC 龙头 MPS 中国区核心成员。2019 年成立标的公司，担任标的公司总经理	在标的公司成立起，负责建设芯片设计团队，带领研发团队相继攻关电源管理、电机驱动芯片产品，为标的公司芯片发展奠定基础，拥有多项国内、国际专利
唐锐	本科学历，曾在 MPS、英特格灵芯片有限公司担任主任测试工程师。2019 年加入标的公司，担任标的公司测试总监	搭建标的公司测试平台，组建相关测试团队，制定开发流程，实现标的公司集成电路测试标准化、规范化
杨斯龙	本科学历，曾在 MPS、内江新城建设指挥部办公室、深圳宝砾微电子有限公司任职，2019 年加入标的公司，担任高级版图设计经理	负责模拟 IC 全新项目、改版、衍生品的版图设计；模拟 IC 版图的架构设计；部门对接，晶圆厂工艺对接；主持版图设计部的日常工作
包涵	硕士学历，曾在 MPS、成都易冲半导体有限公司任职，2020 年加入标的公司，担任产品线总监	负责标的公司 IPM 模块和微电机驱动产品线包括产品开发、客户技术支持等事务管理工作
周枭	博士学历，曾在电子科技大学、航天科工二院二十三所任职，2022 年加入标的公司，担任 IC 设计工程师、高级经理	负责标的公司各类 buck 电源芯片、efuse 芯片研发。根据不同应用需求，设计有时钟同步、多相并联、超低待机功耗等不

核心技术人员	工作履历	对标的公司研发的具体贡献
		同功能的电源芯片；设计有反向阻断、反接保护、高精度电流监测、多相并联、超低待机功耗等不同功能的 efuse 芯片。负责研发人才招聘，完善研发人才梯队

上述核心技术人员均与标的公司签署了保密协议，并参与了标的公司的股权激励。

（九）安全生产、环境保护及节约能效情况

标的公司所属行业不属于高危险、重污染行业。标的公司主要从事模拟芯片的研发设计与销售，产品的生产和封装测试均委外交由专业晶圆制造、芯片封测厂完成，标的公司日常生产经营不涉及高危险、重污染、高耗能的情况。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

标的公司制定完善的质量控制体系，取得了 ISO9001、ISO14001 质量体系认证及欧盟 CE 认证、美国 UL 认证，将产品质量控制贯穿设计开发、生产制造、客户服务完整链条。

报告期内，标的公司始终高度重视客户对产品和服务的质量反馈信息，积极通过设计开发过程、测试开发过程、可靠性验证过程、生产订单管理过程、代工厂管理过程、不合格品管理过程、客户投诉管理过程、客户满意度管理过程等体系化的管理控制，预防式地提前消除质量隐患。报告期内，标的公司及其子公司未发生过重大质量纠纷的情况。

（十一）生产经营资质

截至本报告书签署日，晶艺半导体取得的主要经营资质及许可情况如下：

序号	资质名称	持有主体	资质编号	核发机关	有效期
1	海关进出口货物收发人备案回执	晶艺半导体	海关编码：51013699DJ 检验检疫备案号：5109500410	成都海关	长期有效

截至本报告书签署日，晶艺半导体及其子公司已经取得从事其主营业务所必需的相关许可、资质、认证等，有权从事其目前正在从事的经营活动；截至本报告书签署日，晶艺半导体取得的上述主要经营资质不存在按照中国法律应

当被吊销、撤销、注销、撤回或即将到期的情形。

八、主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总计	56,455.75	78,300.03	63,023.95
负债总计	15,638.18	39,992.73	9,428.36
所有者权益	40,817.57	38,307.30	53,595.59
归属于母公司所有者的净资产	40,817.57	38,307.30	53,595.59
利润表项目	**2026 年 1-2 月**	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	8,106.74	34,971.68	25,493.82
营业成本	3,365.89	13,104.43	8,699.86
利润总额	-6,951.41	-1,498.11	4,829.34
净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
归属于母公司所有者的净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
归属于母公司所有者的净利润（剔除股份支付）	2,585.12	8,968.14	6,669.06
扣非归母净利润	2,497.57	8,264.98	5,511.71
主要财务指标	**2026 年 2 月 28 日/2026 年 1-2 月**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**	**2024 年 12 月 31 日/2024 年度**
流动比率（倍）	3.71	1.92	6.15
速动比率（倍）	3.00	1.65	4.94
资产负债率	27.70%	51.08%	14.96%
总资产周转率（次/年）	0.72	0.49	0.42
应收账款周转率（次/年）	6.55	6.80	7.92
存货周转率（次/年）	1.62	1.06	0.76
毛利率	58.48%	62.53%	65.87%

注：财务指标计算公式如下：
①流动比率＝流动资产/流动负债
②速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
③资产负债率＝总负债/总资产×100%
④总资产周转率=营业总收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]
⑤应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
⑥存货周转率＝营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]
⑦毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
⑧2026 年 1-2 月总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率已年化处理

九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项

本次交易标的资产为晶艺半导体100.00%股权，晶艺半导体专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品，标的公司经营不涉及自建房产，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。

十、债权债务转移情况

本次交易完成后，晶艺半导体仍为独立的法人主体，晶艺半导体所涉的所有债权、债务仍由晶艺半导体按相关约定继续享有和承担，本次交易不涉及债权债务的转移问题。

十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理

（一）收入的确认原则和计量方法

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2） 客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2） 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该

商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4） 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

标的公司芯片自研业务及芯片定制化量产业务属于在某一时点履行的履约义务。标的公司根据与客户签订的合同（订单）约定将相关产品交付客户，经由客户签收确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。涉及境内公司出口销售的，收入在标的公司完成报关手续并取得出口货物报关单、货运提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（二）会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响

经查阅同行业可比上市公司年度报告，标的公司收入确认原则和计量方法、固定资产折旧年限及残值率等主要会计政策和会计估计与同行业可比上市公司不存在重大差异，对标的公司净利润无重大影响。

（三）财务报表的编制基础

标的公司财务报表以持续经营为编制基础。

（四）财务报表合并范围及变化情况

报告期内，标的公司纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	子公司层级	合并期间
1	香港晶艺半导体有限公司	一级	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日

（五）资产转移剥离调整情况

报告期内，标的公司不存在资产转移剥离情况。

（六）重要会计政策或会计估计与上市公司差异及变更情况

报告期内，标的公司重要会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。

（七）行业特殊的会计处理政策

标的公司不存在行业特殊的会计处理政策。

第五章 发行股份情况

一、发行股份购买资产情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

（二）定价基准日及发行价格

1、定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第六次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《重组管理办法》，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
前 20 个交易日	43.50	34.81
前 60 个交易日	41.46	33.18
前 120 个交易日	40.60	32.49

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（三）发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方。

（四）交易金额及对价支付方式

金证评估以 2026 年 2 月 28 日为评估基准日出具了评估报告，截至评估基准日晶艺半导体 100%股权的评估值为 165,000 万元。参考上述评估结果并经各方协商，确定晶艺半导体 100%股权的交易对价为 165,000 万元。

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权。根据交易各方协商结果，结合交易对方初始投资成本、是否承担业绩承诺义务、晶艺半导体整体估值等因素，对晶艺半导体 100%股权交易对方所持有的晶艺半导体股权价格采取差异化定价，差异化定价原则具体参见本报告书“第一章　本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“4、交易价格及支付方式”。

本次交易中，各交易对方的现金及股份支付比例由交易各方协商确定，上市公司本次交易支付的交易对价总额不超过标的资产评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次交易支付方式的安排明细如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	易坤	晶艺半导体 13.68%股权	-	24,345.02	24,345.02
2	晶格共智	晶艺半导体 11.99%股权	13,459.35	7,880.75	21,340.10
3	晶格共创	晶艺半导体 4.50%股权	5,037.24	2,965.30	8,002.54
4	晶格共赢	晶艺半导体 4.30%股权	4,238.71	3,408.15	7,646.87
5	晶格顶峰	晶艺半导体 4.20%股权	4,953.93	2,515.11	7,469.04
6	晶格未来	晶艺半导体 4.00%股权	4,477.86	2,635.50	7,113.37
7	YA XU	晶艺半导体 10.29%股权	15,278.79	-	15,278.79
8	曾鸣	晶艺半导体 4.00%股权	5,936.72	-	5,936.72
9	曾岳琦	晶艺半导体 4.00%股权	-	5,936.72	5,936.72
10	晶艺求精	晶艺半导体 3.97%股权	562.06	6,494.85	7,056.91
11	晶艺共治	晶艺半导体 3.97%股权	1,148.37	5,908.55	7,056.91

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
12	李六军	晶艺半导体 3.46%股权	-	6,162.86	6,162.86
13	融芯科技	晶艺半导体 1.00%股权	742.09	742.09	1,484.18
14	曾浩	晶艺半导体 1.00%股权	742.83	742.83	1,485.67
15	凌风	晶艺半导体 1.00%股权	1,484.18	-	1,484.18
16	薛峰	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
17	陈国栋	晶艺半导体 0.80%股权	-	1,422.67	1,422.67
18	苏鹏飞	晶艺半导体 0.40%股权	-	711.34	711.34
19	高鹏翼盛	晶艺半导体 9.30%股权	6,907.50	6,907.50	13,815.00
20	高鹏联盛	晶艺半导体 2.62%股权	1,948.27	1,948.27	3,896.54
21	腾元投资	晶艺半导体 1.19%股权	885.58	885.58	1,771.16
22	陈艺琴	晶艺半导体 1.68%股权	872.36	1,328.37	2,200.73
23	易荣坤	晶艺半导体 0.11%股权	456.00	-	456.00
24	芯联启辰	晶艺半导体 5.36%股权	3,980.85	3,980.85	7,961.70
25	华天集团	晶艺半导体 2.24%股权	1,163.15	1,771.15	2,934.31
26	天利投资	晶艺半导体 0.15%股权	608.00	-	608.00
合计			**74,883.85**	**90,116.15**	**165,000.00**

（五）发行股份数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份的数量之和，其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。按上述公式计算得出的股份数量向下取整精确至股，不足一股的部分相应计入上市公司的资本公积金。

依据上述原则计算发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行数量（股）
1	易坤	24,345.02	7,493,081
2	晶格共智	7,880.75	2,425,593
3	晶格共创	2,965.30	912,680
4	晶格共赢	3,408.15	1,048,985
5	晶格顶峰	2,515.11	774,117
6	晶格未来	2,635.50	811,173

序号	交易对方	股份对价（万元）	发行数量（股）
7	YA XU	-	-
8	曾鸣	-	-
9	曾岳琦	5,936.72	1,827,246
10	晶艺求精	6,494.85	1,999,031
11	晶艺共治	5,908.55	1,818,573
12	李六军	6,162.86	1,896,848
13	融芯科技	742.09	228,405
14	曾浩	742.83	228,634
15	凌风	-	-
16	薛峰	1,422.67	437,880
17	陈国栋	1,422.67	437,880
18	苏鹏飞	711.34	218,940
19	高鹏翼盛	6,907.50	2,126,038
20	高鹏联盛	1,948.27	599,652
21	腾元投资	885.58	272,569
22	陈艺琴	1,328.37	408,854
23	易荣坤	-	-
24	芯联启辰	3,980.85	1,225,253
25	华天集团	1,771.15	545,138
26	天利投资	-	-
合计		**90,116.15**	**27,736,570**

在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

（六）锁定期安排

1、交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起 12 个月内不得转让。但是，若交易对方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券

登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。若交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 6 个月内不得上市交易或转让。前述“不得转让”包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

2、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算。

3、进一步地，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的一次性支付的股份，在协议约定的业绩承诺期内逐年解除锁定，即如标的公司完成协议约定的当年业绩承诺或业绩承诺期届满时履行完毕业绩补偿义务的，则按照协议约定的比例解除上述股份的锁定（业绩承诺方之间以其于本次交易获得的股份对价的相对比例解除锁定），具体安排如下：

（1）第一期：标的公司业绩承诺期内第一年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的股份数为业绩补偿锁定股份数的 25% － 因履行业绩承诺期第一年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）；

（2）第二期：标的公司业绩承诺期内第二年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 60% － 因履行业绩承诺期第一年及第二年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）；

（3）第三期：标的公司业绩承诺期内第三年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按协议的约定履行完毕业绩补偿义务（如需）之次日（二

者孰晚），依据协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 100% － 因履行业绩承诺期第一年、第二年及第三年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）。

4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，各方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

二、募集配套资金所发行普通股股份情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

上市公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

（三）发行对象

本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

（四）发行规模及数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 90,083.85 万元，未超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。

本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（五）募集配套资金用途

本次交易募集配套资金不超过 90,083.85 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，具体用途如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
支付交易现金对价	74,883.85	83.13%
支付中介机构费用及相关税费	7,500.00	8.32%
补充上市公司流动资金	7,700.00	8.55%
合计	**90,083.85**	**100.00%**

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司及标的公司可以根据募集资金的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（六）锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意

见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

（七）滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

（八）本次募集配套资金的必要性

1、前次募集资金金额、使用效率及剩余情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司对募投项目已累计投入资金人民币 24,011.25 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目资金人民币 1,886.06 万元；于 2023 年 8 月 14 日起至 2025 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 22,125.19 万元，其中：本年度使用募集资金 3,944.11 万元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用超募资金 9,999.43 万元，其中：本年度使用超募资金补充流动资金 4,000.00 万元，使用超募资金回购公司股份 1,999.43 万元。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 34,319.28 万元（含利息收入、现金管理收益等），截止日募集资金专户余额 19,819.28 万元与募集资金余额 34,319.28 万元差异 14,500.00 万元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款 8,500.00 万元、证券公司保本型理财产品 6,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、首次公开发行募集资金总额	75,213.16
减：发行费用	8,733.27

二、首次公开发行募集资金净额	66,479.89
加：未使用募集资金专户支付的发行费用（印花税等）	16.94
三、截止本期末累计已使用的募集资金	48,510.68
（一）截止本期末募投项目已使用资金	24,011.25
其中：置换预先投入自筹资金	1,886.06
以前年度募投项目已使用资金	18,181.09
本期募投项目已使用资金	3,944.11
项目	**金额**
（二）截止本期末累计已使用超募资金	9,999.43
以前年度超募资金永久补充流动资金金额	4,000.00
本期使用超募资金永久补充流动资金金额	4,000.00
回购公司股份	1,999.43
（三）截止本期末闲置募集资金进行现金管理余额	14,500.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额	
四、利息收入与现金管理收益	1,834.35
其中：存款利息收入	394.66
现金管理收益	1,439.68
减：手续费支出	1.22
五、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	19,819.28

2、本次募集资金用途符合监管规定

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的支付交易现金对价、支付中介机构费用及相关税费及补充上市公司流动资金。若本次上市公司以自有资金或债务融资方式全额支付，将可能导致资产负债率上升，进而对上市公司现金流产生一定不利影响。此外，上市公司坚持前瞻性战略布局，持续加大研发投入以覆盖全品类功率器件、推动功率 IC 及第三代半导体产品系列化，并加强市场推广与渠道建设，运营资金需求持续增加。因此，综合考虑本次交易方案和上市公司的财务状况，上市公司拟通过发行股份募集配套资金并用于支付现金交易对价，保障本次交易的顺利进行，缓解上市公司资金支付压力，提高上市公司财务灵活性，提高整合效用，同时通过募集配套资金用于补充上市公司流动资金，提高上市公司应对短期流动性压力的能力，促进上市公司的进一步发展。

（九）募集配套资金的管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。募集资金到位后，上市公司将及时与独立财务顾问、银行签署募集资金监管协议，并严格按照上述制度与协议的要求规范管理募集资金。

（十）本次募集配套资金失败的补救措施

根据本次交易方案，发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金失败，上市公司将以自有资金或自筹资金解决本次募集资金需求。

第六章 标的资产评估作价基本情况

一、标的资产总体评估情况

（一）评估基本情况

本次采用资产基础法和市场法对晶艺半导体进行评估，评估基准日为 2026 年 2 月 28 日，并采用市场法的评估结果作为标的公司全部股份的评估值。根据金证评估《苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2026】A0554 号），晶艺半导体股东全部权益的评估值为 165,000.00 万元。

截至评估基准日，晶艺半导体的评估情况具体如下：

单位：万元

评估方法	晶艺半导体股东全部权益评估值	合并口径		
		净资产	增值额	增值率
资产基础法	84,979.49	40,817.57	44,161.92	108.19%
市场法	165,000.00		124,182.43	304.24%

（二）评估假设

1、一般假设

（1）交易假设：即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（2）公开市场假设：即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。

（3）持续经营假设：即假定一个经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

2、特殊假设

（1）假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的法律法规、宏观经济形势，以及政治、经济和社会环境无重大变化；

（2）假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策除公

众已获知的变化外，无其他重大变化；

（3）假设与被评估单位相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

（4）假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

（5）假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；

（6）假设委托人及被评估单位提供的基础资料、财务资料和经营资料真实、准确、完整；

（7）假设可比企业交易价格公允，相关财务数据和其他信息真实可靠；

（8）假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响；

（9）假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策与编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一致；

（10）假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式、业务结构与目前基本保持一致，不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境不可预见性变化的潜在影响；

（11）假设被评估单位拥有的各项经营资质，在符合现有续期条件下未来到期后可以顺利续期；

（12）假设被评估单位在符合现有高新企业认定条件下，未来持续被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率；

（13）假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

（三）评估方法的选择

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对

象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

《资产评估执业准则——企业价值》规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、资产基础法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法及市场法。评估方法选择理由如下：

1、资产基础法适用性分析

被评估单位评估基准日资产负债表中各项表内资产、负债及重要的表外资产可被识别并可采用适当的方法单独进行评估，故整体上适用资产基础法。

2、收益法适用性分析

被评估单位是国内领先的电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售企业，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等，属于 Fabless 芯片设计企业。这类轻资产企业将制造、封装、测试委外，注重研发，其核心价值在于技术、研发团队、客户导入、产品平台和未来国产替代机会，而这些往往难以直接从报表资产或短期利润中体现。收益法依赖未来收入、利润、现金流和折现率的可靠预测，但芯片设计行业技术迭代快、研发投入高、产品导入周期长、收益法容易出现“成本端反映研发投入、收入端未充分反映未来机会”的不匹配，不适用盈利模式非线性的新经济企业，未来收益预测和测算风险衡量难以同时进行合理预计，因此不宜采用收益法进行评估。

3、市场法适用性分析

被评估单位主要从事于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售，属于集成电路行业芯片设计企业，经查询，模拟芯片行业存在较多的同行业上市公司，可比公司公开市场交易价格、经营情况和财务状况等相关必要的数据公开、可查询。因此，本次适宜采用整体市场法评估。

被评估单位的定制化量产业务稳定，历史期为企业提供持续稳定的现金流以供技术开发及设计业务开拓，考虑到该业务的服务模式、收入成长性与芯片设计业务存在差异，其价值驱动因素亦有所不同。若将定制化量产业务收入乘以市场法价值比率放大，可能导致整体企业价值被高估。因此谨慎起见，考虑到定制化量产业务线开展以来，稳步发展，企业产品、技术、客户关系、供销体系稳定，企业管理可对其未来年度经营收益及成本费用等相关参数进行估测，获得预期收益所承担的风险也可以量化。故结合可预见的供应体系及客户需求，采用收益法有限年对该业务收益进行预测并折现，视同货币资金或非经营性资产在基准日加回，收益期为评估基准日至 2027 年底。

（四）评估结论

1、资产基础法评估结果

经资产基础法评估，评估基准日被评估单位总资产账面价值 51,926.96 万元，评估值 100,854.88 万元，增值额 48,927.92 万元，增值率 94.22%。总负债账面价值 15,875.39 万元，评估值 15,875.39 万元，无增减值变动。所有者权益账面价值 36,051.57 万元，评估值 84,979.49 万元，评估增值 48,927.92 万元，增值率 135.72%。

2、市场法评估结果

经市场法评估，被评估单位评估基准日股东全部权益评估值为 165,000.00 万元，比审计后母公司账面所有者权益增值 128,948.43 万元，增值率 357.68%；比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值 124,182.43 万元，增值率 304.24%。

3、评估结论

资产基础法评估得出的股东全部权益价值为 84,979.49 万元，市场法评估得出的股东全部权益价值为 165,000.00 万元，两者相差 80,020.51 万元。

资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；市场法是从可比公司的市场估值倍数角度考虑的，反映了当前现状企业的市场估值水平。两种评估方法对企业价值的显化范畴不同，资产基础法仅能对各单项有形资产和可辨认的无形资产进行评估，不能完全体现各单项资产互相匹配和有机组合因素的整合效应对企业价值的贡献；而市场法通过可比企业的股权价值结合其他相关资料分析得出被评估单位的股权价值，价值内涵能够包括企业不可辨认的无形资产，以及各单项资产整合效应的价值，因此评估结果比资产基础法高。

被评估单位属于模拟芯片设计企业，企业的主要价值除固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业拥有的如客户资源、管理能力和人才积累等重要的无形资源的贡献。由于市场法采用的数据直接来源于资本市场，随着我国半导体行业的快速发展，国内 A 股市场上出现了较多的与被评估单位相似的芯片设计上市公司，市场法数据来源公开透明、真实可靠且披露及时，其成熟的估值体系能够更好的体现被评估单位股权价值。考虑到市场法采用的数据更加真实、可靠，评估结果更加客观，且我国的资本市场也日臻成熟，相对稳定的股市也提供了市场法定价的基础，故本次选择市场法评估结果作为最终的评估结论。

根据上述分析，本评估报告评估结论采用市场法评估结果，即：被评估单位评估基准日的股东全部权益价值评估结论为人民币 165,000.00 万元，大写壹拾陆亿伍仟万元整。

本评估结论在市场法评估中考虑了流动性对评估对象价值的影响；由于中国市场缺乏比较可靠的控制权溢价率或缺乏控制权折价率数据，本评估结论没有考虑控制权对评估对象价值的影响。

二、资产基础法评估情况

（一）货币资金

1、银行存款

银行存款账面值 183,999,120.22 元，共有 12 个银行账户，9 个为人民币账户，3 个为美元账户。评估人员对各银行账户进行了函证，取得了各银行账户

的银行对账单和银行存款余额调节表，并对未达账项调整的真实性进行了核实。银行存款以核实无误后的账面价值作为评估值。对于外币账户，在核实原币金额的基础上，按评估基准日的国家外汇牌价折算为人民币的价值作为评估值。

银行存款评估值为 183,999,120.22 元。

2、其他货币资金

其他货币资金账面值 14,131,742.45 元，系定期存款。评估人员核实了相关账户的对账单以及原始凭证，确认账面金额属实。其他货币资金以核实无误后的账面价值作为评估值。

其他货币资金评估值为 14,131,742.45 元。

货币资金评估值合计为 198,130,862.67 元。

（二）应收账款

应收账款账面余额 94,310,212.17 元，坏账准备 4,541,694.30 元，账面价值 89,768,517.87 元，系企业销售商品应收的货款。评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证等相关资料，核实交易事项的真实性、账龄、业务内容和金额等，并对大额款项进行了函证，核实结果账、表、单金额相符。

评估人员在对应收账款核实无误的基础上，借助历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。

根据各欠款单位的具体情况，将应收账款分为单项评估坏账风险损失的应收账款和按组合评估坏账风险损失的应收账款两类，分别采用个别认定法和账龄分析法评估坏账风险损失。

应收账款类别	账面余额（元）
单项评估坏账风险损失的应收账款	3,476,326.25
按组合评估坏账风险损失的应收账款	90,833,885.92
应收账款合计	94,310,212.17

单项评估坏账风险损失的应收账款中，全部为应收关联方的款项，预计发生坏账损失的可能性很小，评估坏账风险损失为 0。

按组合评估坏账风险损失的应收账款中，对很可能收不回部分款项，且难以确定收不回账款数额的，按照账龄分析法，根据账龄和历史回款分析估计坏账风险损失比例，进而估计出评估坏账风险损失，如下表所示：

金额单位：元

账龄	账面余额	评估坏账风险损失比例	评估坏账风险损失金额
一年以下	90,833,885.92	5%	4,541,694.30
一至二年	0.00	20%	0.00
二至三年	0.00	50%	0.00
三至四年	0.00	100%	0.00
合计	**90,833,885.92**		**4,541,694.30**

根据上述方法，得出应收账款评估坏账风险损失为 4,541,694.30 元，以核实后的账面余额减去评估坏账风险损失作为评估值。原账面计提的坏账准备 4,541,694.30 元评估为零。

应收账款评估值为 89,768,517.87 元。

（三）预付账款

预付账款账面值 5,841,085.06 元，系预付的材料及加工款、咨询服务费、物业费等。评估人员在了解预付账款形成原因的基础上，按照重要性原则，对大额或账龄较长等情形的预付账款进行了函证，并对相应的合同等原始凭证进行了抽查。通过核实与分析，未发现账实不符的情况，预计各预付款项均能收回相应资产或权利，则以核实后账面值作为评估值。

预付账款评估值为 5,841,085.06 元。

（四）其他应收款

其他应收款账面余额 3,713,681.51 元，坏账准备 185,684.07 元，账面价值 3,527,997.44 元，系押金、保证金等。评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证等相关资料，核实交易事项的真实性、账龄、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符。

评估人员在对其他应收款核实无误的基础上，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。

根据各欠款单位的具体情况，将其他应收款分为单项评估坏账风险损失的其他应收款和按组合评估坏账风险损失的其他应收款两类，分别采用个别认定法和账龄分析法评估坏账风险损失。

其他应收款类别	账面余额（元）
单项评估坏账风险损失的其他应收款	3,265,992.62
按组合评估坏账风险损失的其他应收款	447,688.89
其他应收款合计	3,713,681.51

单项评估坏账风险损失的其他应收款中，全部为押金保证金、备用金，预计发生坏账损失的可能性较小，统一按照 5%风险损失比例考虑评估坏账风险损失，因此评估坏账风险损失 163,299.63 元。

按组合评估坏账风险损失的其他应收款中，对很可能收不回部分款项，且难以确定收不回账款数额的，按照账龄分析法，根据账龄和历史回款分析估计坏账风险损失比例，进而估计出评估坏账风险损失，如下表所示：

金额单位：元

账龄	账面余额	评估坏账风险损失比例	评估坏账风险损失金额
一年以下	447,688.89	5%	22,384.44
一至二年	0.00	20%	0.00
二至三年	0.00	50%	0.00
三至四年	0.00	100%	0.00
合计	**447,688.89**		**22,384.44**

根据上述方法，得出其他应收款评估坏账风险损失为 185,684.07 元，以核实后的账面余额减去评估坏账风险损失作为评估值。原账面计提的坏账准备 185,684.07 元评估为零。

其他应收款评估值合计为 3,527,997.44 元。

（五）存货

存货账面余额 120,776,093.26 元，存货跌价准备 18,244,093.98 元，账面价值 102,531,999.28 元，包括原材料、在库周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资。

评估人员将存货评估申报表与总账、明细账及财务报表进行核对，查阅相

关账簿记录和原始凭证，以确认存货的真实存在及权属状况。另外，评估人员了解企业的存货内控制度，并通过查阅最近的存货进出库单等，掌握存货的周转情况，并对存货的品质、库存时间进行核查。最后，评估人员与企业存货保管人员共同对存货进行了抽盘，并结合盘点日至评估基准日之间的存货出入库记录倒推计算出评估基准日存货的实有数量。

1、原材料

原材料账面余额 32,889,642.31 元，原材料跌价准备 3,385,820.16 元，账面价值 29,503,822.15 元，主要包括 LA8200CBA、CS100K20B 等晶圆。

对于正常存货，由于原材料流动快，原材料在库时间较短，其账面值很接近市场价格，故按账面值确定评估值。对其中库龄在 2 年以上、原为研发活动购入后因项目取消而无法用于其他客户项目的专用原材料，通过分析计算，扣除相应贬值额后确定评估值。原账面计提的原材料跌价准备评估为 0。

原材料评估值为 29,503,822.15 元。

2、在库周转材料

在库周转材料账面余额 34,683.19 元，在库周转材料跌价准备 0.00 元，账面价值 34,683.19 元。

在库周转材料根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值。被评估单位在库周转材料采用实际成本核算，账面价值包括购置价及其他合理费用。对于价格变动不大的在库周转材料，以核实后的账面值作为评估值。

在库周转材料评估值为 34,683.19 元。

3、库存商品

库存商品账面余额 47,321,878.31 元，库存商品跌价准备 13,685,186.55 元，账面价值 33,636,691.76 元，主要为委外生产的芯片。

对于正常库存商品，根据其不含税出厂销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值；对其中残损、2 年以上库龄的库存商品，通过分析计算，扣除相应贬值额（保留变现净值）后确定评估值；对其中属于

工程验证品、不对外销售的存货，按账面值评估；对未对外销售过的库存商品，参照委托加工物资评估方式评估。

正常库存商品计算公式如下：

库存商品评估值＝库存商品数量×库存商品评估单价

库存商品评估单价＝不含税销售单价×[1－销售费用率－税金及附加率－销售利润率×企业所得税税率－销售利润率×（1－企业所得税税率）×利润扣除率]

其中，库存商品数量根据评估基准日库存商品的实际数量确定；不含税销售单价根据评估基准日近期库存商品的不含税销售价格确定；销售费用率、税金及附加率、销售利润率结合历史年度财务报表情况分析确定；企业所得税税率按评估基准日企业适用的税率确定；利润扣除率根据库存商品的销售状况确定，其中畅销产品、正常销售产品和勉强销售产品的利润扣除率分别为 0%、50%和 100%。

库存商品评估值为 51,034,268.85 元。

4、发出商品

发出商品账面余额 10,125.92 元，发出商品跌价准备 0.00 元，账面价值 10,125.92 元，主要包括已向苏州芯欣微电子有限公司发出的芯片。

对于发出商品，根据其不含税出厂销售价格减去部分销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值，计算公式如下：

发出商品评估值＝发出商品数量×发出商品评估单价

发出商品评估单价＝不含税销售单价×[1－销售费用率×销售费用扣除率－税金及附加率－销售利润率×企业所得税税率－销售利润率×（1－企业所得税税率）×利润扣除率]

其中，发出商品数量根据评估基准日发出商品的实际数量确定；不含税销售单价根据评估基准日近期发出商品的不含税销售价格确定；销售费用率、税金及附加率、销售利润率结合历史年度财务报表情况分析确定；销售费用扣除率根据发出商品的销售进度分析确定；企业所得税税率按评估基准日企业适用

的税率确定；利润扣除率在库存商品利润扣除率基础上下浮确定。

发出商品评估值为 21,200.00 元。

5、委托加工物资

委托加工物资账面余额 40,519,763.53 元，委托加工物资跌价准备 1,173,087.27 元，账面价值 39,346,676.26 元，主要包括委外加工的芯片，全部为半成品状态。

对于委托加工物资，难以将各项委托加工物资折合为最终成品的约当产量，故本次评估对于 2 年库龄以下的存货根据企业的产品销售毛利率水平折合其不含税销售价格后扣减销售费用、全部税金和部分税后净利润后确定评估值，对于 2 年以上库龄的委托加工物资结合其产品特性等因素后考虑扣减率确定其相应估值。

委托加工物资评估值＝委托加工物资数量×委托加工物资评估单价

委托加工物资评估单价＝不含税销售单价×[1－销售费用率－税金及附加率－销售利润率×企业所得税税率－销售利润率×（1－企业所得税税率）×利润扣除率]

委托加工物资折合销售单价＝账面单价×[1＋销售毛利率÷（1－销售毛利率）]

委托加工物资评估值为 46,786,814.72 元。

（六）一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产账面值 32,579,666.61 元，系大额存单。

对于大额存单，评估人员核查了大额存单产品的开户证书，根据本金加持有期利息计算评估值。

一年内到期的非流动资产评估值为 32,579,666.61 元。

（七）其他流动资产

其他流动资产账面值 56,751,474.90 元，系代理加工存货、物业管理费待摊费用。

对于代理加工存货，本次评估按照存货评估方法进行评估。对于待摊费用，评估人员调查了解了待摊费用发生的原因，以核实无误后的账面值作为评估值。

其他流动资产评估值为 79,671,352.73 元。

（八）长期股权投资

1、评估范围

长期股权投资账面余额 829,914.47 元，减值准备 0.00 元，账面价值 829,914.47 元，共 1 项，概况如下：

金额单位：人民币元

序号	企业名称	投资时间	出资比例%	原始投资成本	减值准备	账面价值
1	香港晶艺半导体有限公司	2021 年 5 月	100.00	829,914.47		829,914.47
合计				**829,914.47**		**829,914.47**

2、被投资单位概况

企业名称：香港晶艺半导体有限公司

企业类型：私人股份有限公司

住　　所：UNIT 221, 2/F, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG

商业登记号码：71491278

成立日期：2019-12-23

注册资本：100 万元港币

评估基准日该公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例
1	晶艺半导体有限公司	100.00	100.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

该企业近年的财务状况和经营成果概况如下：

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2026 年 2 月 28 日
资产总计	5,591.10	5,536.39	5,275.09

负债合计	643.92	592.51	433.84
所有者权益合计	4,947.18	4,943.88	4,841.25
项目	**2024 年**	**2025 年**	**2026 年 1-2 月**
营业收入	1,378.76	782.87	53.70
利润总额	459.09	168.01	-27.40
净利润	480.92	108.15	-28.16

3、评估方法

评估人员首先对长期股权投资的形成原因、账面值情况和被投资单位的实际状况进行了调查，并查阅了投资协议、股东会决议、企业章程、会计记录等资料，以核实长期股权投资的真实性和完整性。在此基础上，根据长期股权投资的具体情况选择适当的评估方法进行评估。

具备单独评估条件的长期股权投资，可采用资产基础法、收益法或市场法对被投资单位进行整体评估，并以被投资单位股东权益评估值乘以持股比例确定评估值。

鉴于香港晶艺半导体有限公司的基本职能为辅助母公司业务发展，承担境外地区的贸易职能，本次评估中对该子公司仅选取资产基础法单独评估。

长期股权投资的评估结果汇总如下：

金额单位：元

序号	企业名称	出资比例	股东权益评估值	长期股权投资评估值
1	香港晶艺半导体有限公司	100%	48,263,699.99	48,263,699.99
合计			**48,263,699.99**	**48,263,699.99**

长期股权投资评估值为 48,263,699.99 元。

（九）固定资产-设备类

1、评估范围

纳入本次评估范围的设备类资产包括机器设备、电子设备。评估基准日各类设备的数量及账面价值如下表所示：

金额单位：元

设备类别	数量（台/套/辆）	账面原值	账面净值	减值准备	账面价值
机器设备	541	23,819,312.55	10,229,728.98	0.00	10,229,728.98

设备类别	数量（台/套/辆）	账面原值	账面净值	减值准备	账面价值
电子及其他设备	74	1,056,776.09	451,290.81	0.00	451,290.81
合计	**615**	**24,876,088.64**	**10,681,019.79**	**0.00**	**10,681,019.79**

2、设备概况

企业共拥有设备 615 台（套），按其不同用途分为机器设备、电子及其他设备两类，具体构成如下：

（1）机器设备：共 541 台（套），主要包括高低温冲击气流仪 ATS7100、半导体测试机 STS8200、测试机 CTA8280FE 等设备，主要分布于公司及封测厂。

（2）电子及其他设备：共 74 台（套），包括电脑、格力空气净化器、空调等，主要分布于公司。

企业对于设备类资产采用年限平均法计提折旧，各类设备的折旧政策如下：

设备类别	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	3-8 年	0%	12.50%-33.33%
电子及其他设备	3 年	0%	33.33%

3、清查核实

（1）核实方法

1）核对账目：将被评估单位提供的设备类资产评估申报明细表与日记账、总账、报表以及固定资产台账核对，检查是否相符，并核对了部分设备类原始入账的会计凭证等。

2）资料收集：评估人员按照重要性原则，收集了主要设备的购置合同、发票、付款凭证；收集了设备日常维护与管理制度等评估相关资料。

3）现场勘察：评估人员和企业相关人员共同对评估基准日申报的设备类资产进行了盘点与查看，核对设备名称、规格型号、生产厂家、数量、购置日期、启用日期等基本信息；了解设备的原始制造质量、维护保养情况、运行状态及故障频率、利用率、工作环境状况等使用信息；了解设备的预计使用年限和完损程度等成新状况；填写了典型设备的现场调查表。

4）现场访谈：评估人员向企业调查了解设备类资产账面原值构成、折旧政

策、减值准备计提方法等相关会计政策和会计估计；调查了解主要设备的购置历史和使用现状，以及技术先进性和使用经济性等信息。

（2）核实结论

现场勘察和清查核实表明，设备账、卡、物基本相符，设备管理工作和维护保养情况良好，在用设备性能可靠，质量稳定，均处于正常运行状态。

4、评估方法

（1）评估方法选取理由

根据《资产评估执业准则——机器设备》，执行机器设备评估业务时，要根据评估对象、价值类型、资料收集等具体情况，分析成本法、市场法和收益法三种资产评估基本方法的适用性，并恰当选择评估方法。

由于国内二手设备市场交易不活跃，难以获取足够数量的可比的二手设备交易案例，故不适合采用市场法评估；由于被估设备系整体用于企业经营，基本上不具有独立获利能力，或获利能力无法量化，故不适合采用收益法评估；由于设备重置成本的相关数据和信息来源较多，且各类损耗造成的贬值也可以进行估计，故本次对于设备主要采用成本法评估。

（2）成本法介绍

设备成本法评估的基本公式如下：

评估值＝重置成本×综合成新率

1）重置成本的确定

根据《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）、《关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》（财税[2009]113 号）和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），对于增值税一般纳税人，购置符合增值税抵扣条件的设备，设备重置成本应扣除相应的可抵扣增值税税额。

①国产机器设备重置成本的确定

国产机器设备的重置成本计算公式如下：

重置成本＝设备购置价＋运杂费＋安装费＋基础费＋资金成本－可抵扣增值税额

Ⅰ设备购置价

设备购置价的主要取价依据如下：

- 查询百度爱采购、中关村在线等网站中的设备价格信息；
- 参考评估基准日近期同类设备或功能相近的替代设备的市场价格分析调整确定；
- 在设备原始购置价格基础上考虑市场行情变化及技术进步对设备价格的影响调整确定。

Ⅱ运杂费

运杂费是指设备在运输过程中发生的运输费、装卸费、搬运费等费用，以设备购置价为基数，按一定的运杂费率计取，计算公式如下：

运杂费＝设备购置价×运杂费率

对于购置价格中包含运输费用的设备，不再重复计取运杂费。

Ⅲ安装费

安装费是指为安装设备而发生的人工费、材料费、机械费等费用，以设备购置价为基数，按一定的安装费率计取，计算公式如下：

安装费＝设备购置价×安装费率

对于无须安装的设备，不考虑安装费。

Ⅳ基础费

基础费是指为建造设备基础而发生的人工费、材料费、机械费等费用，以设备购置价为基数，按一定的基础费率计取，计算公式如下：

基础费＝设备购置价×基础费率

对于无须基础或基础费的设备，不考虑基础费；对于已在房屋建筑物类资产评估值中考虑的设备，不再重复计取基础费。

Ⅴ资金成本

对于建设周期长、投资额大的设备，以设备购置价、运杂费、安装费、基础费、前期及其他费用之和为基数，根据合理工期和相应期限的贷款利率，按照资金均匀投入计取资金成本，计算公式如下：

资金成本＝（设备购置价＋运杂费＋安装费＋基础费）×贷款利率×合理工期×1/2

对于建设周期短、投资额小的设备，不计取资金成本。

Ⅵ可抵扣增值税

设备重置成本中的可抵扣增值税包括设备购置价、运杂费、安装费、基础费中的可抵扣增值税，计算公式如下：

可抵扣增值税额＝设备购置价/（1＋13%）×13%＋（运杂费＋安装费＋基础费）/（1＋9%）×9%

2）综合成新率的确定

①机器设备成新率的确定

对于价值量较大的机器设备，在年限法理论成新率的基础上，再结合各类因素进行调整，最终确定设备的综合成新率，计算公式如下：

综合成新率＝理论成新率×调整系数

其中：

理论成新率＝（经济使用年限－已使用年限）÷经济使用年限×100%

调整系数＝K1×K2×K3×K4×K5

各项调整因素包括设备的原始制造质量（K1）、维护保养情况（K2）、设备的运行状态及故障频率（K3）、设备的利用率（K4）、设备的环境状况（K5），根据现场勘查了解到的情况确定。

②电子及其他设备成新率的确定

对于价值量较小的一般电子及其他设备，直接采用年限法确定成新率，计算公式如下：

成新率＝（经济使用年限－已使用年限）÷经济使用年限×100%

5、评估结果

纳入本次评估范围的设备类资产评估结果概况如下表所示：

金额单位：元

设备类别	账面原值	账面价值	评估原值	评估净值	增值额	增值率（%）
机器设备	23,819,312.55	10,229,728.98	22,269,400.00	15,592,036.00	5,362,307.02	52.42
电子及其他设备	1,056,776.09	451,290.81	979,800.00	773,688.00	322,397.19	71.44
合计	**24,876,088.64**	**10,681,019.79**	**23,249,200.00**	**16,365,724.00**	**5,684,704.21**	**53.22**

对于设备类固定资产评估价值与账面价值比较变动原因分析如下：

由于企业对机器设备、电子及其他设备的会计折旧年限短于评估所采用的经济使用年限，实际成新率高于账面成新率，致使机器设备、电子及其他设备均出现评估增值。

（十）在建工程

1、评估范围

在建工程账面余额 12,918.59 元，减值准备 0 元，账面价值 12,918.59 元。全部为在建工程-设备安装工程，系购入尚未安装的柜机空调。

2、清查核实

核对账目：根据被评估单位提供的在建工程评估申报明细表，首先与被评估单位的资产负债表相应科目核对使总金额相符；然后与被评估单位的在建工程明细账、台账核对使明细金额及内容相符；最后对部分在建工程核对了原始记账凭证等。

资料收集：评估人员按照重要性原则，根据在建工程的类型、金额等特征收集了项目合同、付款凭证等评估相关资料。

现场勘查：评估人员和被评估单位相关人员共同对评估基准日申报的在建工程进行了现场勘查。

现场访谈：评估人员向被评估单位调查了解了在建工程的质量、用途等信息；调查了解了在建工程账面原值构成等相关会计政策与规定。

核实结果：在建工程—设备安装工程账面价值组成为设备原价，评估基准日时尚未投入使用，基准日后陆续投入使用。

3、评估方法

被评估单位的在建工程-设备仅为购入的暂未安装的柜机空调，金额较小，本次评估按照账面值确认评估值。

4、评估结果

在建工程账面价值 12,918.59 元，评估值 12,918.59 元。

（十一）使用权资产

使用权资产账面价值 11,829,860.71 元，共计 7 项，系租赁的房屋。

评估人员查阅了使用权资产的相关的入账凭证和租赁合同，根据合同条款复核了使用权资产的入账和折旧过程。由于相关租赁合同中的租金水平与同区域内类似房地产的市场租金水平基本相符，对于使用权资产以核实后的账面值作为评估值。

使用权资产评估值 11,829,860.71 元。

（十二）无形资产-其他无形资产

1、评估范围

无形资产-其他无形资产账面原值 2,732,755.88 元，账面价值 1,297,798.00 元，共计 12 项，包括外购软件 8 项、核心技术资产组 1 项（包含已授权专利 62 项、集成电路布图设计专有权 137 项）、域名资产组 1 项（包含域名 2 项）、商标资产组 1 项（包含商标 2 项）、合同权益 1 项，其中核心技术资产组、商标资产组、域名资产组、合同权益在账面未反映。

2、清查核实

对于外购软件，评估人员在核对总账、明细账的基础上，查验了相关的采购合同和发票，并对软件的使用情况进行现场勘查。

对于专利权、商标权、集成电路布图设计专有权等知识产权，评估人员查验了相关的权利证书、缴费凭证等，并在发证单位网站查询核实知识产权的真

实性、有效性。

对于域名，评估人员查验了相关的注册证书等资料，并登录域名验证了域名的存在性。

3、评估方法

（1）外购软件

企业基准日时点存在 8 项外购软件，购置时间在 2022 至 2025 年期间，目前软件均处于正常使用过程中。鉴于软件更新迭代速度较快且企业软件购置时间较长，已无法向软件供应商询价或网络准确查询其现行不含税价格，故采用国家统计局公布的工业生产者购进价格指数（PPI）对其核实后的原始购入价格进行调整后，考虑一定的成新率确定评估值。

基本公式如下：

技术评估值＝重置成本×（1－贬值率）

其中，重置成本基于核实后的原始购入价格与原始购入当月至评估基准日的 PPI 调整指数综合考虑后进行评估。

（2）关键核心技术

此处描述的关键核心技术包含专利权、集成电路布图设计专有权，考虑到这两类无形资产的形成与企业的业务发展息息相关，且紧密联系，共同发挥作用，难以区分各单项无形资产的贡献，因此此次进行打包评估。

技术类无形资产的基本评估方法包括成本法、收益法、市场法。

收益法是将无形资产在未来收益期内产生的收益，按一定的折现率折算成现值，来求得无形资产价值的方法。由于被评估单位的专利及相关技术均与电机驱动业务及电源管理业务相关，未来收益受到半导体行业整体发展进程与企业自身发展战略调整的影响，精确测算各年度收益数据具有较大不确定性，未来收益预测和测算风险衡量难以同时进行合理预计，因此不宜采用收益法进行评估。

市场法即根据类似无形资产的市场价经过适当的调整，来确定无形资产价值的方法。由于我国的市场经济尚不成熟，无形资产的交易更少，因此无形资

产评估中市场法的使用也很少。且由于技术具有较强的独特性，不同技术进行类比的要求和难度较大，难以收集到类似技术的交易案例及相关案例的具体信息，故本次未采用市场法评估。

而成本法是通过确定无形资产的重置成本及合理回报，并考虑贬值情况，来确定无形资产的评估值。电机驱动业务及电源管理业务的相关核心技术主要系企业自研形成，其研发投入较高，持续高投入形成的相关技术和专利在未来具有长期应用价值。考虑到开发形成过程中的直接成本和间接成本资料可以从企业获得，故宜采用成本法进行评估。

技术评估值＝重置成本×（1－贬值率）

其中，重置成本主要包括直接成本、间接成本、资金成本和合理利润。贬值率根据专利及专有技术状态综合考虑后进行评估。

（3）商标

由于被估商标在行业内市场知名度和影响力较低，主要作为标识作用，对企业收益的直接贡献有限，故本次未采用收益法评估；由于商标具有较强的独特性，不同商标进行类比的要求和难度较大，难以收集到类似商标的交易案例及相关案例的具体信息，故本次未采用市场法评估；由于商标的取得成本可以计量，故本次采用成本法评估，基本公式如下：

商标评估值＝重置成本×（1－贬值率）

其中，重置成本主要包括设计和注册商标所需支付的设计成本和商标申请费用。对于标样相同的商标，设计成本仅考虑一次。由于商标的重置成本较小，故重置成本中未考虑资金成本和合理利润。贬值率根据商标的法定保护期限和使用情况分析确定。

（4）域名

域名对企业的收益的直接贡献有限，且贡献金额难以计量，故本次未采用收益法评估；从公开渠道难以取得类似域名的交易案例信息，故本次未采用市场法评估。域名的申请和注册相对简单，且取得成本可以计量，故本次采用成本法评估，基本公式如下：

域名评估值＝重置成本×（1－贬值率）

其中，重置成本主要包括申请和注册域名所需支付的注册费用。由于域名的重置成本较小，故重置成本中未考虑资金成本和合理利润。贬值率根据域名的总使用期限和已使用期限计算确定。

（5）合同权益

被评估单位定制化量产业务使用知识产权授权，利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，为服务器、通信等领域的客户提供专业的芯片量产服务。对于不同产品类别，约定了不同的授权费标准，除提前终止情形外，标的公司仍可持续开展业务。

企业的定制化量产业务客户较稳定，相关产品能够为被评估单位带来超额收益，属于低于市场费率的有利授权合同权益资产。考虑到这部分业务所对应的合同权益具有较强的获利能力，能为企业带来稳定收益，收益法能够体现其对收益的贡献，且对未来收益的贡献可以预测并用货币计量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故本次采用收益法—多期超额收益折现法评估。

1）多期超额收益法概述

多期超额收益法（MEEM）是先估算被评估无形资产与其他贡献资产共同创造的整体收益，在整体收益中扣除其他贡献资产的贡献，将剩余收益确定为超额收益，并作为被估值无形资产所创造的收益，将上述收益采用恰当的折现率折现以获得无形资产估值的一种方法。

2）基本思路

本次评估以定制化量产业务所产生的未来盈利预测数据为计算基础，预测相关合同权益在未来收益期的现金流贡献。本次收益采用息税前利润口径，再扣减其他所有有形资产、无形资产的相关现金流贡献，确定仅属于合同权益的现金流，结合技术经济年限预测其现金流的衰减情况，最后将合同权益预期合理寿命期内的各期现金流折现，确定评估值。

3）评估模型

$$p=\sum_{i=1}^{n}\frac{F_i\times(1-T_i)}{(1+r)^i}$$

其中： P — 委估无形资产的价值

Fi— 委估无形资产对应第 i 期的超额收益

n — 收益期限

r — 折现率

Ti— 未来第 i 期的企业所得税率

4、无形资产的历史、现实状况与发展前景

纳入本次评估范围的无形资产包括外购软件、专利、专有技术、商标、软件著作权、域名，其中：

外购软件购置于 2022 年至 2025 年之间，当前使用状态正常，预计未来一段时间仍将持续使用。

专利均为自行研发，申请于 2019 年至 2024 年之间，当前使用状态正常，预计未来一段时间仍将持续使用。

集成电路布图设计专有权均为自行研发，申请于 2019 年至 2024 年之间，当前使用状态正常，预计未来一段时间仍将持续使用。

商标均为自创，注册于 2019 年至 2023 年之间，当前使用状态正常，预计未来仍将持续使用。

域名注册于 2018 年至 2022 年之间，当前使用状态正常，预计未来一段时间仍将持续使用。

与定制化量产业务相关的合同权益较稳定，为知识产权授权许可相关的合同权益，预计未来一段时间仍将为企业带来超额收益，合同权益也持续有效。

5、评估实例

无形资产类型：合同权益

评估过程：

（1）收益期限的确定

企业的定制化量产业务相关合同权益较稳定，未约定具体合作期限，除非任何一方因另一方重大违约而终止协议。总体来看，合同权益预计能在未来 2 年内存在超额收益，故收益期为 2026 年 3-12 月和 2027 年度。

（2）预期收益的确定

企业的定制化量产业务客户基本较稳定，定制化量产业务能够为被评估单位带来超额收益，属于合同权益资产。鉴于核心稳定客户构成合同权益资产主要收益来源，其余客户业务规模零散、收益稳定性较弱，本次评估仅选取核心稳定客户对应的预期收益进行测算企业根据未来的发展规划，提供了定制化量产业务未来年度盈利预测。评估师对该盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，进一步修正、完善后，采信了被评估单位盈利预测的相关数据，对盈利预测进行合理性分析。

本次评估预期收益采用息税前利润口径，公式如下：

息税前利润（EBIT）=净利润+财务费用+所得税费用

=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用

1）营业收入预测

本次评估根据企业管理层所提供盈利预测并结合行业及企业自身发展状况对未来年度收入进行预测。

与合同权益相关的未来营业收入预测结果如下：

单位：万元

项目\年份	2026 年 3-12 月	2027 年
主营业务收入	18,172.03	10,601.32

2）营业成本预测

定制化量产业务采用净额法核算，因此无营业成本。

3）税金及附加及期间费用

企业历史年度税金及附加和期间费用构成几乎无变化且相关费用率较稳定，根据历史年度占收入比例情况对税金及附加及期间费用未来按一定比例进行预

测。

（3）其他贡献的测算

1）长期资产的贡献

长期资产投资的回报＝长期资产公允价值×长期资产必要报酬率

本次评估中长期资产的贡献考虑被评估单位配套的固定资产以及与业务相关的其他长期资产的贡献。本次评估长期资产贡献率为 7.93%。

2）营运资金的贡献

营运资金的贡献＝营运资金预测数×营运资金必要回报率

本次评估采用可比上市公司营运资金占营业收入比例进行预测。由于营运资金在经营业务过程中，价值一般不发生变化，其投资者可以在经营结束后回收，因此营运资金的投资者仅需要投资回报即可。本次评估营运资金回报率选择税后基准日一年期 LPR，即 2.55%。

3）组合劳动力的贡献

组合劳动力的贡献＝组合劳动力投入×组合劳动力必要回报率

组合劳动力不是一项可辨识的资产，但却是资产组中不可缺少的一项生产要素，没有劳动力，资产组无法正常运转。一般认为，组合劳动力归结为是商誉的组成因素，但是可以采用成本法合理估算组合劳动力成本。组合劳动力一般包括劳动力的招募成本和劳动力的上岗培训成本两部分。考虑到未来收入的增长，本次评估预测组合劳动力投入与产品收入保持一致增长率。WACC 本质上是企业为获取各类资本（股权和债权）所支付的平均成本。在超额收益评估中，它代表了资本所有者（股东和债权人）所要求的最低必要报酬率。当组合劳动（作为一项资本投入）被纳入评估时，其回报率必须至少达到 WACC 的水平，故本次取 10.40%。

4）其他无形资产贡献

其他无形资产的回报＝其他无形资产公允价值×其他无形资产必要报酬率

本次评估其他无形资产贡献率根据累加法确认为 13.73%。

（4）所得税费用

被评估单位适用的企业所得税税率为 15%。

（5）衰减率

考虑到随着时间的推移，合同权益带来的经济利益会逐渐减少，本次评估在收入预测中已考虑未来收入的存在边际效益递减，故未来年度不考虑衰减率。

（6）合同权益的贡献

合同权益的贡献=（息税前利润－长期资产贡献－营运资金贡献－组合劳动力贡献－其他无形资产贡献－所得税费用）

（7）确定折现率

合同权益贡献也相当于一种无形资产贡献，根据合同权益的特点和搜集资料的情况，本次评估合同权益的回报率与无形资产折现率保持一致。

本次采用风险累加法计算折现率。风险累加法是指将无形资产的无风险报酬率和风险报酬率量化并累加，进而确定无形资产折现率的方法，基本公式如下：

无形资产折现率＝无风险利率＋风险报酬率

1）无风险利率

无风险利率是指投资者投资无风险资产的期望报酬率，该无风险资产不存在违约风险。无风险利率通常可以用国债的到期收益率表示，选择国债时应当考虑其剩余到期年限与企业现金流时间期限的匹配性。评估实践中通常选取与收益期相匹配的国债的市场到期收益率。根据中央国债登记结算有限责任公司编制，并在中国债券信息网发布的数据，评估基准日两年期国债的到期收益率为 1.36%（保留两位小数），故本次评估以此作为无风险利率。

2）风险报酬率

风险报酬率是指投资者承担投资风险所获得的超出无风险利率以上部分的投资回报率。风险报酬率由技术风险报酬率、市场风险报酬率、资金风险报酬率和经营风险报酬率组成，各项风险报酬率的取值范围为 0%~6%。本次评估中，

根据各项风险报酬率的取值范围和调整系数，采用插值法计算得到各项风险报酬率的取值。

各项风险报酬率的分析计算过程如下：

A.技术风险

技术风险测评表

风险因素	权重	打分	加权后分值	评分说明
技术转化风险	30%	0	0	工业化生产
技术替代风险	30%	80	24	替代产品较多
技术权利风险	20%	80	16	主要技术全部未取得专利授权或软件著作权登记
技术整合风险	20%	80	16	相关技术在某些方面需要进行开发
合计	**100%**		**56**	

取值说明：

A/1.技术转化风险：工业化生产（0）；小批量生产（40）；中试（60）；小试（80）：实验室阶段（100）。

A/2.技术替代风险：无替代产品（0）；替代产品较少（40）；替代产品较多（60）；替代产品很多（100）。

A/3.技术权利风险：主要技术全部已取得专利授权或已取得软件著作权登记（0）；主要技术大部分已取得专利授权或软件著作权登记（40）；主要技术小部分已取得专利授权或软件著作权登记（60）；主要技术全部未取得专利授权或软件著作权登记（100）。

A/4.技术整合风险：相关技术完善（0）；相关技术在某些方面需要进行一些调整，以配合待估技术的实施（40）；某些相关技术还需要进行开发（60）；相关技术尚未出现（100）。

技术风险调整系数＝56÷100＝0.56

技术风险报酬率＝0%＋（6%－0%）×0.56＝3.36%

B.市场风险

市场风险测评表

风险因素			权重			打分	加权后分值	评分说明
市场容量风险			40%			50	20	市场容量一般
市场竞争风险	市场现有竞争风险		60%	70%		60	25.2	相比于市场中其他竞争者优势较小
	市场潜在竞争风险	规模经济性		30%	30%	50	2.7	市场存在一定的规模经济
		投资额			40%	50	3.6	项目的投资额及转换费用中等，潜在竞争者存在一定进入的可能性
		销售网络			30%	50	2.7	产品的销售在一定程度上依赖固有的销售网络
合计			**100%**	**100%**	**100%**		**54.20**	

取值说明：

B/1.市场容量风险：市场容量大（0）；市场容量一般（50）；市场容量小（100）。

B/2.市场现有竞争风险：市场中无竞争者（0）；相比于市场中其他竞争者有较大优势（40）；相比于市场中其他竞争者有优势较小（60）；相比于市场中其他竞争者无明显优势（100）。

B/3.市场潜在竞争风险：市场潜在竞争风险取通过规模经济性、投资额及转换费用、销售网络三个因素进一步测评。

B/3/1.规模经济性：市场存在明显的规模经济（0）；市场存在一定的规模经济（50）；市场不存在明显的规模经济（100）。

B/3/2.投资额及转换费用：项目的投资额及转换费用高，潜在竞争者不易进入（0）；项目的投资额及转换费用中等，潜在竞争者存在一定进入的可能性（50）；项目的投资额及转换费用低，潜在竞争者容易进入（100）。

B/3/3.销售网络：产品的销售非常依赖固有的销售网络（0）；产品的销售在一定程度上依赖固有的销售网络（50）；产品的销售不依赖固有的销售网络（100）。

市场风险调整系数＝54.20÷100＝0.5420

市场风险报酬率＝0%＋（6%－0%）×0.5420＝3.25%

C.资金风险

资金风险测评表

风险因素	权重	打分	加权后分值	评分说明
融资风险	50%	30	15	项目的资金缺口较小
流动资金风险	50%	30	15	项目的流动资金压力较小
合计	**100%**		**30**	

取值说明：

C/1.融资风险：项目无资金缺口（0）；项目的资金缺口较小（40）；项目的资金缺口中等（60）；项目的资金缺口较大（100）。

C/2.流动资金风险：项目无流动资金压力（0）；项目的流动资金压力较小（40）；项目的现金流压力中等（60）；项目的流动资金压力较大（100）。

资金风险调整系数＝30÷100＝0.30

资金风险报酬率＝0%＋（6%－0%）×0.30＝1.80%

D.经营风险

经营风险测评表

风险因素	权重	打分	加权后分值	评分说明
销售服务风险	40%	60	24	除现有销售网点外，还需新拓展大量的销售服务网点和人员
质量管理风险	30%	60	18	质量管理体系完善程度较低，有较多环节尚需进行一定补充或调整
技术开发风险	30%	80	24	技术力量较弱，研发投入较少
合计	**100%**		**66**	

取值说明：

D/1.销售服务风险：已有足够的销售网点和人员（0）；除现有销售网点外，还需新拓展少量的销售服务网点和人员（40）；除现有销售网点外，还需新拓展大量的销售服务网点和人员（80）；所有销售网点和人员均需要新拓展（100）。

D/2.质量管理风险：质量管理体系建立完善，实施全过程质量控制（0）；质量管理体系完善程度较高，仅有少量环节尚需进行一定补充或调整（40）；质量管理体系完善程度较低，有较多环节尚需进行一定补充或调整（80）；质

量管理体系尚未建立（100）。

D/3.技术开发风险：技术力量强，研发投入高（0）；技术力量较强，研发投入较高（40）技术力量一般，有一定的研发投入（60）；技术力量弱，研发投入少（100）。

经营风险调整系数＝66÷100＝0.66

经营风险报酬率＝0%＋（6%－0%）×0.66＝3.96%

在上述对各项风险报酬率计算的基础上，风险报酬率计算如下：

风险报酬率＝技术风险报酬率＋市场风险报酬率＋资金风险报酬率＋经营风险报酬率

＝3.36%＋3.25%＋1.80%＋3.96%

＝12.37%（取值至小数点后两位）

折现率计算

无形资产折现率＝无风险利率＋风险报酬率

＝1.36%＋12.37%

＝13.73%

（8）评估值的计算

合同权益评估值＝折现值合计

＝19,183.11 万元

6、评估结果

无形资产——其他无形资产的评估值为 391,827,233.39 元。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用账面价值 455,036.38 元，系办公室装修费、框架开发、分选机、测试机板卡。

评估人员调查了解了长期待摊费用发生的原因，查阅了长期待摊费用的相关合同协议和记账凭证，对形成日期、原始发生额和尚存受益月数进行了核实，

复核长期待摊费用的摊销过程，以核实无误后的账面值作为评估值。

长期待摊费用评估值为 455,036.38 元。

（十四）递延所得税资产

递延所得税资产账面值 4,991,363.30 元。系由于企业计提坏账准备、存货跌价准备形成的可抵扣暂时性差异产生。

评估人员调查了解了递延所得税资产发生的原因和形成过程，查验了确认递延所得税资产的相关记账凭证。经核实，企业计提递延所得税资产的金额符合企业会计准则及税法相关规定。本次评估结合形成递延所得税资产的相关科目的评估处理情况重新计算递延所得税资产，以预计可实现的与可抵扣暂时性差异相关的经济利益确认评估值。

序号	内容或者名称	可抵扣暂时性差异（元）	所得税税率	评估值（元）	计提科目明细
1	信用减值损失	4,727,378.37	15.00%	709,106.75	应收款项
2	租赁房屋导致	-1,088,233.93	15.00%	-163,235.09	租赁负债、使用权资产
3	资产减值准备	9,083,369.69	15.00%	1,362,505.45	存货
4	递延收益	2,872,988.47	15.00%	430,948.27	递延收益
5	资产减值准备-其他流动资产-代理业务资产	3,430,865.05	15.00%	514,629.76	其他流动资产
合计		**19,026,367.65**	**15.00%**	**2,853,955.14**	

递延所得税资产评估值为 2,853,955.14 元。

（十五）其他非流动资产

其他非流动资产账面值 40,080.00 元，系预付的智联云仓软件款。

评估人员核实了其他非流动资产的形成原因，查阅了相关合同和会计凭证，核实其真实性。评估人员经过分析，可以收回相应的资产或获得相应的权利，以核实后的账面值作为评估值。

其他非流动资产评估值为 40,080.00 元。

（十六）短期借款

短期借款账面值 55,434,970.78 元，系银行借入的期限在 1 年以下（含 1 年）

的借款。

评估人员查阅了各笔短期借款的借款合同及相关担保合同、评估基准日前最近一期结息单等资料，逐笔核对了借款金额、借款日期、到期日、还款付息方式和利率，以核实后的账面值作为评估值。

短期借款评估值为 55,434,970.78 元。

（十七）应付票据

应付票据账面值 29,531,279.03 元，系应付的无息银行承兑汇票。

评估人员查阅了相关合同、结算凭证，核实了应付票据票面记载的收、付款单位、金额，以及是否含有票面利率等内容。以核实后账面值作为评估值。

应付票据评估值为 29,531,279.03 元。

（十八）应付账款

应付账款账面值 33,182,408.86 元，系采购应付的材料及加工款、运费、长期资产购置款。

评估人员在了解企业的采购模式和商业信用情况的基础上，按照重要性原则，对大额或账龄较长的应付账款进行了函证，并对相应的合同和凭证进行了抽查，以核实后的账面值作为评估值。

应付账款评估值为 33,182,408.86 元。

（十九）合同负债

合同负债账面值 1,235,034.46 元，为货款。

评估人员在了解合同负债形成原因的基础上，按照重要性原则，对相应的合同和凭证进行了抽查，以核实后的账面值作为评估值。

合同负债评估值为 1,235,034.46 元。

（二十）应付职工薪酬

应付职工薪酬账面值 7,302,683.67 元，系应付职工的工资薪金等。

评估人员在了解企业员工构成和薪酬体系的基础上，核实了评估基准日近

期的职工薪酬计提及发放凭证，以核实后的账面价值作为评估值。

应付职工薪酬评估值为 7,302,683.67 元。

（二十一）应交税费

应交税费账面值 4,779,870.25 元，系应交增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。

评估人员在了解企业应负担的税种、税率以及缴纳方式等税收政策的基础上，查阅了评估基准日近期的纳税申报表和完税凭证，以核实后的账面价值作为评估值。

应交税费评估值为 4,779,870.25 元。

（二十二）其他应付款

其他应付款账面值 3,756,612.98 元，系应付的内部交易转移定价、预提审计费用、差旅费、员工福利费及个税返还等。

评估人员在了解其他应付款形成原因的基础上，按照重要性原则，对大额或账龄较长等情形的其他应付款进行了函证，并对相应的合同和凭证进行了抽查，以核实后的账面值作为评估值。

其他应付款评估值合计为 3,756,612.98 元。

（二十三）一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债账面值 11,365,329.77 元，系将在一年之内到期的租赁负债。

对于租赁负债，评估人员查阅了相关入账凭证、租赁合同、租赁支付凭证等资料，根据合同条款复核了租赁负债的计算过程，以核实后的账面值作为评估值。

一年内到期的非流动负债评估值为 11,365,329.77 元。

（二十四）其他流动负债

其他流动负债账面值 160,554.48 元，系与合同负债相关的待转销项税。评估人员查阅了相关合同，以核实无误的账面值作为评估值。

其他流动负债评估值为 160,554.48 元。

（二十五）租赁负债

租赁负债账面值 9,132,147.01 元，系资产负债表日承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

评估人员查阅了相关入账凭证、租赁合同、租赁支付凭证等资料，根据合同条款复核了租赁负债的计算过程，以核实后的账面值作为评估值。

租赁负债评估值 9,132,147.01 元。

（二十六）递延收益

递延收益账面值 2,872,988.47 元，系收到的政府补助资金。评估人员查阅了相关的补助文件、资金入账凭证等资料，了解补助资金的用途、金额和期限，并核实了补助资金的实际使用情况和相关的会计凭证。

经核查，递延收益共涉及 3 个政府补助项目，其中 1 项为资产相关的政府补助，2 项为收益相关的政府补助，目前被补助项目均正在进行中，尚未进行验收，后期存在返还补助资金的可能性，故递延收益以核实后的账面值作为评估值。

递延收益评估值为 2,872,988.47 元。

（二十七）资产基础法评估结果

经资产基础法评估，评估基准日被评估单位总资产账面价值 51,926.96 万元，评估值 100,854.88 万元，增值额 48,927.92 万元，增值率 94.22%。总负债账面价值 15,875.39 万元，评估值 15,875.39 万元，无增减值变动。所有者权益账面价值 36,051.57 万元，评估值 84,979.49 万元，评估增值 48,927.92 万元，增值率 135.72%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	48,913.16	53,690.03	4,776.87	9.77

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
2	非流动资产	3,013.80	47,164.85	44,151.05	1,464.96
3	债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
5	长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
6	长期股权投资	82.99	4,826.37	4,743.38	5,715.50
7	其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
9	投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
10	固定资产	1,068.10	1,636.57	568.47	53.22
11	在建工程	1.29	1.29	0.00	0.00
12	生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
13	油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
14	使用权资产	1,182.99	1,182.99	0.00	0.00
15	无形资产	129.78	39,182.72	39,052.94	30,091.70
16	开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17	商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
18	长期待摊费用	45.50	45.50	0.00	0.00
19	递延所得税资产	499.14	285.40	-213.74	-42.82
20	其他非流动资产	4.01	4.01	0.00	0.00
21	**资产总计**	**51,926.96**	**100,854.88**	**48,927.92**	**94.22**
22	流动负债	14,674.87	14,674.87	0.00	0.00
23	非流动负债	1,200.51	1,200.51	0.00	0.00
24	**负债合计**	**15,875.39**	**15,875.39**	**0.00**	**0.00**
25	**所有者权益**	**36,051.57**	**84,979.49**	**48,927.92**	**135.72**

三、市场法评估情况

（一）市场法的定义、原理、应用前提和具体评估方法选取

1、市场法的定义和原理

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。

市场法依据的基本原理是市场替代原理，即一个正常的投资者为一项资产

支付的价格不会高于市场上具有相同用途的替代品的现行市价。根据这一原则，相似的企业应该具有类似的价值。因此，具有相似性的被评估企业价值与可比对象价值可以通过同一经济指标联系在一起，即：

$$\frac{V_1}{X_1}=\frac{V_2}{X_2}$$

$$V_1=\frac{V_2}{X_2}\times X_1=\frac{P_2}{X_2}\times X_1$$

其中，为价值比率，V1 为被评估企业的价值，V2 为可比对象的价值。X 为其计算价值比率所选用的经济指标。由于价值的体现较为复杂，不能直接观测到，而在有效市场中，企业的市场交易价格可以在一定程度上反映其价值。因此对于可比对象，评估专业人员一般使用其市场交易价格 P2 作为替代，计算价值比率。因此价值比率的确定成为市场法应用的关键。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法和交易案例比较法都是通过对市场上可比交易数据的分析得出被评估企业的价值，所不同的只是可比对象的来源不同，前者来源于公开交易的证券市场，后者来源于个别的股权交易案例。对于上市公司比较法而言，基本模型中的 V2 可选取上市公司的股权价值或企业价值。对于交易案例比较法而言，基本模型中的 V2 可选取案例的交易价格。

2、上市公司比较法的定义、原理和应用前提

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

上市公司比较法的应用前提如下：

（1）有一个充分发展、活跃的资本市场；

（2）在上述资本市场中存在着足够数量的与评估对象相同或相似的可比上市公司；

（3）能够收集到可比上市公司的交易价格信息、财务信息及其他相关资料。

3、交易案例比较法的定义、原理和应用前提

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法的应用前提如下：

（1）有一个充分发展、活跃的资本市场；

（2）在上述资本市场中存在着足够数量的标的企业与评估对象相同或相似的可比交易案例；

（3）能够收集到可比交易案例的交易价格信息、财务信息及其他相关资料。

4、具体评估方法的选取理由

被评估单位主要从事于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售，属于集成电路行业芯片设计企业，经查询，模拟芯片行业存在较多的同行业上市公司，可比公司公开市场交易价格、经营情况和财务状况等相关必要的数据公开、可查询。因此，本次适宜采用整体市场法评估。

被评估单位的定制化量产业务稳定，历史期为企业提供持续稳定的现金流以供技术开发及设计业务开拓，考虑到该业务的服务模式、收入成长性与芯片设计业务存在差异，其价值驱动因素亦有所不同。若将定制化量产业务收入乘以市场法价值比率放大，可能导致整体企业价值被高估。因此谨慎起见，对于定制化量产业务线开展以来，稳步发展，企业产品、技术、客户关系、供销体系稳定，企业管理可对其未来年度经营收益及成本费用等相关参数进行估测，获得预期收益所承担的风险也可以量化。故结合可预见的供应体系及客户需求，采用收益法有限年对该业务收益进行预测并折现，视同货币资金或非经营性资产在基准日加回，收益期为评估基准日至 2027 年底。

（二）市场法评估过程

1、价值比率的选择和计算

价值比率是指以价值或价格作为分子，以财务数据或其他特定非财务指标等作为分母的比率。价值比率是市场法对比分析的基础，由资产价值与一个与

资产价值密切相关的指标之间的比率倍数表示，即：

$$价值比率=\frac{价值}{与价值密切相关的指标}$$

（1）股权价值比率和企业整体价值比率

按照价值比率分子的计算口径，价值比率可分为股权价值比率与企业整体价值比率。股权价值比率主要指以权益价值作为分子的价值比率，主要包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）等。企业整体价值比率主要指以企业整体价值作为分子的价值比率，主要包括企业价值与息税前利润比率（EV/EBIT）、企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）、企业价值与销售收入比率（EV/S）等。

（2）盈利价值比率、资产价值比率、收入价值比率和其他特定价值比率

$$盈利价值比率=\frac{企业整体价值/股权价值}{盈利类参数}$$

$$资产价值比率=\frac{企业整体价值/股权价值}{资产类参数}$$

$$收入价值比率=\frac{企业整体价值}{收入类参数}$$

$$其他特定价值比率=\frac{企业整体价值/股权价值}{特定类参数}$$

价值比率可以按照分母的性质分为盈利价值比率、资产价值比率、收入价值比率和其他特定价值比率。

常用的价值比率如下表所示：

价值比率分类	股权价值比率	企业整体价值比率
盈利价值比率	P/E PEG P/FCFE	EV/EBITDA EV/EBIT EV/FCFF
资产价值比率	P/B TobinQ	EV/TBVIC
收入价值比率	P/S	EV/S
其他特定价值比率	P/研发支出	EV/其他特定指标

本次市场法评估选取的价值比率为企业价值与营业收入比率（EV/S），理

由如下：

1）被评估单位属于半导体行业，利润指标容易受行业周期波动的影响，代表性不强。被评估单位属于轻资产企业，采用资产指标难以衡量企业真实价值。

2）随着近几年的发展，被评估单位营业收入已初具规模，部分细分领域市场份额已形成竞争优势。考虑到我国半导体行业整体发展尚处于追赶状态，营业收入更能反映企业在行业内的影响力，也更能体现企业价值。

3）与此同时，企业价值指标（EV）属于整体价值，不仅仅包括股权价值，还包括债权价值，能充分反映企业经营性核心资产的价值。本次评估采用企业价值与营业收入比率（EV/S），可以降低可比上市公司与被评估单位因资本结构等方面存在差异而产生的影响，有助于分析被评估单位价值基础的稳定性和可靠性，又能合理反映被评估单位的市场价值。

4）被评估单位作为轻资产、高研发投入的半导体设计企业，公司的半桥智能功率模块（IPM）历经数年的技术积累及业务布局，凭借其小体积、低温升、低电磁干扰、高可靠性、PCB 布局灵活易加工等性能优势已成功导入白色家电主流厂商，该业务线 2025 年实现翻倍增长收入突破亿元，当前处于技术成果集中转化，收入高速增长的关键期。静态或历史数据低估了其业绩表现，且 2026 年收入可结合期后财务数据及订单较为可靠的估计。因此，对于被评估单位这种处于快速成长期且研发投入较大的轻资产公司，动态价值比率是衡量其“未来成长确定性”与“市场规模扩张力”的优选指标。

2、可比上市公司的选择

晶艺半导体主营业务为电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块的研发、设计和销售，属于模拟芯片设计行业，本次可比公司选取申万行业分类为模拟芯片设计，业务包含电源管理芯片、DC-DC、电源关键字的 A 股上市公司，一共得到 19 家，针对这些公司进一步筛选。

本次市场法评估对于可比上市公司的选取标准如下：

（1）在中国国内 A 股上市，且截至评估基准日至少已上市 1 年。

（2）采用 Fabless 经营模式，专注于芯片研发与销售，晶圆制造、封装测

试等生产环节主要通过外部供应商完成。

（3）与评估对象同属于模拟芯片行业，且主要经营业务为电源管理芯片，营业收入构成中电源管理类的占比不低于 70%。

（4）根据相关上市公司公告的文件，评估基准日近期未发生重大资产重组等可能使股票价格存在异常波动的重大事件。

（5）由于本次评估的价值比率采用了动态 EV/S，计算可比公司的价值比率需要用到可比公司的预测收入数据，故将同花顺 iFind 中显示预测收入数据缺失的公司剔除。

具体筛选过程如下：

证券代码	证券简称	主营产品类型	剔除原因
300661.SZ	圣邦股份	信号链集成电路、电源管理集成电路、传感器	
300671.SZ	富满微	LED 灯、LED 控制及驱动类芯片、电源管理类芯片、MOSFET 类芯片、其他类芯片、租赁、设计、服务费	
300782.SZ	卓胜微	射频前端分立器件、各类模组产品解决方案、低功耗蓝牙微控制器芯片	产品差异大
600171.SH	上海贝岭	集成电路产品	
600877.SH	电科芯片	硅基模拟半导体相关芯片、器件、模组、整体解决方案、智能终端应用产品	产品差异大
603068.SH	博通集成	无线数传类芯片、无线音频类芯片	产品差异大
603160.SH	汇顶科技	指纹识别芯片、触控芯片、其他芯片	产品差异大
603375.SH	盛景微	电子控制模块、起爆控制器、放大器	产品差异大
688045.SH	必易微	电源管理、电机驱动、电池管理、信号链及微控制器	
688052.SH	纳芯微	传感器产品、信号链产品、电源管理产品	
688061.SH	灿瑞科技	智能传感器芯片、电源管理芯片、封装测试服务	
688130.SH	晶华微	医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片、电池管理芯片	产品差异大
688141.SH	杰华特	电源管理芯片、信号链芯片、功率产品	
688153.SH	唯捷创芯	射频功率放大器模组、接收端模组	产品差异大
688173.SH	希荻微	DC-DC 芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度 PMIC 芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片、传感器芯片	
688209.SH	英集芯	电源管理类、数模混合 SoC 类、电池管理类、其他	
688220.SH	翱捷科技	支持蜂窝移动通信系统的蜂窝基带芯片以及支持非蜂窝移动通信系统的非蜂窝物联网芯片	产品差异大

证券代码	证券简称	主营产品类型	剔除原因
688270.SH	ST 臻镭	射频收发芯片、高速高精度 ADC/DAC 芯片、电源管理芯片、微系统、模组、终端射频前端芯片、技术服务	
688286.SH	敏芯股份	MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器、MEMS 惯性传感器	产品差异大
688325.SH	赛微微电	电池计量芯片、电池安全芯片、充电管理	产品差异大
688368.SH	晶丰明源	电源管理芯片、控制驱动芯片	基准日近期重组并购
688381.SH	帝奥微	电源管理、信号链	
688391.SH	钜泉科技	智能电表芯片、物联网及其他芯片、其他	产品差异大
688458.SH	美芯晟	信号链光学传感器、电源管理芯片、数模混合 SoC 芯片、模拟电源管理芯片、汽车电子芯片	
688484.SH	南芯科技	消费电子、工业领域、汽车电子、智能算力	
688508.SH	芯朋微	高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品	
688512.SH	慧智微	4G 模组、5G 模组、技术服务	产品差异大
688515.SH	裕太微	网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载高速视频传输芯片	产品差异大
688536.SH	思瑞浦	信号链类模拟芯片、电源类模拟芯片	
688582.SH	芯动联科	集成电路产品	产品差异大
688601.SH	力芯微	电源转换芯片、电源防护芯片、信号链芯片、驱动芯片	
688653.SH	康希通信	Wi-Fi FEM、IoT FEM、音频 IoT 模组	产品差异大
688699.SH	明微电子	显示驱动、线性电源、电源管理	经营模式含封测
688790.SH	昂瑞微	射频前端芯片、射频 SoC 芯片	产品差异大
688798.SH	艾为电子	高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片	

由于晶艺半导体的收入主要来自 DC-DC 的稳压供电类芯片及集成电机驱动芯片与功率器件的智能功率模块（IPM），稳压供电芯片及电机驱动芯片均属于电源管理芯片的细分。因此，在上述初步筛选的基础上，根据电源管理芯片业务占比进行筛选，剔除收入构成中电源管理类的占比低于 70%的公司，统计数据为 2025 年度数据。

此外，晶艺半导体的 DC-DC 稳压供电类产品主要应用领域包括家电、安防摄像头、智能电表、电动两轮车等工业及消费市场。对于可比公司的产品及其

应用领域的相似性做进一步分析筛选。具体如下表：

证券代码	证券简称	电源管理业务占比	剔除原因
300661.SZ	圣邦股份	61.05%	电源管理低于 70%，信号链占比高
300671.SZ	富满微	80.19%	缺乏预测收入
688045.SH	必易微	96.72%	AC-DC 为主，DC-DC 占比较低
600171.SH	上海贝岭	26.00%	电源管理低于 70%，微电子贸易占比过高；
688052.SH	纳芯微	34.85%	电源管理低于 70%，信号链、传感器占比高
688061.SH	灿瑞科技	31.57%	电源管理低于 70%，传感器为主
688141.SH	杰华特	87.48%	
688173.SH	希荻微	70.19%	
688209.SH	英集芯	78.60%	
688270.SH	ST 臻镭	45.53%	电源管理低于 70%，射频收发芯片
688381.SH	帝奥微	52.84%	电源管理低于 70%，信号链占比高
688458.SH	美芯晟	73.60%	AC-DC 及传感器收入占比高
688484.SH	南芯科技	99.91%	主要面向手机、移动电源等 3C 消费电子
688508.SH	芯朋微	99.66%	
688536.SH	思瑞浦	34.07%	电源管理低于 70%，信号链为主
688601.SH	力芯微	85.68%	缺乏预测收入
688798.SH	艾为电子	36.69%	电源管理低于 70%，数模混合 Soc 为主

根据上述选取标准，最终选取得到可比上市公司如下：

证券代码	证券简称	上市日期	公司简介
688141.SH	杰华特	2022-12-23	杰华特微电子股份有限公司的主营业务是模拟集成电路的研发与销售。公司的主要产品是 AC-DC 芯片、DC-DC 芯片、线性电源芯片、电池管理芯片、检测芯片、接口芯片、转换器芯片、时钟芯片、线性芯片、传感器芯片、高速信号芯片、驱动芯片、功率产品。下游覆盖 AI 服务器、笔记本、通信交换机、工业控制、新能源汽车、安防摄像头等。
688173.SH	希荻微	2022-01-21	希荻微电子集团股份有限公司的主营业务是包括电源管理芯片和信号链芯片在内集成电路的研发、设计和销售。公司的主要产品是 DC-DC 芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度 PMIC 芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片、传感器芯片。覆盖智能手机、智能穿戴、车载座舱电源、小家电与 AI 终端供电方案。
688209.SH	英集芯	2022-04-19	深圳英集芯科技股份有限公司的主营业务是电源管理、电池管理、数模混合 SoC 等相关芯片的研发、设计与应用。公司的主要产品是电源管理芯片类、电池管理芯片类、数模混合 SoC 芯片类。下游覆盖移动电源、无线充电器、

证券代码	证券简称	上市日期	公司简介
			TWS 耳机、智能门锁、无线安防设备，产品延伸至便携储能。
688508.SH	芯朋微	2020-07-22	无锡芯朋微电子股份有限公司的主营业务是提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司拥有 AC-DC、高低压 DC-DC、BLDC 驱动、IPM 功率模块完整产品线，70-90V 高压 DC-DC 系列成熟完善，功率器件与驱动方案配套齐全。下游核心布局白色家电、国网智能电表、工业工控、电动两轮车、POE 安防设备，可为整机提供电源 + 电机一体化功率解决方案。

经确认上述四家可比公司 EV 和 S 的相关系数计算如下：

比率	EV/S
相关系数	0.9735
R 方	0.9476
调整后的 R 方	**0.9214**

四家可比公司的 EV/S 调整后的 R 方高于 0.9，具有较高的拟合优度，意味着收入与企业价值存在较强的正相关关系，故本次评估宜采用 EV/S 作为价值比率乘数。

可比公司剔除股权部分流动性因素后的动态 EV/S 计算过程和结果如下表所示：

单位：万元

项目	字母或计算公式	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
总市值	A	2,300,657.07	682,332.87	1,058,931.93	896,992.79
非经营性资产负债	B	103,262.24	13,034.11	75,560.08	194,887.83
少数股东权益	C	33,530.79	6,303.81	131.16	-
付息债务	D	246,346.05	14,973.38	8,704.71	34,759.72
货币资金	E	44,173.21	76,674.98	72,822.51	56,804.33
EV（不含货币资金）	F＝A-B＋C＋D-E	2,433,098.46	613,900.98	919,385.22	680,060.35
营业收入（2026 年）	G	269,137.33	97,882.00	166,100.00	120,036.00
EV/S（2026 年动态）	H＝F÷G	9.04	6.27	5.54	5.67

注：（1）可比上市公司总市值采用基准日前 30 个交易日收盘价均价计算；（2）付息债务、货币资金等资产负债表数据采用可比上市公司的基准日前最新一期财务报表数据，即选取 2025 年 12 月 31 日合并报表数据；（3）营业收入采用基准日市场证券调研机构对于可比上市公司的未来第一个财年的主营业务收入的预测均值。（4）可比上市公司非经营性资产和负债主要包括交易性金融资产、其他应收款（投资意向金）、其他流动资产（募投费）、一年内到期的非流动资产（债权投资）、长期股权投资、债券投资、其他债券投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、递延所得税资产、其他非流动资产（预付设备

工程款、预付投资款）、衍生金融负债、其他应付款（股权转让款、资金拆借、工程款）、长期应付款、递延收益、递延所得税负债。

3、价值比率的修正

根据可比企业近年的财务数据计算可比企业价值比率和财务指标后，对可比企业上述价值比率进行必要的修正，具体如下：

项目		权重	待估对象	可比公司 1	可比公司 2	可比公司 3	可比公司 4
			晶艺半导体	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
价值比率 EV/S				9.04	6.27	5.54	5.67
交易日期修正	交易指数		100	100	100	100	100
	打分系数		100	100	100	100	100
交易情况修正	交易情况		正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易
	打分系数		100	100	100	100	100
企业规模修正	总资产	100%	33,609	534,366.48	185,196.63	246,442.96	330,844.49
	打分系数		100	110	108	110	110
	小计		100	110	108	110	110
成长能力修正	收入增长率	100%	53.4%	58.2%	72.2%	12.5%	18.5%
	打分系数		100	101	104	92	93
	小计		100	101	104	92	93
偿债能力修正	资产负债率	50%	35.95%	65.18%	19.67%	10.94%	17.61%
	打分系数		100	94	103	105	104
	流动比率	50%	2.81	1.27	3.73	7.60	4.94
	打分系数		100	98	101	105	102
	小计		100	96	102	105	103
运营能力修正	存货周转率（次）	33%	1.18	2.10	3.25	2.18	2.13
	打分系数		100	101	102	101	101
	应付周转率（次）	33%	10.12	5.40	7.72	15.87	7.63
	打分系数		100	105	102	94	102
	应收账款周转率	33%	11.28	5.44	6.65	10.26	6.63
	打分系数		100	94	95	99	95
	小计		100	100	100	98	99
盈利能力修正	净资产收益率	50%	-45.77%	-39.92%	-7.85%	8.51%	7.14%
	打分系数		100	102	110	110	110

项目		权重	待估对象	可比公司 1	可比公司 2	可比公司 3	可比公司 4
			晶艺半导体	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
	销售毛利率	50%	35.05%	26.37%	30.11%	34.38%	37.24%
	打分系数		100	97	98	100	101
	小计		100	100	104	105	106
研发能力修正	研发费用率	100%	38.82%	36.1%	27.8%	19.7%	22.6%
	打分系数		100	99	98	96	97
	小计		100	99	98	96	97
修正后价值比率 EV/S				8.56	5.37	5.28	5.29

本次采用上市公司比较法，且计算口径均为基准日近 30 个交易日的平均市值，市场交易价格未发现明显的异常交易因素，因此不进行交易日期和交易情况修正。

（1）经营规模修正

经营规模是企业资产体量的大小，一般来说体量越大，整体市值越高。一般来说，衡量企业经营规模的大小主要是营业收入和总资产规模。由于本次评估采用 EV/S 价值比率，价值比率中已经考虑了营业收入因素的影响，不宜采用营业收入规模作为修正参数，故本次按照总资产规模进行修正。

（2）成长能力修正

成长能力是衡量企业未来发展的能力，一般来说成长速度越快，整体市值越高。成长能力指标包括营业收入增长率，净利润增长率等。芯片设计服务企业市场份额会对企业市值产生较大的影响，因此本次选择营业收入增长率作为修正指标。

（3）偿债能力修正

企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力，是企业能否健康生存和发展的关键，反映企业财务状况和经营风险的重要标志。静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。本次选择流动比率、资产负债率作为修正因素。流动比率是用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。指标值越高，偿债能力越高。资产负债率反映了企业

整体的财务杠杆情况，一定程度上反映了企业的偿债能力。指标值越高，偿债能力越低。

（4）运营能力修正

运营能力是指企业基于外部市场环境的约束，通过内部人力资源和生产资料的配置组合而对财务目标实现所产生作用的大小，通俗来讲，就是企业运用各项资产以赚取利润的能力。周转率反映了资产周转的速度，用以衡量企业在一定时期的营运能力。资产类指标值越高，说明企业营运能力越好，负债类指标值越低，说明企业运营能力越好。本次选取存货周转率、应收账款周转率、应付周转率作为修正因素。

（5）盈利能力修正

盈利能力是指企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。企业销售毛利率、息税前利润率、净资产收益率一定程度上反映了企业在经营模式和获利能力上的差异，本次主要使用销售毛利率和净资产收益率来衡量其盈利能力。指标值越高，说明企业盈利能力越好。

（6）研发能力修正

研发能力是指企业研发的投入状况，能够在一定程度体现其技术进步能力，通常能反映企业未来技术突破的可能性。研发能力指标主要通过研发费用及研发人员数量上体现。本次采用研发费用率作为修正指标。

经过上述修正后，计算得出加权修正后价值比率：

加权修正后价值比率＝各可比公司修正后价值比率×各自权重

项目	可比公司 1	可比公司 2	可比公司 3	可比公司 4
	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
价值比率 EV/S	9.04	6.27	5.54	5.67
交易日期修正	100/100	100/100	100/100	100/100
交易情况修正	100/100	100/100	100/100	100/100
经营规模修正	100/110	100/108	100/110	100/110
成长性修正	100/101	100/104	100/92	100/93

偿债能力修正	100/96	100/102	100/105	100/103
运营能力修正	100/100	100/100	100/98	100/99
盈利能力修正	100/100	100/104	100/105	100/106
研发能力修正	100/99	100/98	100/96	100/97
修正后价值比率 EV/S	8.56	5.37	5.28	5.29

4、流动性折扣的考虑

一般认为不可流通股与流通股之间的价格差异主要由下列因素造成：

（1）承担的风险

流通股的流通性很强，一旦发生风险后，流通股持有者可以迅速出售所持有股票，减少或避免风险。非流通股持有者在遇到同样情况后，则不能迅速做出上述反应而遭受损失。

（2）交易的活跃程度

流通股交易活跃，价格上升。非流通股缺乏必要的交易人数，另外非流通股一般数额较大，很多投资者缺乏经济实力参与非流通股的交易，因而，与流通股相比，交易缺乏活跃，价格较低。

评估人员参考新股发行定价估算方式进行测算，所谓新股发行定价估算方式就是国内上市公司新股 IPO 的发行定价与该股票正式上市后的交易价格之间的差异来研究缺少流动折扣的方式。

根据筛选后可比公司的细分行业分类，按照 SW 电子-半导体-模拟芯片设计收集在该行业分类下距基准日上市满一年的可比公司，分别研究其自新股发行日至上市后第 90 交易日、120 日、180 日以及 250 日收盘价之间的关系，剔除跌幅大于 90%的异常情况，该跌幅远高于行业内其他可比公司，负向偏离度较大，为谨慎考虑，将其作为异常值剔除。剔除后结果如下：

简称	首发上市日期	首发上市价格	上市后 90 个交易日	上市后 120 个交易日	上市后 180 个交易日	上市后 250 个交易日	流动性折扣 90 日	流动性折扣 120 日	流动性折扣 180 日	流动性折扣 250 日
电科芯片	1995-10-13	1.00	11.98	14.10	29.90	23.64	91.65%	92.91%	96.66%	95.77%
上海贝岭	1998-09-24	6.53	15.48	14.54	30.70	33.11	57.82%	55.09%	78.73%	80.28%
赛微微电	2022-04-22	74.55	51.10	48.65	46.80	40.60	-45.89%	-53.24%	-59.29%	-83.62%

简称	首发上市日期	首发上市价格	上市后90个交易日	上市后120个交易日	上市后180个交易日	上市后250个交易日	流动性折扣90日	流动性折扣120日	流动性折扣180日	流动性折扣250日
汇顶科技	2016-10-17	19.42	96.04	90.22	102.35	99.26	79.78%	78.47%	81.03%	80.44%
圣邦股份	2017-06-06	29.82	72.79	90.88	87.01	107.20	59.03%	67.19%	65.73%	72.18%
富满微	2017-07-05	8.11	46.60	40.43	39.24	40.50	82.60%	79.94%	79.33%	79.97%
博通集成	2019-04-15	18.63	90.55	108.41	94.15	77.82	79.43%	82.82%	80.21%	76.06%
卓胜微	2019-06-18	35.29	367.47	435.14	511.46	714.73	90.40%	91.89%	93.10%	95.06%
晶丰明源	2019-10-14	56.68	109.20	74.10	91.64	144.09	48.10%	23.51%	38.15%	60.66%
芯朋微	2020-07-22	28.30	112.03	82.47	72.66	137.57	74.74%	65.68%	61.05%	79.43%
敏芯股份	2020-08-10	62.67	148.99	116.88	95.32	119.75	57.94%	46.38%	34.25%	47.66%
思瑞浦	2020-09-21	115.71	510.36	356.00	540.50	638.34	77.33%	67.50%	78.59%	81.87%
明微电子	2020-12-18	38.43	136.01	187.64	308.37	185.23	71.74%	79.52%	87.54%	79.25%
力芯微	2021-06-28	36.48	186.97	150.36	170.36	137.30	80.49%	75.74%	78.59%	73.43%
艾为电子	2021-08-16	76.58	218.68	167.00	144.78	118.67	64.98%	54.14%	47.11%	35.47%
希荻微	2022-01-21	33.57	28.16	28.04	24.72	26.06	-19.21%	-19.72%	-35.80%	-28.82%
臻镭科技	2022-01-27	61.88	65.80	78.89	149.06	110.31	5.96%	21.56%	58.49%	43.90%
英集芯	2022-04-19	24.23	23.54	20.43	21.94	17.86	-2.94%	-18.58%	-10.46%	-35.67%
纳芯微	2022-04-22	230.00	329.11	311.95	323.84	288.64	30.11%	26.27%	28.98%	20.32%
必易微	2022-05-26	55.15	49.30	66.98	66.14	64.56	-11.87%	17.66%	16.62%	14.58%
晶华微	2022-07-29	62.98	44.77	46.46	42.58	43.00	-40.67%	-35.56%	-47.91%	-46.47%
帝奥微	2022-08-23	41.68	43.30	43.00	36.17	28.28	3.74%	3.07%	-15.23%	-47.38%
钜泉科技	2022-09-13	115.00	118.79	115.16	100.83	75.10	3.19%	0.14%	-14.05%	-53.12%
杰华特	2022-12-23	38.26	39.90	41.00	31.32	26.87	4.11%	6.68%	-22.16%	-42.39%
裕太微	2023-02-10	92.00	185.22	141.50	112.70	58.79	50.33%	34.98%	18.37%	-56.49%
南芯科技	2023-04-07	39.99	35.50	41.09	40.05	30.34	-12.65%	2.67%	0.15%	-31.79%
芯动联科	2023-06-30	26.74	39.70	37.85	34.56	28.78	32.65%	29.35%	22.64%	7.08%
康希通信	2023-11-17	10.50	13.72	10.69	11.66	14.49	23.47%	1.78%	9.95%	27.54%
盛景微	2024-01-24	38.18	42.24	34.27	40.37	38.21	9.61%	-11.40%	5.43%	0.07%
平均值							**36.07%**	**33.33%**	**32.96%**	**25.01%**

采用250日收盘价计算的流动性折扣均值与其他时间节点差异较大，为谨慎起见本次评估采用90天、120天、180天股价流动性折扣的最大值36.10%（小数点后一位取整）作为缺少流动性折价率参数。

5、溢余及非经营性资产及负债

晶艺半导体非经营性资产及负债评估情况如下：

单位：万元

类别	会计科目名称	内容	账面价值	评估价值
非经营性资产	一年内到期的非流动资产	大额存单	3,257.97	3,257.97
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异形成	508.02	286.54
	溢余资产	货币资金及定制化量产业务	52,144.80	52,144.80
	非经营性资产小计		**55,910.78**	**55,689.30**
非经营性负债	短期借款	应付利息	7.62	7.62
	一年内到期的非流动负债	应付利息	0.59	0.59
	递延收益	政府补助	287.30	287.30
	非经营性负债小计		**295.50**	**295.50**
非经营性资产、负债净值			**55,615.28**	**55,393.80**

（1）定制化量产业务评估思路

被评估单位利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，基于授权的知识产权，协助下游客户提供芯片定制服务业务，产品主要应用于服务器、通信等领域。

被评估单位的定制化量产业务稳定，历史期为企业提供持续稳定的现金流以供技术开发及设计业务开拓，考虑到该业务的服务模式、收入成长性与芯片设计业务存在差异，其价值驱动因素亦有所不同。若将定制化量产业务收入乘以市场法价值比率放大，可能导致整体企业价值被高估。因此谨慎起见，考虑到定制化量产业务线开展以来，稳步发展，企业产品、技术、客户关系、供销体系稳定，企业管理可对其未来年度经营收益及成本费用等相关参数进行估测，获得预期收益所承担的风险也可以量化。故结合可预见的供应体系及客户需求，采用收益法有限年对该业务收益进行预测并折现，视同货币资金或非经营性资产在基准日加回，收益期为评估基准日至2027年底。

具体而言，本次评估以定制化量产业务所产生的未来盈利预测数据为计算基础，预测相关资产在未来收益期的现金流贡献，并通过现金流折现，得到定制化量产业务经营性资产的评估值。

（2）评估模型

$$V=\sum_{i=1}^{n}\frac{F_i}{(1+r)^i}$$

其中：V—评估基准日定制化量产业务经营性资产价值；

Fi—未来第 i 个收益期的预期资产自由现金流量；

r—折现率；

i—详细预测期第 i 年；

1）业务资产现金流量的确定

定制化量产业务资产组的自由现金流量是指可由企业资本的全部提供者自由支配的现金流量，计算公式如下：

资产自由现金流量＝净利润＋税后的付息债务利息＋折旧和摊销－资本性支出－营运资本增加

即：

资产自由现金流量＝EBITDA*（1-所得税税率）－资本性支出－营运资本增加

2）折现率的确定

本次收益法评估采用资产组的自由现金流折现模型，选取加权平均资本成本（WACC）作为折现率，计算公式如下：

$$WACC=R_d\times（1-T）\times\frac{D}{D+E}+R_e\times\frac{E}{D+E}$$

其中：Re—权益资本成本；

Rd—付息债务资本成本；

E—权益的市场价值；

D—付息债务的市场价值；

T—企业所得税税率。

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）确定公司的权益资本成本，计算公式如下：

$$R_e = R_f + \beta \times （R_m - R_f） + \varepsilon$$

其中：Re—权益资本成本；

Rf—无风险利率；

β—权益系统性风险调整系数；

（Rm－Rf）—市场风险溢价；

ε—特定风险报酬率。

（3）营业收入的预测

定制化量产业务采用净额法核算，其历史年度的营业收入情况如下：

金额单位：万元

项目\年份	2024 年	2025 年	2026 年 1-2 月
营业收入	12,339.78	14,796.18	3,177.67

定制化量产业务 2026 年及 2027 年的营业收入预测建立在在手订单、可预见的客户需求及供应链产能基础之上，整体预测具备合理性及可实现性。该业务未来年度营业收入预测数据如下：

金额单位：万元

项目\年份	2026 年	2027 年
营业收入	22,808.66	10,652.99

（4）税金及附加的预测

定制化量产业务资产组的税金及附加主要包括城建税、教育费附加、地方教育附加和印花税。本次在预测企业各年流转税的基础上，结合相应的税率估

算未来各年的城建税及教育费附加；对于印花税等其他税费，考虑到该等费用历史年度占营业收入的比例较为稳定，盈利预测参考历史年度纳税情况并结合收入的比例预测。

定制化量产业务资产组未来年度税金及附加预测数据详见自由现金流预测表。

（5）销售费用的预测

定制化量产业务资产组销售费用主要包括职工薪酬、折旧和摊销、差旅费、检测费等，未来年度销售费用预测数据如下表所示。

金额单位：万元

项目\年份	2026年	2027年
销售费用	**284.36**	**174.67**
占营业收入比例	1.25%	1.64%

（6）管理费用的预测

定制化量产业务资产组管理费用主要包括职工薪酬、折旧和摊销、咨询服务费、差旅费等，未来年度管理费用预测数据如下表所示。

金额单位：万元

项目\年份	2026年	2027年
管理费用	**803.51**	**504.19**
占营业收入比例	3.52%	4.73%

（7）研发费用的预测

定制化量产业务资产组研发费用主要包括职工薪酬、折旧和摊销、材料费等，未来年度研发费用预测数据如下表所示。

金额单位：万元

项目\年份	2026年	2027年
研发费用	**872.50**	**482.19**
占营业收入比例	3.83%	4.53%

（8）财务费用的预测

定制化量产业务资产组财务费用主要包括利息收入、汇兑损益、手续费及其他，未来年度财务费用预测数据如下表所示：

金额单位：万元

项目\年份	2026年	2027年
财务费用	**-8.18**	**0.00**

（9）其他收益的预测

历史年度的其他收益主要是增值税即征即退及代扣个人所得税手续费返还等，上述因素未来各年发生的可能性及发生金额难以可靠预测，本次评估未来不再预测其他收益。

（10）所得税费用的预测

晶艺半导体为高新技术企业，且享受西部大开发所得税优惠。本次收益法预测中未来各年研发费用占营业收入的比例符合《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2016]32号）中要求，故假设企业未来可继续被认定为高新技术企业并享受相关企业所得税优惠政策。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第7号）的相关规定，本次预测中对于研发费用按照发生额的100%在税前加计扣除。

定制化量产业务资产组未来年度所得税费用预测数据详见自由现金流预测表。

（11）资本性支出的预测

资本性支出主要包括固定资产、无形资产和长期待摊费用的更新性资本性支出和扩张性资本性支出。定制化量产业务属于轻资产业务，产品全部采用代工模式组织生产，后续不存在扩张性资本性支出；同时该业务收益预测采用有限年期模型，评估基准日存量设备可充分覆盖预测期内全部生产经营需求，预测期内无需发生资产更新类资本投入。

（12）营运资本增加额的预测

营运资本增加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资本。营运资本的增加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，

在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。

本报告所定义的营运资本和营运资本增加额分别为：

营运资本＝最佳货币资金保有量＋存货＋应收款项－应付款项

营运资本增加额＝当期营运资本－上期营运资本

1）最佳货币资金保有量

最佳货币资金保有量＝月付现成本费用×最佳货币资金保有量月数

其中：

月付现成本费用＝营业成本＋税金＋期间费用－折旧和摊销

最佳货币资金保有量月数参考企业历史年度现金周转情况，并结合预测年度各项周转率水平综合分析确定。

2）应收款项

应收款项＝营业收入总额÷应收款项周转率

其中，应收款项主要包括应收账款、应收票据以及与经营业务相关的其他应收账款等诸项（预收款项、合同负债作为应收款项的减项处理）。

3）应付款项

应付款项＝营业成本总额÷应付款项周转率

其中，应付款项主要包括应付账款、应付票据以及与经营业务相关的其他应付账款等诸项（预付款项作为应付款项的减项处理）。

4）存货

存货＝营业成本总额÷存货周转率

根据对企业历史年度各项周转率指标的统计分析以及预测期内各年度收入与成本预测的情况，测算得到企业未来年度营运资本增加额，预测数据如下：

金额单位：万元

项目\年份	2026年	2027年	2027年末
营运资本增加额	1,875.45	-6,598.56	-4,936.97

（13）资产回收预测

本次评估于经营期末考虑营运资金的回收价值，对于营运资金，按照经营期最后一年营运资金占用全部回收；对于固定资产或无形资产等长期资产，经营期末的资产账面净值较低，不考虑资产处置的可回收价值，不作为期末加回。预测结果见自由现金流预测表。

（14）自由现金流的预测

综上所述，企业未来年度的自由现金预测数据如下：

金额单位：万元

项目\年份	2026年3-12月	2027年	2027年末
一、营业收入	**19,630.99**	**10,652.99**	
减：营业成本	0.00	0.00	
税金及附加	363.18	176.77	
销售费用	272.74	174.67	
管理费用	745.01	504.19	
研发费用	753.65	482.19	
财务费用	0.00	0.00	
加：其他收益	0.00	0.00	
投资收益	0.00	0.00	
净敞口套期收益	0.00	0.00	
公允价值变动收益	0.00	0.00	
信用减值损失	-0.15	0.00	
资产减值损失	0.00	0.00	
资产处置收益	0.00	0.00	
二、营业利润	**17,496.25**	**9,315.17**	
加：营业外收入	0.00	0.00	
减：营业外支出	0.00	0.00	
三、利润总额	**17,496.25**	**9,315.17**	
减：所得税费用	2,616.91	1,329.29	
四、净利润	**14,879.35**	**7,985.88**	
减：少数股东损益	0.00	0.00	
五、归属于母公司股东的净利润	**14,879.35**	**7,985.88**	
加：税后付息债务利息	0.00	0.00	
折旧和摊销	133.92	160.25	
减：资本性支出	0.00	0.00	

项目\年份	2026年3-12月	2027年	2027年末
营运资本增加	1,875.45	-6,598.56	
加：资本回收			4,936.97
六、企业自由现金流	**13,137.82**	**14,744.69**	**4,936.97**

（15）折现率的确定

本次收益法评估采用企业自由现金流折现模型，选取加权平均资本成本（WACC）作为折现率，计算公式如下：

$$WACC = R_d \times （1 - T） \times \frac{D}{D+E} + R_e \times \frac{E}{D+E}$$

其中：Re—权益资本成本；

Rd—付息债务资本成本；

E—权益价值；

D—付息债务价值；

T—企业所得税税率。

本次评估采用资本资产定价模型（CAPM）确定公司的权益资本成本，计算公式如下：

$$R_e = R_f + \beta \times （R_m - R_f） + \varepsilon$$

其中：Re—权益资本成本；

Rf—无风险利率；

β—权益系统性风险调整系数；

（Rm－Rf）—市场风险溢价；

ε—特定风险报酬率。

1）无风险利率（Rf）的确定

无风险利率是指投资者投资无风险资产的期望报酬率，该无风险资产不存

在违约风险。无风险利率通常可以用国债的到期收益率表示，选择国债时应当考虑其剩余到期年限与企业现金流时间期限的匹配性。根据中央国债登记结算有限责任公司编制，并在中国债券信息网发布的数据，评估基准日两年期国债的到期收益率为 1.36%（保留两位小数），故本次评估以此作为无风险利率。

2）市场风险溢价（Rm－Rf）的确定

市场风险溢价是指投资者对与整体市场平均风险相同的股权投资所要求的预期超额收益，即超过无风险利率的风险补偿。本次评估采用中国证券市场指数和国债收益率曲线的历史数据计算中国的市场风险溢价。首先，选取中证指数有限公司发布的能较全面反映沪深两市股票收益水平的沪深 300 净收益指数的年度数据，采用几何平均法，分别计算近十年各年自基日以来的年化股票市场收益率。接下来，选取中央国债登记结算有限责任公司编制，并在中国债券信息网发布的十年期国债到期收益率数据，作为近十年各年的无风险利率。最后，将近十年各年自基日以来的年化股票市场收益率与当年的无风险利率相减，得到近十年各年的市场风险溢价，并综合分析后得到本次评估采用的市场风险溢价为 5.80%。

3）资本结构比率（D/E）的确定

资本结构比率是指付息债务与权益资本的比率。

经过计算，同行业可比上市公司的平均资本结构比率（D/E）与被评估企业资本结构有一定差异，故本次采用企业自身资本结构计算折现率。经过迭代计算，企业的自身资本结构比率（D/E）为 0.0%。

4）贝塔系数（β系数）的确定

非上市公司的β系数（权益系统性风险调整系数）通常由多家可比上市公司的平均β系数调整得到，即计算可比上市公司带财务杠杆的β系数（βL）并调整为不带财务杠杆的β系数（βU），在此基础上通过取平均值等方法得到评估对象不带财务杠杆的β系数（βU），最后考虑评估对象适用的资本结构得到其带财务杠杆的β系数（βL），计算公式如下：

$$\beta_L = \beta_U \times \left[1 + （1 - T） \times \frac{D}{E}\right]$$

式中：βL—带财务杠杆的β系数；

βU—不带财务杠杆的β系数；

T—企业所得税税率；

D/E—付息债务与权益资本价值的比率。

根据可比上市公司带财务杠杆的β系数、企业所得税率、资本结构比率等数据，计算得到行业剔除财务杠杆调整后β系数平均值，并计算得到评估对象的β系数βL＝0.868。

5）特定风险报酬率（ε）的确定

特定风险报酬率旨在反映评估对象自身特定因素导致的非系统性风险，主要考量评估对象与所选取的可比上市公司在企业规模、业务模式、所处经营阶段、核心竞争力、主要客户及供应商依赖等方面的差异。对于定制化量产业务，本次评估采用的特定风险系数为 4.0%。

6）权益资本成本（Re）的计算

将上述参数代入权益资本成本的计算公式，计算得出被评估单位的权益资本成本如下：

Re＝Rf＋βL×（Rm－Rf）＋ε

＝1.36%＋0.868×5.8%＋4.00%

＝10.4%

7）付息债务资本成本（Rd）的确定

付息债务资本成本取评估基准日企业实际平均付息债务利率 2.55%。

8）加权平均资本成本（WACC）的计算

将上述参数代入加权平均资本成本的计算公式，计算得出被评估单位的加权平均资本成本如下：

WACC＝Rd×（1－T）×D/（D＋E）＋Re×E/（D＋E）

＝2.55%×（1－15.00%）×0.00%＋10.4%×100.00%

＝10.4%

（16）经营性资产价值的计算

将上述预测的未来资产组自由现金流折现并加总，得到定制化量产业务的经营性资产价值为 29,600.00 万元。

金额单位：万元

项目\年份	2026 年 3-12 月	2027 年	2027 年末
企业自由现金流	**13,137.82**	**14,744.69**	**4,936.97**
折现率	10.4%	10.4%	10.4%
折现期（月）	5.0	16.0	22.0
折现系数	0.9596	0.8764	0.8341
折现值	12,607.05	12,922.25	4,117.93
经营性资产评估值	**29,600.00**		

6、市场法评估结果

杰华特 EV/S 倍数远高于其余三家可比公司，为避免极值对估值模型的影响，本次评估价值比率计算给予杰华特的权重为 0%，其余三家分别为 33.33%，合计 100%。

采用 EV/S 计算被评估单位股权价值的过程和结果如下表所示：

金额单位：万元

项目	可比公司 1	可比公司 2	可比公司 3	可比公司 4
	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
价值比率 EV/S	9.04	6.27	5.54	5.67
交易日期修正	100/100	100/100	100/100	100/100
交易情况修正	100/100	100/100	100/100	100/100
经营规模修正	100/110	100/108	100/110	100/110
成长性修正	100/101	100/104	100/92	100/93
偿债能力修正	100/96	100/102	100/105	100/103
运营能力修正	100/100	100/100	100/98	100/99
盈利能力修正	100/100	100/104	100/105	100/106
研发能力修正	100/99	100/98	100/96	100/97

项目	可比公司 1	可比公司 2	可比公司 3	可比公司 4
	杰华特	希荻微	英集芯	芯朋微
修正后价值比率 EV/S	8.56	5.37	5.28	5.29
权重	0%	33%	33%	33%
加权修正后价值比率 EV/S	5.31			
企业营业收入（万元）	33,500.00			
经营性企业价值（万元）	178,000.00			
减：付息债务（万元）	6,518.50			
减：少数股东权益（万元）	-			
经营性股权价值（万元）	171,481.50			
考虑流动性折扣后经营性股权价值（万元）	109,600.00			
加：货币资金及非经营性资产	55,393.80			
评估值（万元）	165,000.00			

四、引用其他评估机构报告或估值机构报告的内容

本次评估未引用其他估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等估值资料。

五、估值特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

本次评估不存在评估特殊处理或对评估结论有重大影响的事项。

六、评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对评估及交易作价的影响

评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项如下：

1、2026 年 1 月 6 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,333.4111 万元减少至 5,002.7596 万元，其中：美的投资减少 102.0408 万元注册资本并退出晶艺半导体；天利投资减少 21.8659 万元注册资本；高鹏翼盛减少 85.2770 万元注册资本；高鹏联盛减少 24.0525 万元注册资本；腾元投资减少 10.933 万元注册资本；易荣坤减少 16.3994 万元注册资本；上海芯琏减少 70.0829 万元注册资本。本次减资以各股东的投资成本为基础协商定价，晶艺半导体已于 2026 年 1 月向上述股东支付合计为 24.145.83 万元的回购款。2026 年 3 月 4 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权

回购涉及的减资款项已于评估基准日前支付，该事项不影响评估结论。

2、截至评估基准日被评估单位股东未完全出资，认缴出资金额 5,333.4111 万元，实缴金额 5,313.4111 万元。2026 年 3 月 3 日，易坤投资 151.20 万元以货币形式补足实缴注册资本 20 万元。被评估单位评估基准日股东全部权益市场价值未考虑未来补足认缴出资额对于股东全部权益价值的影响。

七、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析

（一）董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的意见

1、评估机构的独立性

本次交易的资产评估机构为金证评估，系符合《证券法》规定的评估机构。金证评估及其经办评估师与公司、重组各方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，资产评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

金证评估出具的相关资产评估报告的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规及规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次资产评估的目的是确定标的公司截至评估基准日的市场价值，作为交易定价的参考依据。金证评估采用资产基础法、市场法对标的公司在评估基准日的股东全部权益价值进行评估，最终采用市场法的评估值作为标的公司股东全部权益价值的评估结论。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

以上评估方法能够比较合理地反映被评估企业的股权价值，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法的选取得当，评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估结果具有公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易的标的资产的最终交易价格以金证评估出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

综上，董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的评估报告结论具有公允性，交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）评估预测的合理性

本次资产评估使用到的评估方法、评估参数、评估数据等均来自法律法规、评估准则、评估证据及合法合规的参考资料等，评估预测具备合理性。

（三）后续变化对评估的影响

本次评估是基于现有的国家法律、法规、产业政策、税收政策并基于现有市场情况，未考虑今后市场发生目前不可预测的重大变化和波动。董事会未来将会根据行业宏观环境、产业政策、税收政策等方面的变化采取合适的应对措施，保证标的公司经营与发展的稳定。

（四）敏感性分析

在市场法评估模型中，流动性折扣及可比公司股价变动对市场法评估结果有较大的影响，故对标的公司市场法评估结果与流动性折扣及可比公司股价变动进行了敏感性分析，结果如下：

1、流动性折扣

缺乏流动性折扣变动（绝对值）	变动后缺乏流通性折扣	评估值（万元）	缺乏流动性折扣率每1.0%变动对评估值影响金额（万元）	评估值变动率
3.00%	39.10%	159,800.00	-1,700.00	-3.15%
2.00%	38.10%	161,500.00	-1,800.00	-2.12%
1.00%	37.10%	163,300.00	-1,700.00	-1.03%

缺乏流动性折扣变动（绝对值）	变动后缺乏流通性折扣	评估值（万元）	缺乏流动性折扣率每1.0%变动对评估值影响金额（万元）	评估值变动率
0.00%	36.10%	165,000.00	0.00	0.00%
-1.00%	35.10%	166,700.00	1,700.00	1.03%
-2.00%	34.10%	168,400.00	1,700.00	2.06%
-3.00%	33.10%	170,100.00	1,700.00	3.09%

注：相关测算假设其他参数保持不变

2、可比公司股价变动

可比公司股价变动率	评估值（万元）	可比公司股价每1.0%变动对评估值影响金额（万元）	评估值变动率
3%	169,000.00	1,500.00	2.42%
2%	167,500.00	1,300.00	1.52%
1%	166,200.00	1,200.00	0.73%
0%	165,000.00	0.00	0.00%
-1%	163,500.00	1,500.00	-0.91%
-2%	162,200.00	1,300.00	-1.70%
-3%	160,800.00	1,400.00	-2.55%

注：相关测算假设其他参数保持不变

（五）交易标的与上市公司的协同效应分析

上市公司与标的公司同属于功率半导体领域企业，本次交易首先可对上市公司功率半导体业务进行较大程度的补足，完善上市公司在功率半导体的产品布局，形成应用场景更完善、技术规格更全面的功率半导体产品体系，一方面功率 IC 产品由高可靠应用领域向智能家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等全电子领域拓展，另一方面，在具体产品方面，交易后公司功率半导体产品实现从中大功率电源管理 IC 向中小功率电源管理 IC 的覆盖，产品矩阵更为全面。

同时，得益于双方产品同领域的特点，本次交易后双方共享客户资源与销售渠道的难度较低，借助标的公司较为丰富的客户积累，可以逐步推广导入上市公司的 SiC MOSFET 及工业电源用产品；标的公司丰富的电源管理产品还可以通过上市公司渠道和客户资源打入高可靠性需求市场，助力国产替代。

其次，同为 Fabless 模式的半导体设计企业，双方可共享工艺平台、优化供应链管理能力，并通过规模化采购提升对供应商的议价能力，降低晶圆及封装

测试成本；借助标的公司在民用领域的规模化出货能力与上市公司的高可靠质量保证体系，优化库存管理与产能调配，更好地应对市场需求波动。

最后，本次交易完成后，双方运营管理系统、销售渠道、服务网络、各个工种和职能部门整合共享，有助于实现提质增效，另一方面，双方研发人员、资源相互共享，可实现在工艺优化、器件设计、封装技术等方面的技术迭代创新能力提升，有助于公司形成更完整的功率半导体系统级解决方案，从而提升公司的核心竞争力。

因此，本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有协同效应，但目前协同效应尚难以具体量化，出于谨慎性原则，本次交易评估定价过程中未考虑上市公司与标的公司可能产生的协同效应。

（六）定价公允性分析

1、可比公司对比分析

选取企业规模、资产配置、所处成长阶段及成长性、经营风险及财务风险、业务结构与标的公司相近的上市公司为可比公司，截至 2026 年 2 月 28 日，估值情况如下：

证券代码	证券名称	市销率
688141.SH	杰华特	9.93
688173.SH	希荻微	7.41
688209.SH	英集芯	6.21
688508.SH	芯朋微	7.98
平均数		**7.88**
中位数		**7.69**
标的公司		**4.72**

注：市销率=可比上市公司 2026 年 2 月 28 日市值/标的公司 100%对价÷可比上市公司 2025 年度营业收入/标的公司 2025 年度营业收入

本次交易中，标的公司的市销率低于可比上市公司相应指标的平均值和中位值，本次交易作价以评估机构正式出具的评估结果为基础，经交易双方协商确定。结合同行业上市公司指标情况，本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

2、可比交易对比分析

根据近年来公开市场信息，筛选的同行业可比交易案例情况具体如下：

证券简称	标的简称	标的业务	评估值（万元）	静态 PS	动态 PS
概伦电子	锐成芯微	提供集成电路产品所需的半导体 IP 设计、授权及相关服务	157,479.00	6.32	-
概伦电子	纳能微	提供集成电路产品所需的半导体 IP 设计、授权及相关服务	60,000.00	9.06	8.15
中微公司	众硅	高端化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。	250,140.00	10.25	8.93
思瑞浦	创新微	高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售，主要产品包括锂电保护芯片、AC-DC、功率器件等	106,000.00	4.19	2.72
希荻微	诚芯微	模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售；主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET 和电池管理芯片等多种集成电路产品	31,100.00	1.57	1.54
泰凌微	磐启微	低功耗无线物联网芯片的研发、设计和销售	85,000.00	6.00	3.70
华海诚科	衡所华威	半导体芯片封装材料研发、生产和销售	165,800.00	3.54	3.04
均值				**5.85**	**4.68**
中位数				**6.00**	**3.37**
本次交易				**4.72**	**2.93**

注：概伦电子收购锐成芯微案例中，未披露标的公司评估基准日后一个会计年度的收入，因此无法计算动态市销率。

本次交易，标的公司 100%股东权益作价 16.50 亿元，对应静态市销率为 4.72 倍、动态市销率为 2.93 倍，低于可比交易案例平均值和中位数。

综上所述，本次评估标的资产股东全部权益价值评估结果客观反映了标的公司股权的市场价值，本次交易定价具有合理性。

（七）交易定价与评估结果差异分析

本次交易中，标的公司 100%股份的交易定价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告为基础，并经交易双方协商确定，交易定价与评估结果不存在重大差异。

八、董事会对本次股份发行定价合理性的分析

本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体 100.00%股份，并募集配套资金。本次发行股份的定价合理性分析如下：

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

综上所述，公司本次发行股份的发行定价符合《重组管理办法》等相关规定，本次股份发行定价合理。

九、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了分析，发表独立意见如下：

1、评估机构的独立性

本次交易的资产评估机构为金证评估，系符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构。金证评估及其经办评估师与公司、重组各方、标的公司，除

业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，资产评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

金证评估出具的相关资产评估报告的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规及规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与目的的相关性

本次资产评估的目的是确定标的公司截至评估基准日的市场价值，作为交易定价的参考依据。金证评估采用资产基础法、市场法对标的公司在评估基准日的股东全部权益价值进行评估，最终采用市场法的评估值作为标的公司股东全部权益价值的评估结论。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

以上评估方法能够比较合理地反映被评估企业的股权价值，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法的选取得当，评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估定价的公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易的标的资产的最终交易价格以金证评估出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

综上所述，独立董事一致认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的评估报告结论具有公允性，交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、业绩承诺及可实现性

（一）业绩承诺的合理性

本次交易的业绩承诺以标的公司管理层结合标的公司未来经营情况为基础，由业绩承诺方与上市公司协商确定，业绩承诺具有合理性。

（二）业绩承诺补偿相关协议签署情况

上市公司与易坤等签署了《业绩补偿协议》，具体详见报告书“第七章 本次交易主要合同”相关内容。

（三）交易对方履约能力及履约保障措施

本次交易方案中已经设置较为充分的履约保障措施，能够较好地保护上市公司及中小股东利益，相关交易对方就业绩承诺已签署了《业绩补偿协议》，并出具了相关承诺。

十一、本次交易资产定价的合理性

（一）本次交易的资产定价过程经过了充分的市场博弈，交易价格公允；

（二）本次评估所选取的评估或者估值方法与标的资产特征相匹配，评估、估值参数选取合理；

（三）标的资产交易作价与历史交易作价的差异具备合理性，具体分析情况请参见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（三）最近三年增减资、股权转让及改制、评估情况，与本次重组评估情况的差异原因”；

（四）本次交易与相同或者类似资产在可比公司中的估值水平不存在重大差异，具体情况参见本报告书“第六章 标的资产评估作价基本情况”之“七、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”。

第七章 本次交易主要合同

一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容

（一）合同主体、签订时间

2026 年 3 月，上市公司（本节简称“甲方”）与交易对方易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、YA XU、曾鸣、曾岳琦、晶艺求精、晶艺共治、李六军、融芯科技、曾浩、凌风、薛峰、陈国栋、苏鹏飞、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、陈艺琴、易荣坤、芯联启辰、华天集团、天利投资（该协议中交易对方合称“转让方”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买转让方合计持有的标的公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

（二）本次交易的方案

2.1 上市公司拟以定向发行股份及支付现金的方式向交易对方（包括转让方）购买其持有的标的公司股权（包括转让方持有的标的公司 100%股权（对应注册资本 5,002.7596 万元）），以取得对标的公司的控制权。为免疑义，如交易对方中的任何一方退出本次交易，则标的资产对应的标的公司股权比例将根据该交易对方持有的标的公司股权比例相应调整。待标的公司审计、评估工作完成后，双方将另行签署补充协议以明确本次交易的最终交易方案。

2.2 如果中国证监会、上交所等监管机构要求或者上市公司董事会、股东会决议对本次交易方案作出调整的，经双方以书面方式协商一致，可对本次交易的交易方案相应进行调整。

（三）标的资产的作价

本次交易标的资产的交易价格将以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关中国法律规定的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的公司全部股权截至基准日的评估值为基础，由上市公司与交易对方共同协商确定。待标的公司审计、评估工作完成后，双方将另行签署补充协议对标的资产的具体交易价格予以确认。

（四）交易对价的支付方式

4.1 双方同意，受限于本次交易的最终交易方案，上市公司将通过定向发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付购买标的资产的全部对价；其中，现金对价的金额及其支付安排由双方另行签署补充协议予以约定，股份对价的具体发行方案如下：

4.1.1 发行方式、发行对象和认购方式

上市公司拟向相关交易对方定向发行股份，交易对方以其持有的相应标的资产分别认购上市公司发行的新增股份。

4.1.2 发行股份的种类和面值

本次发行涉及的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

4.1.3 定价基准日

本次发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日，即上市公司首次审议本次发行股份及支付现金购买资产事宜的董事会决议公告日。

4.1.4 发行价格

本次发行的发行价格为人民币 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价（定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总量）的 80%。

本次发行的最终发行价格或定价原则尚需经上市公司股东会审议批准。在定价基准日至本次发行结束之日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将按照中国法律的规定进行相应调整。

4.1.5 发行数量

本次发行涉及的发行股份的数量的计算方法为：发行股份的数量=股份对价÷本次发行的每股发行价格。按上述公式计算得出的“发行股份的数量”按照向

下取整精确至股，不足一股的部分相应计入上市公司的资本公积金。

本次发行的发行数量以经上交所审核通过且中国证监会予以注册的股份数量为准。在定价基准日至本次发行结束之日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将按照中国法律的规定进行相应调整。

4.1.6 股份锁定安排

交易对方取得的上市公司本次发行的新增股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；如交易对方在取得本次发行的新增股份时对其用于认购该等股份的相关标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则相关股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；如交易对方为私募投资基金，且截至定价基准日对其用于认购本次发行的新增股份的相关标的资产持续拥有权益的时间已满 48 个月，则相关股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。其中承担标的公司业绩承诺及补偿义务的交易对方（如有），还应根据相关方届时签署的业绩承诺及补偿协议执行相关股份锁定安排。

若前述股份锁定安排与届时适用中国法律或相关监管政策不符的，双方应对上述约定进行相应调整。

4.1.7 上市地点

本次发行涉及的新增股份将在上交所科创板上市交易。

4.1.8 滚存未分配利润的处理

上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的上市公司新老股东按照其届时对上市公司的持股比例共同享有。

（五）标的资产的交割及交易对价的支付

5.1 本协议及约定本次交易最终交易方案的补充协议的全部条款生效后，上市公司及转让方应尽快实施本次交易，转让方应积极配合上市公司及标的公司办理标的资产的交割手续，使得标的资产能够尽快过户至上市公司名下。自交割日起，上市公司即成为标的资产的唯一合法所有者，转让方不再享有与相关标的资产有关的任何权利。

5.2 双方将另行协商确定标的资产于过渡期间的损益享有和补足安排。双方确认，上市公司将聘请经易坤认可的符合《中华人民共和国证券法》等相关中国法律要求的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告。

5.3 标的资产交割完成后，上市公司将根据相关中国法律的规定支付本次交易的交易对价，包括办理新增股份的发行登记手续，转让方应对此提供必要的配合与协助。

（六）业绩承诺与补偿措施

本次交易的业绩承诺和补偿的具体方案将由上市公司与相关交易对方在标的公司的审计、评估工作完成后按照中国法律及相关监管政策的要求另行协商确定，业绩承诺义务人及业绩补偿方案的具体内容以相关方届时签署的业绩承诺及补偿协议的约定为准。

（七）陈述、保证及承诺

7.1 双方各自陈述和保证如下，并确保该等陈述和保证自签署日至交割日始终真实、准确：

（1）其为依据中国法律依法设立并有效存续的主体/中国籍自然人，具有完全的民事权利能力及民事行为能力；受限于本协议第 8.1 条的约定，其已依法取得为签署本协议所必需的批准、同意、授权和许可；以及

（2）其签署、交付和履行本协议，（i）不会违反任何适用中国法律；（ii）不会违反其作为缔约一方并对其有约束力的任何契约、承诺或其它文件；（iii）不会违反其组织章程文件（如适用）；以及（iv）其不存在可能影响其履行本协议的潜在的或者已经发生的尚未了结的诉讼、仲裁或其他司法或行政程序。

7.2 转让方向上市公司作出如下陈述、保证及承诺，并确保该等陈述和保证自签署日至交割日始终真实、准确：

（1）其已根据相关中国法律及标的公司章程的规定履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资、出资不实等违法违规行为；其对相关标的资产享有完整的所有权，不存在委托持股、信托持股或其他类似安排；相

关标的资产不存在质押、抵押、担保、冻结、查封或任何其他权利负担或第三方权利，亦不存在任何权属争议或纠纷或潜在的争议或纠纷或涉及任何司法或行政程序，相关标的资产的过户或转移不存在法律障碍；

（2）其为履行及实施本次交易之目的而向上市公司及其中介机构提供的所有文件和材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且文件、材料为副本或复印件的，其均与原件一致和相符；

（3）其将积极签署并准备与本次交易有关的一切合理且必要的文件，与上市公司共同向有权部门申请办理本次交易的审批/注册手续，并在本次发行股份及支付现金购买资产事宜完成全部必需的审批/注册程序后按本次交易相关协议的约定实施本次交易方案。

7.3 自签署日起至交割日，转让方应单独且共同地尽一切努力确保标的公司及其合并报表范围内的子公司（以下合称“标的集团”）处于良好经营状态，并承诺将履行以下义务：

（1）确保标的集团按照与过去惯例及谨慎商业惯例相符的正常经营方式经营业务，不得实施日常经营以外可能导致标的集团或其资产、业务发生重大不利变化的决策和/或行为；

（2）确保标的集团遵守其适用的法律、法规、规范性文件及其相应的章程、内部管理制度；

（3）确保标的集团不会增加或减少注册资本，不会发行任何股权/股份、债券或其他证券（或任何期权、认股权证或购买股权的其他权利）；

（4）确保标的集团有效存续，标的集团不会通过任何吸收合并、新设合并、资产业务整合或其他非常规业务交易计划；

（5）除非事先取得上市公司的书面同意，确保标的集团不会宣布、计提、拨备或支付任何分红或进行任何其他分配；

（6）确保标的集团不会对外提供任何担保、保证或向他人提供借款（不包括正常业务经营过程中标的公司对标的公司全资子公司提供的符合商业惯例的担保、保证或借款（如有）、员工备用金）；

（7）确保标的集团不会同意或承诺作出前述任何一项行动。

（八）协议的生效、终止或解除

8.1 本协议自双方签署之日起成立，除第 1 条、第 7 条至第 13 条自本协议成立时即生效外，本协议其他条款自本协议成立且下列条件全部成就时生效：

（1）上市公司董事会、股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜；

（2）双方已就本次交易的最终交易方案另行签署补充协议；

（3）转让方内部决策机构审议通过本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜（如需）；

（4）本次发行股份及支付现金购买资产事宜获得上交所的审核通过，并经中国证监会注册；以及

（5）本次发行股份及支付现金购买资产事宜获得适用中国法律所要求的其他有权机关的事前审批、核准或许可（如适用）。

8.2 下列任一情形发生时，可以终止或解除本协议：

（1）经双方协商一致并达成书面协议，可以终止或解除本协议；

（2）如上市公司无法通过本次交易取得标的公司的控制权的，上市公司有权单方以书面通知方式终止本协议；

（3）如上市公司未在双方协商约定的期限内办妥股份对价和现金对价的交割手续的，任一转让方有权解除本协议；

（4）如任何一方严重违反本协议约定，且在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起 5 个工作日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议，并有权向违约方索赔；

（5）本协议签署后，无论任何原因导致本次交易未获得上交所审核通过或中国证监会未予以注册的，任何一方均可以书面通知方式终止本协议；以及

（6）如任何政府部门制定、发布、颁布、实施或通过会导致本次交易不合

法或限制或禁止本次交易的任何法律或政府命令，则任何一方均可以书面通知方式终止本协议。

（九）法律适用与争议解决

9.1 本协议的订立、生效和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

9.2 如果双方之间就本协议的签署、履行、解释等方面产生任何争议，双方首先应通过友好协商解决；如自争议发生之日起 30 日内协商不成的，任何一方可将争议提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

（十）违约责任

10.1 本协议签署后，除因不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约。给守约方造成损失的，违约方应予以赔偿。

10.2 双方同意，第 10.1 条中有关损害赔偿的约定不应为守约方所将获得的唯一的救济。如果违约方未能依约履行或违反本协议中的任何约定，守约方可以寻求基于本协议以及适用中国法律而可以主张的任何其他权利或可以寻求的任何及所有其他救济，包括但不限于实际履行。

10.3 如因中国法律或政策限制，或因上市公司董事会、股东会未能审议通过本次交易，或因中国证监会、上交所等监管机构未能批准、核准或注册等原因，导致本次交易不能实施的，不视为任何一方违约，但由于任何一方怠于履行其义务或违反所适用的法律、法规、规范性文件、监管机构的要求或本协议约定而导致该等情形的除外。

二、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的主要内容

（一）合同主体、签订时间

2026 年 8 月，上市公司（本节简称“甲方”）与交易对方易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、YA XU、曾鸣、曾岳琦、晶艺求精、晶艺共治、李六军、融芯科技、曾浩、凌风、薛峰、陈国栋、苏鹏飞、高鹏翼盛、高鹏联盛、腾元投资、陈艺琴、易荣坤、芯联启辰、华天集团、天利

投资（该协议中交易对方合称“转让方”或“交易对方”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买转让方合计持有的标的公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

（二）本次交易的方案

2.1 上市公司同意以发行股份及支付现金的方式购买包括转让方在内的交易对方持有的标的公司股权，转让方同意以其持有的标的资产参与本次交易。

2.2 如果中国证监会、上交所、上市公司董事会（经股东会授权）对本次交易方案做出调整的，经双方以书面方式协商一致，本次交易方案可相应进行调整。

（三）标的资产的作价及交易对价的支付

3.1 根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日，标的公司 100%股权的评估值为 165,000.00 万元。双方考虑评估结果，结合是否承担业绩承诺及补偿义务、股份锁定等因素，交易对方转让标的公司股权采取差异化定价。经协商确认，上市公司向转让方支付的合计交易对价及支付方式、支付节奏如下：

单位：万元，万股

序号	交易对方	现金对价	股份对价	总对价	发股数量	第一期现金对价	第二期现金对价
1	易坤	-	24,345.02	24,345.02	749.31	-	-
2	晶格共智	13,459.35	7,880.75	21,340.10	242.56	-	13,459.35
3	晶格共创	5,037.24	2,965.30	8,002.54	91.27	-	5,037.24
4	晶格共赢	4,238.71	3,408.15	7,646.87	104.90	-	4,238.71
5	晶格顶峰	4,953.93	2,515.11	7,469.04	77.41	-	4,953.93
6	晶格未来	4,477.86	2,635.50	7,113.37	81.12	-	4,477.86
7	YA XU	15,278.79	-	15,278.79	-	3,055.76	12,223.03
8	曾鸣	5,936.72	-	5,936.72	-	1,187.34	4,749.38
9	曾岳琦	-	5,936.72	5,936.72	182.72	-	-
10	晶艺求精	562.06	6,494.85	7,056.91	199.90	-	562.06
11	晶艺共治	1,148.37	5,908.55	7,056.91	181.86	-	1,148.37
12	李六军	-	6,162.86	6,162.86	189.68	-	-

序号	交易对方	现金对价	股份对价	总对价	发股数量	第一期现金对价	第二期现金对价
13	融芯科技	742.09	742.09	1,484.18	22.84	-	742.09
14	曾浩	742.83	742.83	1,485.67	22.86	297.13	445.70
15	凌风	1,484.18	-	1,484.18	-	296.84	1,187.34
16	薛峰	-	1,422.67	1,422.67	43.79	-	-
17	陈国栋	-	1,422.67	1,422.67	43.79	-	-
18	苏鹏飞	-	711.34	711.34	21.89	-	-
19	高鹏翼盛	6,907.50	6,907.50	13,815.00	212.60	-	6,907.50
20	高鹏联盛	1,948.27	1,948.27	3,896.54	59.97	-	1,948.27
21	腾元投资	885.58	885.58	1,771.16	27.26	-	885.58
22	陈艺琴	872.36	1,328.37	2,200.73	40.89	440.15	432.22
23	易荣坤	456.00	-	456.00	-	91.20	364.80
24	芯联启辰	3,980.85	3,980.85	7,961.70	122.53	-	3,980.85
25	华天集团	1,163.15	1,771.15	2,934.31	54.51	-	1,163.15
26	天利投资	608.00	-	608.00	-	-	608.00
合计		**74,883.85**	**90,116.15**	**165,000.00**	**2,773.66**	**5,368.42**	**69,515.44**

对于 YA XU、曾鸣、曾浩、凌风、陈艺琴、易荣坤，上市公司将在《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》全部条款生效后 10 个工作日内支付转让方交易对价的 20%，在交割日后 10 个工作日内支付剩余的现金对价。对于其他有现金对价的交易对方，上市公司将在交割日后 10 个工作日内支付全部的现金对价。

上市公司应自交割日起 10 个工作日内向中国结算上海分公司提交对价股份的登记申请并于自交割日起 30 日内协助转让方将对价股份登记至转让方名下，转让方应就此向上市公司提供必要的配合。为免疑义，若股份对价为 0 元，则对价股份数量为 0 股，上市公司无需向转让方发行任何对价股份，本条有关对价股份登记的约定不适用。如转让方为业绩承诺方，《业绩补偿协议》对转让方取得对价股份另有约定的，以《业绩补偿协议》约定为准。

双方同意，如遇中国证监会、上交所、中国结算上海分公司等相关政府部门及办公机构等不可归责于一方的原因导致《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》第 3 条约定的手续未在上述限定期限内完成的，双方同意给予时间上合理地豁免，具体由双方另行友好协商确定，不视为违约。

（四）本次发行股份方案

4.1 发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

4.2 定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日。经双方协商，本次发行股份的发行价格为 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至本次发行股份发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份的发行价格按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格，计算结果向上取整保留两位小数。

最终发行价格尚需经上市公司股东会批准，并经上交所审核通过及中国证监会予以注册。

4.3 发行对象

本次交易发行股份的对象为包括转让方在内的标的公司的现有股东。

4.4 发行股份数量：

本次发行股份中上市公司向发行对象发行股份数量的计算公式为：发行数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算得

出的“发行数量”按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司的资本公积金（舍尾取整）。

最终发行数量以经上市公司股东会批准，并经上交所审核通过及中国证监会予以注册确定的股份数量为准。

在定价基准日至本次发行股份发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

4.5 股份锁定安排

（1）若转让方与上市公司及其他相关方未签署《业绩补偿协议》，转让方因本次交易取得的上市公司新增股份，自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。但是，①若转让方取得新增股份时，转让方对转让方用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；②若转让方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时转让方对转让方用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 6 个月内不得上市交易或转让。前述“不得转让”包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

（2）若转让方与上市公司及其他相关方于 2026 年 8 月 5 日签署了《业绩补偿协议》，在满足前述股份锁定安排的前提下，转让方因本次交易取得的上市公司新增股份应根据前述业绩补偿协议的约定予以分期发行、锁定及解锁。

本次交易完成后，转让方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新法规规则、监管要求不相符，转让方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、上交所的规定和规则办理，上市公司应就符合解除锁定

条件的对价股份及时提交解除限售申请。

4.6 滚存未分配利润安排

上市公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。

（五）标的资产的交割

5.1 自本协议全部条款生效后，上市公司及转让方应尽快实施本次交易，在本次交易所涉及的自然人交易对方取得完税凭证后 20 个工作日内，转让方应积极配合上市公司及标的公司完成标的资产的交割，使得本次交易项下全部标的资产能够尽快过户至上市公司名下。如遇相关政府部门及办公机构等原因导致前述手续未在上述限定期限内完成的，双方应同意给予时间上合理地豁免，但至晚不得晚于在本次交易所涉及的自然人交易对方取得完税凭证后的 40 个工作日。如因非双方原因导致标的资产未按照前述期限完成交割的，不视为上市公司或转让方违约。

5.2 自交割日起，上市公司即成为标的资产的唯一合法所有者，转让方不再享有与标的资产有关的任何权利和义务。

5.3 本次交易完成后，标的公司的累积未分配利润由交易完成后的股东享有。

（六）过渡期安排

6.1 过渡期内，转让方承诺通过采取行使股东权利等一切有效的措施，确保对标的资产的合法和完整的所有权，保证标的资产权属清晰，未经上市公司书面同意，不得对标的资产设置质押或其他权利负担，亦不得转让标的资产。

6.2 过渡期内，转让方将通过对提交董事会（如转让方向标的公司委派董事）和/或股东会审议的事项进行合理表决的方式促使标的公司及其下属企业（为免疑义，标的公司合并报表范围内的控股子公司及其分支机构视为其下属企业，下同）以符合相关法律和良好经营惯例的方式保持正常运营。转让方通过董事会（如转让方向标的公司委派董事）和/或股东会知悉标的公司及其下属企业的下列情况时，应及时告知上市公司相关事项：

1）对现有的业务做出实质性变更，或者开展任何现有业务类型范围之外的

业务且开展该等业务涉及的财务预算超过 2,000 万元，或者停止或终止现有主要业务；

2）增加或减少注册资本，或者发行债券、可转换债、认股权或者设定其他可转换为股权的权利，或者授予或同意授予任何收购或认购标的公司的股权（不包括标的公司间接层面的股权）的权利；

3）对标的公司及其下属企业现有主要资产进行处置或设定任何形式的权利限制，包括但不限于标的公司及其下属企业的注册商标、专利、集成电路布图、专有技术等，但与过往主营业务经营惯例一致的经营活动除外；

4）采取任何主动或被动行为使其资质证书或任何政府机构颁发的其他资质或许可失效（为免疑义，标的公司在相关资质证书、其他资质或许可期限正常届满后根据相关法律法规要求及时完成续期或换发的，不属于此种情形）；

5）单项金额在 1,000 万元或在过渡期内累计金额在 3,000 万元以上的对外重大投资、重大收购；

6）转移、处置单项金额在 1,000 万元或在过渡期内累计金额在 3,000 万元以上的标的公司及其下属企业财产，增加、创设单项金额在 1,000 万元或在过渡期内累计金额在 3,000 万元以上的标的公司及其下属企业债务，但与过往主营业务经营惯例一致的经营活动除外；

7）放弃或转让任何权利（包括债权、担保权益）导致对标的公司产生重大不利影响，或者承担任何负债或其他责任导致对标的公司产生重大不利影响；

8）新增对外提供任何贷款或担保，但不包括：（i）进行正常业务经营产生的贷款或担保；（ii）标的公司及其合并报表范围内的子公司之间的贷款或担保；

9）因标的公司/交易对方原因导致发生其他影响本次交易推进的重大不利变化。

6.3 过渡期内，作为本次交易的购买方，上市公司应尽合理商业努力促使不会出现下列情形：

1）控股股东或实际控制人发生变更；

2）对现有的业务做出实质性变更，停止或终止现有主要业务；

3）上市公司主营业务经营发生重大不利变化；因上市公司原因导致发生其他影响本次交易推进的重大不利变化；

4） 不再具备《上市公司证券发行注册管理办法》要求上市公司具备的向特定对象发行股票之条件。

6.4 过渡期内，标的公司产生的收益由重组完成后的股东享有，产生的亏损（剔除过渡期内股份支付对标的资产净利润影响）由交易对方按标的公司原有持股比例以现金方式向上市公司补足。具体收益及亏损金额应按收购标的资产的比例计算。

双方同意，在标的资产交割完成日后 60 日内，由上市公司及易坤共同认可的符合《证券法》相关规定的审计机构对标的公司过渡期期间损益进行审计，并出具审计报告予以确认。为避免歧义，双方认可以标的资产交割完成日上一个月的最后一天作为过渡期专项审计的审计基准日。若转让方与上市公司及其他相关方签署了《业绩补偿协议》，业绩承诺期与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》约定的过渡期存在重合，且转让方已根据本条约定对过渡期亏损进行补偿的，则在计算业绩补偿金额时应扣减转让方按本条约定已补偿的亏损金额。

6.5 双方应于交割完成当年上市公司年度报告披露之日前（“异议期”）对另一方过渡期安排的实际履行情况进行核实并确认，如一方认为另一方未能按照本协议约定履行过渡期承诺，应在异议期内提出，异议期后任何一方不应向另一方就本第 6 条约定向另外一方提出诉讼、要求或主张。

（七）标的公司的后续经营管理

7.1 本次交易交割完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。标的公司设董事 5 名，设监事 1 名，均由上市公司按照《中华人民共和国公司法》、本次交易完成后适用的标的公司《公司章程》、上市公司内部控制管理制度及其他有关法律、法规规定提名及选任。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，应当一人一票。

7.2 本次交易交割完成后，在业绩承诺期内，在标的公司原有管理层按照法律法规及公司章程履行其职责的前提下，上市公司将保持标的公司原有经营管理层的稳定性及独立性，日常经营管理、决策仍由现有的经营团队负责，认可标的公司在本次交易前已经执行的销售政策、员工薪酬和奖励制度等内部管理制度在本次交易完成后可保持其一贯性。标的公司在遵循上市公司章程及子公司管理制度等相关涉及上市公司规范管理及合规运作的制度前提下，独立核算，自主经营。

7.3 本次交易交割完成后，上市公司向标的公司委派 1 名财务经理，负责双方财务系统、制度对接等事项。

7.4 本次交易交割完成后，标的公司与员工已缔结的劳动合同关系继续有效，本次交易不涉及人员安置。

7.5 本次交易交割完成后，标的公司在交割日前的生产经营活动中产生的任何债权债务，在交割日后仍由标的公司享有或承担，本次交易不涉及债权债务转移。

7.6 上市公司承诺，不会利用所取得的标的公司控制权损害标的公司利益，在上市公司与标的公司或上市公司控制的其他企业与标的公司发生交易时，确保交易公平，按照双方在本次交易交割前已发生的交易定价原则及方式进行交易。

7.7 上市公司不得通过标的公司单方解聘标的公司核心员工，未经标的公司总经理同意，不得调整核心员工的工作岗位。

（八）陈述、保证及承诺

8.1 双方各自陈述、保证和承诺如下：

8.1.1 其为依据中国法律依法设立并有效存续的主体/中国籍自然人，具有完全的民事权利能力及民事行为能力，已依法取得为签署本协议所必需的批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署本协议；

8.1.2 签署本协议不违反任何其适用的法律、法规和政府主管部门及/或其注册地所适用相关法律、法规和政府主管部门的有关规定；

8.1.3 签署本协议不违反标的公司章程或其它组织规则中的任何条款，也不违反其作出或订立的对其或其资产有拘束力的任何重要承诺、协议和合同；

8.1.4 转让方同意本次交易并配合后续相关工作，承诺就本次交易放弃根据法律、标的公司《公司章程》和/或相关协议享有的优先购买权、优先清算权、回购权、优先收购权（如涉及）等权利，承诺就标的公司审议关于本次交易事宜的股东会上投赞成票，认可并同意其他标的公司股东在本次交易同时向上市公司转让其持有的标的公司全部股权，本次交易完成后标的公司的控股股东、实际控制人将发生变更，转让方不会因该等事项向标的公司及/或其第一大股东和/或实际控制人或其关联方提出任何异议、权利主张或追究其责任；

8.1.5 转让方承诺其对标的资产具有完整的所有权，标的资产不存在质押、抵押、担保、查封、权利负担或第三方权利的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议或潜在纠纷或争议，标的资产过户或转移不存在法律障碍；

8.1.6 转让方承诺其为履行本协议而提交的所有文件、资料等书面材料均真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

8.1.7 转让方承诺在过渡期内不会做出致使或可能致使标的公司及其子公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为；在本次交易完成或本补充协议终止前不会将所持标的公司的股权转让给任何第三方（包括转让方各主体内部之间的相互转让）或在标的公司股权上设定任何他项权利（包括但不限于抵押、质押等），否则该等转让/设定他项权利行为无效，如因此影响本次交易顺利实施或影响交易进程，则相关主体应对包括上市公司在内的其他方因此产生的一切损失进行充分赔偿；

8.1.8 转让方承诺，本次交易完成后，若标的公司芯片定制化量产业务因标的公司于报告期初至该业务业绩承诺期满期间（即 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日）的行为，使标的公司遭受损失（包括但不限于造成的知识产权相关赔偿、承担违约责任或被主管行政管理部门处罚等情形），转让方应承担标的公司实际发生的直接损失的赔偿责任，转让方的赔偿金额以实际损失乘以转让方本次交易前所持标的公司股权比例的金额为准，但不超过转让方本次交易取得的税后交易对价。

8.1.9 双方承诺其将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，共同向有关审批部门办理本次交易的审批手续，并在上交所审核通过及中国证监会予以注册本次交易后按本协议约定实施本次交易方案。

（九）协议的生效、变更、终止或解除

9.1 本补充协议自双方签名盖章之日起成立，除第 1 条、第 6.1 条至 6.3 条、第 8 至第 15 条自本补充协议成立时生效外，其他条款于原协议全部条款生效之日同时生效。

9.2 下列任一情形发生时，本协议可以终止或解除：

9.2.1 经双方协商一致并达成书面协议，可以终止或解除本协议；

9.2.2 如标的公司股东易坤、成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）、成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）、成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）、成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）、成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）、成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）、成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞未能均就本次交易向上市公司出售其持有的标的公司全部股权，上市公司可以选择终止本协议；

9.2.3 如因为任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起 10 日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议；

9.2.4 如果因本协议规定的任一生效条件未能成就或被满足，致使本协议无法生效并得以正常履行，且双方未就延期及修订本次交易的方案达成一致，则任何一方均可终止本协议；如非因一方或双方违约的原因造成前述生效条件（无论是一项、多项或全部）未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用及成本，且双方互不承担责任；

9.2.5 如任何政府部门制定、发布、颁布、实施或通过会导致本次交易不合法或限制或禁止本次交易的任何法律或政府命令，则任何一方均可终止本协议。

（十）法律适用与争议解决

10.1 本协议的订立、生效和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

10.2 本协议受中华人民共和国法律管辖。如果双方之间就本协议的签署、履行、解释等方面产生任何争议，双方首先应通过友好协商解决；如自争议发生之日起 30 日内协商不成的，任何一方可将争议提交标的公司住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

（十一）违约责任

11.1 本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下做出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约。给守约方造成损失的，违约方应予以赔偿。

11.2 如因法律或政策限制，或因上市公司股东会未能审议通过本次交易，或因中国证监会、上交所等监管机构未能批准、核准或注册等原因，导致本次交易不能实施，则不视为任何一方违约，任何一方不得向其他方提出任何权利主张或赔偿请求，但由于任何一方怠于履行其义务或存在违反中国证监会、上交所等监管机构相关法律法规和规范性文件要求的情形导致该等情形的除外。

（十二）不可抗力

12.1 本协议所称不可抗力事件是指不可抗力受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签署之日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、台风、地震、罢工、暴乱及战争（不论是否宣战）以及国家法律、政策的调整。

12.2 提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

12.3 任何一方由于受到本补充协议第 12.1 条约定的不可抗力事件的影响，部分或全部不能履行本协议项下义务的，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续 30 日或以上并且致使协议任何一方完全丧失继续履行本协议的能力，则任何

一方有权以书面方式通知对方及标的公司，终止本协议。

三、《业绩补偿协议》的主要内容

2026 年 8 月，上市公司（本节简称“甲方”）与交易对方易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞（该协议中交易对方合称“业绩承诺方”）签署了《苏州锴威特半导体股份有限公司与易坤等 12 名交易对方的业绩补偿协议》。

（一）本次交易对价支付安排

1.1 双方确认，本次交易标的公司 100%股权整体对价为 165,000 万元，股份支付对价为人民币 901,161,461.61 元，现金支付对价为人民币 748,838,538.39 元。其中，芯片自研业务板块估值对应的对价为人民币 135,400.00 万元（下称“芯片自研业务对价”）；芯片定制化量产业务板块估值对应的对价为人民币 29,600.00 万元（下称“芯片定制化量产业务对价”）。

业绩承诺方的总对价为人民币 997,503,012.41 元，其中股份支付的对价为 658,727,806.92 元，现金支付的对价为 338,775,205.49 元。在《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》第 3.3 条的约定基础上，特别的，对于本协议之业绩承诺方，业绩承诺方所获的股份对价中，对应芯片定制化量产业务的对价部分（即 29,600.00 万元）股份对价，将依据本协议下述约定分期支付；其余 362,727,806.92 元股份对价，仍按照《补充协议（一）》第 3.3 条约定一次性支付。

1.2 前款芯片定制化量产业务分期支付的股份对价，具体支付节奏基于本协议第 3.3.1 条确定。

1.3 双方确认，按照《补充协议（一）》第 3.3 条约定一次性支付的股份对价及基于本协议第 3.3.1 条的约定分期支付的股份对价情况具体如下：

序号	交易对方	本次交易取得的股份（股）	一次性支付的股份（股）	分期支付的股份（股）
1	易坤	7,493,081	4,126,058	3,367,023
2	成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）	2,425,593	1,335,651	1,089,942
3	成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）	912,680	502,567	410,113

序号	交易对方	本次交易取得的股份（股）	一次性支付的股份（股）	分期支付的股份（股）
4	成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）	1,048,985	577,623	471,362
5	成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）	774,117	426,267	347,850
6	成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）	811,173	446,672	364,501
7	成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）	1,999,031	1,100,765	898,266
8	成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）	1,818,573	1,001,396	817,177
9	李六军	1,896,848	1,044,498	852,350
10	薛峰	437,880	241,119	196,761
11	陈国栋	437,880	241,119	196,761
12	苏鹏飞	218,940	120,560	98,380
合计		**20,274,781**	**11,164,295**	**9,110,486**

（二）业绩承诺期

2.1 各方同意，业绩承诺期为 2026 年度、2027 年度及 2028 年度（以下简称“业绩承诺期”），其中芯片定制化量产业务的业绩承诺期为 2026 年度、2027 年度（以下简称“芯片定制化量产业务业绩承诺期”）。

（三）业绩承诺方的业绩承诺及补偿方案

3.1 业绩承诺

3.1.1 各方确认，经各方协商一致，业绩承诺方按照业务板块进行业绩承诺：

业绩承诺方承诺：标的公司芯片定制化量产业务 2026 年度、2027 年度累积实现的净利润不低于 25,500 万元。标的公司芯片自研业务 2026 年度、2027 年度和 2028 年度实现的收入分别不低于 33,500 万元、45,200 万元和 56,600 万元，三年累积实现的收入不低于 135,300 万元。

各方同意，上述业绩承诺期内芯片定制化量产业务各年的实际净利润以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片定制化量产业务归属于母公司股东的净利润（应剔除股份支付费用及非经常性损失）

为准；芯片自研业务的收入数以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片自研业务的营业收入为准。

3.1.2 在业绩承诺期内，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，在业绩承诺期内，原则上将维持标的公司的会计政策、会计估计；除非法律法规规定改变会计政策、会计估计。

3.2 业绩承诺实现情况及补偿方式

3.2.1 业绩承诺期内，由上市公司及易坤共同认可的具有《中华人民共和国证券法》规定资格的会计师事务所根据本协议的约定对标的公司芯片定制化量产业务实际净利润情况、芯片自研业务的实际营业收入进行审核并出具专项审核报告（以下简称“《专项审核报告》”），相关实际业绩数与承诺业绩数的差异情况以该《专项审核报告》载明的数据为准。《专项审核报告》就芯片定制化量产业务和芯片自研业务的会计处理、分拆政策、原则保持与报告期一致，出具时间应不晚于上市公司相应年度审计报告的出具时间，且不晚于当期业绩承诺期各年度次年的 4 月 30 日，无论标的公司是否完成交割。

3.2.2 业绩承诺方进一步承诺，在业绩补偿义务全部履行完毕前，不得在其通过本次交易取得的尚未解锁的业绩补偿锁定股份（定义见下文第 3.6 条）之上设置质押权、第三方收益权等他项权利或其他可能对实施本协议项下业绩补偿安排造成不利影响的其他权利，不通过质押股份或类似方式逃废补偿义务。

3.3 芯片定制化量产业务业绩补偿方式

3.3.1 各期实际发行股份数应按照如下公式计算：

上市公司当期向业绩承诺方发行股份数量 =（本次交易标的公司芯片定制化量产业务当期累计实现的净利润 ÷ 2026 年度和 2027 年度累计承诺的净利润总额）×（全体股东等值芯片定制化量产业务 2.96 亿元对价 ÷ 本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））— 上市公司基于芯片定制化量产业务向业绩承诺方已支付的股数。

为避免歧义，当上述公式中标的公司芯片定制化量产业务当期累计实现的净利润累计超过 25,500 万元时，则按 25,500 万元计算。

各业绩承诺方按其各自在本次交易中获得的总对价的相对比例取得各期实际发行股份。

依据上述公式计算的发行股份数量应精确至个位数，不足一股的尾数按零取值。

3.3.2 上市公司应在具有证券业务资格的会计师事务所出具当期《专项审核报告》后 10 个工作日内（且不超过收到中国证监会同意注册文件之日起 48 个月内）向上海证券交易所或届时履行相应职能的有权机构提交关于当期实际发行股份数量的定向发行申请，并于《专项审核报告》出具后 30 日内协助业绩承诺方将对价股份登记至业绩承诺方名下。为避免歧义，双方确认，对价股份登记至业绩承诺方名下应当以标的公司股权完成交割为前提。

根据本协议第 3.3 条发行的股份，业绩承诺方应尽最大努力配合发行申请所必要的手续并签署必要的文件。

3.3.3 履约保障措施

如上市公司或业绩承诺方在各期实际发行股份发行时不符合中国证监会规定的发行条件的，则上市公司应当在满足发行条件后尽快重新启动发行。如上市公司未能在收到中国证监会同意注册文件之日起 48 个月内完成各期实际发行股份发行的，则上市公司应在发行期限届满后 2 个月或上市公司及业绩承诺方共同确认的其他时间内以现金形式向业绩承诺方支付等值于各期应向各业绩承诺方发行的股份对价的金额，即根据本协议第 3.3.1 条约定的各期应向各业绩承诺方发行的股份数量*本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））。

3.4 芯片自研业务业绩补偿方式

3.4.1 根据《专项审核报告》，业绩承诺期内，芯片自研业务如果业绩承诺期内各期标的公司累积实现的实际营业收入数达到该期累积承诺的营业收入数的 90%（含本数），则不触发补偿程序，否则业绩承诺方应对上市公司进行业绩补偿。

3.4.2 业绩承诺期内，若触发补偿，业绩承诺方应进行股份补偿，补偿股份数量的计算公式如下：

（1）当期应补偿金额＝（业绩承诺期内芯片自研业务各期累积承诺的营业收入数*90%－业绩承诺期内芯片自研业务各期累积实际实现的营业收入数）÷芯片自研业务业绩承诺期内三年累计承诺的营业收入总数 × 业绩承诺方就本次交易获得的税后股份对价×（芯片自研业务板块估值对应对价÷标的公司 100%股权对价）－芯片自研业务板块累积已补偿金额（如有）

其中，各期是指标的公司累积实现或承诺营业收入为当年及之前业绩承诺年度累积，下同。

应补偿股份数＝应补偿金额÷本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））。

（2）依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，不足一股的尾数向上取整。

（3）业绩承诺方为承担本协议第 3.4.2 条项下补偿义务的主体，业绩承诺方之间以其各自于本次交易获得的芯片自研业务股份对价的相对比例各自承担补偿责任。

（4）业绩承诺方承诺以其基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价对应的股份应优先用于履行业绩补偿承诺。

（5）业绩承诺方应优先以其基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价进行补偿，若业绩承诺方因其于本次交易中获得的且届时仍持有的股份不足进行股份补偿而需向上市公司进一步进行现金补偿的，业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 30 个工作日内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。

3.4.3 上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权事项的，则应补偿股份数相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，当年应补偿股份数累计获得的现金分红（扣除所得税后）应同时返还给上市公司，返还的现金分红不作为累积已补偿金额。

3.4.4 如果业绩承诺方根据本协议第 3.4 条的约定须向上市公司进行股份补偿的，上市公司将在相应的《专项审核报告》出具后 30 日内召开董事会确定业

绩承诺方应补偿金额、应补偿股份数量及补偿股份方式并发出股东会通知。就业绩承诺方需补偿的股份，上市公司应以总价 1 元进行定向股份回购注销。

3.4.5 各方同意，业绩承诺方因芯片自研业务承诺补偿合计不超过业绩承诺方基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价所对应的股份数量。

为避免歧义，本第 3.4.2 条第（4）（5）款、第 3.4.5 条所称基于芯片自研业务估值所获得的税后股份对价对应的股份，即业绩承诺方就本次交易获得的全部税后股份对价对应的股份×（本次交易芯片自研业务估值÷本次交易标的公司 100%股权估值），以及该部分股份在业绩承诺期内获得的上市公司送股、转增的股份数（如有）。

3.5 减值测试及补偿

3.5.1 在业绩承诺期届满日至业绩承诺期最后一年上市公司的年度报告公告日期间，由上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试专项报告，并在年度报告公告同时出具相应的减值测试结果。

如：标的资产的期末减值额＞已补偿股份总数×本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格＋已补偿现金（如有），则业绩承诺方应向上市公司另行补偿。另行补偿时，业绩承诺方应优先以其于本次交易中获得的作为交易作价的上市公司新增股份进行补偿，不足部分以现金进行补偿。

另需补偿的股份数＝标的资产期末减值额÷本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格－业绩承诺期内累积已补偿股份总数－业绩承诺期已补偿现金（如有）÷本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格。另行补偿的股份数量不足 1 股的按 1 股计算。

应补偿金额＝（标的资产应补偿股份数－业绩承诺期内累积已补偿股份总数）×本次交易中上市公司向业绩承诺方发行股份的价格－业绩承诺期已补偿现金（如有）。

标的资产期末减值额为标的资产本次交易作价减去标的资产在业绩承诺期末的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产因股东增资、减资、接受赠与、利润分配以及送股、公积金转增股本等除权除息行为的影响。

3.5.2 各方同意，业绩承诺方因标的资产业绩承诺和减值测试补偿合计不超过业绩承诺方于本次交易中取得的股份对价的税后净额，应补偿股份的总数不超过业绩承诺方就本次交易获得税后股份对价对应的股份数，即业绩承诺方就本次交易获得的税后股份对价÷本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））以及该部分股份在业绩承诺期内获得的上市公司送股、转增的股份数（如有）。

3.5.3 就减值测试所涉及的股份补偿其他事宜，双方同意参照本协议第 3.4.3、3.4.4 条的约定实施。

3.6 股份解锁

3.6.1 各方同意，业绩承诺方因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日（即该等股份登记于各业绩承诺方的证券账户之日）起 12 个月内不得转让。但是，若业绩承诺方取得新增股份时，用于认购上市公司本次交易新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至转让方名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。本次交易完成后，业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述股份锁定期约定。

3.6.2 各方进一步同意，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的本协议第 1.3 条约定的分期支付的股份，股份锁定期自首期股份发行结束之日起算；

3.6.3 各方进一步同意，在满足前款项下股份锁定期安排的前提下，业绩承诺方获得的本协议第 1.3 条约定的一次性支付的股份，在本协议约定的业绩承诺期内逐年解除锁定，即如标的公司完成本协议约定的当年业绩承诺或业绩承诺期届满时履行完毕业绩补偿义务的，则按照本协议约定的比例解除上述股份的锁定（业绩承诺方之间以其于本次交易获得的股份对价的相对比例解除锁定），具体安排如下：

（1）第一期：标的公司业绩承诺期内第一年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次

日（二者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的股份数为业绩补偿锁定股份数的 25% － 因履行业绩承诺期第一年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）；

（2）第二期：标的公司业绩承诺期内第二年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕当年业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 60% － 因履行业绩承诺期第一年及第二年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）；

（3）第三期：标的公司业绩承诺期内第三年业绩实现情况相关《专项审核报告》出具之次日和按本协议的约定履行完毕业绩补偿义务（如需）之次日（二者孰晚），依据本协议相关约定可申请解锁且上市公司应当申请解锁的累积股份数为业绩补偿锁定股份数的 100% － 因履行业绩承诺期第一年、第二年及第三年对应的业绩补偿义务的已补偿股份数（如有）。

3.6.4 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，各方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

3.6.5 解除限售安排

（1）根据本次交易安排，业绩承诺方持有的全部股份在本次交易完成后根据法律法规在中国结算上海分公司登记为限售股份。上市公司承诺，在前述限售股份符合解除限售条件后 10 个交易日内，上市公司应就可申请解锁的股份向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交解除限售申请。

（2）上市公司承诺，将根据届时法律法规要求履行相关信息披露义务并披露相关中介机构意见。业绩承诺方持有的上市公司股份解除限售后，除非因业绩承诺方自身原因导致股份被质押、冻结或存在其他第三方权利限制，业绩承诺方可根据届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所的规定、规则和其他已作出的关于股份限售的承诺处置已解除限售的上市公司股份。

（3）如业绩承诺方在本次交易中获得的上市公司新增股份按照上述第 3.6.2 条分期解锁安排解除限售时，相关可解除限售股份仍处于该款约定的股份

锁定期内，则该等可解除限售股份的实际解除限售时间应相应顺延至该款约定的股份锁定期届满之日。

（四）超额业绩奖励

4.1 若标的公司芯片定制化量产业务对应业绩承诺期累积实现净利润超过累积对应期间承诺净利润且 2027 年度标的公司芯片自研业务实现净利润为正，甲方同意将按照超额实现净利润部分的 80%给予标的公司员工超额业绩奖励，但奖励的总金额不得超过标的资产本次交易价格的 20%。

超额业绩奖励应于 2028 年 4 月 30 日之前由标的公司以现金方式向标的公司员工发放超额业绩奖励，如 2027 年度标的公司芯片自研业务实现净利润为负，则从下一会计年度开始按季度（一季度、半年度、前三季度、全年）进行考核，在经审计的财务报告（一季报、半年报、三季报或年度报告）中自研业务实现净利润为正的情况下，方可于相应专项审计报告出具后次月 20 日前发放超额业绩奖励。超额业绩奖励的具体分配方案由标的公司主要管理团队决定。

4.2 前款所称净利润系以上市公司及易坤共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》并基于通用目的与编制基础审计的标的公司芯片自研业务归属于母公司股东的净利润（应剔除股份支付费用及非经常性损失）为准。

4.3 超额业绩奖励相关的纳税义务由实际受益人自行承担。

（五）主要管理团队及技术骨干留任、竞业禁止

5.1 人员留任及竞业禁止义务

5.1.1 留任承诺：本次交易完成后，业绩承诺方应确保附件所列主要管理团队及技术骨干（下称“核心人员”），在本次交易的业绩承诺期间持续在标的公司或其下属子公司（以下合称“任职公司”）全职工作，并签署期限覆盖整个业绩承诺期的劳动合同。

5.1.2 任职期及竞业禁止承诺：业绩承诺方应确保，所有核心人员在业绩承诺期内在标的公司任职并在此期限内严格履行竞业禁止义务。竞业禁止义务具体包括：

（1）未经甲方事先书面同意，核心人员本人不得直接或间接从事、参与、投资、经营、加入与标的公司存在相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体（下称“竞争业务”）；

（2）核心人员不得以任何方式（包括但不限于作为股东、合伙人、董事、监事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人等）为从事竞争业务的任何实体提供服务或建立合作关系（持有上市公司股票或相关证券情形除外）。

5.1.3 例外情形：核心人员在业绩承诺期内，非因自身原因（包括但不限于被任职公司主动辞退、双方协商一致解除劳动关系、达到法定退休年龄并办理退休手续等）而离职的，可豁免第 5.1.1 条的连续任职要求，但仍须严格遵守第 5.1.2 条约定的竞业禁止义务。

（六）协议的生效、变更、终止或解除

本协议自各方签名盖章之日起成立，除第 6-10 条自成立时生效外，其他条款于交易协议全部条款生效之日同时生效。若交易协议终止或解除的，本协议同时终止。

（七）法律适用与争议解决

本协议的订立、生效和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

如果双方就本协议的签署、履行、解释等方面产生任何争议，首先应通过友好协商解决；如自争议发生之日起 30 日内协商不成的，任何一方可将争议提交标的公司住所地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

（八）违约责任

8.1 本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下做出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定及本协议约定承担违约责任。

8.2 如因法律或政策限制，或因上市公司股东会未能审议通过本次交易，或因中国证监会、上交所等监管机构未能批准或核准等原因，导致本次交易不能实施，则不视为任何一方违约，任何一方不得向其他方提出任何权利主张或赔偿请求，但由于任何一方怠于履行其义务或存在违反中国证监会、上交所等监

管机构相关法律法规和规范性文件要求的情形导致该等情形的除外。

8.3 为避免歧义，各方确认，业绩承诺方各方连带承担违约责任。

（九）不可抗力

9.1 本协议所称不可抗力事件是指不可抗力受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签署之日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、台风、地震、罢工、暴乱及战争（不论是否宣战）、贸易制裁以及国家法律、政策的调整。

9.2 提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

9.3 如因不可抗力影响，需要对本协议约定的业绩承诺及补偿安排及补偿事项进行调整的，应当以中国证监会明确的情形或法院判决认定为准，除此之外，相关方履行本协议项下的补偿义务不得进行任何调整。

第八章 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定

本次交易的标的资产为晶艺半导体100%股权，标的公司专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，标的公司从事的业务属于国家鼓励类产业。本次交易符合国家产业政策相关法律和行政法规的规定。

本次交易标的资产为股权，不涉及环境保护、土地管理相关内容。报告期内，标的公司不存在违反环境保护、土地管理相关法律和行政法规的规定受到处罚的情况。

本次交易未达到《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的经营者集中申报标准，无须在本次交易实施前事先向国家市场监督管理总局申报。

本次交易的标的公司晶艺半导体为注册于中国境内的企业，上市公司在本次交易中不涉及《企业境外投资管理办法》和《境外投资管理办法》项下的境外投资行为，本次交易无需取得相关境外投资主管部门核准或备案。本次交易完成后上市公司不会新增外资股东，因此无需履行外资准入的审批或备案程序。因此，本次交易符合有关外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定。。

综上，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《科创板股票上市规则》等相关规定及上市公司股东所持股份的情况，按照交易作价计算，本次交易完成后，上市公司股本总额不超过人民币4亿元，社会公众持有的股份不低于上市公司总股本的25%，上市公司股本结构仍符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件，不会导致上市公司

不符合股票上市条件。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易项下的标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商确定。本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，上市公司董事会已就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了同意的意见，独立董事对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了独立意见。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的公司为合法设立、有效存续的公司，交易对方合法拥有其持有的该等股权，该等资产产权权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形。截至本报告书签署日，标的公司股权不存在其他质押、权利担保或其它受限制的情形。

本次交易完成后，标的公司仍然依法存续，标的公司的债权债务仍由其享有或承担，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移。

综上，本次交易标的资产权属清晰，在本次交易相关协议和相关法律程序得到严格履行的情形下，标的资产交割不存在实质法律障碍，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易有利于上市公司整体战略布局和实施，同时扩大整体经营规模，有利于上市公司增强持续经营能力。交易完成后，上市公司的资产规模、收入

水平预计将有效提升，不存在可能导致上市公司在本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易的标的资产为完整经营性资产，本次交易完成后，上市公司仍将在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后，上市公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善上市公司法人治理结构。本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

基于以上分析，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定的情形

本次交易前后，上市公司实际控制人均为丁国华先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、四十四条的规定的情形

（一）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字〔2026〕00001119 号），上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

（二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

截至本报告书签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

（三）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致上市公司财务状况发生重大不利变化，不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化

本次交易完成后，上市公司将持有晶艺半导体 100%的股权，根据《备考审阅报告》，上市公司的资产规模、收入水平预计将有效提升。本次交易有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力和持续经营能力，随着后续标的公司业务的发展以及与上市公司之间协同效应的发挥，本次交易预计能够使得上市公司提高资产质量和增强持续经营能力，不会导致上市公司财务状况发生重大不利变化。

2、本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

（1）关于同业竞争

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司实际控

制人仍为丁国华先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争。此外，上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（2）关于关联交易

本次交易前后，上市公司最近一年一期主要关联交易金额及占比情况详见本报告书“第十一章 同业竞争和关联交易/二/（四）本次交易对上市公司关联交易的影响”。同时，为持续规范本次交易完成后的关联交易，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、易坤及其一致行动人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

因此，本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（四）本次交易涉及的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

1、标的资产权属清晰

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权，标的公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据中国法律或标的公司《公司章程》规定需要终止的情形。本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制的情形。在本次交易相关协议和相关法律程序得到严格履行的情形下，标的资产交割不存在实质法律障碍。本次交易不改变相关交易各方自身债权债务的享有和承担方式。

2、标的资产为经营性资产

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100%股权，标的公司专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，标的资产属于经营性资产范畴。

3、标的资产能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次交易标的资产权属清晰，在交易各方严格履行本次交易相关协议的情况下，在本次交易相关协议和相关法律程序得到严格履行的情形下，交易各方能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

（五）本次交易涉及分期发行股份支付购买资产对价

本次交易涉及分期发行股份支付购买资产对价，上市公司签署的《业绩补偿协议》中对后期股份不能发行的履约保障措施作出了安排，具体如下：

如上市公司或业绩承诺方在各期实际发行股份发行时不符合中国证监会规定的发行条件的，则上市公司应当在满足发行条件后尽快重新启动发行。如上市公司未能在收到中国证监会同意注册文件之日起 48 个月内完成各期实际发行股份发行的，则上市公司应在发行期限届满后 2 个月或上市公司及业绩承诺方共同确认的其他时间内以现金形式向业绩承诺方支付等值于各期应向各业绩承诺方发行的股份对价的金额，即根据《业绩补偿协议》第 3.3.1 条约定的各期应向各业绩承诺方发行的股份数量*本次交易股份的发行价格（即 32.49 元/股，并根据交易协议予以调整（如涉及））。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定。

四、本次交易符合《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《重组审核规则》第八条的规定

根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组、发行股份购买资产，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，且与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

本次交易的标的资产属于半导体设计领域，符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业，标的资产与上市公司主营业务具有协同效应。本次交易有利于上市公司整体战略布局和实施，同时扩大整体经营规模，有利于上市公司增强持续经营能力。具体内容详见本报告书“第一章 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易标的公司科创属性及其与上市公司主营业务的协同效应”。

综上，本次交易符合《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公

司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定。

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定

《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。”关于本次交易符合前述条文及其适用意见以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的情况，说明如下：

（一）本次交易的募集配套资金规模符合相关规定

《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格百分之一百的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过百分之一百的，一并适用上市公司发行股份融资的审核、注册程序。

《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定：“‘拟购买资产交易价格’指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外。”

本次拟募集配套资金的金额不超过 90,083.85 万元，未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，符合上述募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%的规定。

（二）本次交易的募集配套资金用途符合相关规定

《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定：“考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金

总额的 50%。”

本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金，用途符合上述规定。

综上，本次交易涉及的发行股份募集配套资金方案符合上述规定。

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条相关规定

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第六次会议决议公告日，经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
前 20 个交易日	43.50	34.81
前 60 个交易日	41.46	33.18
前 120 个交易日	40.60	32.49

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十六条相关规定。

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条、第四十八条和《重组审核规则》第十二条的规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

本次交易中，交易对方已经依据《重组管理办法》第四十七条的规定做出了股份锁定承诺，详见本报告书“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“6、锁定期安排”。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十八条的规定

《重组管理办法》第四十八条规定：上市公司发行股份购买资产导致特定对象持有或者控制的股份达到法定比例的，应当按照《上市公司收购管理办法》

的规定履行相关义务。

本次交易将触发易坤及其一致行动人的权益披露义务，易坤及其一致行动人已按照《上市公司收购管理办法》的规定披露简式权益变动报告书。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十八条的规定。

（三）本次交易符合《重组审核规则》第十二条的规定

本次交易的交易对方不属于上市公司，不涉及上市公司股东在公司实施发行股份购买资产中取得股份的情形；本次交易不构成重组上市。因此，本次交易符合《重组审核规则》第十二条的规定。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十七条、第四十八条和《重组审核规则》第十二条的规定。

八、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定

（一）本次交易不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

截至本报告书签署日，上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投

资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。

（二）本次交易符合《发行注册管理办法》第十二条的规定

1、本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金。因此，符合《发行注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

2、本次募集配套资金并非用于持有财务性投资，亦未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。因此，符合《发行注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

3、本次募集配套资金用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金。上市公司控股股东、实际控制人丁国华及其一致行动人罗寅、港鹰实业、陈锴，以及丁国华控制的员工持股平台港晨芯已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于保障上市公司独立性的承诺函》。该等承诺有利于上市公司规范关联交易，避免同业竞争，保持上市公司独立性。因此，本次募集配套资金将不会导致上市公司新增构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。因此，符合《发行注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

4、本次募集配套资金未用于标的公司项目建设。

因此，本次交易符合《发行注册管理办法》第十二条的规定。

九、本次交易符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的要求

根据《发行注册管理办法》第四十条规定的适用意见：上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百

分之三十。

上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。因此，本次交易符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的要求。

十、本次交易符合“并购六条”的相关规定

2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），明确支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。

标的公司是国内领先的电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售企业，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等。上市公司和标的公司同属于功率半导体领域，本次交易是上市公司响应监管政策，通过并购半导体产业链优质资产进行产业整合，将完善上市公司在功率半导体的产品布局，共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综合功率半导体解决方案，可以提升上市公司投资价值、实现上市公司高质量发展的重要举措。标的公司虽然报告期内亏损，但剔除股份支付后已处于盈利状态，标的公司在已有业务领域已形成核心竞争力及竞争壁垒，本次交易完成后，上市公司将改善资产质量、聚焦更多资源向新质生产力发展，符合“并购六条”的相关规定。

本次交易对中小投资者权益保护作出多方面安排。一是严格履行信息披露义务，及时准确披露交易进展，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。二是严格履行相关程序，在董事会会议召开前，本次交易事项由独立董事召开了专门会议审议并经独立董事过半数同意。三是提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。四是单独统计、披露中小股东投票结果。五是确保资产定价公允，聘请专业机构审计评估，并由独立董事和董事会分析定价合理性。六是安排股份锁定，同时设置业绩承诺。

综上，本次交易有助于上市公司补链强链、向新质生产力发展，不影响上市公司持续经营能力，并已设置中小投资者利益保护相关安排，符合并购六条的相关规定。

十一、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求

（一）本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，无需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件

本次交易标的资产为晶艺半导体 100.00%股权，标的公司专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品。标的公司经营不涉及自建厂房，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，无需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。

就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进行了披露（具体详见本报告书之“重大事项提示”之“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”），并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示（具体详见本报告书之“第十二章 风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）交易审批风险”）。

（二）本次交易拟购买标的资产为企业股权，在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在影响本次交易标的资产权属转移及过户的实质性障碍，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况

本次交易的标的资产为晶艺半导体 100.00%股权。在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在影响本次交易标的资产转移及过户的实质性障碍，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

（三）本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立

本次交易完成后，标的公司成为上市公司全资子公司，上市公司能实际控制标的公司生产经营。本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（四）本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

十二、相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

截至本报告书签署日，本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与重大资产重组的情形。

十三、中介机构对本次交易符合《重组管理办法》等规定发表的明确意见

独立财务顾问和律师核查意见详见本报告书“第十四章 对本次交易的结论

性意见”之“二、独立财务顾问意见”及“三、法律顾问意见”。

第九章 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析

（一）本次交易前上市公司财务状况分析

1、主要资产结构分析

根据上市公司 2024 年度、2025 年度经审计的财务报表，本次交易前，上市公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产：				
货币资金	28,210.57	30.15%	17,338.70	17.97%
交易性金融资产	19,672.79	21.02%	42,270.71	43.81%
应收票据	2,588.44	2.77%	2,608.61	2.70%
应收账款	11,914.93	12.73%	7,909.95	8.20%
应收款项融资	463.43	0.50%	288.67	0.30%
预付款项	377.66	0.40%	396.83	0.41%
其他应收款	1,689.28	1.81%	365.70	0.38%
存货	14,722.38	15.73%	11,432.48	11.85%
其他流动资产	437.53	0.47%	310.00	0.32%
流动资产合计	**80,077.02**	**85.58%**	**82,921.65**	**85.95%**
非流动资产：				
其他权益工具投资	1,019.57	1.09%	1,000.00	1.04%
固定资产	8,674.50	9.27%	9,964.28	10.33%
在建工程	635.54	0.68%	65.25	0.07%
使用权资产	282.61	0.30%	497.63	0.52%
无形资产	501.53	0.54%	45.44	0.05%
长期待摊费用	190.81	0.20%	311.98	0.32%
递延所得税资产	1,670.31	1.79%	1,120.91	1.16%
其他非流动资产	517.45	0.55%	549.65	0.57%
非流动资产合计	**13,492.31**	**14.42%**	**13,555.15**	**14.05%**
资产总计	**93,569.33**	**100.00%**	**96,476.80**	**100.00%**

（1）资产总体构成分析

2024 年末、2025 年末，上市公司资产总额分别为 96,476.80 万元、93,569.33 万元。其中流动资产分别为 82,921.65 万元、80,077.02 万元，占资产总额的比重分别为 85.95%、85.58%；非流动资产分别为 13,555.15 万元、13,492.31 万元，占资产总额的比重分别为 14.05%、14.42%。上市公司资产以流动资产为主，资产结构基本稳定。

（2）流动资产分析

上市公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成。2024 年末、2025 年末，上述四项流动资产合计金额分别为 78,951.84 万元、74,520.67 万元，占流动资产的比例合计分别为 95.21%、93.06%。

（3）非流动资产分析

上市公司的非流动资产主要由其他权益工具投资、固定资产、递延所得税资产及其他非流动资产构成。2024 年末、2025 年末，上述四项非流动资产合计金额分别为 12,634.84 万元、11,881.83 万元，占非流动资产的比例合计分别为 93.21%、88.06%。

2、主要负债构成分析

根据上市公司 2024 年度、2025 年度经审计的财务报表，本次交易前，上市公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债：				
短期借款	960.69	7.37%	-	-
应付票据	2,017.76	15.47%	1,184.33	19.88%
应付账款	5,926.58	45.44%	2,185.69	36.70%
预收款项	620.10	4.75%	346.09	5.81%
合同负债	386.82	2.97%	326.72	5.49%
应付职工薪酬	1,347.25	10.33%	990.46	16.63%
应交税费	86.04	0.66%	64.14	1.08%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
其他应付款	36.18	0.28%	1.02	0.02%
一年内到期的非流动负债	148.04	1.14%	270.38	4.54%
其他流动负债	901.72	6.91%	145.64	2.45%
流动负债合计	**12,431.18**	**95.31%**	**5,514.46**	**92.58%**
非流动负债：				
租赁负债	109.74	0.84%	225.27	3.78%
长期应付款	103.00	0.79%	103.00	1.73%
递延收益	273.04	2.09%	-	-
递延所得税负债	125.86	0.96%	113.42	1.90%
非流动负债合计	**611.64**	**4.69%**	**441.68**	**7.42%**
负债合计	**13,042.82**	**100.00%**	**5,956.15**	**100.00%**

（1）负债总体构成分析

2024 年末、2025 年末，上市公司负债总额分别为 5,956.15 万元、13,042.82 万元。其中流动负债分别为 5,514.46 万元、12,431.18 万元，占负债总额的比重分别为 92.58%、95.31%；非流动负债分别为 441.68 万元、611.64 万元，占负债总额的比重分别为 7.42%、4.69%。公司负债以流动负债为主，负债结构基本稳定。

（2）流动负债分析

上市公司的流动负债主要由应付票据、应付账款、应付职工薪酬和其他流动负债构成。2024 年末、2025 年末，上述流动负债合计金额分别为 4,506.12 万元、10,193.31 万元，占流动负债的比例合计分别为 81.71%、82.00%。

（3）非流动负债分析

上市公司的非流动负债主要由租赁负债、递延收益和递延所得税负债构成。2024 年末、2025 年末，上述非流动负债合计金额分别为 338.69 万元、508.64 万元，占非流动负债的比例合计分别为 76.68%、83.16%。

3、偿债能力分析

本次交易前，上市公司主要偿债能力指标基本情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	13.94	6.17
流动比率（倍）	6.44	15.04
速动比率（倍）	5.26	12.96

注 1：资产负债率=期末负债合计/期末资产合计
注 2：流动比率=流动资产/流动负债
注 3：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

2024 年末、2025 年末，上市公司资产负债率分别为 6.17%、13.94%，流动比率分别为 15.04 倍、6.44 倍，速动比率分别为 12.96 倍、5.26 倍，公司资产负债结构良好，偿债能力较强。

（二）本次交易前上市公司经营成果分析

1、利润构成分析

根据上市公司 2024 年度、2025 年度经审计的财务报表，本次交易前，上市公司经营成果如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
营业总收入	**25,456.78**	**13,013.44**
营业收入	25,456.78	13,013.44
营业总成本	**31,971.95**	**19,149.80**
营业成本	17,076.29	8,331.46
税金及附加	52.21	56.82
销售费用	2,230.99	1,947.70
管理费用	4,369.09	3,426.12
研发费用	8,379.59	5,866.02
财务费用	-136.23	-478.31
加：其他收益	495.55	452.64
投资收益	824.11	513.26
公允价值变动收益	38.76	170.71
信用减值损失	49.22	-437.25
资产减值损失	-4,742.43	-5,075.76
资产处置收益	-0.16	1.79
营业利润	**-9,850.12**	**-10,510.97**
加：营业外收入	2.50	0.06

项目	2025 年度	2024 年度
减：营业外支出	2.25	1.72
利润总额	**-9,849.87**	**-10,512.62**
减：所得税费用	-627.60	-790.94
净利润	**-9,222.27**	**-9,721.68**
归属于母公司所有者的净利润	-9,078.26	-9,718.93

2024 年、2025 年，上市公司实现营业收入 13,013.44 万元和 25,456.78 万元，2025 年较 2024 年增长 95.62%，并实现亏损收窄，主要系新产品的量产、客户订单增加带动营业收入增长，同时新增投资控股公司并表所致。

2、盈利能力分析

项目	2025 年度	2024 年度
毛利率（%）	32.92	35.98
净利率（%）	-36.23	-74.70
加权平均净资产收益率（%）	-10.65	-10.08
基本每股收益（元/股）	-1.24	-1.32

注 1：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
注 2：净利率=净利润/营业收入；
注 3：加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；
注 4：基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/发行在外的普通股加权平均数。

2024 年、2025 年，上市公司毛利率分别为 35.98%、32.92%，受宏观经济环境、地缘政治变局、行业周期等不利因素的扰动，公司主要产品存在毛利率波动的情况。

2025 年，上市公司加权平均净资产收益率较 2024 年小幅下滑，主要系业绩亏损带来的净资产下滑所致；受营业收入增长和业绩减亏的影响，净利率较 2024 年大幅收窄，基本每股收益较 2024 年有所改善，整体亏损幅度明显收窄。

二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）行业发展概况

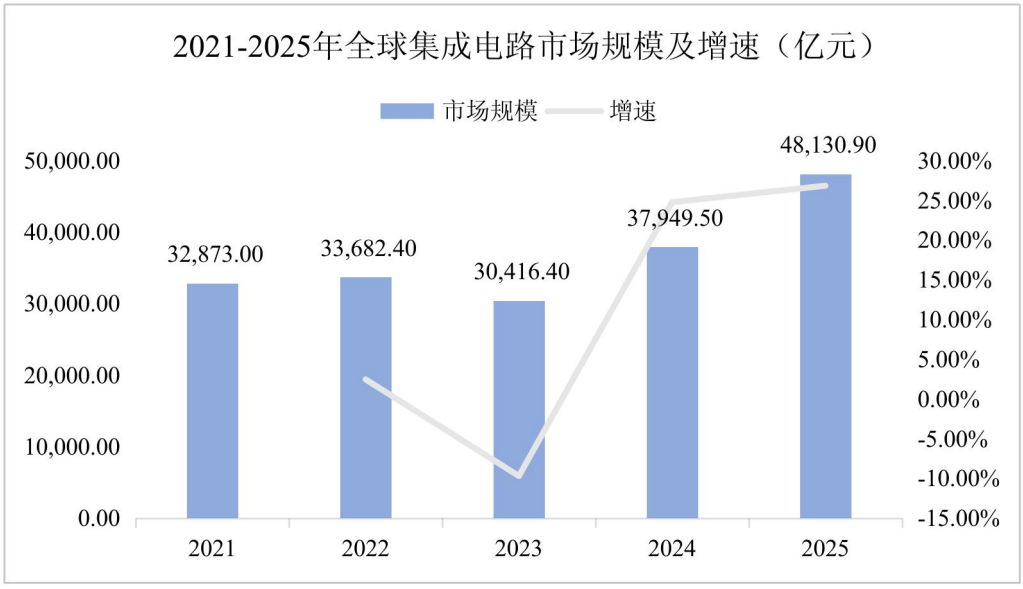
1、集成电路行业发展概况

（1）集成电路

集成电路作为信息技术领域的重要基石，已成为驱动科技进步和产业转型

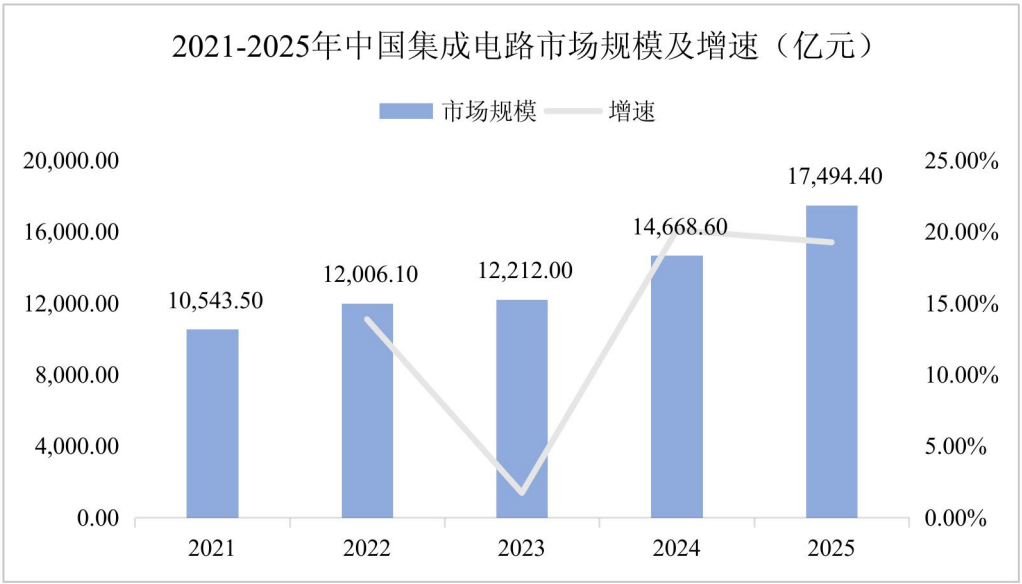
的核心动力。它推动了个人电脑、互联网、智能设备、云计算、大数据和人工智能等革命性技术的兴起，这些技术深刻改变了人类的生活方式。如今，随着技术的迭代和市场的拓展，集成电路行业正迎来全新机遇，进入一个更加多元化和高效化的加速发展时期。

2023 年，全球宏观经济持续疲软，半导体市场需求低迷，仅部分细分领域如新能源汽车等呈现增长，导致 2023 年全球半导体市场规模下滑。2024 年以来，受 AI 热潮下带动的智能手机、AIPC、边缘计算、电源管理等领域，以及汽车行业电动化、智能化的发展趋势，工业领域的自动化能力持续提升，全球集成电路行业需求景气度持续提升。根据弗若斯特沙利文统计数据，全球集成电路市场规模由 2021 年的 32,873.0 亿元增长至 2025 年的 48,130.9 亿元，对应年复合增长率为 10.0%。



数据来源：弗若斯特沙利文

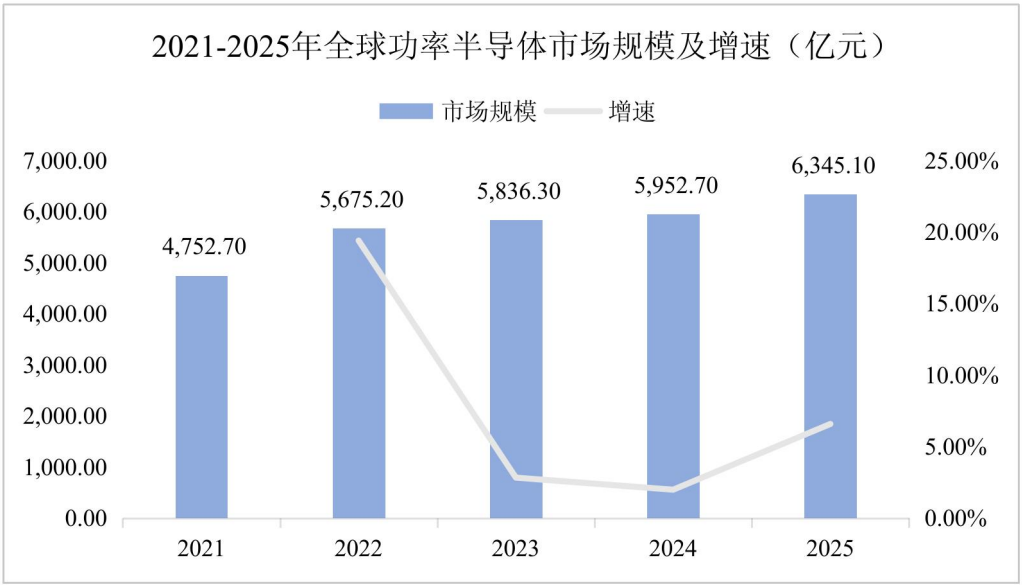
中国作为全球重要的集成电路消费市场，在终端需求扩张及国产替代推进背景下，市场规模持续扩大。一方面，下游应用领域快速发展带动本土需求增长；另一方面，在供应链安全及产业政策支持推动下，国内集成电路自给率逐步提升，进一步强化本土市场增长动能。中国市场增长速度高于全球平均水平，市场规模由 2021 年的 10,543.5 亿元提升至 2025 年的 17,494.4 亿元，年复合增长率为 13.5%。



数据来源：弗若斯特沙利文

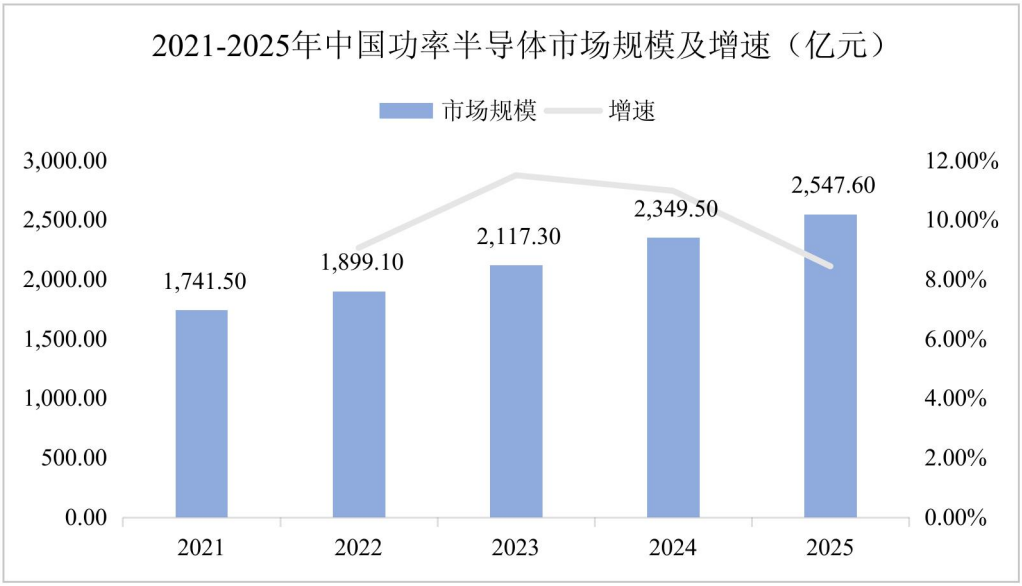
（2）功率半导体

功率半导体是用于控制和管理电能传输与转换的核心电子元件，广泛应用于各类电子设备和系统中。功率半导体在整个行业中占比稳定，随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高，拥有“品类多、应用广”特性的功率半导体已成为电子产业创新发展的重要动力之一。根据弗若斯特沙利文统计数据，全球市场规模由 2021 年的 4,752.7 亿元增长至 2025 年的 6,345.1 亿元，对应复合增长率为 7.5%。展望未来，在新能源汽车渗透率持续提升、工业自动化升级以及人工智能与算力基础设施建设加速推进的背景下，功率半导体市场有望延续增长趋势。



数据来源：弗若斯特沙利文

近年来，受到国际贸易摩擦及国内行业促进政策持续加码等多重因素的影响，国内集成电路行业繁荣发展，国产化替代加速进行。中国市场规模由 2021 年的 1,741.5 亿元持续扩大至 2025 年的 2,547.6 亿元，期间复合增长率达到 10.0%。



数据来源：弗若斯特沙利文

2、智能功率模块（IPM）行业概况

（1）IPM 行业发展情况

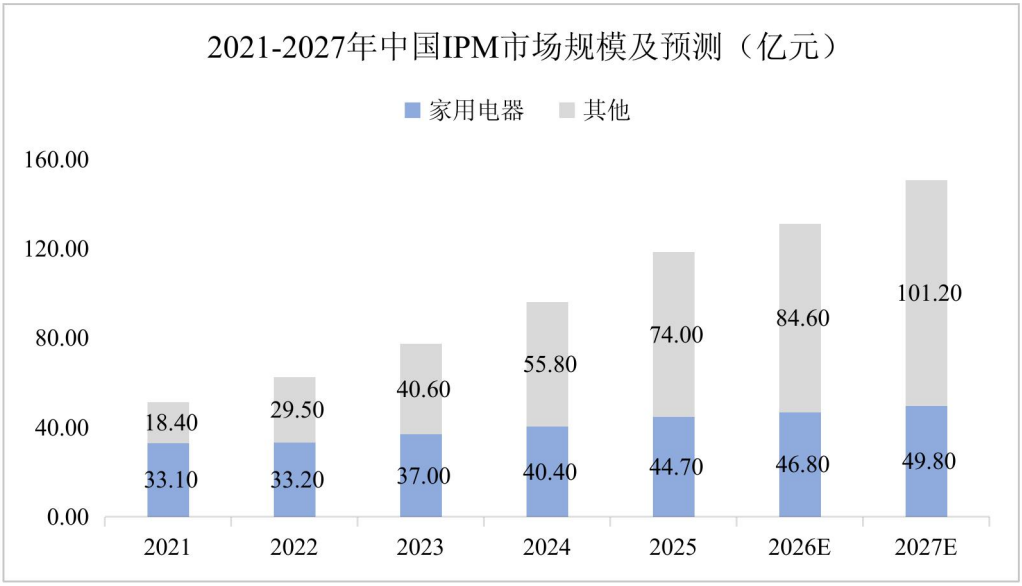
智能功率模块（IPM）是将功率器件与驱动电路、保护电路等功能集成于一体的电力电子模块。相比传统分立器件方案，IPM 通过高度集成化设计，在实现对功率器件的驱动与控制功能的同时，集成过流、过压、过热等多重保护能力，从而提升系统的安全性、可靠性及运行效率。随着电力电子系统向高功率密度、小型化及高可靠性方向发展，IPM 逐步由传统分立器件替代方案，演进为电机驱动及功率控制系统中的关键组件，并在新能源汽车、家用电器及工业设备等领域得到广泛应用。IPM 主要应用场景及特点介绍如下：

应用领域	典型应用场景	主要功能	技术特点
家用电器	空调、冰箱、洗衣机等变频家电	电机驱动、变频控制	应用成熟、成本敏感、出货量大
新能源汽车	电驱逆变器、电机控制系统	电机驱动、功率控制	高功率密度、高可靠性、耐高温要求高
工业设备	变频器、伺服驱动系统、工业电机控制	转速与扭矩控制、能效优化	运行稳定性要求高、适应复杂工况

应用领域	典型应用场景	主要功能	技术特点
新能源与电力电子	光伏逆变器、储能系统	电能转换与调节、电网适配	高电压等级、高效率要求
其他应用	电动工具、风机、水泵等	电机控制、功率调节	应用分散、增长稳定

资料来源：公开资料，弗若斯特沙利文

受新能源汽车、工业自动化等新兴应用驱动，中国 IPM 市场规模呈现快速增长态势，由 2021 年的 51.5 亿元增长至 2025 年的 118.7 亿元，年复合增长率达到 23.2%，预计在 2027 年进一步提升至 150.9 亿元。家电领域是 IPM 最为成熟的应用场景，整体规模保持稳健增长，由 2021 年的 33.1 亿元增长至 2025 年的 44.7 亿元，预计在 2027 年达到 49.8 亿元。



数据来源：弗若斯特沙利文

家电应用细分产品中，由于空调产品高端化、节能要求提升及智能化水平不断提高，变频控制成为主流方案，适配 IPM 产品高集成、高可靠、高效节能的技术优势；IPM 作为变频控制核心器件，通过调节电机转速实现高效运行，已从压缩机逐步延伸至室内风机及室外风机，带动单台空调 IPM 使用数量持续提升，从而推动整体价值量增长。中国变频空调 IPM 市场由 2021 年的 29.4 亿元增长至 2025 年的 39.6 亿元，并预计在 2027 年进一步提升至 43.7 亿元，整体保持稳步增长态势。其中，压缩机 IPM 仍为当前市场的主要构成部分，2025 年规模达到 20.5 亿元，占比超过 50%；与此同时，内风机及外风机 IPM 市场亦持续扩张，分别达到 8.4 亿元及 10.6 亿元，成为推动市场增长的重要来源。

数据来源：弗若斯特沙利文

（2）半桥 IPM 技术路线发展概况

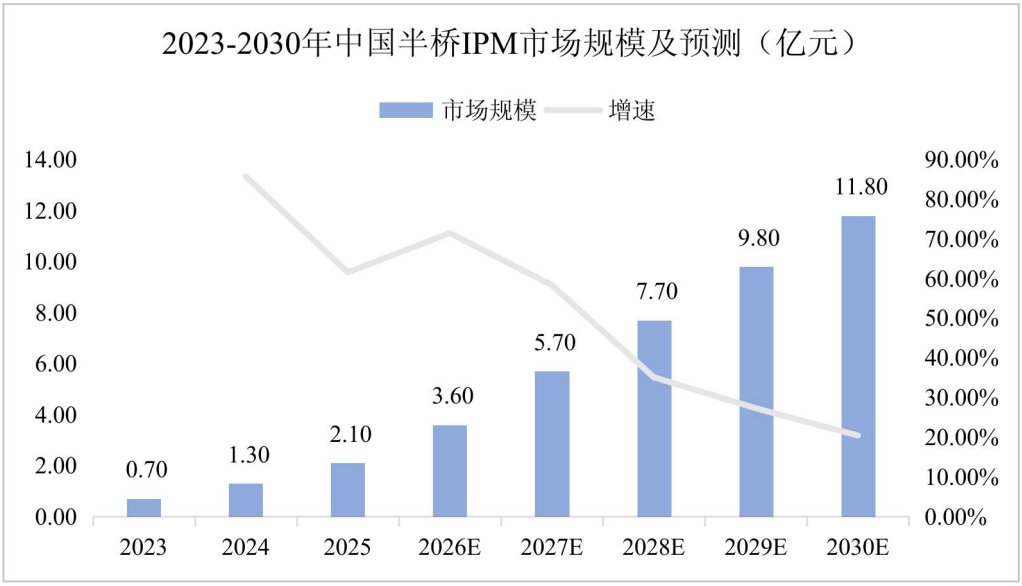
在结构形式上，IPM 方案逐渐从传统的三相全桥集成模块，向更加灵活的半桥模块组合方案演进。其中，三相全桥 IPM 以高集成度和成熟度为特点，广泛应用于中高功率场景；而以三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案，则在布局灵活性、散热性能及生产工艺等方面展现出优势，逐步在家电尤其是中低功率应用场景中得到推广。标的公司主要深耕 IPM 领域的半桥模块技术路线，凭借自主研发的特色封装技术、高可靠性高压半桥驱动 IC（HVIC）设计技术等核心技术，采用半桥技术路线开发的产品可高效适配变频家电电机驱动的应用场景。

相较于三相全桥 IPM 方案，三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案采用模块化设计思路，即每颗 IPM 负责一个桥臂，通过三颗独立模块组合实现完整的三相驱动功能。在布局方面，该方案在结构上将原本集中于单一模块的功率器件进行物理分散，具备更高灵活性，适用于空间结构复杂或对布线对称性要求较高的应用场景，有助于缩短功率回路路径并降低寄生参数；在热管理方面，热源分布更加均匀，可有效降低局部热点，提高整体散热效率，相比全桥 IPM 方案无需单独配置散热器件，节省客户方案成本；由于每个桥臂独立运行，系统能够实现更精细的温度监测与保护，提高运行安全性。另一方面，由于半桥 IPM 产品在行业应用时间较短，技术优化仍在验证迭代过程中，目前半桥 IPM 方案在高功率场景适配性、规模化应用成熟度等方面相比全桥 IPM 方案存在劣势。

以白色家电的变频空调为例，由于空调压缩机对驱动产品的可靠性、一致

性及长期供货能力要求相对较高，且压缩机功率普遍在 1-3kw，适配高功率密度驱动产品，目前主流产品多采用全桥 IPM 方案，主要由少数具备规模化量产能力的厂商主导。本土厂商方面，士兰微、华润微及吉林华微等企业在白色家电 IPM 领域已实现较大规模出货，其中士兰微在该领域收入体量已达到较高水平；外资厂商方面，三菱电机、英飞凌、东芝、瑞萨、电产三垦及罗姆等凭借长期技术积累及品牌优势，在中高端市场仍占据重要地位。

此外，空调室内外风机用 IPM 则更关注成本、尺寸及规模化供货能力，由于半桥 IPM 产品设计的散热性能相比全桥 IPM 产品更为优异，无需单独配置散热器，下游客户解决方案整体成本降低，因此目前半桥 IPM 产品在空调内外风机的应用中逐步渗透。根据弗若斯特沙利文统计数据，中国半桥 IPM 市场规模从 2023 年 0.7 亿元快速增长至 2025 年 2.1 亿元，预计 2028 年市场规模将增长至 7.70 亿元。



数据来源：弗若斯特沙利文

3、电源管理芯片行业概况

（1）电源管理芯片

受全球电子设备智能化升级、新能源汽车渗透率提升、工业自动化及 AI 服务器等高性能计算场景对高效电能转换与精细化电源管理需求增加等因素驱动，全球电源管理芯片市场规模由 2021 年的 2,954.8 亿元增长至 2022 年的 3,672.5 亿元。2023 年，受阶段性供给过剩、消费电子等终端市场需求疲软及渠道库存

水平较高等因素影响，促使部分制造商采取降价策略，加快库存消化，导致产品价格承压，全球电源管理市场连续两年出现收缩，至 2024 年市场规模回落至 3,425.5 亿元。随着下游领域需求逐步修复、汽车电子及工业控制等应用场景持续拓展，2025 年市场规模上升至 3,733.8 亿元；预计全球电源管理芯片市场将继续保持稳健增长，2027 年增长至 4,077.3 亿元。

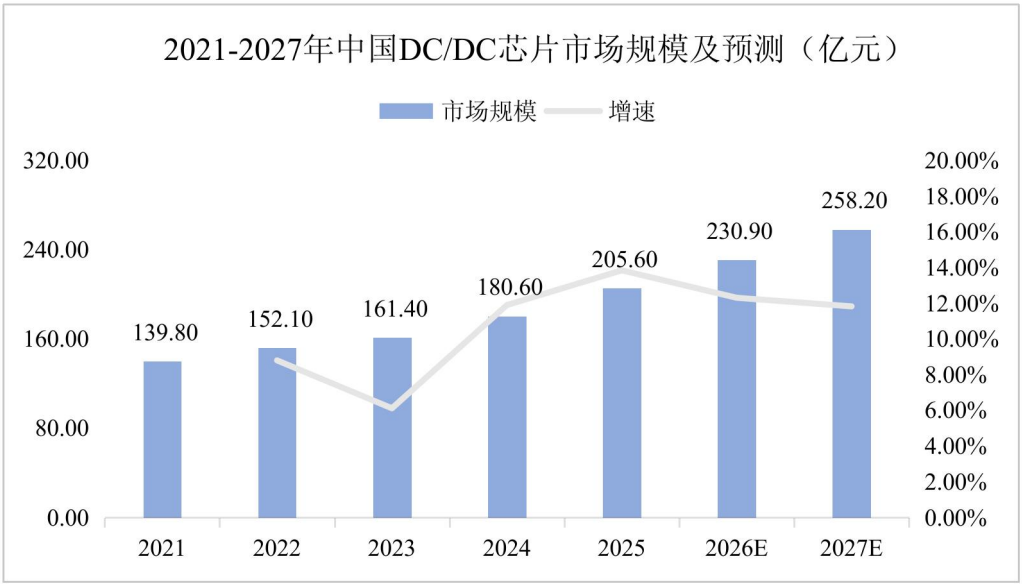
数据来源：弗若斯特沙利文

受变频家电渗透率提升、工业自动化升级、新能源汽车渗透率提升及通信基础设施建设等因素驱动，中国电源管理芯片市场规模由 2021 年的 999.0 亿元增长至 2025 年的 1,390.0 亿元，期间复合增长率约为 8.6%。预测未来随着汽车电动化、智能驾驶及智能座舱渗透率持续提升，工业与能源领域设备需求持续带动等影响，至 2027 年中国电源管理芯片市场规模将增长至 1,769.0 亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文

（2）DC-DC 转换芯片

DC-DC 转换芯片是一类用于实现直流电压转换与稳压输出的电源管理芯片，主要用于满足电子设备中不同功能模块对电压水平和供电效率的差异化需求。受通信设备与服务器电源架构持续向低电压、多电源轨演进，以及新能源汽车、车载电子系统及工业控制系统中高效率 DC-DC 转换需求快速提升的带动，中国 DC-DC 转换芯片市场规模由 2021 年的 139.8 亿元增长至 2025 年的 205.6 亿元，年复合增长率为 10.1%。受算力基础设施建设加速、车载电子电气架构向集中式与域控制演进，以及高功率密度、高转换效率 DC-DC 产品在服务器、车规及工业场景中的渗透率持续提升等因素推动，预计中国 DC-DC 转换芯片市场规模 2027 年将增长至 258.2 亿元。



数据来源：中国半导体行业协会，弗若斯特沙利文

4、下游应用领域发展情况

标的公司主营业务产品主要下游应用覆盖变频家电、智能电表、安防摄像头等市场领域。

（1）变频家电

从市场规模来看，中国变频家电市场整体保持稳定增长，由 2021 年的 4,249.8 亿元增长至 2025 年的 6,273.1 亿元，对应年复合增长率为 10.2%，并预计在 2030 年进一步增长至 8,508.7 亿元，2025 至 2030 年期间年复合增长率为 6.3%。空调、冰箱、洗衣机等白色家电产品是变频家电市场的主要组成部分，其中空调为变频技术应用最为成熟的品类，冰箱及洗衣机的变频渗透率亦逐年持续提升。从系统结构来看，随着变频技术的推广，整机电源架构及控制系统复杂度不断提升，带动电源管理芯片和电机驱动产品在家电中的应用持续增加。

（2）智能电表

受智能电网建设持续推进、配用电网络升级改造需求增长及存量设备更新替换周期带动等因素影响，中国智能电表市场规模保持稳步增长。根据国家能源局、国家电网统计数据，中国智能电表数据由 2021 年的 222.7 亿元人民币增长至 2025 年的 372.6 亿元人民币，年复合增长率为 13.7%。随着国家电网及南方电网持续推进配电网优化升级及计量设备更新改造，智能电表作为配用电环节关键的数据采集与计量设备，市场需求预计将持续释放，中国智能电表市场

规模预计于 2030 年增长至 650.1 亿元人民币，2025 年至 2030 年期间年复合增长率为 11.8%。智能电表的电源管理需求主要来自计量芯片、MCU、通信模块、显示单元、存储单元及备用电源管理等功能模块。一台智能电表通常需要配置约 3 至 5 颗电源管理芯片，其中 DC-DC 转换芯片约 1 至 2 颗，主要用于实现市电或外部输入电源向低压控制电路、计量模块及通信模块的转换。

（3）安防摄像头

受智慧城市建设持续推进、安防智能化升级需求增长及人工智能视觉识别技术不断成熟等因素影响，中国 AI 安防摄像头出货量保持较快增长。根据中国安全防范产品行业协会统计数据，中国 AI 安防摄像头市场规模将由 2021 年的 15.9 百万台增长至 2025 年的 74.9 百万台，年复合增长率为 47.4%。随着人工智能技术在安防监控、园区管理、交通治理及城市公共安全等场景中的持续渗透，AI 安防摄像头作为智能感知与实时分析的重要终端设备，其市场需求预计将持续释放，中国 AI 安防摄像头出货量预计于 2030 年增长至 164.0 百万台，2025 年至 2030 年期间年复合增长率为 17.0%。

5、行业技术特点和未来发展趋势

（1）芯片集成化和小型化

电源管理芯片正向高集成度方向发展，以适应智能手机轻薄化和高能效、智能汽车智能化等需求。基于数模混合 SoC 芯片设计、嵌入式软件等技术，单一芯片将控制器、驱动器、功率器件（如氮化镓器件）等集成到单颗芯片内，实现电压转换、充电管理、电池保护、充电协议等多种功能，进而大幅减少外围电路元件，占用更小电路板空间，提升系统性能。集成化的芯片设计也可以有效降低系统成本和设计复杂性，缩短终端厂商的研发周期，同时提高系统的长期可靠性。

（2）半桥 IPM 模块设计凭借其散热性能等优势成为变频家电领域重点的应用路线

相较于三相全桥 IPM 方案，三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案采用模块化设计思路，即每颗 IPM 负责一个桥臂，通过三颗独立模块组合实现完整的三相驱动功能。在布局方面，该方案在结构上将原本集中于单一模块的功率器件进

行物理分散，具备更高灵活性，适用于空间结构复杂或对布线对称性要求较高的应用场景，有助于缩短功率回路路径并降低寄生参数；在热管理方面，热源分布更加均匀，可有效降低局部热点，提高整体散热效率，相比全桥 IPM 方案无需单独配置散热器件，节省客户方案成本；此外由于每个桥臂独立运行，系统能够实现更精细的温度监测与保护，提高运行安全性。因此半桥 IPM 模块设计逐渐成为变频家电领域尤其是空调内外风机等关注成本、尺寸及规模化供货能力产品的重点应用路线。

（二）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策持续推动集成电路行业发展

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键产业。近年来国家密集出台了多项支持政策，包括《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等，2022 年教育部、财政部、发改委也联合发布《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》，提出加强集成电路、人工智能等领域人才的培养。除上述各项鼓励政策，国家也站在战略高度对产业发展提出顶层规划，自上而下地从研发项目支持、产业投资、人才补贴等方面进行多角度、全方位的扶持，促进集成电路产业的发展。国家的政策支持为行业创造了良好的政策环境和投融资环境，在促进行业发展的同时加速国产替代的进程，国内集成电路行业已进入长期快速增长通道。

（2）下游新兴产业快速发展、市场空间广阔

功率半导体作为半导体的重要分类之一，应用范围广阔，消费电子产品与工业级电子产品的技术更替令功率半导体在过去十年持续增长。

电机驱动产品方面，随着新能源汽车渗透率持续提升，电驱系统、车载充电机及电池管理系统等关键环节对功率器件的控制精度和响应速度提出更高要求；制造业向自动化、智能化方向升级，以及节能降耗要求不断强化，电机系

统逐步向变频化、高效化演进，对驱动产品在开关性能、抗干扰能力及保护功能等方面提出更高要求。功率驱动产品在上述系统中用于实现对 MOSFET、IGBT 等器件的高效驱动与保护，是电能转换与电机控制的核心支撑之一。

电源管理芯片方面，随着终端产品智能化、联网化水平不断提升，电源转换、稳压输出、电源分配及上电控制等基础功能需求相应增加，电源管理芯片作为保障各类电子设备稳定运行的基础器件。当前终端产品通常集成处理器、存储器、显示模组、摄像头、传感器、无线连接单元等多个子系统，而不同模块对电压、电流及供电时序的要求并不相同。这使得终端厂商需要配置更多 DC-DC 转换芯片、线性稳压器、负载开关及电荷泵等产品。

（3）贸易摩擦助推国产替代加速

根据海关总署统计数据，2024 年我国集成电路进口 3,856 亿美元，进口量为 5,491.8 亿块，同比分别增长 10.4%和 14.6%，是中国进口金额最高的商品。2024 年我国集成电路出口 1,595 亿美元，贸易逆差 2,261 亿美元，集成电路国产替代空间巨大。与此同时，随着我国经济的发展以及贸易规模的扩大，参与国际贸易与全球竞争的广度与深度逐步加深，在集成电路等关键领域的贸易摩擦也进一步加剧。日益频繁的国际贸易摩擦对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，加速了集成电路的国产替代进程，国内半导体供应链国产化进程不断加速。我国模拟芯片企业有望通过技术进步与自主创新，整合境内集成电路产业链资源，把握国产替代的历史机遇。

2、不利因素

（1）设计人才短缺

功率半导体在结构和功能上的特殊性，要求其设计工程师不仅需要掌握丰富的芯片设计专业知识，还需深入理解芯片的制作工艺和器件的物理特性。因此，与数字芯片相比，模拟芯片设计对于设计工程师的依赖程度更高。相较于国际市场，国内经验丰富的模拟芯片设计人才相对稀缺，从而限制了国内模拟芯片整体技术的发展。尽管近年来我国高校和研究机构对相关人才的培养力度已逐渐加大，国内模拟芯片厂商也不断招揽、培养和积累设计人才，但人才匮乏的情况依然存在，加上模拟芯片人才的培养周期较长，对短期内本土功率半

导体设计行业的发展形成了挑战。

（2）高端产品竞争力不足

国外领先的功率半导体企业在技术、产品品类和市场等方面具备较强的优势，与国际主流模拟集成电路公司相比，国内功率半导体厂商发展时间较短，在技术储备和产品种类上仍存在一定差距，无法满足高端功率半导体对工艺技术上的差异化要求和产能需求，很多高端模拟产品领域仍为国外厂商所垄断。尽管近年来国内模拟芯片厂商不断实现产品和技术突破，但整体上国内功率半导体设计行业在设计人才、设计经验等核心技术方面与世界先进水平还存在较大差距，高端产品竞争力不足。

（三）行业壁垒情况

1、技术壁垒

功率半导体产品性能高度依赖器件结构设计与制造工艺的协同优化，在MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件等领域，需要在导通损耗、开关性能及可靠性之间实现复杂平衡。同时，功率器件对晶圆制造工艺（如沟槽结构、外延生长等）及封装技术（如散热设计、电气隔离等）要求较高，新进入者通常难以在短期内建立成熟的技术体系并实现稳定量产。

2、人才壁垒

功率半导体设计高度依赖于经验丰富的专业人才，这类芯片及器件的设计不仅需要扎实的理论基础，还需要长期的实践积累和对细节的敏锐洞察力。尽管随着我国集成电路产业的发展，行业从业人员逐步增多，但具有完整知识储备、丰富技术经验的高端人才仍较为稀缺，拥有丰富经验、掌握核心技术的人才团队是功率半导体设计企业的核心竞争力之一。因此，标的公司所处行业存在较高的人才壁垒。

3、资金壁垒

功率半导体设计企业通常需要持续、大量的资金投入，以支持产品研发、技术创新与工艺升级，从而应对下游应用市场快速变化的需求。产品从前期产品定义、仿真设计、验证测试，到最终实现客户认证并顺利进入量产阶段，其

开发周期较长且资金投入规模较大。如果企业无法持续地投入资金进行技术更新和产品创新，将难以在激烈的市场竞争中保持领先地位。因此，本行业对企业的资金实力形成了较高的壁垒。

4、客户认证壁垒

功率半导体广泛应用于工业控制、能源系统、汽车电子等对可靠性要求较高的领域，客户通常需经过严格的产品验证及认证流程，尤其在车规级市场中，产品需满足长期可靠性测试及质量体系要求，导入周期较长。一旦进入供应链，客户粘性较强，新进入者在获取核心客户及实现规模化导入方面面临较高门槛。

（四）行业经营模式

1、IDM 模式

IDM 模式，即垂直整合制造模式，指企业在内部完成从集成电路设计、晶圆制造到封装、测试的全产业链环节。这种模式要求企业具备强大的研发能力、雄厚的资金实力和广泛的市场影响力。除了进行集成电路设计外，企业还拥有自己的晶圆厂、封装和测试设施，部分企业甚至延伸至下游电子设备制造领域。成功采用该模式的企业主要包括德州仪器、英特尔和三星半导体等全球大型跨国公司。

2、Fabless 模式

Fabless 模式，即无晶圆厂模式，指集成电路企业专注于芯片的设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试等生产环节外包给专业的代工合作伙伴完成。与 IDM 模式相比，Fabless 模式降低了企业的初期投资门槛，使其能够专注于设计技术和知识产权的创造，同时减少设备和固定成本，降低技术风险，并利用全球范围内的优质资源。目前，集成电路企业大多采用 Fabless 模式，主要代表企业包括高通、博通、英伟达、迈威科技、展讯等。

3、虚拟 IDM 模式

虚拟 IDM 模式，即虚拟垂直整合制造模式，指集成电路设计厂商不仅专注于设计环节，还拥有自己的工艺平台，能够要求晶圆代工厂商配合导入特有的制造工艺和专有设备，但生产线本身不属于设计厂商。与传统 IDM 模式相比，

虚拟 IDM 模式降低了企业的初始进入成本和固定资产投入，使其能够专注于设计与销售环节，同时持续提升工艺平台的性能，实现设计与工艺的协同优化，加快产品迭代，增强市场竞争力。

（五）行业周期性及区域性或季节性特征

1、行业周期性

受“摩尔定律”等芯片发展规律的影响，集成电路行业整体具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，但集成电路行业的不同产品领域、不同环节的周期性特征存在明显差异，比如数字芯片一般呈现较为明显的周期性特征。标的公司所属的功率半导体领域，具有产品种类多、下游应用领域分散、市场需求量大等特征，行业整体波动相对较小，行业周期性不明显，行业更多受整体宏观经济波动影响。

2、行业区域性

全球主要集成电路厂商均分布在欧洲、美洲及日韩等地区，已形成较为成熟的体系，在技术上存在明显的竞争优势。国内集成电路设计企业主要集中在经济较发达、工业基础配套完善的电子信息产业集聚地区，分别是长三角地区、珠三角地区以及环渤海地区。上述区域科研力量强、资本支持多、贴近消费市场，拥有较为充足的区位优势，已经形成了相对完善、成熟的产业链。

3、行业季节性

电机驱动产品中，由于半桥 IPM 模块目前应用于空调等白色家电领域，下游变频家电产品对应在进入夏季、冬季前销量需求提升，销量在 3-6 月、11-12 月占比较高，对应电机驱动产品采购比例上升，呈现季节波动的特征。电源管理芯片产品的下游应用市场广阔，下游客户季节性需求呈现此消彼长的动态均衡关系，因此季节性不明显。

（六）行业与上下游联系情况

1、上游行业发展与该行业的关联性及影响

晶圆制造行业、封装测试行业是集成电路设计行业的上游行业，集成电路设计企业在设计阶段需要充分考虑工艺的可实现性，上游企业的工艺水平直接

决定了芯片设计的上限，同时还需要整合行业资源确保供应稳定。上游行业对集成电路设计行业的影响主要体现在（1）产品良率：晶圆制造和封装测试的技术水平、良率将直接影响最终芯片的良率；（2）产品成本：晶圆价格和封测试费用将直接影响芯片的成本；（3）交货周期：晶圆制造厂、封装测试厂的产能会直接影响芯片的交货周期。因此，集成电路设计企业需要与晶圆制造厂和封装测试厂密切合作、建立良好的关系。

2、下游行业发展与该行业的关联性及影响

电机驱动产品的下游应用领域之一为变频家电，电源管理芯片的主要下游应用领域为智能电表、安防、通信、消费电子、工业控制和汽车等，终端产品市场的增长及芯片行业整体国产化率的提升，将带来功率半导体企业市场空间和业务规模的增长；另一方面，下游终端厂商可以将消费者对产品性能的诉求传递至集成电路设计企业，提高集成电路设计企业对市场需求的洞察力，帮助其有针对性的优化工艺和设计、提升芯片及器件性能，推动集成电路设计行业的持续发展。

（七）行业主要企业及竞争格局

1、行业竞争状况

从功率半导体行业整体来看，目前全球市场仍由国际厂商主导，国内厂商的规模较小，市场较为分散。国外头部功率半导体厂商产品料号多，产品组合丰富，更容易为客户提供一站式解决方案，客户黏性强。此外，国外头部模拟厂商基本采用 IDM 模式，能够更好的进行设计工艺协同优化，加快产品迭代。

电源管理芯片领域，业内知名的企业主要有德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）、芯源系统（MPS）、英飞凌（Infineon）及意法半导体（STMicroelectronics）等国际厂商在电源管理芯片领域整体仍保持较强竞争优势，尤其在产品线完整性、技术平台成熟度及面向工业、汽车、通信等中高端应用场景的综合服务能力方面具备较深积累。国内厂商以 Fabless 模式为主，包括南芯科技、圣邦股份、矽力杰、杰华特、思瑞浦、希荻微、英集芯、力芯微等。

IPM 模块产品领域，中国 IPM 市场上国际厂商与本土厂商并存，整体集中

度较高，并在不同应用领域差异较为明显，在新能源汽车及高端工业等应用领域，由于对功率密度、可靠性及车规级认证要求较高，市场仍主要由国际厂商主导。家电领域，IPM 应用以白色家电为核心，主要集中在变频空调、冰箱及洗衣机等产品中。从产品类型来看，空调压缩机驱动多采用全桥 IPM 方案，对可靠性、一致性及长期供货能力要求较高，因此市场集中度相对较高，主要由少数具备规模化量产能力的厂商主导。本土厂商方面，士兰微、华润微及吉林华微等企业在白色家电 IPM 领域已实现较大规模出货，其中士兰微在该领域收入体量已达到较高水平；外资厂商方面，三菱电机、英飞凌、东芝、瑞萨、电产三垦及罗姆等凭借长期技术积累及品牌优势，在中高端市场仍占据重要地位。半桥 IPM 产品方面，晶艺半导体、华润微等围绕空调风机用半桥 IPM 持续布局，在白色家电半桥 IPM 领域实现产品导入及规模化出货。

2、行业内主要竞争对手

（1）德州仪器

德州仪器（NASDAQ: TXN）总部位于美国，是全球领先的模拟半导体巨头，在稳压供电类电源管理芯片方面，公司产品覆盖 Buck、Boost、Buck-Boost 等 DC-DC 稳压器以及广泛的 LDO 产品，产品组合完整、应用范围广，能够满足工业、汽车、通信及各类电子系统的基础供电与点负载稳压需求。

（2）芯源系统

芯源系统（NASDAQ: MPWR）是一家全球知名的高性能电源管理半导体公司。在稳压供电类电源管理芯片方面，公司产品涵盖 DC-DC 转换器、LDO、高压 Buck 稳压器、负载开关及电源模块等，强调高效率、高集成度与易用性，在数据中心、汽车、工业及能源相关场景中具有布局。

（3）英飞凌

英飞凌（ETR: IFX）总部位于德国，不仅是功率器件的领导者，也是全球电源管理芯片领域的核心厂商。在稳压供电类电源管理芯片方面，公司提供较完整的 DC-DC 转换与数字多相电压调节方案，相关产品覆盖 AI 及云数据中心、存储、交换机、通信基站及汽车电子等领域，并在车用高集成 PMIC 方向具备较强产品基础。

（4）杰华特

杰华特（688141.SH）是国内领先的模拟集成电路设计企业之一，长期深耕电源管理芯片领域。公司在稳压供电类电源管理芯片方面具备较强的技术开发及本土化服务能力，产品已覆盖通信、工业、新能源及消费电子等多个下游应用领域。

（5）圣邦股份

圣邦股份（300661.SZ）是中国高性能模拟芯片领域的代表性企业之一，电源管理芯片为其核心产品方向之一。公司在稳压供电类电源管理芯片领域拥有较丰富的产品布局和较强的市场响应能力，已在工业、通信、汽车电子及智能终端等领域建立一定市场基础。

（6）峰岹科技

峰岹科技（688279.SH）专注于电机驱动控制芯片及相关功率驱动产品，主要应用于无刷电机控制、家电及电动工具等领域，在电机驱动芯片细分市场具备较强竞争力。公司以高集成度及系统级解决方案为特点，并逐步向工业及汽车电子领域拓展。

（7）士兰微

士兰微（600460.SH）为国内领先的 IDM 模式半导体企业之一，覆盖芯片设计、制造及封装测试等环节，在功率器件及相关驱动电路方面均有布局。公司在功率半导体领域积累较深，正加大在高压及车规级相关产品方向的投入。

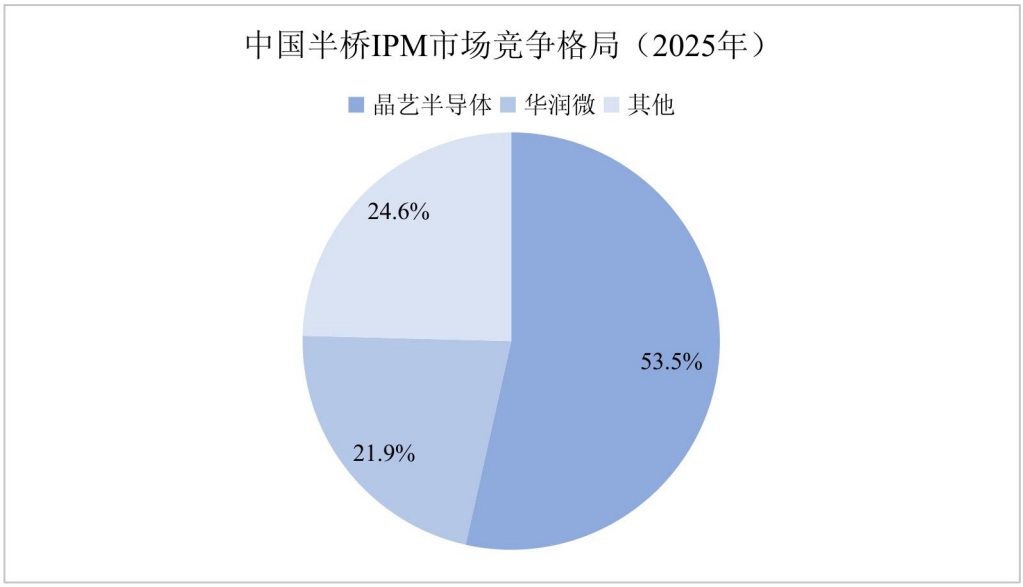
（8）华润微

华润微（688396.SH）具备设计、制造及封测一体化能力，在功率器件及功率 IC 领域拥有较完整布局。依托 IDM 模式，公司在工业控制及新能源领域具备一定客户基础，并逐步延伸至驱动及电源管理相关产品。

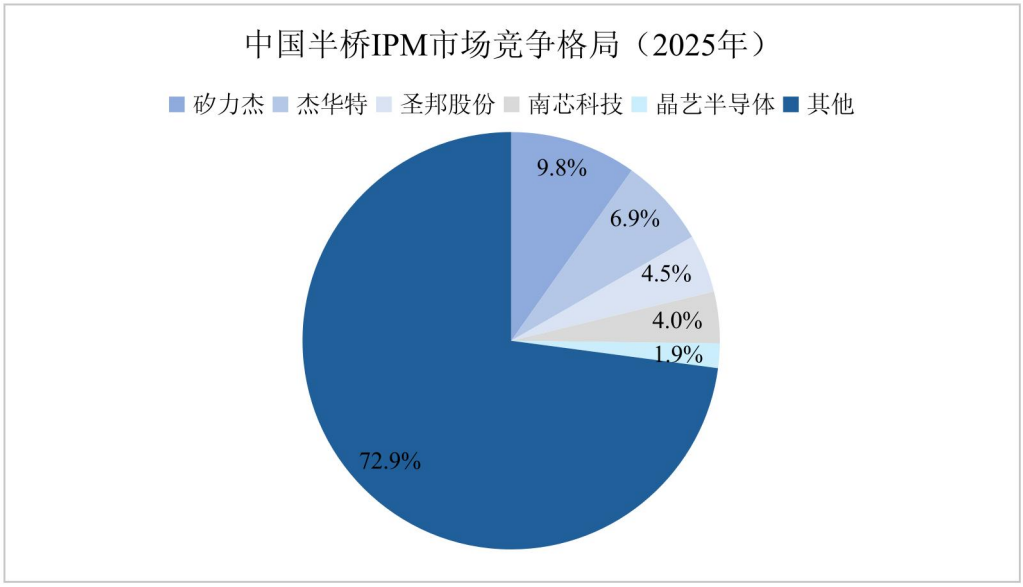
3、标的公司的行业地位

根据弗若斯特沙利文出具的《中国功率半导体市场独立研究报告》，标的公司围绕空调风机用半桥 IPM 持续布局，在白色家电半桥 IPM 领域最早实现产品导入及规模化出货，并与下游客户建立了相对稳定的合作关系。2025 年标的

公司产品在国内 IPM 半桥模块市场份额达 53.5%，行业排名第一。



电源管理 DC-DC 芯片领域，根据弗若斯特沙利文测算数据，2025 年，标的公司跻身国内 DC-DC 市场本土厂商出货量前五，市场份额达 1.9%。



（八）标的公司的核心竞争力

1、研发团队专业资深，技术创新与成果转化能力突出

标的公司构建了一支专业能力突出、行业经验丰富的研发团队，目前研发人员规模超 80 人，占整体员工比例超 50%；研发核心成员均来自国内外知名半导体企业，平均从业经验超过 15 年，具备深厚的模拟芯片设计、BCD 工艺开发与先进封装技术研发经验，能够精准把握行业技术发展趋势与下游客户的产

品需求。

凭借强大的研发实力，晶艺半导体持续推进技术创新与产品迭代，截至报告期末，已取得 50 项授权发明专利、137 项集成电路布图登记，形成了完善的知识产权保护体系，技术成果转化能力处于行业前列。同时，公司获评国家级专精特新重点小巨人企业、工信部“中国芯”优秀技术创新产品、GEI 中国潜在独角兽企业、四川省科技厅首批种子独角兽企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业等多项资质认证与荣誉奖项，彰显了公司在技术创新与产品研发方面的行业认可度。

2、半桥智能功率模块产品在变频家电领域市场地位突出

标的公司深耕智能功率模块（IPM）领域，凭借自主研发的特色封装技术、高可靠性高压半桥驱动 IC（HVIC）设计技术等核心技术，采用半桥技术路线开发的产品可高效适配变频家电电机驱动应用场景，能够有效降低客户终端系统的综合成本。

目前，标的公司 IPM 产品已成功导入美的、小米、格力、TCL、海信日立等国内家电行业龙头企业的供应链体系；该类产品兼具小体积、低温升、低电磁干扰、高可靠性、PCB 布局灵活易加工等性能优势，不仅能够帮助客户降低产品开发与生产成本，还能提升终端电子产品的工作稳定性、延长使用寿命，并缩短客户的产品开发周期，在变频家电领域形成了显著的产品竞争力与市场优势。经测算，标的公司 2025 年标的公司产品在国内 IPM 半桥模块市场份额达 53.5%，行业排名第一。

3、电源管理产品布局契合国产替代趋势，多细分领域实现进口替代突破

标的公司聚焦智能电表、安防监控、光模块、固态硬盘、通信设备、服务器等下游高景气、高可靠性要求的应用领域，研发布局电源管理 IC 产品。依托自主研发的 ACOT 控制架构，结合业界领先的 BCD 工艺、先进功率封装技术，电源管理 IC 产品的性能与品质达到行业先进水平，成功在多个细分领域实现高性能电源管理 IC 的国产替代。

目前，标的公司电源管理 IC 产品已广泛应用于联特、光迅、华工正源、海康威视、大华、三星电气、威胜、记忆科技等业内知名企业，在国产替代进程

中占据了有利的市场地位。

4、优质多元、长期稳定的客户基础

晶艺半导体凭借领先的产品技术、稳定的产品品质与完善的技术服务能力，积累了超 500 家量产客户，客户群体广泛分布于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防监控、通信设备、服务器等多个下游应用领域，成功进入这些领域的头部客户供应链并实现批量量产，客户结构优质且多元。

在电机驱动产品领域，晶艺半导体产品已进入全球主流家电企业的供应链体系，与美的、奥克斯、格力、追觅、小米、TCL、海信日立、麦格米特等头部客户建立了长期稳定的合作关系并实现批量供货；在电源管理芯片领域，产品成功进入国家电网、南方电网体系内主要智能电表客户供应链，同时与小米、海康威视等家电、安防领域的标杆客户达成深度合作，并在光模块、固态硬盘等新兴高景气市场实现快速布局，成功突破光迅、联特、华工正源、记忆科技等核心客户，与各领域核心客户形成了较强的合作粘性，为业务的持续稳定发展奠定了坚实的客户基础。

三、标的公司的财务状况分析

（一）资产构成分析

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	53,516.07	94.79%	76,225.54	97.35%	57,482.34	91.21%
非流动资产	2,939.69	5.21%	2,074.49	2.65%	5,541.60	8.79%
资产合计	**56,455.75**	**100.00%**	**78,300.03**	**100.00%**	**63,023.95**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司资产总额分别为 63,023.95 万元、78,300.03 万元和 56,455.75 万元。截至 2026 年 2 月末，标的公司资产总额较 2025 年末下降 21,844.28 万元，主要系标的公司 2026 年 1-2 月流动资产减少了 22,709.47 万元所致。

报告期各期末，标的公司资产主要为流动资产，流动资产占总资产的比例分别为 91.21%、97.35%和 94.79%，符合芯片设计行业轻资产经营的特点。

1、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，标的公司流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	24,352.74	45.51%	37,542.55	49.25%	19,633.80	34.16%
交易性金融资产	-	0.00%	13,030.21	17.09%	15,034.22	26.15%
应收账款	8,760.98	16.37%	5,353.58	7.01%	4,416.12	7.68%
预付账款	787.25	1.47%	655.41	0.86%	682.40	1.19%
其他应收款	352.80	0.66%	353.49	0.46%	299.84	0.52%
存货	10,253.20	19.16%	10,919.02	14.32%	11,343.59	19.73%
一年内到期的非流动资产	3,257.97	6.08%	3,240.51	4.24%	-	0.00%
其他流动资产	5,751.13	10.75%	5,130.77	6.73%	6,072.38	10.56%
流动资产合计	**53,516.07**	**100.00%**	**76,225.54**	**100.00%**	**57,482.34**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货等构成，占流动资产的比例分别为 87.72%、87.69%、81.04%。

（1）货币资金

报告期各期末，标的公司货币资金主要为存放在各银行机构的银行存款，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行存款	24,352.74	37,542.55	19,633.80
合计	**24,352.74**	**37,542.55**	**19,633.80**

报告期各期末，标的公司货币资金分别为 19,633.80 万元、37,542.55 万元和 24,352.74 万元，占流动资产的比例分别为 34.16%、49.25%和 45.51%。2025 年末标的公司货币资金较 2024 年末增加 17,908.75 万元，主要系标的公司业务快速发展，经营性现金净流入 15,654.39 万元所致。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，标的公司交易性金融资产主要为存放在银行机构的结构性存款，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	13,030.21	15,034.22
其中：结构性存款	-	13,030.21	15,034.22
合计	**-**	**13,030.21**	**15,034.22**

（3）应收账款

①应收账款变动情况分析

报告期各期末，标的公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	9,222.09	5,635.35	4,648.55
减：坏账准备	461.10	281.77	232.43
应收账款账面价值	**8,760.98**	**5,353.58**	**4,416.12**

报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为 4,416.12 万元、5,353.58 万元和 8,760.98 万元，占流动资产的比例分别为 7.68%、7.01%和 16.37%，占比较低，反映出标的公司回款状况较好、应收账款周转较快。其中，2026 年 2 月底标的公司应收账款账面价值占比较以往年度高，主要系主要客户货款尚在信用期内所致。

②应收账款余额的账龄分布

报告期内，标的公司应收账款余额的账龄结构情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,222.09	100.00%	5,635.35	100.00%	4,648.55	100.00%
小计	**9,222.09**	**100.00%**	**5,635.35**	**100.00%**	**4,648.55**	**100.00%**
减：坏账准备	**461.10**	**-**	**281.77**	**-**	**232.43**	**-**
合计	**8,760.98**	**-**	**5,353.58**	**-**	**4,416.12**	**-**

报告期各期末，标的公司应收账款账龄均在一年以内，反映出标的公司款项回收效率较高，客户均按照合同约定时间完成付款。

③应收账款坏账准备计提情况

标的公司根据新金融工具准则的规定确认应收账款坏账准备，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。报告期各期末，标的公司应收账款按坏账准备计提方法分类情况如下：

单位：万元

种类	2026 年 2 月 28 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备	-	0.00%	-	0.00%	-
按组合计提坏账准备	9,222.09	100.00%	461.10	100.00%	8,760.98
其中：按账龄组合计提坏账准备	9,222.09	100.00%	461.10	100.00%	8,760.98
合计	**9,222.09**	**100.00%**	**461.10**	**100.00%**	**8,760.98**
种类	**2025 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备	-	0.00%	-	0.00%	-
按组合计提坏账准备	5,635.35	100.00%	281.77	100.00%	5,353.58
其中：按账龄组合计提坏账准备	5,635.35	100.00%	281.77	100.00%	5,353.58
合计	**5,635.35**	**100.00%**	**281.77**	**100.00%**	**5,353.58**
种类	**2024 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备	-	0.00%	-	0.00%	-
按组合计提坏账准备	4,648.55	100.00%	232.43	100.00%	4,416.12
其中：按账龄组合计提坏账准备	4,648.55	100.00%	232.43	100.00%	4,416.12
合计	**4,648.55**	**100.00%**	**232.43**	**100.00%**	**4,416.12**

④应收账款坏账计提政策与同行业可比公司对比情况

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，标的公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。标的公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例不存在重大差异，具体情况如下：

公司简称	1-6 个月	6-12 个月	1-2 年	2-3 年	3 年以上
杰华特	5.00%	5.00%	30.00%	50.00%	100.00%
芯朋微	5.00%	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%
希荻微	1.00%	1.00%	未披露	未披露	未披露
英集芯	5.00%	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%
标的公司	**5.00%**	**5.00%**	**20.00%**	**50.00%**	**100.00%**

注：数据来源于同行业上市公司 2024 年度或 2025 年度报告。

⑤应收账款前五名情况

报告期各期末，标的公司应收账款余额前五名如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例
2026 年 2 月 28 日	1	D 公司	4,918.96	53.34%
	2	中山市智驰微电子有限公司	1,292.20	14.01%
	3	深圳市安世通科技有限公司	1,066.99	11.57%
	4	深圳市仁天芯科技有限公司	323.16	3.50%
	5	中印云端（深圳）科技有限公司	259.00	2.81%
	合计		**7,860.30**	**85.23%**
2025 年 12 月 31 日	1	D 公司	2,528.27	44.86%
	2	深圳市安世通科技有限公司	772.19	13.70%
	3	中山市智驰微电子有限公司	443.39	7.87%
	4	厦门信和达电子有限公司	382.69	6.79%
	5	深圳市仁天芯科技有限公司	370.86	6.58%
	合计		**4,497.39**	**79.80%**
2024 年 12 月 31 日	1	D 公司	2,606.42	56.07%
	2	大联大商贸有限公司	300.58	6.47%
	3	深圳市安世通科技有限公司	292.94	6.30%
	4	中山市智驰微电子有限公司	186.76	4.02%
	5	厦门信和达电子有限公司	145.07	3.12%
	合计		**3,531.77**	**75.98%**

注 1:厦门信和达电子有限公司包含同一控制下的深圳市胜达威电子有限公司、环阳科技香港有限公司，下同

注 2:大联大商贸有限公司包含同一控制下的大联大商贸（深圳）有限公司、诠鼎科技股份有限公司、世平国际（香港）有限公司

报告期各期末，标的公司应收账款余额前五名客户占比分别为 75.98%、79.80%和 85.23%。其中，2024 年末、2026 年 2 月末标的公司对 D 公司的应收

账款占比超过 50%，主要系标的公司所服务的终端客户经营规模较大，相应采购量较大所致。

（4）预付款项

报告期各期末，标的公司预付款项分别为 682.40 万元、655.41 万元和 787.25 万元，占流动资产的比例分别为 1.19%、0.86%和 1.47%，主要为预付晶圆采购款。报告期各期末，标的公司预付款项及账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	462.49	58.75%	397.41	60.64%	465.42	68.20%
1 至 2 年	121.58	15.44%	51.70	7.89%	216.94	31.79%
2 至 3 年	203.14	25.80%	206.25	31.47%	0.04	0.01%
3 年以上	0.04	0.00%	0.04	0.01%	-	-
合计	**787.25**	**100.00%**	**655.41**	**100.00%**	**682.40**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司预付款项金额前五名如下：

单位：万元

时间	序号	预付账款方名称	账面余额	占预付款项余额的比例
2026 年 2 月 28 日	1	G 公司	573.65	72.87%
	2	上海积塔半导体有限公司	74.11	9.41%
	3	芯联集成电路制造股份有限公司	71.52	9.09%
	4	北京分贝通科技有限公司	18.10	2.30%
	5	泰和泰律师事务所	8.96	1.14%
	合计		**746.35**	**94.81%**
2025 年 12 月 31 日	1	G 公司	347.66	53.04%
	2	上海积塔半导体有限公司	75.24	11.48%
	3	芯联集成电路制造股份有限公司	74.14	11.31%
	4	四川龙天物业管理有限公司	61.59	9.40%
	5	成都天河中西医科技保育有限公司	18.60	2.84%
	合计		**577.23**	**88.07%**
2024 年 12 月 31 日	1	G 公司	299.18	43.84%
	2	芯联集成电路制造股份有限公司	230.08	33.72%
	3	上海积塔半导体有限公司	76.95	11.28%

时间	序号	预付账款方名称	账面余额	占预付款项余额的比例
	4	南通越亚半导体有限公司	20.55	3.01%
	5	北京分贝通科技有限公司	12.07	1.77%
	合计		**638.83**	**93.62%**

报告期各期末，标的公司前五大预付款项合计金额分别为 638.83 万元、577.23 万元和 746.35 万元，占预付款余额比例分别为 93.62%、88.07%和 94.81%，主要为预付的晶圆采购款。

（5）其他应收款

①其他应收款构成情况

报告期各期末，标的公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
押金保证金	326.60	330.59	269.64
应收暂付款	44.77	41.50	45.98
账面余额合计	**371.37**	**372.09**	**315.63**
减：坏账准备	18.57	18.60	15.78
账面价值合计	**352.80**	**353.49**	**299.84**

报告期各期末，标的公司其他应收款分别为 299.84 万元、353.49 万元和 352.80 万元，保持稳定；占流动资产的比例分别为 0.52%、0.46%和 0.66%。

报告期各期末，标的公司其他应收款为押金保证金、应收个人社保公积金，其中押金保证金主要为租房押金。

②其他应收款账龄情况

报告期各期末，标的公司其他应收款账龄具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	139.40	135.33	54.98
1-2 年	8.66	8.66	116.11
2-3 年	108.36	113.15	16.54
3 年以上	114.95	114.95	128.00
小计	**371.37**	**372.09**	**315.63**

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
减：坏账准备	18.57	18.60	15.78
合计	**352.80**	**353.49**	**299.84**

报告期各期末，标的公司其他应收款主要系业务开展过程中各类押金保证金。其中，2025 年末、2026 年 2 月末标的公司 2-3 年、3 年以上的其他应收款主要是付给华润上华科技有限公司的押金保证金。

③其他应收款前五名情况

报告期各期末，标的公司前五大其他应收款情况如下：

单位：万元

时间	序号	其他应收款方名称	款项性质	账面余额	占其他应收款余额比例
2026 年 2 月 28 日	1	无锡华润上华科技有限公司	押金保证金	200.00	53.86%
	2	四川龙天物业管理有限公司	押金保证金	90.19	24.28%
	3	成都景浩物流有限公司	押金保证金	9.39	2.53%
	4	成都阳光泰和商业管理有限责任公司	押金保证金	8.66	2.33%
	5	深圳市星河雅兴投资发展有限公司	押金保证金	6.61	1.78%
	合计		**-**	**314.85**	**84.78%**
2025 年 12 月 31 日	1	无锡华润上华科技有限公司	押金保证金	200.00	53.76%
	2	四川龙天物业管理有限公司	押金保证金	90.19	24.24%
	3	成都景浩物流有限公司	押金保证金	9.39	2.52%
	4	成都阳光泰和商业管理有限责任公司	押金保证金	8.66	2.33%
	5	深圳市星河雅兴投资发展有限公司	押金保证金	6.61	1.78%
	合计		**-**	**314.85**	**84.63%**
2024 年 12 月 31 日	1	无锡华润上华科技有限公司	押金保证金	228.00	72.23%
	2	成都景浩物流有限公司	押金保证金	9.39	2.98%
	3	成都阳光泰和商业管理有限责任公司	押金保证金	8.66	2.74%
	4	深圳市星河雅兴投资发展有限公司	押金保证金	6.61	2.09%
	5	上海诚二德装饰设计工程有限公司	押金保证金	5.83	1.85%
	合计		**-**	**258.49**	**81.89%**

（6）存货

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 11,343.59 万元、10,919.02 万元和 10,253.20 万元，占流动资产的比例分别为 19.73%、14.32%和 19.16%，较为稳定。

①存货构成及变动情况

报告期各期末，标的公司存货账面价值的具体构成情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	2,950.38	28.78%	2,958.23	27.09%	2,523.18	22.24%
库存商品	3,363.67	32.81%	4,196.30	38.43%	4,166.59	36.73%
委托加工物资	3,934.67	38.38%	3,761.02	34.44%	4,653.81	41.03%
周转材料	3.47	0.03%	3.47	0.03%	-	-
发出商品	1.01	0.01%	-	-	-	-
合计	**10,253.20**	**100.00%**	**10,919.02**	**100.00%**	**11,343.59**	**100.00%**

标的公司作为集成电路设计公司，采用 Fabless 经营模式，根据市场需求向晶圆制造商采购晶圆，并由封测厂进行封装测试。标的公司存货主要由库存商品、原材料、委托加工物资构成，其中原材料主要为晶圆，委托加工物资主要为在封装测试厂进行封装测试的芯片，库存商品主要为已完成封装测试的芯片产品。

②存货跌价计提情况

报告期各期末，标的公司存货跌价准备余额分别为 460.70 万元、1,895.35 万元和 1,824.41 万元，主要为库存商品的跌价准备。报告期各期末，标的公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
存货账面余额	12,077.61	12,814.37	11,804.28
存货跌价准备	1,824.41	1,895.35	460.70
其中：原材料	338.58	337.81	116.16
库存商品	1,368.52	1,460.09	324.30

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
委托加工物资	117.31	97.45	20.23
存货账面价值	**10,253.20**	**10,919.02**	**11,343.59**

报告期各期末，标的公司存货跌价准备金额分别为 460.70 万元、1,895.35 万元和 1,824.41 万元，占存货余额的比例分别为 3.90%、14.79%和 15.11%。其中，2025 年存货跌价准备金额较 2024 年大幅增加，主要是由于产品库龄增加所致，由于前期部分型号产品备货较多，客户需求减少以及产品型号迭代导致部分型号产品周转变慢，库龄较长，标的公司从谨慎性出发按照存货跌价准备政策对库龄 2 年以上的存货全额计提存货跌价准备，从而使得 2025 年存货跌价金额大幅增加。

（7）一年内到期的非流动资产

报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动资产分别为 0 万元、3,240.51 万元和 3,257.97 万元，系标的公司购买的大额存单。

（8）其他流动资产

报告期各期末，标的公司其他流动资产分别为 6,072.38 万元、5,130.77 万元和 5,751.13 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
芯片定制化量产业务存货	5,666.39	5,097.17	5,809.51
预缴税金	33.10	33.60	259.36
待摊费用	51.65	-	-
待抵扣进项税额	-	-	3.52
合计	**5,751.13**	**5,130.77**	**6,072.38**

2、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，标的公司非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	1,068.10	36.33%	1,108.88	53.45%	1,374.20	24.80%

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
在建工程	1.29	0.04%	9.72	0.47%	-	-
使用权资产	1,182.99	40.24%	77.73	3.75%	308.80	5.57%
无形资产	129.78	4.41%	138.89	6.70%	189.05	3.41%
长期待摊费用	45.50	1.56%	50.94	2.46%	72.76	1.31%
递延所得税资产	508.02	17.28%	515.61	24.85%	390.52	7.05%
其他非流动资产	4.01	0.14%	172.72	8.33%	3,206.28	57.86%
非流动资产合计	**2,939.69**	**100.00%**	**2,074.49**	**100.00%**	**5,541.60**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产和递延所得税资产构成。

报告期各期末，标的公司非流动资产分别为 5,541.60 万元、2,074.49 万元和 2,939.69 万元，2025 年末非流动资产较 2024 年末有所降低，主要系其他非流动资产降低 3,033.56 万元所致；2026 年标的公司使用权资产增加了 1,105.26 万元，带动了 2026 年 2 月末标的公司非流动资产较 2025 年末增加了 865.20 万元。

（1）固定资产

①固定资产构成情况

报告期各期末，标的公司固定资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机器设备	1,022.97	95.77%	1,069.86	96.48%	1,325.29	96.44%
电子设备	3.79	0.35%	2.11	0.19%	6.41	0.47%
办公设备	41.34	3.87%	36.91	3.33%	42.49	3.09%
合计	**1,068.10**	**100.00%**	**1,108.88**	**100.00%**	**1,374.20**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司固定资产分别为 1,374.20 万元、1,108.88 万元和 1,068.10 万元，占非流动资产的比例分别为 24.80%、53.45%和 36.33%，整体金额较为稳定，占比波动主要系非流动资产总额波动所致。

报告期各期末，标的公司固定资产结构相对稳定，以机器设备为主。

②固定资产折旧情况

报告期各期末，标的公司固定资产及折旧、减值计提情况如下表：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
账面原值：			-
机器设备	2,381.93	2,356.57	2,174.26
电子设备	23.77	21.52	20.95
办公设备	81.90	73.48	58.60
账面原值合计	**2,487.61**	**2,451.57**	**2,253.80**
累计折旧：			
机器设备	1,358.96	1,286.72	848.96
电子设备	19.99	19.41	14.54
办公设备	40.56	36.57	16.10
累计折旧合计	**1,419.51**	**1,342.69**	**879.60**
减值准备：			
机器设备			
电子设备			
办公设备			
减值准备合计			
账面价值：			
机器设备	1,022.97	1,069.86	1,325.29
电子设备	3.79	2.11	6.41
办公设备	41.34	36.91	42.49
账面价值合计	**1,068.10**	**1,108.88**	**1,374.20**

截至 2026 年 2 月末，标的公司固定资产账面原值为 2,487.61 万元，账面价值为 1,068.10 万元，固定资产成新率为 42.94%。

③固定资产折旧政策及同行业比较

标的公司及同行业可比公司固定资产均采用年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限和预计残值率对比情况如下：

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率
杰华特	通用设备	年限平均法	5	5%
	专用设备	年限平均法	5	5%
	运输工具	年限平均法	5	5%

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率
	机器设备	年限平均法	10	5%
	房屋建筑物	年限平均法	30	5%
芯朋微	房屋建筑物	年限平均法	20	5%
	机器设备	年限平均法	10	5%
	电子设备	年限平均法	3	5%
	运输设备	年限平均法	4	5%
	实验设备	年限平均法	3-5	5%
	其他设备	年限平均法	5	5%
希荻微	工程设备	年限平均法	5	0-5%
	办公设备	年限平均法	3-5	0-5%
	运输工具	年限平均法	5	0-5%
	土地	年限平均法	-	0-5%
	房屋建筑物	年限平均法	30-40	0-5%
	其他设备	年限平均法	5	0-5%
英集芯	研发及测试设备	年限平均法	3-5	0-5%
	运输工具	年限平均法	4	5%
	办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5%
标的公司	**机器设备**	**年限平均法**	3-8	0%
	电子设备	**年限平均法**	3	0%
	办公设备	**年限平均法**	3	0%

注：数据来源于可比公司 2024 年度、2025 年度报告。

综上，标的公司固定资产折旧政策与同行业公司不存在重大差异。

（2）使用权资产

报告期各期末，标的公司使用权资产分别为 308.80 万元、77.73 万元和 1,182.99 万元，占非流动资产的比例分别为 5.57%、3.75%和 40.24%，系执行新租赁准则，对租赁资产确认的使用权资产。报告期各期末，使用权资产均为房屋建筑物租赁。

2026 年 2 月末标的公司使用权资产较 2025 年末显著增加，主要系标的公司新迁办公地址 NIC 国创中心，租赁物业增长所致。

（3）无形资产

报告期各期末，标的公司无形资产分别为 189.05 万元、138.89 万元和 129.78 万元，金额较低，为标的公司所有的各类计算机软件。

（4）长期待摊费用

报告期各期末，标的公司长期待摊费用分别为 72.76 万元、50.94 万元和 45.50 万元，金额较小。报告期各期末，标的公司长期待摊费用为装修费、知识产权许可使用费等。

（5）递延所得税资产

报告期各期末，标的公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
未经抵销的递延所得税资产			
资产减值准备	481.25	471.15	246.89
可抵扣亏损	-	-	147.69
租赁负债	161.12	10.66	44.08
递延收益	43.09	50.00	3.30
合计	**685.46**	**531.80**	**441.97**
未经抵销的递延所得税负债			
使用权资产	177.45	11.66	46.32
公允价值变动	-	4.53	5.13
合计	**177.45**	**16.19**	**51.45**
以抵销后净额列示的递延所得税资产	**508.02**	**515.61**	**390.52**

报告期各期末，标的公司递延所得税资产分别为 390.52 万元、515.61 万元和 508.02 万元，占非流动资产的比例分别为 7.05%、24.85%和 17.28%。2025 年末，标的公司递延所得税资产较 2024 年末增加，主要系存货跌价准备金额增加较多从而使标的公司可抵扣暂时性差异有所增加。

（6）其他非流动资产

报告期各期末，标的公司其他非流动资产分别为 3,206.28 万元、172.72 万元和 4.01 万元，占非流动资产的比例分别为 57.86%、8.33%和 0.14%，金额较

小占比较低。2024 年末，其他非流动资产主要为标的公司购买的大额存单 3,132.53 万元。

（二）负债构成分析

报告期各期末，标的公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	14,437.67	92.32%	39,659.39	99.17%	9,348.73	99.16%
非流动负债	1,200.51	7.68%	333.34	0.83%	79.63	0.84%
负债合计	**15,638.18**	**100.00%**	**39,992.73**	**100.00%**	**9,428.36**	**100.00%**

报告期各期末，标的公司负债总额分别为 9,428.36 万元、39,992.73 万元和 15,638.18 万元，截至 2025 年 12 月末，标的公司负债总额较 2024 年末增加 30,564.37 万元，主要系标的公司新增其他应付款 24,166.61 万元所致。

报告期各期末，标的公司负债主要为流动负债，流动负债占总负债的比例分别为 99.16%、99.17%和 92.32%。

1、流动负债构成及变动分析

报告期各期末，标的公司流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	5,543.50	38.40%	4,003.02	10.09%	4,105.15	43.91%
应付票据	2,953.13	20.45%	2,884.25	7.27%	-	0.00%
应付账款	3,322.18	23.01%	3,497.95	8.82%	2,656.61	28.42%
合同负债	134.33	0.93%	125.06	0.32%	75.32	0.81%
应付职工薪酬	799.54	5.54%	3,018.06	7.61%	2,156.49	23.07%
应交税费	477.99	3.31%	789.64	1.99%	21.00	0.22%
其他应付款	54.42	0.38%	24,254.71	61.16%	88.10	0.94%
一年内到期的非流动负债	1,136.53	7.87%	1,071.86	2.70%	236.28	2.53%
其他流动负债	16.06	0.11%	14.83	0.04%	9.79	0.10%

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	14,437.67	100.00%	39,659.39	100.00%	9,348.73	100.00%

报告期各期末，标的公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬等构成。

报告期各期末，标的公司流动负债分别为 9,348.73 万元、39,659.39 万元和 14,437.67 万元，2025 年末增加较为多，主要系标的公司确认应付股权回购款使其他应付款显著增长所致。

（1）短期借款

报告期各期末，标的公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
保证借款	5,543.50	4,003.02	4,105.15
合计	**5,543.50**	**4,003.02**	**4,105.15**

报告期各期末，标的公司的短期借款分别为 4,105.15 万元、4,003.02 万元和 5,543.50 万元，系为了业务开展向银行借入的短期保证借款。

（2）应付票据

报告期各期末，标的公司的应付票据分别为 0.00 元、2,884.25 万元和 2,953.13 万元，均系应付银行承兑汇票。

（3）应付账款

报告期各期末，标的公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付材料及加工费	3,261.61	3,495.14	2,609.76
应付长期资产款	1.51	2.00	23.40
应付费用款	59.06	0.82	23.45
合计	**3,322.18**	**3,497.95**	**2,656.61**

报告期各期末，标的公司应付账款分别为 2,656.61 万元、3,497.95 万元和

3,322.18 万元，整体较为稳定，主要由应付晶圆采购、封测及加工等产生的应付材料款构成。

（4）合同负债

报告期各期末，标的公司合同负债分别为 75.32 万元、125.06 万元和 134.33 万元，合同负债金额较低且相对稳定。报告期各期末，标的公司合同负债主要为收到客户预付货款。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，标的公司应付职工薪酬分别为 2,156.49 万元、3,018.06 万元和 799.54 万元。报告期各期末，标的公司应付职工薪酬主要为计提但尚未发放的工资和奖金，报告期内，随着标的公司业务的快速增长，标的公司应付职工薪酬呈稳定增长趋势。

（6）应交税费

报告期各期末，标的公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
增值税	78.32	288.36	-
企业所得税	377.81	438.33	-
城市维护建设税	9.63	24.66	2.08
教育费附加	4.13	10.57	0.89
地方教育附加	2.75	7.05	0.59
印花税	5.35	20.67	17.43
合计	**477.99**	**789.64**	**21.00**

报告期各期末，标的公司应交税费分别为 21.00 万元、789.64 万元和 477.99 万元，主要为应交增值税和应交企业所得税。

（7）其他应付款

报告期各期末，标的公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
股权回购款	-	24,145.83	-
预提费用	43.79	86.70	67.73
应付员工款项	10.63	22.18	20.37
合计	**54.42**	**24,254.71**	**88.10**

报告期各期末，标的公司其他应付款分别为 88.10 万元、24,254.71 万元和 54.42 万元。2025 年标的公司为回购原股东所持股权，确认了应付股权回购款 24,145.83 万元，使 2025 年末其他应付款余额明显增加。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动负债分别为 236.28 万元、1,071.86 万元和 1,136.53 万元。报告期各期末，标的公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的租赁负债。

（9）其他流动负债

报告期各期末，标的公司其他流动负债分别为 9.79 万元、14.83 万元和 16.06 万元。报告期各期末，标的公司其他流动负债主要为待转销项税额。

2、非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，标的公司非流动负债均构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
租赁负债	913.21	-	57.62
递延收益	287.30	333.34	22.01
递延所得税负债	-	-	-
非流动负债合计	**1,200.51**	**333.34**	**79.63**

报告期各期末，标的公司非流动负债分别为 79.63 万元、333.34 万元和 1,200.51 万元，2026 年 2 月末非流动负债余额增长较多主要系尚未支付的租赁付款额的现值增加所致。

（三）偿债能力分析

1、标的公司偿债能力

报告期内，标的公司偿债能力相关指标如下：

项目	2026 年 2 月 28 日/2026 年 1-2 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
流动比率（倍）	3.71	1.92	6.15
速动比率（倍）	3.00	1.65	4.94
资产负债率	27.70%	51.08%	14.96%
息税折旧摊销前利润（万元）	-6,774.46	-562.30	5,643.74
利息保障倍数（倍）	-265.77	-4.02	48.94
利息保障倍数（倍）-不考虑股份支付	121.46	74.21	64.06

注 1：流动比率=流动资产/流动负债
注 2：速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
注 3：资产负债率=总负债/总资产×100%
注 4：息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
注 5：利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

报告期各期末，标的公司流动比率分别为 6.15 倍、1.92 倍和 3.71 倍，速动比率分别是 4.94 倍、1.65 倍和 3.00 倍，资产负债率分别为 14.96%、51.08%和 27.70%，整体偿债能力较强，其中，2025 年流动比例、速动比例下降，资产负债率上升，系确认应付股权回购款使其他应付款显著增长所致。

利息覆盖能力方面，报告期内，标的公司受计提股份支付费用的影响，利息保证倍数为负，剔除股份支付影响，报告期各期利息保障倍数为 64.06 倍、74.21 倍、121.46 倍，保障能力较强。

2、同行业对比分析

2024 年末和 2025 年末，标的公司与同行业可比上市公司偿债指标对比情况如下：

项目	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动比率	杰华特	1.27	2.05
	芯朋微	4.94	5.52
	希荻微	3.73	6.17
	英集芯	7.60	13.71

项目	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	可比公司均值	**4.39**	**6.86**
	标的公司	**1.92**	**6.15**
速动比率	杰华特	0.77	1.43
	芯朋微	4.29	4.82
	希荻微	2.94	5.50
	英集芯	3.99	9.80
	可比公司均值	**3.00**	**5.39**
	标的公司	**1.65**	**4.94**
资产负债率	杰华特	65.18%	49.50%
	芯朋微	17.61%	15.69%
	希荻微	19.67%	13.34%
	英集芯	10.94%	6.55%
	可比公司均值	**28.35%**	**21.27%**
	标的公司	**51.08%**	**14.96%**

注 1：流动比率=流动资产/流动负债
注 2：速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
注 3：资产负债率=总负债/总资产×100%

2024 年末，标的公司流动比率、速动比率、资产负债率与同行业可比公司平均值较为可比，其中，流动比率、速动比率略低于同行业可比公司平均值，主要系同行业可比公司通过上市募集资金进一步提高了资金实力，流动资产增加较多。

2025 年末，标的公司流动比率、速动比率较低，资产负债率较高主要系确认应付股权回购款使其他应付款显著增长所致。剔除该部分其他应付款影响，2025 年标的公司流动比率、速动比率、资产负债率分别为 4.91、4.21、20.24%，与同行业可比公司平均值较为可比。

（四）资产周转能力分析

1、标的公司资产周转能力指标

报告期内，标的公司资产周转能力相关指标如下：

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
总资产周转率（次/年）	0.72	0.49	0.42
应收账款周转率（次/年）	6.55	6.80	7.92

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
存货周转率（次/年）	1.62	1.06	0.76

注 1：总资产周转率=营业收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]；
注 2：应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收票据余额+期末应收票据余额+期初应收账款余额+期末应收账款余额+期初应收款项融资余额+期末应收款项融资余额）/2]；
注 3：存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
注 4：2026 年 1-2 月总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率已年化处理。

报告期内，在产品较好的市场竞争力驱动下，总资产周转率和存货周转率不断改善。报告期内，随着业务发展个别客户的收入规模和应收账款同时增加致使应收账款余额占营业收入比例有所提高，应收账款周转率有所降低，但仍然维持在较高水平。

2、同行业对比分析

报告期内，标的公司与同行业可比上市公司资产周转能力指标对比情况如下：

项目	公司名称	2025 年度	2024 年度
总资产周转率（次/年）	杰华特	0.56	0.40
	芯朋微	0.37	0.34
	希荻微	0.51	0.29
	英集芯	0.70	0.70
	可比公司平均值	**0.54**	**0.43**
	标的公司	**0.49**	**0.42**
应收账款周转率（次/年）	杰华特	4.39	3.77
	芯朋微	4.21	4.12
	希荻微	6.65	4.65
	英集芯	10.26	10.15
	可比公司平均值	**6.38**	**5.67**
	标的公司	**6.80**	**7.92**
存货周转率（次/年）	杰华特	2.1	1.41
	芯朋微	2.13	2.33
	希荻微	3.25	2.19
	英集芯	2.18	2.33
	可比公司平均值	**2.42**	**2.07**
	标的公司	**1.06**	**0.76**

注 1：总资产周转率=营业收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

注 2：应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收票据余额+期末应收票据余额+期初应收账款余额+期末应收账款余额+期初应收款项融资余额+期末应收款项融资余额）/2]
注 3：存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

2024 年和 2025 年，标的公司总资产周转率与同行业可比公司平均值较为接近，处于同行业合理水平。

2024 年和 2025 年，标的公司应收账款周转率略高于同行业可比公司平均值，主要系标的公司产品市场竞争力较强，在与下游经销商合作过程中，款项回收情况较好。

2024 年和 2025 年，标的公司存货周转率低于同行业可比公司平均值，主要是由于相比对同行业可比公司，标的公司经营规模相对较小，同时考虑到上游原材料供应紧张，标的公司以前年度备货较多，存货余额较大所致。

四、标的公司的盈利能力及未来趋势分析

报告期内，标的公司利润表主要科目构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、营业收入	**8,106.74**	**100.00%**	**34,971.68**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**
减：营业成本	3,365.89	41.52%	13,104.43	37.47%	8,699.86	34.13%
税金及附加	46.47	0.57%	200.19	0.57%	60.46	0.24%
销售费用	285.48	3.52%	1,954.98	5.59%	1,803.48	7.07%
管理费用	10,393.56	128.21%	12,187.67	34.85%	2,346.14	9.20%
研发费用	926.78	11.43%	8,452.32	24.17%	8,844.17	34.69%
财务费用	4.25	0.05%	-131.75	-0.38%	-254.53	-1.00%
其中：利息费用	25.49	0.31%	140.01	0.40%	115.32	0.45%
利息收入	38.04	0.47%	338.22	0.97%	333.65	1.31%
加：其他收益	192.71	2.38%	1,269.18	3.63%	1,575.85	6.18%
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00%	5.83	0.02%	-23.97	-0.09%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16.91	0.21%	310.96	0.89%	422.99	1.66%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179.46	-2.21%	-52.57	-0.15%	-138.82	-0.54%
资产减值损失	-64.97	-0.80%	-2,231.55	-6.38%	-1,017.07	-3.99%

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
（损失以“-”号填列）						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00%	-2.55	-0.01%	13.02	0.05%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-6,950.52**	**-85.74%**	**-1,496.85**	**-4.28%**	**4,826.24**	**18.93%**
加：营业外收入	-	0.00%	0.00	0.00%	3.23	0.01%
减：营业外支出	0.90	0.01%	1.26	0.00%	0.13	0.00%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-6,951.41**	**-85.75%**	**-1,498.11**	**-4.28%**	**4,829.34**	**18.94%**
减：所得税费用	333.85	4.12%	486.18	1.39%	-96.45	-0.38%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-7,285.27**	**-89.87%**	**-1,984.29**	**-5.67%**	**4,925.79**	**19.32%**

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，标的公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	8,106.74	100.00%	34,949.33	99.94%	25,493.82	100.00%
其他业务收入	-	-	22.35	0.06%	-	-
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,971.68**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

标的公司专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品的研发、设计和销售，报告期内，标的公司主营业务收入占比维持在 99%以上，主营业务突出。

2、主营业务收入的产品构成

报告期内，标的公司产品主要包括电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，标的公司主营业务收入的产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自研业务	4,929.07	60.80%	20,153.15	57.66%	13,154.03	51.60%

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
-电机驱动	3,270.34	40.34%	11,637.28	33.30%	5,756.09	22.58%
-电源管理	1,658.73	20.46%	8,515.87	24.37%	7,397.94	29.02%
芯片定制化量产业务	3,177.67	39.20%	14,796.18	42.34%	12,339.78	48.40%
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务收入主要包括自研业务和芯片定制化量产业务，其中芯片定制化量产业务采用净额法进行核算，自研业务报告期内收入占比分别为 51.60%、57.66%和 60.80%，由电机驱动产品收入和电源管理产品构成，两类产品收入报告期内均呈现增长趋势，其中电机驱动产品得益于 IPM 产品的收入快速增长，在整体收入中的占比逐年提高。

3、主营业务收入的区域构成

报告期内，标的公司主营业务收入的区域构成情况如下：

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华南	7,064.44	87.14%	26,524.12	75.89%	16,975.78	66.59%
华东	696.05	8.59%	5,891.53	16.86%	4,956.31	19.44%
海外	193.50	2.39%	2,113.09	6.05%	3,435.05	13.47%
其他	152.75	1.88%	420.59	1.20%	126.68	0.50%
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务收入的区域分布较为稳定，以华南地区和华东地区为主，来自于华南和华东的主营业务收入合计占比分别为 86.03%、92.75%和 95.73%。

4、主营业务收入的销售模式构成

报告期内，标的公司主营业务收入的销售模式构成情况如下：

单位：万元

销售模式	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	7,728.97	95.34%	33,614.30	96.18%	24,580.25	96.42%
直销模式	377.77	4.66%	1,335.03	3.82%	913.56	3.58%

销售模式	2026 年 1-2 月		2025 年		2024 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	**8,106.74**	**100.00%**	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司销售模式以经销为主，经销模式收入占主营业务收入比例分别为 96.42%、96.18%和 95.34%。

5、主营业务收入季节性波动情况

2024 年和 2025 年，标的公司主营业务收入按季度分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例
第一季度	7,001.47	20.03%	4,202.58	16.48%
第二季度	7,729.63	22.12%	6,505.12	25.52%
第三季度	9,035.53	25.85%	7,047.71	27.64%
第四季度	11,182.70	32.00%	7,738.41	30.35%
合计	**34,949.33**	**100.00%**	**25,493.82**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，每年度内收入逐季度增加，第四季度收入占比最高，主要是由于一方面标的公司报告期内处于收入持续增长期，另一方面芯片设计行业的销售情况与下游电子产品市场需求高度相关，标的公司客户需根据节假日及下游市场需求合理备货。受春节假期开工影响，标的公司客户往往在第四季度末提前备货，致使标的公司第四季度收入占比相对较高而第一季度收入占比相对较低。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，标的公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	3,365.89	100.00%	13,104.43	100.00%	8,699.86	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-
合计	**3,365.89**	**100.00%**	**13,104.43**	**100.00%**	**8,699.86**	**100.00%**

报告期内，标的公司营业成本均为主营业务成本，营业成本变动趋势和营业收入变动趋势一致。

2、主营业务成本的产品构成

报告期内，标的公司主营业务成本的产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自研业务	3,365.89	100.00%	13,104.43	100.00%	8,699.86	100.00%
-电机驱动	2,309.20	68.61%	7,725.86	58.96%	4,145.67	47.65%
-电源管理	1,056.69	31.39%	5,378.57	41.04%	4,554.18	52.35%
芯片定制化量产业务	-	-	-	-	-	-
合计	**3,365.89**	**100.00%**	**13,104.43**	**100.00%**	**8,699.86**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务成本分别为 8,699.86 万元、13,104.43 万元和 3,365.89 万元，主营业务成本随业务规模的扩大而增长，与主营业务收入变动趋势相匹配。

报告期内，标的公司主营业务成本来源于自研业务的电机驱动和电源管理产品业务，芯片定制化量产业务采用净额法核算，成本为零。整体来看，标的公司主营业务成本与业务模式以及主营业务收入的产品构成情况一致，并与相关产品的收入变动趋势匹配。

3、主营业务成本的类型构成

报告期内，标的公司主营业务成本的类型构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
材料成本	2,297.69	68.26%	9,073.70	69.24%	6,319.21	72.64%
委外加工费	1,050.73	31.22%	3,869.50	29.53%	2,283.30	26.25%
其他费用	17.46	0.52%	161.23	1.23%	97.36	1.12%
合计	**3,365.89**	**100.00%**	**13,104.43**	**100.00%**	**8,699.86**	**100.00%**

注：委外加工费主要系晶圆封装和测试费用、模组产品加工费用。

标的公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售，晶圆制

造和封装测试环节通过委外方式完成。报告期内，标的公司成本结构较为稳定，主营业务成本主要为材料成本和委外加工费用，其中材料成本占比分别为72.64%、69.24%和68.26%，委外加工费占比分别为26.25%、29.53%和31.22%。

2025年度，标的公司材料成本占比有所下降、委外加工费占比有所上升，主要系标的公司采购的晶圆等材料价格呈下降趋势。报告期内，随着全球晶圆供应链逐步恢复正常，晶圆制造行业整体价格有所下降，因此标的公司晶圆采购价格有所降低。由于单位成本中委外加工费占比相对较低，且价格变动幅度相对较小，因此材料成本下降时，委外加工费占比有所提高。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利结构分析

报告期内，标的公司综合毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-2月		2025年度		2024年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	4,740.85	100.00%	21,844.90	99.90%	16,793.96	100.00%
其他业务毛利	-	-	22.35	0.10%	-	-
合计	**4,740.85**	**100.00%**	**21,867.24**	**100.00%**	**16,793.96**	**100.00%**

报告期内，标的公司综合毛利主要来源于主营业务产生的毛利，主营业务毛利占比维持在99%以上。

报告期内，标的公司主营业务毛利来源及构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-2月		2025年度		2024年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自研业务	1,563.18	32.97%	7,048.72	32.27%	4,454.17	26.52%
-电机驱动	961.14	20.27%	3,911.42	17.91%	1,610.42	9.59%
-电源管理	602.04	12.70%	3,137.30	14.36%	2,843.76	16.93%
芯片定制化量产业务	3,177.67	67.03%	14,796.18	67.73%	12,339.78	73.48%
合计	**4,740.85**	**100.00%**	**21,844.90**	**100.00%**	**16,793.96**	**100.00%**

报告期内，标的公司主营业务毛利分别为16,793.96万元、21,844.90万元和4,740.85万元，主营业务毛利额逐年增加。

2、主营业务毛利率分析

报告期内，标的公司各产品的主营业务毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
自研业务	31.71%	60.80%	34.98%	57.66%	33.86%	51.60%
-电机驱动	29.39%	40.34%	33.61%	33.30%	27.98%	22.58%
-电源管理	36.30%	20.46%	36.84%	24.37%	38.44%	29.02%
芯片定制化量产业务	100.00%	39.20%	100.00%	42.34%	100.00%	48.40%
合计	**58.48%**	**100.00%**	**62.50%**	**100.00%**	**65.87%**	**100.00%**

报告期内，标的公司芯片定制化量产业务采用净额法核算，毛利率为 100%，除此之外，标的公司自研业务毛利率分别为 33.86%、34.98%和 31.71%，整体较为稳定。

3、同行业可比公司毛利率比较

2024 年和 2025 年，标的公司自研业务毛利率与同行业可比上市公司的比较情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度
杰华特	26.37%	27.35%
芯朋微	37.24%	36.75%
希荻微	30.11%	31.10%
英集芯	34.38%	33.51%
平均值	**32.02%**	**32.18%**
标的公司（自研业务）	**34.98%**	**33.86%**

注：数据来源为可比公司定期报告。

2024 年和 2025 年，标的公司自研业务产品毛利率分别为 33.86%和 34.98%，高于杰华特、希荻微和英集芯，低于芯朋微，与可比公司平均水平接近。

（四）报告期利润的主要来源、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析

1、报告期利润的主要来源

报告期内，标的公司主要利润来源情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
营业收入	8,106.74	34,971.68	25,493.82
营业利润	-6,950.52	-1,496.85	4,826.24
营业利润（剔除股份支付影响）	2,919.87	9,455.58	6,569.51
营业外收入	-	0.00	3.23
营业外支出	0.90	1.26	0.13
利润总额	-6,951.41	-1,498.11	4,829.34
净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
归属于母公司所有者的净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,497.57	8,264.98	5,511.71
剔除股份支付影响后归属于母公司所有者的净利润	2,585.12	8,968.14	6,669.06

报告期内，标的公司营业利润分别为 4,826.24 万元、-1,496.85 万元和-6,950.52 万元，剔除股份支付影响后，营业利润分别为 6,569.51 万元、9,455.58 万元和 2,919.87 万元，营业利润主要来自于芯片定制化量产业务和芯片自研业务。标的公司一方面持续维持芯片定制化量产业务的稳定发展，一方面不断在自研产品领域进行研发和市场推广，促进自研业务收入增长。

2、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析

（1）研发和技术实力

标的公司所处的集成电路设计行业，技术及产品迭代速度较快，芯片设计公司需要持续投入大量的资金和人员进行现有产品的升级更新和新产品的开发，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，以保持产品竞争优势和市场地位。标的公司构建了一支专业能力突出、行业经验丰富的研发团队，目前研发人员规模超 80 人，占整体员工比例超 50%；研发核心成员均来自国内外知名半导体企业，平均从业经验超过 15 年，具备深厚的模拟芯片设计、BCD 工艺开发与先进封装技术研发经验，能够精准把握行业技术发展趋势与下游客户的产品需求。虽然标的公司核心团队具备较强的研发能力及丰富的行业经验，但是产品的研发进程及产业化存在不确定性，如果标的公司产品研发产业化效果未达预期，或者产品未能进一步实现技术迭代和性能升级，或者所开发的产品不契合市场需求，标的公司将面临前期的研发投入难

以收回、预计效益难以达到的风险，影响盈利能力的连续性和稳定性。

（2）供应链稳定性

标的公司系 fabless 模式的芯片设计厂商，对于芯片设计厂商而言，自身不拥有晶圆产线，业务依赖上游硅片材料、晶圆代工、以及封装测试、物料配套等外部供应链体系，供应链稳定直接决定产能配额、交付周期与量产节奏，是企业履约经营的前提。标的公司的供应链合作伙伴主要系国内知名的晶圆代工企业、封装测试企业等，标的公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，但若后续行业供需格局变化、上游供应节奏波动、原材料价格变动等因素引发供应链运行不确定性增加，可能对标的公司生产计划安排、成本管控及经营业绩带来相应影响。

（3）行业竞争趋势

集成电路行业市场竞争激烈，以德州仪器等为代表的国际知名厂商凭借在资本、平台和研发等方面的优势积累，在国内模拟芯片的高端市场占据了较大的市场份额，对国内进军中高端产品市场的企业造成较大的竞争压力。随着国内集成电路产业的快速发展，部分国内模拟芯片厂商脱颖而出，在细分市场与国际知名厂商的技术水平差距不断缩小。与此同时国内模拟芯片厂商数量增多，行业竞争持续加剧，标的公司面临较为激烈的行业竞争环境。未来面对日益激烈的市场竞争，标的公司能否制定有效的竞争策略并保持竞争优势将对标的公司的市场占有率和盈利能力造成实质影响。

（五）盈利能力的驱动要素及其可持续性分析

晶艺半导体盈利能力的主要的驱动要素如下：

1、国家支持政策不断出台，有利于半导体行业的长期发展

半导体产业作为信息产业的核心引擎，是支撑经济社会和保障国家信息安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家密集出台了多项支持政策和集成电路产业发展规划，在财税征收、资金支持、配套建设等诸多方面建立了完善的政策支持体系，为半导体行业的发展创造了良好的政策环境，为国内半导体行业带来了良好的发展机遇。国家的政策支持为行业创造了良好的政策环境和投融资环境，有利于晶艺半导体提高持续经营能力和盈利能力的持续性。

2、下游应用行业需求的增长和国产替代加速，为标的公司带来广阔市场空间

电源管理芯片的应用范围广阔。受光模块、AI 服务器及通信设备升级、新能源汽车及智能汽车持续发展、智能电表及安防等应用需求增长等因素驱动，中国电源管理芯片市场规模预计将由 2025 年的 1,390.0 亿元增长至 2030 年的 2,564.0 亿元，期间复合增长率约为 13.0%。标的公司产品广泛应用于高端消费电子、家电、服务器、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信等市场领域，客户结构优质且多元，得益于上述下游市场需求的快速增长以及半导体领域国产化趋势的加快，未来市场增长空间广阔。

3、标的公司技术实力强劲、核心产品市场地位突出等为公司持续经营和稳步发展奠定基础

晶艺半导体构建了一支专业能力突出、行业经验丰富的研发团队，具备深厚的模拟芯片设计、BCD 工艺开发与先进封装技术研发经验，能够精准把握行业技术发展趋势与下游客户的产品需求。晶艺半导体持续推进技术创新与产品迭代，已取得 50 项授权发明专利、137 项集成电路布图登记，形成了完善的知识产权保护体系，技术成果转化能力处于行业前列。同时，标的公司获评国家级专精特新重点小巨人企业、工信部“中国芯”优秀技术创新产品、GEI 中国潜在独角兽企业、四川省科技厅首批种子独角兽企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业等多项资质认证与荣誉奖项，彰显了标的公司在技术创新与产品研发方面的行业认可度。

晶艺半导体深耕智能功率模块（IPM）领域，凭借自主研发的特色封装技术、高可靠性高压半桥驱动 IC（HVIC）设计技术等核心技术，采用半桥技术路线开发的产品可高效适配变频家电电机驱动应用场景，产品已成功导入美的、小米、格力、TCL、海信日立等国内家电行业龙头企业的供应链体系，在变频家电领域形成了显著的产品竞争力与市场优势。

（六）期间费用分析

1、期间费用整体情况

报告期内，标的公司期间费用及占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	285.48	3.52%	1,954.98	5.59%	1,803.48	7.07%
管理费用	10,393.56	128.21%	12,187.67	34.85%	2,346.14	9.20%
研发费用	926.78	11.43%	8,452.32	24.17%	8,844.17	34.69%
财务费用	4.25	0.05%	-131.75	-0.38%	-254.53	-1.00%
期间费用合计	**11,610.07**	**143.22%**	**22,463.22**	**64.23%**	**12,739.26**	**49.97%**
其中：股份支付费用	9,870.39	121.76%	10,952.43	31.32%	1,743.27	6.84%
剔除股份支付费用影响后的期间费用	1,739.68	21.46%	11,510.79	32.91%	10,995.99	43.13%

报告期内，标的公司期间费用分别为 12,739.26 万元、22,463.22 万元和 11,610.07 万元，期间费用占营业收入的比例分别为 49.97%、64.23%和 143.22%，期间费用以研发费用和管理费用为主。剔除股份支付费用影响后，报告期内标的公司期间费用分别为 10,995.99 万元、11,510.79 万元和 1,739.68 万元，占营业收入的比例分别为 43.13%、32.91%和 21.46%。

2025 年，标的公司剔除股份支付费用影响后的期间费用率较 2024 年下降，主要系标的公司 2025 年度营业收入较 2024 年大幅增长所致。2026 年 1-2 月，标的公司剔除股份支付费用影响后的期间费用率较 2025 年下降，主要系月度平均营业收入有所增长。

2、销售费用

报告期各期，标的公司销售费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	231.98	81.26%	1,633.71	83.57%	1,464.23	81.19%
差旅费	12.64	4.43%	129.17	6.61%	101.41	5.62%
折旧摊销	12.10	4.24%	71.56	3.66%	67.37	3.74%
检测费	10.61	3.72%	47.10	2.41%	85.81	4.76%
业务招待费	0.81	0.28%	19.50	1.00%	23.53	1.30%
样品费	10.70	3.75%	11.23	0.57%	8.62	0.48%
其他	6.65	2.33%	42.72	2.19%	52.51	2.91%

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	**285.48**	**100.00%**	**1,954.98**	**100.00%**	**1,803.48**	**100.00%**

标的公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费、折旧摊销构成，上述费用合计占销售费用的比例分别为 90.55%、93.84%和 89.93%。

报告期内，标的公司销售费用分别为 1,803.48 万元、1,954.98 万元和 285.48 万元，占当期营业收入的比例分别为 7.07%、5.59%和 3.52%，报告期内销售费用保持平稳，销售费用率下降主要系标的公司收入增长所致。

3、管理费用

报告期各期，标的公司管理费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股份支付费用	9,842.14	94.69%	9,122.93	74.85%	0.00	0.00%
职工薪酬	431.69	4.15%	2,474.15	20.30%	1,787.15	76.17%
咨询服务费	42.94	0.41%	248.91	2.04%	142.77	6.09%
折旧摊销费	26.42	0.25%	102.02	0.84%	85.26	3.63%
差旅费	8.85	0.09%	90.58	0.74%	91.24	3.89%
其他	41.53	0.40%	149.08	1.22%	239.72	10.22%
合计	**10,393.56**	**100.00%**	**12,187.67**	**100.00%**	**2,346.14**	**100.00%**

标的公司管理费用主要由股份支付费用、职工薪酬和咨询服务费构成，上述费用合计占管理费用的比例分别为 82.26%、97.20%和 99.26%。

报告期内，标的公司管理费用分别为 2,346.14 万元、12,187.67 万元和 10,393.56 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.20%、34.85%和 128.21%，剔除股份支付费用后，报告期各期管理费用分别为 2,346.14 万元、3,064.74 万元和 551.42 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.20%、8.76%和 6.80%。

4、研发费用

报告期各期，标的公司研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股份支付费用	28.26	3.05%	1,829.51	21.65%	1,743.27	19.71%
职工薪酬	636.89	68.72%	4,210.84	49.82%	4,044.94	45.74%
模具费	68.58	7.40%	1,042.69	12.34%	1,777.71	20.10%
折旧摊销费	97.86	10.56%	546.02	6.46%	474.42	5.36%
材料费	20.13	2.17%	402.19	4.76%	427.15	4.83%
其他	75.06	8.10%	421.08	4.98%	376.67	4.26%
合计	**926.78**	**100.00%**	**8,452.32**	**100.00%**	**8,844.17**	**100.00%**

报告期内，标的公司研发费用主要由职工薪酬、股份支付费用、模具费、折旧摊销费构成，上述费用合计占研发费用的比例分别为 90.91%、90.27%和 89.73%。

报告期内，标的公司研发费用分别为 8,844.17 万元、8,452.32 万元和 926.78 万元，占当期营业收入的比例分别为 34.69%、24.17%和 11.43%。剔除股份支付费用影响后，报告期内，标的公司研发费用分别为 7,100.90 万元、6,622.81 万元和 898.52 万元，占当期营业收入的比例分别为 27.85%、18.94%和 11.08%，研发费用率有所下降，主要系标的公司销售收入增长，根据研发项目进展和需求，阶段性调整研发人员规模和研发试制投入所致。

5、财务费用

报告期内，标的公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
利息支出	25.49	140.01	115.32
利息收入	-38.04	-338.22	-333.65
汇兑损益	15.22	54.36	-44.37
手续费	1.58	12.09	8.18
合计	**4.25**	**-131.75**	**-254.53**

报告期内，标的公司财务费用分别为-254.53 万元、-131.75 万元和 4.25 万元，占营业收入比分别为-1.00%、-0.38%和 0.05%，金额和占收入比例均较小。报告期内，标的公司财务费用主要由利息收支和汇兑损益构成。

6、同行业可比公司的期间费用率比较

标的公司与同行业可比公司的期间费率比较情况如下：

指标	公司名称	2026 年 1-2 月 /2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度
销售费用率	杰华特	6.79%	7.29%	6.78%
	芯朋微	1.54%	1.57%	2.06%
	希荻微	5.63%	6.26%	11.49%
	英集芯	2.31%	2.42%	2.48%
	平均值	**4.07%**	**4.39%**	**5.70%**
	标的公司	3.52%	5.59%	7.07%
管理费用率	杰华特	8.90%	8.28%	8.23%
	芯朋微	5.04%	4.85%	3.58%
	希荻微	6.66%	10.35%	17.33%
	英集芯	3.30%	3.57%	3.96%
	平均值	**5.98%**	**6.76%**	**8.27%**
	标的公司	128.21%	34.85%	9.20%
	标的公司（剔除股份支付）	6.80%	8.76%	9.20%
研发费用率	杰华特	38.66%	36.06%	36.89%
	芯朋微	20.08%	22.60%	23.44%
	希荻微	19.81%	27.80%	46.31%
	英集芯	21.29%	19.74%	21.15%
	平均值	**24.96%**	**26.55%**	**31.95%**
	标的公司	11.43%	24.17%	34.69%
	标的公司（剔除股份支付）	11.08%	18.94%	27.85%

注：数据来源为可比公司定期报告或招股说明书。

2024 年和 2025 年，标的公司销售费用率、管理费用率（剔除股份支付）与同行业可比公司不存在重大差异，研发费用率低于同行业可比公司，主要是由于标的公司营业收入中存在一部分客户定制产品收入，该部分业务报告期内研发投入较低，若仅以自研产品收入计算，报告期各期研发费用率则分别达到 67.24%、41.89%和 18.80%。

（七）非经常性损益分析

报告期内，标的公司非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项 目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-2.55	13.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	51.49	439.37	972.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16.91	316.78	399.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.90	-1.26	3.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,840.21	-10,888.76	-1,765.83
小 计	**-9,772.72**	**-10,136.41**	**-377.73**
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	10.12	112.85	208.20
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-9,782.84	-10,249.27	-585.92
归属于母公司所有者的净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	**2,497.57**	**8,264.98**	**5,511.71**

报告期内，标的公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为-585.92 万元、-10,249.27 万元和-9,782.84 万元，非经常性损益净额为负主要系一次性确认的股份支付费用所致。标的公司非经常性损益主要为政府补助、金融资产公允价值变动损益和一次性确认的股份支付费用。

（八）其他变动幅度较大的项目分析

1、税金及附加

报告期内，标的公司税金及附加分别为 60.46 万元、200.19 万元和 46.47 万元，主要为城市维护建设税、教育费附加和印花税。报告期内，标的公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
城市维护建设税	23.99	95.20	16.40
教育费附加	10.28	40.80	7.03

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
地方教育附加	6.85	27.20	4.69
印花税	5.35	36.99	32.34
合计	**46.47**	**200.19**	**60.46**

2、其他收益

报告期内，标的公司其他收益分别为 1,575.85 万元、1,269.18 万元和 192.71 万元，主要为政府补助和增值税加计抵减。报告期内，标的公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
与收益相关的政府补助	51.49	439.37	972.97
与资产相关的政府补助	0.78	4.67	1.99
增值税加计抵减	140.44	817.80	600.23
代扣个人所得税手续费返还	-	2.16	0.67
重点人群增值税减免	-	5.19	-
合计	**192.71**	**1,269.18**	**1,575.85**

3、投资收益

报告期内，标的公司投资收益分别为-23.97 万元、5.83 万元和 0 万元，均系处置交易性金融资产取得的投资收益。

4、公允价值变动收益

报告期内，标的公司公允价值变动收益分别为 422.99 万元、310.96 万元和 16.91 万元，均系由分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款公允价值变动所产生。

5、信用减值损失

报告期内，标的公司信用减值损失分别为-138.82 万元、-52.57 万元和-179.46 万元，为应收账款和其他应收款坏账损失。

6、资产减值损失

报告期内，标的公司资产减值损失分别为-1,017.07 万元、-2,231.55 万元和-

64.97 万元，为存货跌价损失和其他流动资产减值损失，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
存货跌价损失	-50.17	-2,099.81	-550.94
其他流动资产减值损失	-14.80	-131.73	-466.12
合计	**-64.97**	**-2,231.55**	**-1,017.07**

7、资产处置收益

报告期内，标的公司资产处置收益分别为 13.02 万元、-2.55 万元和 0 万元，均系使用权资产处置收益。

8、营业外收入

报告期内，标的公司营业外收入分别为 3.23 万元、0.00 万元和 0.00 万元，金额较小，主要为与企业日常活动无关的违约金收入等。

9、营业外支出

报告期内，标的公司营业外支出分别为 0.13 万元、1.26 万元和 0.90 万元，金额较小，主要为违约赔偿金等零星支出。

（九）股份支付情况

为建立、健全激励机制，充分调动标的公司员工的工作积极性，标的公司成立以来，开展了多轮针对管理层及核心人员等员工的股权激励。报告期内，因实施股权激励产生的股份支付费用情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
管理费用	9,842.14	9,122.93	-
研发费用	28.26	1,829.51	1,743.27
合计	**9,870.39**	**10,952.43**	**1,743.27**

截至 2026 年 6 月 30 日，因标的公司已实施的股权激励，相应股份支付费用在服务期内分摊，报告期后尚待确认的股份支付金额为 23,611.42 万元。根据标的公司激励股权管理制度及激励股权授予协议的约定，在服务期内，如标的公司发生并购、重组或其他导致控制权变更之重大事项，则触发加速行权机制：服务期视为提前届满，激励对象届时所持全部尚未解锁股权一次性解锁，不受

前述分期解锁安排之限制。因此，除在服务期内进行分摊外，上述尚待确认的股份支付金额将在本次交易完成前加速行权，一次性确认全部股份支付费用，预计将对标的公司重组实施当年的经营业绩产生影响。

五、标的公司现金流量分析

报告期内，标的公司现金及现金等价物净增加额分别为 1,758.48 万元、18,164.27 万元和-19,926.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,472.61	15,654.39	7,519.04
投资活动产生的现金流量净额	6,263.53	2,351.57	-6,573.36
筹资活动产生的现金流量净额	-22,682.08	273.80	745.53
现金及现金等价物净增加额	**-19,926.94**	**18,164.27**	**1,758.48**

（一）报告期经营活动现金流量净额变动的原因

报告期内，标的公司经营活动现金流净额情况如下：

单位：万元

项 目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	9,059.89	57,299.60	44,741.93
收到的税费返还	-	67.95	996.07
收到其他与经营活动有关的现金	21.60	1,310.43	1,319.64
经营活动现金流入小计	9,081.49	58,677.97	47,057.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,780.75	32,633.89	29,883.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,524.72	7,455.44	6,756.01
支付的各项税费	968.81	874.40	181.64
支付其他与经营活动有关的现金	279.83	2,059.86	2,717.79
经营活动现金流出小计	12,554.10	43,023.58	39,538.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,472.61	15,654.39	7,519.04

报告期内，标的公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,519.04 万元、15,654.39 万元和-3,472.61 万元。2026 年 1-2 月，标的公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于：（1）2026 年 1-2 月经营周期相对较短，受客户短期付款节奏影响，部分主要客户信用期尚未届满，应收账款余额较高、回款相对滞后；（2）受半导体行业产能偏紧影响，标的公司为锁定产能、保障供应链

稳定，加大备货采购力度，相应采购付款支出增多；（3）本期内集中支付年度奖金。

报告期各期，标的公司经营活动产生的现金流量净额与净利润具体差异情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
净利润	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
加：资产减值准备	64.97	2,231.55	1,017.07
信用减值准备	179.46	52.57	138.82
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136.92	714.93	641.79
无形资产摊销	9.11	54.58	46.12
长期待摊费用摊销	5.43	26.29	11.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	2.55	-13.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-	-0.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-16.91	-310.96	-422.99
财务费用（收益以“－”号填列）	3.61	37.31	-77.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-5.83	23.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7.60	-125.10	-109.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	736.77	-1,010.09	993.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,276.12	-121.60	-675.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,908.57	5,140.05	-724.02
其他	9,870.39	10,952.43	1,743.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,472.61	15,654.39	7,519.04

（二）报告期投资活动现金流量净额变动的原因

报告期内，标的公司投资活动现金流量净额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
收回投资收到的现金	13,000.00	104,000.00	62,000.00
取得投资收益收到的现金	67.49	444.12	555.27
收到其他与投资活动有关的现金	2,261.77	3,879.36	-
投资活动现金流入小计	15,329.25	108,323.48	62,555.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.79	242.28	748.51
投资支付的现金	6,000.00	102,000.00	64,448.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,055.93	3,729.63	3,932.11
投资活动现金流出小计	9,065.72	105,971.91	69,128.62
投资活动产生的现金流量净额	6,263.53	2,351.57	-6,573.36

报告期内，标的公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,573.36 万元、2,351.57 万元和 6,263.53 万元。报告期内，标的公司投资活动的现金流出和流入主要系购买结构性存款以及结构性存款到期收回产生的现金流。

（三）报告期筹资活动现金流量净额变动的原因

报告期内，标的公司筹资活动现金流净额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
取得借款收到的现金	1,535.88	5,000.00	10,370.78
筹资活动现金流入小计	1,535.88	5,000.00	10,370.78
偿还债务支付的现金	25.00	4,100.00	9,270.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.76	134.23	98.34
支付其他与筹资活动有关的现金	24,172.20	491.97	256.13
筹资活动现金流出小计	24,217.96	4,726.20	9,625.25
筹资活动产生的现金流量净额	-22,682.08	273.80	745.53

报告期内，标的公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 745.53 万元、273.80 万元和-22,682.08 万元，2026 年 1-2 月支付其他与筹资活动有关的现金主要系支付的股份回购款。

六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排

本次交易完成后，标的公司将作为上市公司的全资子公司，纳入上市公司管理体系。上市公司将在认真客观地分析双方管理体系差异、尊重标的公司原

有企业文化的基础上，完善各项管理流程，对标的公司的业务、资产、财务、人员与机构等各方面进行整合，充分发挥双方产品、技术、研发、销售、采购各方面的协同效应，以尽快实现上市公司整体战略的推进实施。具体整合管控安排如下：

（一）业务整合

本次交易完成后，上市公司在保持标的公司相对独立运营的基础上，将标的公司统一纳入上市公司的战略发展规划当中，结合双方的能力优势边界，推动双方治理、管理协同，协同标的公司管理层共同参与上市公司董事会管理，加强双方在管理方面的能力整合，促使各项业务之间的互补、协同发展，从而增强上市公司的盈利能力和行业竞争力。同时，上市公司将发挥其上市公司平台、资金、股东等方面的优势，支持标的公司扩大业务规模、提高经营业绩。

标的公司与上市公司同属于功率半导体领域，双方在业务上具有极高的协同性，双方整合后，将完善上市公司在功率半导体的产品布局，共同构建应用场景更完善、技术规格更全面的综合功率半导体解决方案，在产品覆盖下游市场、产品技术、产品矩阵方面得以提升、强化。

（二）资产整合

本次交易完成后，标的公司作为上市公司的全资子公司，仍为独立的法人企业，上市公司原则上将保持标的公司资产的相对独立性，确保标的公司拥有与其业务经营有关的资产。同时，标的公司将按上市公司的管理标准，制定科学的资金使用计划，在上市公司董事会授权范围内行使其正常生产经营相关的权利，并遵照《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》以及上市公司《公司章程》等履行相应程序。

同时，上市公司将统筹协调资源，在符合法律法规及保持标的公司规范治理的情况下，合理安排上市公司与标的公司之间的资源分配与共享，优化配置资产，并充分利用其平台优势、资金优势支持标的公司业务的发展，协助其提高资产的使用效率，增强上市公司综合竞争力。

（三）财务整合

本次交易完成后，上市公司将继续按照上市公司治理要求对标的公司进行

整体的财务管控，将合规风控体系系统地植入标的公司，加强标的公司财务方面的内控建设和管理，完善财务部门机构、人员设置，搭建符合上市公司标准的财务管理体系，加强对成本费用核算、资金管控、税务等管理工作，统筹内部资金使用和外部融资，防范运营、财务风险。同时，上市公司将统筹标的公司的资金使用和外部融资，提高上市公司整体的资金使用效率，实现内部资源的统一管理和优化配置。

（四）人员整合

本次交易完成后，上市公司将在保持标的公司相对独立运营和现有经营管理团队稳定的基础上，将标的公司员工纳入上市公司统一管理体系，推动标的公司管理层及员工与上市公司形成利益长期共同体，提高团队积极性、创造力和稳定性，为上市公司战略发展目标的实现提供持续内在动力。

（五）机构整合

本次交易完成后，上市公司将继续保持标的公司现有内部组织机构相对独立稳定，通过执行董事、管理层实现对标的公司在重大战略布局、经营决策、人事任免等方面的决策与管理，全面防范内部控制风险。上市公司将基于对子公司的管控需要，完善管理部门职责设置和人员配置，优化管控制度，进一步完善标的公司内部控制制度、风险管控体系和业务流程，加强规范化管理。

综上，上市公司制定了切实可行的整合管控计划，能够实现对标的公司的有效整合，有利于充分发挥上市公司与标的公司的协同效应，增强上市公司的持续经营能力和市场竞争力。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析

1、本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响

上市公司与标的公司同属于功率半导体领域，本次交易首先可对上市公司功率半导体业务进行较大程度的补足，完善上市公司在功率半导体的产品布局，形成应用场景更完善、技术规格更全面的功率半导体产品体系，一方面功率 IC 产品由高可靠应用领域向高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、

安防、通信、服务器等全电子领域拓展，另一方面，在具体产品方面，交易后公司功率半导体产品实现从中大功率 AC-DC 电源管理 IC 向 DC-DC 电源管理 IC 的覆盖，电源管理 IC 产品矩阵更为全面。

同时，得益于双方产品同领域的特点，本次交易后双方共享客户资源与销售渠道的难度较低，借助标的公司较为丰富的客户积累，可以逐步推广导入上市公司的 SiC MOSFET 及工业电源用产品；标的公司丰富的电源管理产品还可以通过上市公司渠道和客户资源打入高可靠性需求市场，助力国产替代。

其次，同为 Fabless 模式的半导体设计企业，双方可共享工艺平台、优化供应链管理能力，并通过规模化采购提升对供应商的议价能力，降低晶圆及封装测试成本；借助标的公司在民用领域的规模化出货能力与上市公司的高可靠质量保证体系，优化库存管理与产能调配，更好地应对市场需求波动。

最后，本次交易完成后，双方运营管理系统、销售渠道、服务网络、各个工种和职能部门整合共享，有助于实现提质增效，另一方面，双方研发人员、资源相互共享，可实现在工艺优化、器件设计、封装测试技术等方面的技术迭代创新能力提升，有助于公司形成更完整的功率半导体系统级解决方案，从而提升公司的核心竞争力。

综上，本次交易完成后，上市公司主营业务未发生变化，不会因本次交易形成多主业经营，上市公司产品、技术、客户、运营等盈利能力驱动因素得以有效提升，有利于提升公司的核心竞争力，从而提高公司的持续经营能力。

2、本次交易完成后上市公司在未来经营中的优劣势

（1）未来经营中的优势

上市公司采用“功率器件+功率 IC”双轮驱动模式，功率器件覆盖硅基功率 MOSFET、集成快恢复的功率 MOSFET（FRMOS）、碳化硅基 MOSFET 和 JFET 等产品，电压等级覆盖 20V-3300V，积累了多项核心技术，其中 3 项达到国际先进水平，1 项达国内领先水平；功率 IC 业务主要系 PWM 控制 IC、栅极驱动 IC、智能开关控制 IC 等产品，重点为高可靠领域客户提供功率器件、功率控制和驱动 IC 的系统化解决方案，已形成 80 余款功率 IC 产品，基于与晶圆代工厂深度合作，根据晶圆代工厂的标准工艺可以调整优化工艺参数和流程，

以可靠的产品品质、优秀的产品性能和服务赢得客户，同时已开始利用高可靠性领域积累的技术向工控应用领域进行产品和市场拓展布局。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司产品谱系将得以完善，客户、渠道、技术等方面也将全面优化，可提升上市公司在功率半导体设计领域中的综合竞争力，提升持续经营能力，助力实现双方打造中国功率半导体领先企业的愿景，具体内容详见本报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（八）标的公司的核心竞争力”。

（2）未来经营中的劣势

本次交易完成后，上市公司需在业务、资产、财务、人员及机构方面对标的公司进行管控与整合，实现协同发展，若上市公司经营管理无法随发展相匹配，将一定程度上降低上市公司的运作效率，对上市公司业务的正常发展产生不利影响。

3、本次交易后上市公司偿债能力和财务安全性分析

（1）资产负债结构与偿债能力

根据德皓会计师出具的备考审阅报告，不考虑本次交易中募集配套资金的影响，本次交易完成后上市公司资产负债结构与偿债能力分析如下：

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日			
	交易前	比例	交易后（备考）	比例
流动资产	78,542.32	85.66%	132,127.45	47.46%
非流动资产	13,152.87	14.34%	146,243.80	52.54%
资产总计	**91,695.19**	**100.00%**	**278,371.24**	**100.00%**
流动负债	11,487.29	93.88%	100,722.35	92.58%
非流动负债	749.32	6.12%	8,070.49	7.42%
负债合计	**12,236.62**	**100.00%**	**108,792.84**	**100.00%**
资产负债率	13.34%		39.08%	
流动比率（倍）	6.84		1.31	
速动比率（倍）	5.40		1.05	

项目	2025 年 12 月 31 日			
	交易前	比例	交易后（备考）	比例
流动资产	80,077.02	85.58%	156,180.34	51.34%
非流动资产	13,492.31	14.42%	148,003.19	48.66%
资产总计	**93,569.33**	**100.00%**	**304,183.53**	**100.00%**
流动负债	12,431.18	95.31%	126,686.60	94.57%
非流动负债	611.64	4.69%	7,271.57	5.43%
负债合计	**13,042.82**	**100.00%**	**133,958.18**	**100.00%**
资产负债率	13.94%		44.04%	
流动比率（倍）	6.44		1.23	
速动比率（倍）	5.26		1.03	

本次交易前，截至 2026 年 2 月末，上市公司资产负债率为 13.34%，其中流动资产为 78,542.32 万元，占资产总额比例为 85.66%；非流动资产为 13,152.87 万元，占资产总额比例为 14.34%；流动负债为 11,487.29 万元，占负债总额比例为 93.88%，非流动负债为 749.32 万元，占负债总额比例为 6.12%。

根据德皓会计师出具的备考审阅报告，本次交易完成后，截至 2026 年 2 月末，上市公司资产负债率为 39.08%，其中流动资产为 132,127.45 万元，占资产总额比例为 47.46%；非流动资产为 146,243.80 万元，占资产总额比例为 52.54%；流动负债为 100,722.35 万元，占负债总额比例为 92.58%，非流动负债为 8,070.49 万元，占负债总额比例为 7.42%。

总体来看，鉴于标的公司资产规模及经营特点，本次交易完成后，上市公司资产总额、负债总额均较交易前原财务报表有所提升，资产负债率有所上升，整体仍处于较低水平；本次交易完成后流动比率和速动比率下降，主要系进行模拟备考合并时将本次交易应支付现金对价计入其他应付款，导致交易完成后流动负债规模增加。

（2）财务安全性分析

截至 2026 年 3 月末，上市公司货币资金余额为 28,257.00 万元、交易性金融资产账面价值 16,540.64 万元，资产负债率为 15.31%，资产负债率较低。本次交易需支付的部分现金对价拟通过本次交易的配套募集资金支付，给上市公

司带来财务压力处于可控范围，本次交易不会对上市公司财务安全性产生重大不利影响。

4、本次交易有关的企业合并的会计政策及会计处理对上市公司财务状况、持续经营能力的影响

本次交易以上市公司和标的公司的《审计报告》为基础，参考《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，按照“非同一控制下企业合并”的处理原则进行编制。本次交易有关的企业合并的会计政策及会计处理不会对上市公司财务状况、持续经营能力产生影响。

5、本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后续商誉减值的应对措施

（1）本次交易前上市公司和交易标的商誉情况

本次交易前，上市公司和标的公司均没有商誉。

（2）本次交易后上市公司商誉情况

截至评估基准日，根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2026〕17359 号），晶艺半导体股东全部权益账面值为 40,817.57 万元。依据金证评估出具的晶艺半导体评估报告，截至评估基准日，标的公司经评估后的股东全部权益为 165,000.00 万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定标的公司全部股东权益整体交易价格为 165,000.00 万元。

本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司全资子公司。备考财务报表以购买成本扣除 2026 年 2 月 28 日晶艺半导体可辨认净资产公允价值并考虑递延所得税影响后的差额，确认为备考合并财务报表中的商誉金额。以上对标的资产可辨认无形资产及公允价值的确认情况符合企业会计准则的规定。

根据《备考审阅报告》，截至 2026 年 2 月末，本次交易完成后上市公司商誉为 90,353.03 万元，占总资产、净资产的比例分别为 32.46%、53.28%。本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如本次拟收购的标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险；如发生商誉减值，则会减少上市公司当期损益。

（3）后续商誉减值的应对措施

上市公司将按期进行商誉减值测试，每年度按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定和中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关要求对商誉进行减值测试，并根据减值测试结果计提商誉减值准备。

本次交易完成后，上市公司将与标的公司进行资源整合，力争通过发挥协同效应，提高标的公司的持续经营能力和盈利能力，以持续保持标的公司的竞争力，尽可能地降低商誉减值风险。

6、本次交易对上市公司科研创新能力的影响

上市公司现有超过 80 人的专业研发团队，在硅基及碳化硅基功率器件研发、隔离拓扑电源管理控制、智能开关控制芯片等领域具有深厚积累，核心技术涵盖高压 MOSFET 寿命控制、短沟道 SiC MOSFET 沟道控制等国际先进技术；标的公司拥有超过 80 人的专业研发团队，具备资深模拟芯片设计、BCD 工艺开发与先进封装专家团队，在 SiP 集成封装、定制化磁器件设计、电机驱动控制、各类型拓扑结构电源管理控制等领域积累深厚。本次交易完成后，上市公司研发技术实力将显著提升，双方研发团队与技术储备将形成强大合力，通过核心技术共享及研发资源整合实现在工艺优化、器件设计、封装测试技术等方面深度协同，全面提高上市公司产品迭代创新能力。

上市公司专注于高可靠的功率器件和面向高可靠领域应用的功率 IC 的研发，这包含硅基 MOSFET 和第三代 SiC 化合物功率器件，以及大功率驱动和隔离拓扑的 PWM 控制 IC。标的公司擅长定制化功率 IC、功率模块 IPM 及 SiP 封装产品开发、低压电机驱动和非隔离拓扑电源管理 IC 开发。本次交易完成后，双方研发资源将实现互补协同，实现功率器件和功率 IC 联合优化，有助于公司形成更完整的功率半导体系统级解决方案，从而提升公司的核心竞争力。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景的分析

本次交易完成后，上市公司在保持标的公司相对独立运营的基础上，将标的公司统一纳入上市公司的战略发展规划当中，结合双方的能力优势边界，推动双方治理、管理协同，协同标的公司管理层共同参与上市公司董事会管理，加强双方在管理方面的能力整合，促使各项业务之间的互补、协同发展，从而

增强上市公司的盈利能力和行业竞争力。具体整合管控计划详见本报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排”。

本次交易完成后，上市公司与标的公司将在产品谱系、研发资源、供应链资源、销售渠道与服务网络等方面发挥协同效应，将有效增强上市公司的持续经营能力，提升市场竞争力和行业影响力。上市公司与标的公司的具体协同效应的发挥请详见“第一章 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（二）本次交易的目的”。

（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析

1、本次交易后，上市公司每股收益等财务指标分析

上市公司假设本次交易完成后的公司架构于 2025 年 1 月 1 日已经存在，且在报告期内未发生重大变化，以此假定的公司架构为会计主体编制了备考财务报表；德皓会计师对此进行了审阅并出具了《备考审阅报告》。

（1）本次交易前后资产负债结构的影响

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日			2025 年 12 月 31 日		
	交易前	交易后	变动比例	交易前	交易后	变动比例
流动资产	78,542.32	132,127.45	68.22%	80,077.02	156,180.34	95.04%
非流动资产	13,152.87	146,243.80	1011.88%	13,492.31	148,003.19	996.94%
资产总计	**91,695.19**	**278,371.24**	**203.58%**	**93,569.33**	**304,183.53**	**225.09%**
流动负债	11,487.29	100,722.35	776.82%	12,431.18	126,686.60	919.10%
非流动负债	749.32	8,070.49	977.04%	611.64	7,271.57	1088.86%
负债合计	**12,236.62**	**108,792.84**	**789.08%**	**13,042.82**	**133,958.18**	**927.06%**
归属于母公司股东的所有者权益	**78,408.79**	**168,528.61**	**114.94%**	**79,465.73**	**169,164.56**	**112.88%**

本次交易完成后，上市公司总资产、总负债和归属于母公司股东的所有者权益均有显著的增长。总资产增加主要系合并标的公司资产及非同控下收购形成商誉所致；总负债增加主要系本次交易的现金对价部分影响所致，但总体规模相对较小。

（2）本次交易前后对上市公司偿债能力的影响

项目	2026 年 2 月 28 日		2025 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后	交易前	交易后
流动比率（倍）	6.84	1.31	6.44	1.23
速动比率（倍）	5.40	1.05	5.26	1.03
资产负债率（合并）	13.34%	39.08%	13.94%	44.04%

注：上述财务指标的计算方法如下：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率=负债总额/资产总额。

本次交易完成后，上市公司资产负债率仍处于较低水平，虽然流动比率和速动比率下降，但仍处于较高水平，不存在重大偿债风险。

（3）本次交易前后对上市公司盈利能力的影响分析

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日			2025 年 12 月 31 日		
	交易前	交易后	变动比例	交易前	交易后	变动比例
营业收入	3,408.97	11,407.15	234.62%	25,456.78	57,609.35	126.30%
营业成本	2,268.70	7,271.69	220.52%	17,076.29	37,835.60	121.57%
营业利润	-1,080.23	-10,488.72	/	-9,850.12	-26,031.25	/
利润总额	-1,080.23	-10,489.62	/	-9,849.87	-26,032.26	/
净利润	-1,069.68	-10,444.23	/	-9,222.27	-23,688.20	/
归属于母公司所有者的净利润	-1,057.83	-10,432.38	/	-9,078.26	-23,544.19	/
归属于母公司股东的净利润（剔除股份支付、PPA 影响）	-1,057.83	1,885.93	/	-9,078.26	2,094.68	/
基本每股收益（元/股）	-0.14	-1.03	/	-1.24	-2.33	/
基本每股收益（元/股）（剔除股份支付、PPA 影响）	-0.14	0.19	/	-1.24	0.21	/

上市公司产品谱系将得以完善，客户、渠道、技术等方面也将全面优化，可提升上市公司在功率半导体设计领域中的综合竞争力，提升持续经营能力，营业收入规模显著增长。根据上市公司经审计的财务数据及经审阅的备考财务数据，本次交易完成后，上市公司 2025 年和 2026 年 1-2 月的利润水平有所下降，主要系标的公司计提股份支付费用以及本次交易 PPA 折旧摊销所致。若剔除上述影响，本次交易完成后，上市公司 2025 年和 2026 年 1-2 月的归属于母

公司所有者的净利润为 2,094.68 万元、1,885.93 万元，盈利能力得到较大幅度提升。

后续，随着标的公司业务的发展以及与上市公司之间协同效应的发挥，本次交易预计能够使得上市公司盈利能力逐步上升，增厚上市公司的每股收益。本次交易中，上市公司与业绩承诺方签署了《业绩补偿协议》，具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（六）设置业绩承诺及补偿安排”。根据上述业绩补偿约定，本次交易完成后，上市公司未来经营业绩将有所提升。此外，为应对每股收益摊薄的风险，提升上市公司未来的持续经营能力，为上市公司股东创造更多的盈利和稳定的回报，上市公司采取了填补摊薄即期回报的相关措施。

2、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，标的公司未来的资本性支出将纳入上市公司未来的年度计划、发展规划中统筹考虑。同时，上市公司将继续利用资本平台的融资功能，通过自有资金、再融资、银行贷款等多种方式筹集所需资金，满足未来资本性支出的需求。

3、职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及职工安置方案。

4、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确认，上述交易成本不会对上市公司造成不利影响。

第十章 财务会计信息

一、标的公司财务会计资料

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日和 2026 年 2 月 28 日的资产负债表和 2024 年度、2025 年度以及 2026 年 1-2 月的利润表和现金流量表进行了审计，并出具了天健审〔2026〕17359 号无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司报告期内芯片自研业务及芯片定制化量产业务的模拟财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2026〕17360 号模拟审计报告。

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
货币资金	24,352.74	37,542.55	19,633.80
交易性金融资产	-	13,030.21	15,034.22
应收账款	8,760.98	5,353.58	4,416.12
预付款项	787.25	655.41	682.40
其他应收款	352.80	353.49	299.84
存货	10,253.20	10,919.02	11,343.59
一年内到期的非流动资产	3,257.97	3,240.51	-
其他流动资产	5,751.13	5,130.77	6,072.38
流动资产合计	**53,516.07**	**76,225.54**	**57,482.34**
固定资产	1,068.10	1,108.88	1,374.20
在建工程	1.29	9.72	-
使用权资产	1,182.99	77.73	308.80
无形资产	129.78	138.89	189.05
长期待摊费用	45.50	50.94	72.76
递延所得税资产	508.02	515.61	390.52
其他非流动资产	4.01	172.72	3,206.28
非流动资产合计	**2,939.69**	**2,074.49**	**5,541.60**
资产总计	**56,455.75**	**78,300.03**	**63,023.95**
短期借款	5,543.50	4,003.02	4,105.15
应付票据	2,953.13	2,884.25	-

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付账款	3,322.18	3,497.95	2,656.61
合同负债	134.33	125.06	75.32
应付职工薪酬	799.54	3,018.06	2,156.49
应交税费	477.99	789.64	21.00
其他应付款	54.42	24,254.71	88.10
一年内到期的非流动负债	1,136.53	1,071.86	236.28
其他流动负债	16.06	14.83	9.79
流动负债合计	**14,437.67**	**39,659.39**	**9,348.73**
租赁负债	913.21	-	57.62
递延收益	287.30	333.34	22.01
非流动负债合计	**1,200.51**	**333.34**	**79.63**
负债合计	**15,638.18**	**39,992.73**	**9,428.36**
所有者权益：	-	-	-
实收资本	5,313.41	5,313.41	5,313.41
资本公积	82,279.36	72,408.96	61,456.53
减：库存股	24,145.83	24,145.83	-
其他综合收益	198.03	272.88	383.49
盈余公积	1,481.35	1,481.35	1,481.35
未分配利润	-24,308.75	-17,023.49	-15,039.19
归属于母公司所有者权益合计	40,817.57	38,307.30	53,595.59
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	**40,817.57**	**38,307.30**	**53,595.59**
负债和所有者权益总计	**56,455.75**	**78,300.03**	**63,023.95**

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	**8,106.74**	**34,971.68**	**25,493.82**
减：营业成本	3,365.89	13,104.43	8,699.86
税金及附加	46.47	200.19	60.46
销售费用	285.48	1,954.98	1,803.48
管理费用	10,393.56	12,187.67	2,346.14
研发费用	926.78	8,452.32	8,844.17

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
财务费用	4.25	-131.75	-254.53
其中：利息费用	25.49	140.01	115.32
利息收入	38.04	338.22	333.65
加：其他收益	192.71	1,269.18	1,575.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5.83	-23.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16.91	310.96	422.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179.46	-52.57	-138.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64.97	-2,231.55	-1,017.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2.55	13.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-6,950.52**	**-1,496.85**	**4,826.24**
加：营业外收入	-	-	3.23
减：营业外支出	0.90	1.26	0.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-6,951.41**	**-1,498.11**	**4,829.34**
减：所得税费用	333.85	486.18	-96.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-7,285.27**	**-1,984.29**	**4,925.79**
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,285.27	-1,984.29	4,925.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	**-74.85**	**-110.61**	**70.43**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74.85	-110.61	70.43
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	**-7,360.12**	**-2,094.90**	**4,996.23**
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,360.12	-2,094.90	4,996.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,059.89	57,299.60	44,741.93
收到的税费返还	-	67.95	996.07
收到其他与经营活动有关的现金	21.60	1,310.43	1,319.64
经营活动现金流入小计	9,081.49	58,677.97	47,057.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,780.75	32,633.89	29,883.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,524.72	7,455.44	6,756.01
支付的各项税费	968.81	874.40	181.64
支付其他与经营活动有关的现金	279.83	2,059.86	2,717.79
经营活动现金流出小计	12,554.10	43,023.58	39,538.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,472.61	15,654.39	7,519.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	13,000.00	104,000.00	62,000.00
取得投资收益收到的现金	67.49	444.12	555.27
收到其他与投资活动有关的现金	2,261.77	3,879.36	-
投资活动现金流入小计	15,329.25	108,323.48	62,555.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.79	242.28	748.51
投资支付的现金	6,000.00	102,000.00	64,448.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,055.93	3,729.63	3,932.11
投资活动现金流出小计	9,065.72	105,971.91	69,128.62
投资活动产生的现金流量净额	6,263.53	2,351.57	-6,573.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	1,535.88	5,000.00	10,370.78
筹资活动现金流入小计	1,535.88	5,000.00	10,370.78
偿还债务支付的现金	25.00	4,100.00	9,270.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.76	134.23	98.34
支付其他与筹资活动有关的现金	24,172.20	491.97	256.13
筹资活动现金流出小计	24,217.96	4,726.20	9,625.25
筹资活动产生的现金流量净额	-22,682.08	273.80	745.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-35.78**	**-115.49**	**67.27**

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
五、现金及现金等价物净增加额	**-19,926.94**	**18,164.27**	**1,758.48**
加：期初现金及现金等价物余额	33,817.91	15,653.64	13,895.15
六、期末现金及现金等价物余额	**13,890.97**	**33,817.91**	**15,653.64**

（四）分部模拟财务报表

1、分部模拟财务报表的编制原则

标的公司通过拆分调整编制的芯片自研业务、芯片定制化量产业务两个业务板块的财务报表，需符合企业会计准则以及其他相关法律、法规和规章的要求，会计政策遵循一贯性原则。因此，标的公司在通过拆分调整编制两个业务板块的财务报表时，所选用的会计政策与标的公司合并财务报表采用的会计政策保持一致。

标的公司在拆分调整编制两个业务板块的财务报表时，应以标的公司既定的业务架构和产品类别为前提，以实际发生的交易或事项为依据，以历史成本计价原则和收入与相关成本、费用配比原则为主要编制基础，按照报告期内各会计期间各业务板块的业务实质进行拆分编制，同时对标的公司的资产、负债、收入、成本、费用等进行划分，从而确定纳入两个业务板块各自的财务报表。

2、分部模拟资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
货币资金	14,806.46	9,546.27	24,352.74	21,658.30	15,884.25	37,542.55	10,131.04	9,502.76	19,633.80
交易性金融资产	-	-	-	7,517.13	5,513.08	13,030.21	7,757.66	7,276.56	15,034.22
应收账款	3,846.04	4,914.94	8,760.98	2,258.32	3,095.27	5,353.58	1,320.44	3,095.68	4,416.12
预付款项	558.77	228.48	787.25	374.91	280.49	655.41	447.73	234.67	682.40
其他应收款	294.63	58.17	352.80	282.88	70.61	353.49	271.06	28.78	299.84
存货	10,253.20	-	10,253.20	10,919.02	-	10,919.02	11,343.59	-	11,343.59

项目	2026 年 2 月 28 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一年内到期的非流动资产	1,980.84	1,277.12	3,257.97	1,869.45	1,371.06	3,240.51	-	-	-
其他流动资产	28.34	5,722.79	5,751.13	-	5,130.77	5,130.77	1.81	6,070.57	6,072.38
流动资产合计	**31,768.29**	**21,747.77**	**53,516.07**	**44,880.01**	**31,345.53**	**76,225.54**	**31,273.32**	**26,209.03**	**57,482.34**
固定资产	698.53	369.57	1,068.10	725.26	383.62	1,108.88	900.84	473.36	1,374.20
在建工程	1.29	-	1.29	9.72	-	9.72	-	-	-
使用权资产	649.22	533.76	1,182.99	38.45	39.29	77.73	148.84	159.96	308.80
无形资产	107.16	22.62	129.78	111.18	27.71	138.89	148.42	40.62	189.05
长期待摊费用	41.53	3.97	45.50	44.76	6.18	50.94	66.56	6.20	72.76
递延所得税资产	340.52	167.50	508.02	351.32	164.30	515.61	228.93	161.58	390.52
其他非流动资产	2.20	1.81	4.01	85.61	87.11	172.72	1,570.66	1,635.61	3,206.28
非流动资产合计	**1,840.45**	**1,099.24**	**2,939.69**	**1,366.29**	**708.20**	**2,074.49**	**3,064.26**	**2,477.34**	**5,541.60**
资产总计	**33,608.75**	**22,847.01**	**56,455.75**	**46,246.30**	**32,053.73**	**78,300.03**	**34,337.58**	**28,686.37**	**63,023.95**
短期借款	5,543.50	-	5,543.50	4,003.02	-	4,003.02	4,105.15	-	4,105.15
应付票据	2,129.65	823.48	2,953.13	2,217.83	666.42	2,884.25	-	-	-
应付账款	1,570.49	1,751.68	3,322.18	1,520.68	1,977.28	3,497.95	1,069.73	1,586.88	2,656.61
合同负债	134.33	-	134.33	125.06	-	125.06	75.32	-	75.32
应付职工薪酬	746.71	52.83	799.54	2,585.33	432.73	3,018.06	1,858.01	298.48	2,156.49
应交税费	60.91	417.08	477.99	202.67	586.97	789.64	10.83	10.16	21.00
其他应付款	27.27	27.15	54.42	11,996.71	12,258.00	24,254.71	32.00	56.10	88.10

项目	2026 年 2 月 28 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一年内到期的非流动负债	1,063.91	72.62	1,136.53	1,035.96	35.90	1,071.86	113.88	122.39	236.28
其他流动负债	16.06	-	16.06	14.83	-	14.83	9.79	-	9.79
流动负债合计	**11,292.82**	**3,144.85**	**14,437.67**	**23,702.08**	**15,957.30**	**39,659.39**	**7,274.71**	**2,074.02**	**9,348.73**
租赁负债	501.17	412.04	913.21	-	-	-	27.77	29.85	57.62
递延收益	287.30	-	287.30	333.34	-	333.34	22.01	-	22.01
非流动负债合计	**788.47**	**412.04**	**1,200.51**	**333.34**	**-**	**333.34**	**49.78**	**29.85**	**79.63**
负债合计	**12,081.29**	**3,556.89**	**15,638.18**	**24,035.43**	**15,957.30**	**39,992.73**	**7,324.49**	**2,103.87**	**9,428.36**
归属于母公司所有者权益合计	21,527.46	19,290.12	40,817.57	22,210.88	16,096.42	38,307.30	27,013.09	26,582.50	53,595.59
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益合计	**21,527.46**	**19,290.12**	**40,817.57**	**22,210.88**	**16,096.42**	**38,307.30**	**27,013.09**	**26,582.50**	**53,595.59**
负债和所有者权益总计	**33,608.75**	**22,847.01**	**56,455.75**	**46,246.30**	**32,053.73**	**78,300.03**	**34,337.58**	**28,686.37**	**63,023.95**

3、分部模拟利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月			2025 年度			2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
一、营业收入	**4,929.07**	**3,177.67**	**8,106.74**	**20,175.50**	**14,796.18**	**34,971.68**	**13,154.03**	**12,339.78**	**25,493.82**
减：营业成本	3,365.89	-	3,365.89	13,104.43	-	13,104.43	8,699.86	-	8,699.86
税金及附加	28.25	18.22	46.47	115.49	84.70	200.19	31.20	29.26	60.46

项目	2026 年 1-2 月			2025 年度			2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
销售费用	273.86	11.62	285.48	1,705.33	249.65	1,954.98	1,545.94	257.54	1,803.48
管理费用	6,477.56	3,916.00	10,393.56	7,776.39	4,411.27	12,187.67	1,876.58	469.56	2,346.14
研发费用	805.62	121.16	926.78	7,832.93	619.39	8,452.32	8,296.94	547.22	8,844.17
财务费用	12.43	-8.18	4.25	-19.77	-111.99	-131.75	-82.79	-171.74	-254.53
其中：利息费用	25.34	0.15	25.49	137.01	3.00	140.01	108.05	7.26	115.32
利息收入	23.13	14.91	38.04	195.12	143.10	338.22	172.16	161.49	333.65
加：其他收益	137.65	55.05	192.71	920.67	348.52	1,269.18	1,285.25	290.60	1,575.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	3.36	2.47	5.83	-12.37	-11.60	-23.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10.28	6.63	16.91	179.39	131.57	310.96	218.26	204.73	422.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84.18	-95.28	-179.46	-49.98	-2.58	-52.57	-43.24	-95.58	-138.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50.17	-14.80	-64.97	-2,099.81	-131.73	-2,231.55	-550.94	-466.12	-1,017.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-1.26	-1.29	-2.55	6.27	6.74	13.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-6,020.96**	**-929.55**	**-6,950.52**	**-11,386.94**	**9,890.09**	**-1,496.85**	**-6,310.46**	**11,136.70**	**4,826.24**
加：营业外收入	-	-	-	0.00	-	0.00	3.23	-	3.23

项目	2026 年 1-2 月			2025 年度			2024 年度		
	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计	芯片自研业务	芯片定制化量产业务	合计
减：营业外支出	0.90	-	0.90	1.26	-	1.26	0.13	-	0.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-6,021.86**	**-929.55**	**-6,951.41**	**-11,388.21**	**9,890.09**	**-1,498.11**	**-6,307.36**	**11,136.70**	**4,829.34**
减：所得税费用	10.80	323.05	333.85	-122.38	608.56	486.18	-64.33	-32.12	-96.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-6,032.66**	**-1,252.61**	**-7,285.27**	**-11,265.82**	**9,281.53**	**-1,984.29**	**-6,243.03**	**11,168.82**	**4,925.79**

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料

根据德皓会计师出具的备考审阅报告，上市公司最近一年及一期的主要备考财务报表信息如下：

（一）备考报表编制假设及编制基础

德皓会计师出具的《备考审阅报告》的编制假设及编制基础如下：

本备考合并财务报表根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令（第 230 号））《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—一上市公司重大资产重组（2025 年修订）》（证监会公告（2025）5 号）的相关规定编制，仅供本公司实施本次重组事项使用。因此，本备考合并财务报表可能不适用于其他用途。

本备考合并财务报表仅包括 2026 年 2 月 28 日、2025 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2026 年 1-2 月、2025 年度的备考合并利润表；不包括 2026 年 1-2 月、2025 年度的备考合并现金流量表，2026 年 1-2 月、2025 年度的备考合并股东权益变动表以及与金融工具相关的风险以及公允价值的披露等财务报表附注；也不包括比较财务报表、本公司个别财务报表及相关财务报表附注。本备考合并财务报表不是一份完整的财务报表，也不包含一份完整财务报表所应披露的所有会计政策及相关附注。

除下述事项外，本备考合并财务报表根据备考报表所述的会计政策编制。这些会计政策符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求。本备考合并财务报表以持续经营为基础编制。

本备考合并财务报表假设本次资产重组事项已于报告期期初 2025 年 1 月 1 日（以下简称“模拟购买日”）实施完成，即上述资产重组交易完成后的架构在本备考合并财务报表报告期最早期初 2025 年 1 月 1 日已经存在。

本公司根据下述方法编制本备考合并财务报表：

1、合并成本

由于本公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式完成本次资产重组。本公司在编制备考合并财务报表时，将重组方案确定的支付对

价人民币 165,000 万元作为备考合并财务报表 2025 年 1 月 1 日的购买成本。根据拟发行的股份总数和发行价格计算确定的支付对价 901,161,461.61 元分别增加股本 27,736,570.00 元和资本公积 873,424,891.61 元（其中发行股份分期支付的部分假设于 2025 年 1 月 1 日已全部支付），拟支付现金金额确定的支付对价 748,838,538.39 元，相应确认为其他应付款。公司为募集配套资金而发行股份的部分不在备考合并财务报表中列示。

2、标的公司可辨认资产和负债于模拟购买日（2025 年 1 月 1 日）的计量

晶艺半导体公司的各项资产、负债在模拟购买日的初始计量基于各项资产、负债于评估基准日（2026 年 2 月 28 日）公允价值进行调整确定 2025 年 1 月 1 日晶艺半导体各项可辨认资产、负债的公允价值，并以此为基础在备考合并财务报表中根据本附注三所述的会计政策和会计估计进行后续计量。本次重组交易基准日的公允价值业经金证（上海）资产评估有限公司评估，并出具了金证评报字[2026]A0554 号资产评估报告。

3、商誉

本次资产重组为非同一控制下企业合并，上述合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产于 2026 年 2 月 28 日公允价值份额后的差额人民币 903,530,265.73 元在本备考合并财务报表中确认为商誉。同时假定商誉在各期间未发生减值，2025 年 1 月 1 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 2 月 28 日各时点保持一致。

4、权益项目列示

鉴于备考合并财务报表之特殊编制目的，本备考合并财务报表的股东权益按“归属于母公司股东权益”和“少数股东权益”列示，不再区分“股本”、“资本公积”、“其他综合收益”、“盈余公积”和“未分配利润”等明细项目。同时备考合并财务报表仅列示有限备考合并注释，未披露与金融工具相关的风险、分部报告等相关信息。

5、备考合并财务报表未考虑本次资产重组事项而产生的费用、支出和税收等影响。

6、其他

本公司 2025 年度财务报表业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了德皓审字[2026]00001119 号审计报告，2026 年 1-2 月财务报表业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。晶艺半导体公司 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审[2026]17359 号审计报告。本备考财务报表以前述经审计、审阅的财务报表为基础，并按照本编制基础中所述情况进行调整后，采用本附注中所述的重要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行编制。

本备考合并财务报表的编制基础具有可能影响信息可靠性的固有限制，未必真实反映假设本次交易已于 2025 年 1 月 1 日完成的情况下本公司于 2026 年 2 月 28 日、2025 年 12 月 31 日的合并财务状况，以及 2026 年 1-2 月、2025 年度的合并经营成果。

（二）备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,227.11	65,753.13
交易性金融资产	31,587.50	32,703.00
应收票据	2,354.65	2,588.44
应收账款	20,733.39	16,995.09
应收款项融资	365.24	463.43
预付款项	1,379.67	1,033.06
其他应收款	2,193.75	2,193.97
存货	26,707.51	25,641.41
一年内到期的非流动资产	3,257.97	3,240.51
其他流动资产	6,320.67	5,568.30
流动资产合计	**132,127.45**	**156,180.34**
非流动资产：		
其他权益工具投资	1,019.57	1,019.57
固定资产	10,052.37	10,390.17
在建工程	603.64	645.25
使用权资产	1,467.01	360.34
无形资产	39,659.14	42,102.96

项目	2026 年 2 月 28 日	2025 年 12 月 31 日
商誉	90,353.03	90,353.03
长期待摊费用	214.30	241.75
递延所得税资产	2,368.27	2,199.95
其他非流动资产	506.46	690.17
非流动资产合计	**146,243.80**	**148,003.19**
资产总计	**278,371.24**	**304,183.53**
流动负债：		
短期借款	7,003.60	4,963.71
应付票据	4,582.72	4,902.02
应付账款	8,882.89	9,136.72
预收款项	665.83	620.10
合同负债	547.43	511.88
应付职工薪酬	1,405.44	4,365.31
应交税费	565.41	875.68
其他应付款	74,979.12	99,174.74
一年内到期的非流动负债	1,272.91	1,219.91
其他流动负债	816.99	916.55
流动负债合计	**100,722.35**	**126,686.60**
非流动负债：		
租赁负债	1,037.90	109.74
长期应付款	165.00	103.00
递延收益	618.47	606.38
递延所得税负债	6,249.13	6,452.45
非流动负债合计	8,070.49	7,271.57
负债合计	**108,792.84**	**133,958.18**
所有者权益（或股东权益）：		
归属于母公司股东权益合计	**168,528.61**	**169,164.56**
少数股东权益	1,049.79	1,060.79
股东权益合计	**169,578.40**	**170,225.35**
负债和股东权益总计	**278,371.24**	**304,183.53**

（三）备考合并利润表

单位：万元

项 目	2026 年 1-2 月	2025 年
一、营业总收入	**11,407.15**	**57,609.35**
减：营业成本	7,271.69	37,835.60
营业税金及附加	52.58	252.40
销售费用	623.65	4,195.09
管理费用	11,709.31	20,548.77
研发费用	2,072.42	17,043.22
财务费用	8.27	-267.98
其中：利息费用	30.74	174.94
利息收入	38.04	511.15
加：其他收益	382.20	1,764.73
投资收益（损失以“-”号填列）	12.79	829.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67.84	349.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-209.16	-1.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-411.62	-6,973.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-10,488.72**	**-26,031.25**
加：营业外收入		2.50
减：营业外支出	0.90	3.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-10,489.62**	**-26,032.26**
减：所得税费用	-45.38	-2,344.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-10,444.23**	**-23,688.20**
（一）归属于母公司所有者的净利润	-10,432.38	-23,544.19
（二）少数股东损益	-11.86	-144.01

第十一章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争的情况及避免同业竞争的措施

（一）本次交易完成后，上市公司与公司控股股东、实际控制人及其关联企业之间的同业竞争的情况

本次交易完成前，除锴威特及其下属企业外，上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他关联企业目前均未从事与锴威特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，锴威特与其控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，锴威特的控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易不会导致锴威特与其控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业之间产生同业竞争。

（二）相关承诺

本次交易完成后，为避免同业竞争问题，维护上市公司及其股东的合法权益，促进上市公司长远稳定发展，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见报告书“第一章 本次交易概况”之“六、交易各方重要承诺”相关内容。

二、关联交易情况

（一）本次交易构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，易坤及控制的晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来将成为上市公司持股 5%以上的股东，根据《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）标的公司关联方及关联关系

按照《公司法》、《上市规则》、《企业会计准则》及中国证监会的有关规定，报告期内，标的公司的关联方和关联关系如下：

1、直接或者间接控制标的公司的自然人、法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系	一致行动关系
1	易坤	标的公司控股股东、实际控制人，直接持有标的公司 13.68%的股权，并通过晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来控制标的公司 28.98%股权，合计控制标的公司 42.67%股权	-
2	晶格共智	直接持有标的公司 11.99%股权，系标的公司员工持股平台	易坤担任执行事务合伙人
3	晶格共创	直接持有标的公司 4.50%股权，系标的公司员工持股平台	晶艺众合担任晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来执行事务合伙人
4	晶格共赢	直接持有标的公司 4.30%股权，系标的公司员工持股平台	
5	晶格顶峰	直接持有标的公司 4.20%股权，系标的公司员工持股平台	
6	晶格未来	直接持有标的公司 4.00%股权，系标的公司员工持股平台	
7	晶艺众合	担任晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来执行事务合伙人	易坤持有 100%股权并担任执行董事兼总经理

2、直接或间接持有标的公司 5%以上股权的自然人

序号	关联方名称	关联关系
1	YA XU	直接持有标的公司 10.29%股权
2	曾鸣	直接持有标的公司 4.00%股权，与曾岳琦系父子关系，与谭清系夫妻关系，与曾岳琦、谭清合计持有标的公司 5%以上股权
3	曾岳琦	直接持有标的公司 4.00%股权，与曾鸣系父子关系，与谭清系母子关系，与曾鸣、谭清合计持有标的公司 5%以上股权
4	谭清	间接持有标的公司 4.67%股权，与曾鸣系夫妻关系、与曾岳琦系母子关系，与曾鸣、曾岳琦合计持有标的公司 5%以上股权
5	李六军	直接持有标的公司 3.46%股权，通过晶格共智、晶格共赢、晶格顶峰、晶格共创、晶艺求精、晶艺共治、华天集团、天利投资间接持有标的公司 4.01%股权，合计持有标的公司 5%以上股权
6	唐鹏飞	高鹏翼盛和高鹏联盛实际控制人，间接控制标的公司 5%以上股权

3、标的公司董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	易坤	董事长、总经理
2	李六军	董事、副总经理
3	薛峰	董事、副总经理、董事会秘书
4	凌风	董事
5	邓永成	董事
6	曹剑锋	监事
7	陈国栋	销售副总

序号	关联方名称	关联关系
8	苏鹏飞	财务负责人

4、1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员

与上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括实际控制人、董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母均为标的公司关联方。

5、直接持有标的公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致行动人

序号	关联方名称	关联关系
1	高鹏翼盛	直接持有标的公司 9.30%股权
2	高鹏联盛	直接持有标的公司 2.62%股权，与高鹏翼盛的执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司，与高鹏翼盛合计持有标的公司 5%以上股权
3	芯联启辰	直接持有标的公司 5.36%股权

6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

序号	关联方名称	关联关系
1	易坤	担任晶艺众合执行董事兼总经理

7、由 1 至 6 所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

由 1 至 6 所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，亦构成标的公司关联方。

8、间接持有标的公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致行动人

序号	关联方名称	关联关系
1	天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）	持有高鹏翼盛 99.998%财产份额，间接持有标的公司 5%以上股权
2	SAIF EAGLE FUND GROUP LTD.	持有天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）99.995%财产份额，间接持有标的公司 5%以上股权
3	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司	担任高鹏翼盛、高鹏联盛执行事务合伙人，间接控制标的公司 5%以上股权
4	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	担任芯联启辰执行事务合伙人，间接控制标的公司 5%以上股权

9、标的公司的控股子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	香港晶艺	晶艺半导体全资子公司

10、其他关联方

报告期内，与标的公司存在关联交易或关联方往来的其他关联方如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	天水华天科技股份有限公司	李六军曾经担任董事（2023-05 卸任）
2	华天科技（昆山）电子有限公司	李六军曾经担任董事（2023-11 卸任）
3	上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙）	标的公司的历史股东，与标的公司股东芯联启辰均受芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）控制

（三）报告期内标的公司的关联交易

报告期内，标的公司发生的关联交易具体情况如下：

1、采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
华天科技（昆山）电子有限公司	封装测试服务	-	-	1,686.46
天水华天科技股份有限公司	封装测试服务	-	-	250.02
合计		-	-	**1,936.48**

注 1：华天科技（昆山）电子有限公司于 2024 年 11 月开始不再为标的公司关联方，此处数据为 2024 年 1-11 月采购金额。
注 2：天水华天科技股份有限公司于 2024 年 5 月开始不再为标的公司关联方，此处数据为 2024 年 1-5 月采购金额。

2024 年度，标的公司向关联方采购商品、接受劳务的金额为 1,936.48 万元，采购内容主要为封装测试服务，相关交易采用市场化定价原则，具备公允性和商业合理性。

2、接受关联方担保

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
易坤	3,001.52	2025.11.26	2028.11.25	否
易坤	975.59	2025.07.08	2028.07.08	否
易坤	1,005.44	2025.06.18	2028.06.18	否
易坤	4,489.66	2025.07.15	2028.07.15	否

3、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月	2025 年度	2024 年度
关键管理人员薪酬	208.16	1,410.09	1,056.05

4、关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2026.2.28	2025.12.31	2024.12.31
其他应付款	高鹏翼盛	-	6,903.00	-
	高鹏联盛	-	1,947.00	-
	上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙）	-	3,750.00	-
小计		-	**12,600.00**	-

注：上述其他应付款系标的公司回购相关股东股权的股权回购款，标的公司于 2025 年与相关股东签署协议，于 2026 年完成了款项支付。

（四）本次交易对上市公司关联交易的影响

根据上市公司 2025 年度、2026 年 1-2 月的财务报表，以及德皓会计师出具的《备考审阅报告》，上市公司本次交易前后关联交易数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-2 月		2025 年度	
	本次交易前	本次交易后（备考）	本次交易前	本次交易后（备考）
向关联方销售商品、提供劳务金额	10.25	10.25	596.11	596.11
营业收入	3,408.97	11,407.15	25,456.78	57,609.35
占营业收入比例	0.30%	0.09%	2.34%	1.03%

本次交易完成后，上市公司及其子公司与关联方的持续性关联交易主要为向关联方出售商品/提供劳务等。本次交易不会新增上市公司关联交易，但上市公司收入规模会增加，使得关联交易占比会有所下降。该部分关联交易具备商业合理性，定价具有公允性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。整体而言，本次交易不会新增上市公司关联交易，不会对上市公司独立性造成影响。

（五）本次交易完成后规范关联交易的措施

本次交易前，上市公司已依照《公司法》《证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对关联交易的原则、关联人和关联关系、

关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。为减少及规范将来可能存在的关联交易，维护上市公司以及中小股东的合法权益，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、易坤及其一致行动人已出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，具体内容参见报告书“第一章 本次交易概况”之“六、交易各方重要承诺”相关内容。

第十二章 风险因素分析

投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易方案尚需满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，可能导致本次交易暂停、中止或取消，该等因素包括但不限于：

1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕消息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易的内幕消息进行内幕交易而导致本次交易被暂停、中止或取消的可能；

2、在本次交易过程中，市场环境的变化和监管机构的审核要求可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被取消的可能；

3、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。

若本次交易因上述某种原因或几种原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动，则面临交易定价及其他条件可能需要重新调整的风险。提请广大投资者注意相关风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（二）交易审批风险

本次交易尚需满足多项条件及取得相关主管部门批准后方可实施，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：

1、上市公司股东会审议批准本次交易方案；

2、本次交易尚需经上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复；

3、相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。

上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

（三）标的公司评估增值较高的风险

根据金证评估出具的《评估报告》，于评估基准日（2026 年 2 月 28 日）经采用市场法和资产基础法评估并最终选取市场法评估结果作为评估结论，晶艺半导体股东全部权益评估值为 165,000.00 万元，较合并报表归属于母公司所有者权益增值 124,182.43 万元，增值率 304.24%。

虽然金证评估在评估过程中严格参照相关评估准则或指引进行评估，但仍可能出现因政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，导致实际情况与评估假设不一致并最终导致标的资产的评估值与实际情况不符的风险。

（四）标的公司未能实现业绩承诺的风险

根据上市公司与本次交易的业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，业绩承诺方对本次交易完成后晶艺半导体的芯片定制化量产业务的净利润以及芯片自研业务的收入情况分别进行了业绩承诺。标的公司生产经营受宏观经济、市场环境、行业竞争等多方面因素的影响，若业绩承诺期间出现影响标的公司生产经营的不利因素，则本次交易存在业绩承诺无法实现的风险。

（五）业绩补偿无法覆盖全部交易对价的风险

本次交易中标的资产合计交易作价为 165,000.00 万元，其中业绩承诺方因本次交易取得对价金额为 99,750.30 万元，其补偿金额上限不超过业绩承诺方于本次交易中取得的股份对价的税后净额，应补偿股份的总数不超过业绩承诺方就本次交易获得税后股份对价对应的股份数。因此，若标的公司在本次交易后的经营业绩出现波动，存在业绩补偿金额无法覆盖全部交易对方获取交易对价的风险。

（六）未来上市公司商誉减值的风险

本次交易前，截至 2026 年 2 月 28 日，上市公司商誉账面价值为 0 万元。

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，上市公司会在合并日就本次交易合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分确认商誉。根据德皓会计师出具的《备考审阅报告》，假设公司在 2025 年 1 月 1 日起将标的资产纳入合并报表范围，截至 2026 年 2 月 28 日上市公司商誉账面价值为 90,353.03 万元，占总资产、净资产的比例分别为 32.46%、53.28%（未考虑募集配套资金）。假定配套募集资金后上市公司净资产增加 9.01 亿元，则本次交易完成后上市公司账面商誉占总资产、净资产的比例约为 24.52%、34.80%。

本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如本次拟收购的标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险；如发生商誉减值，则会减少上市公司当期损益。上市公司将按期进行商誉减值测试，并根据减值测试结果计提商誉减值准备。本次交易完成后，上市公司将与标的公司进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高标的公司的竞争力，以便尽可能地降低商誉减值风险。

（七）募集配套资金不达预期的风险

作为本次交易的交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否通过交易所审核及证监会注册尚存在不确定性。此外，若公司股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金不能足额募集乃至募集失败的风险，如募集配套资金不达预期，则本次交易的现金对价将由上市公司以自筹或自有资金支付，存在增加上市公司经营压力的风险。

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）宏观经济和行业政策波动的风险

半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，其下游市场需求受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，存在一定的周期性。未来，如果宏观经济环境持续低迷，或者下游市场需求发生波动，将可能对标的公司的经

营业绩产生不利影响。未来，如果宏观经济环境持续低迷，或者消费电子、工业、通信等下游市场需求发生波动，将对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

标的公司是一家采用 Fabless 经营模式的功率半导体企业，标的公司所在的功率半导体行业受国家政策鼓励影响发展迅速，一方面，行业内企业数量增加迅速，另一方面行业内企业不断结合自身优势拓展市场。国内功率半导体的市场参与者数量不断增多，标的公司面临的市场竞争逐渐加剧。尽管标的公司在技术、市场等方面具有竞争优势，但若未来标的公司无法正确把握市场动态及行业发展态势，无法结合市场需求进行相应产品创新、开发，则标的公司的业务和经营业绩将受到一定影响。

（三）产品和技术迭代升级的风险

标的公司所处行业具有技术产品更新要求高、资金投入大、研发周期长等特点。为保证产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，标的公司在研发方面投入大量资源。如果标的公司未来研发投入不足，或不能紧跟行业的前沿需求或者不能对应用领域和终端市场进行准确的判断，快速识别并响应客户需求的变化，技术及产品升级跟不上技术变革的步伐，标的公司将面临核心竞争力下降的风险，从而对标的公司的生产经营造成重大不利影响。

目前标的公司与授权方合作稳定，但若因授权相关各方自身原因导致授权被终止，将会影响标的公司定制化量产业务的后续开展，并对标的公司未来业绩产生不利影响。

（四）芯片定制化量产知识产权授权、业务持续性风险

半导体行业属于技术密集型行业，涉及众多知识产权，标的公司在芯片定制化量产业务中涉及使用知识产权授权，标的公司芯片定制化量产业务以相关授权为基础，利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，为服务器、通信等领域的客户提供专业的芯片量产服务。未来，如果受地缘政治、市场变化等因素影响，可能使标的公司芯片定制化量产业务使用的知识产权授权无法继续，从而对相关业务的持续性、稳定性及合规性产生风险，进而对标的公司业绩产生不利影响。

（五）核心技术人员流失的风险

标的公司所处的功率半导体行业属于技术密集型、人才密集型行业，优秀的研发人员团队对标的公司主营业务的可持续发展至关重要。目前标的公司主要管理层及研发团队在芯片设计领域深耕多年，拥有丰富的产品研发经验。随着市场竞争的加剧，集成电路设计人才的竞争也日趋激烈。若标的公司不能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面临核心技术人员流失的风险，并对标的公司生产经营和持续研发能力产生不利影响。

（六）核心技术泄露的风险

标的公司自成立以来始终专注于功率半导体产品的技术研发，组建了专业的研发技术团队，并经过自主研发，形成多项核心技术，在产品生产各环节发挥了关键的作用。标的公司通过申请专利、规范研发过程管理等措施对自主知识产权进行保护，防止核心技术泄露，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露，也不能完全排除未来因员工违反相关协议等因素导致的技术秘密泄露风险。

（七）主要客户集中的风险

报告期内，标的公司对前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入的比例为 63.23%、65.26%和 73.96%，主要为业内知名的电子元器件经销商，终端客户为国内外知名家电、安防、服务器等行业企业。未来若标的公司主要客户或终端品牌厂商的经营情况和资信状况发生不利变化，主要客户经营、采购战略发生较大变化，部分主要客户需求减少，可能导致标的公司收入增速有所放缓甚至下滑。

（八）主要供应商集中的风险

标的公司采取 Fabless 的运营模式，专注于芯片设计环节，将芯片制造、封装测试委托给专业厂商。标的公司采购主要包括晶圆和封装测试，晶圆制造商以及封装测试供应商较为集中。报告期内，标的公司对前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 84.01%、81.84%和 92.35%。

若突发重大灾害等事件，或者由于晶圆制造商和封装测试厂等供应商产能不足、自身管理水平欠佳等原因影响标的公司产品的正常生产和交付进度，而

标的公司未能及时拓展新的供应商进行有效替代，将对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（九）自研业务毛利率下滑的风险

报告期内，标的公司主营业务由自研业务和芯片定制化量产业务两部分构成，其中芯片定制化量产业务采用净额法核算，自研业务采用总额法核算；报告期各期，标的公司自研业务毛利率分别为 33.86%、34.98%和 31.71%，标的公司毛利率波动受市场竞争变化、客户及产品结构变化、原材料价格波动等因素影响。如果未来芯片定制化量产业务受行业及合作伙伴采购策略变动影响发生不利变动，或者标的公司自研业务因市场供需或竞争环境变化增长不及预期，标的公司存在毛利率下滑风险。

（十）存货跌价的风险

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 11,343.59 万元、10,919.02 万元和 10,253.20 万元，占各期末总资产的比例分别为 18.00%、13.95%和 18.16%。报告期各期末，标的公司存货跌价准备金额分别为 460.70 万元、1,895.35 万元和 1,824.41 万元，占存货余额的比例分别为 3.90%、14.79%和 15.11%，存货跌价计提比例较高。如果标的公司无法准确根据市场及客户需求进行合理备货，将增加因市场环境变化或产品无法满足客户需求等情况出现的存货跌价的风险，进而对标的公司业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）上市公司股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市场投机行为、投资者心理预期等诸多因素影响。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。为此，公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照相关法律法规及公司内部制度的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，

以利于投资者做出正确的投资决策。提请投资者关注相关风险。

（二）不可抗力的风险

公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第十三章 其他重要事项

一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况

标的公司报告期内不存在被其股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变化，上市公司不存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

二、本次交易对于上市公司负债结构的影响

本次交易对于上市公司负债结构的影响请参见本报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司持续经营的能力的影响分析”。

三、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况

根据《重组管理办法》第十四条有关规定：

“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至本报告书签署日，公司在本次重组前 12 个月内不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规章制度，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，上市公司的控制权结构未发生变化，上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。

五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明

（一）利润分配及现金分红政策

本次交易完成后，上市公司将继续重视对社会公众股东的合理投资回报，维护社会公众股东权益。上市公司现行的《公司章程》对利润分配及现金分红政策如下：

“第一百六十二条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。其中，现金股利政策目标为剩余股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，年末资产负债率高于 60%，当年经营性现金流为负等情形之一的，可以不进行利润分配。

（一）公司的利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，可以满足公司正常经营和持续发展且无重

大投资计划或重大现金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（二）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，制定以下差异化的现金分红政策：

1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

（3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40%。

公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于 30%的，应说明下列情况：

（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

（2）留存未分配利润的预计用途及收益情况；

（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（四）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（六）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

（七）独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

（八）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（九）公司年度盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配方案的，应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十）审计委员会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（十一）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（十二）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1．因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

2．因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

3．因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年

度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 30%；

4．证券监督管理部门、证券交易所等主管部门规定的其他事项。

（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）本次交易后上市公司的现金分红政策

本次交易完成后，上市公司将继续执行现行有效的现金分红相关政策。同时，上市公司将根据中国证监会、上交所及相关法律法规的要求，不断完善利润分配制度。

六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

（一）公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

为防止关于本次交易的内幕消息泄露，上市公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密制度，严格限定相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下：

1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人信息及筹划过程，制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

3、在上市公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。

4、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密

义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司股票。

综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。

（二）本次交易的内幕信息知情人自查期间

本次交易内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即2025年9月16日至2026年8月5日。

（三）本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易内幕信息知情人自查范围包括：

1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

2、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等相关知情人员；

3、交易对方及其主要负责人及相关知情人员；

4、相关中介机构及具体业务经办人员；

5、前述1至4项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人及其配偶、父母、成年子女。

（四）本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

上市公司将于本报告书经董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司提交上述核查对象买卖股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。

七、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明

公司股票于2026年3月16日开市起停牌，2026年2月5日、2026年3月13日分别为本次交易首次公告前第21个交易日、第1个交易日，本次交易首次公告日前连续20个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数波

动情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日（2026 年 2 月 5 日）	停牌前第 1 个交易日（2026 年 3 月 13 日）	涨跌幅
上市公司（元/股）	39.68	45.75	15.30%
上证综指（000001.SH）	4,075.92	4,095.45	0.48%
集成电路指数（884953.WI）	8,790.68	8,575.98	-2.44%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			14.82%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅			17.74%

本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计上涨 15.30%，同期上证综指（000001.SH）累计上涨 0.48%，集成电路指数（884953.WI）累计下跌 2.44%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，并及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报上海证券交易所，并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，上市公司已在本报告书之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”中进行了相关风险提示。

八、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意

见，上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及上市公司董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划详见本报告书“重大事项提示”之“五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排

本次交易对中小投资者权益保护的安排详见本报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

十、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息

上市公司严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息。

第十四章 对本次交易的结论性意见

一、独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《重组管理办法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项召开独立董事专门会议，并发表审核意见如下：

“（一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，独立董事专门会议针对公司的实际情况进行了自查，认为公司本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）公司本次交易的方案符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）根据上市公司、标的公司经审计的2025年度财务数据以及本次交易作价情况，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易前后，上市公司实际控制人均为丁国华先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条相关规定，本次交易不构成重组上市。

（五）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，标的公司实际控制人易坤控制的上市公司股份比例将超过5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（六）为实施本次交易相关事宜，同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，同意公司与本次交

易的业绩承诺方签署附生效条件的《业绩补偿协议》。

（七）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的各项条件。

（八）本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。

（九）本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。

（十）本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

（十一）公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

（十二）在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的相关标准，不存在异常波动的情况。

（十三）在本次交易前 12 个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

（十四）公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段应当履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司就本次交易提交的法律文件合法有效。

（十五）公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公

开或泄露本次交易相关信息的情况。

（十六）同意批准与本次交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告、资产评估报告，同意公司董事会将前述相关审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告、资产评估报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

（十七）本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（十八）本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的评估报告结论具有公允性，交易价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（十九）公司在本次交易中的聘请行为合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（二十）本次交易摊薄公司即期回报的影响及填补措施具有合理性，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺合法有效。

（二十一）同意公司制定的《苏州锴威特半导体股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。

（二十二）同意公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交易一切相关事宜。

综上，作为公司独立董事，我们认为公司本次交易符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形；我们一致同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。”

二、独立财务顾问意见

公司聘请华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，根据华泰联合证券出具的《独立财务顾问报告》，华泰联合证券认为：

“1、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。本次交易遵守了国家相关法律、法规的要求，已取得现阶段必要的批准和授权，并履行了必要的信息披露程序；

2、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

3、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

4、本次交易标的资产的定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

5、本次交易所涉及的资产权属清晰，在各方严格履行协议的情况下，交易对方所持有的标的资产转让给上市公司将不存在法律障碍；

6、本次交易不涉及债权债务处理或变更事项；

7、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

8、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

9、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构；

10、短期来看，本次交易后，上市公司备考报表中资产规模、营业收入、归属于母公司股东的所有者权益均有所增加，有利于增强上市公司抗风险能力；备考报表中基本每股收益有所减少，主要原因系标的公司报告期内计提股份支付以及本次交易 PPA 折旧摊销所致，剔除上述影响后，本次交易后基本每股收益有所增长。长期来看，随着标的公司的业务发展与业绩释放，规模效应逐步凸显，标的公司将持续提升其盈利水平，有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力；

11、本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

12、上市公司最近一年财务报告由注册会计师出具标准无保留意见的审计

报告；

13、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

14、本次发行股份及支付现金所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在各方严格履行协议的情况下，能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

15、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市；

16、本次交易约定的资产交付安排不会导致上市公司在本次交易后无法及时获得标的资产的风险，标的资产交付安排相关的违约责任切实有效；

17、本次交易构成关联交易；

18、上市公司对于本次交易摊薄即期回报的分析具有合理性，并制定了填补可能被摊薄即期回报的措施，上市公司实际控制人及其一致行动人以及董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益；

19、本次交易的业绩承诺补偿安排具备可行性及合理性；

20、本次募集配套资金符合相关法规规定；

21、上市公司在本次交易中的聘请行为合法合规，不存在其他有偿聘请除独立财务顾问、法律顾问、审计及备考审阅机构、评估机构、境外法律顾问彭李律师行有限法律责任合伙与植德律师事务所有限法律责任合伙联营之外的其他第三方的行为；本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人的行为；上述行为符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。”

三、法律顾问意见

公司聘请德恒律师作为本次交易的法律顾问，根据德恒律师出具的《法律意见书》，德恒律师认为：

“1、本次重组的方案符合中国法律、法规的规定，合法有效；

2、本次重组的相关方均依法有效存续，具备实施本次重组的主体资格；

3、本次重组的相关方签署的相关协议符合中国法律、法规的规定，在各协议约定的生效条件成就时生效；

4、本次重组涉及的有关事项已获得了现阶段必要的授权和批准，尚需取得锴威特股东会审议通过、上交所的审核通过以及中国证监会的注册；

5、本次重组不构成重组上市，符合《重组办法》等法律法规规定的相关实质性条件；

6、本次重组的交易标的权属清晰，交易对方以其所持标的资产认购锴威特的股份不存在法律障碍；

7、本次重组构成关联交易，已经按照相关中国法律法规和锴威特公司章程对关联交易的规定履行信息披露义务和审议批准程序；

8、本次重组不涉及债权债务的处理及员工安置；

9、截至本《法律意见》出具之日，锴威特已依法履行了本次重组现阶段的法定信息披露和报告义务；

10、本次重组的证券服务机构具备为本次重组提供服务的适当资格；

11、在取得所有应获得的批准、核准后，锴威特实施本次重组不存在重大法律障碍。”

第十五章 中介机构及有关经办人员

一、独立财务顾问

机构名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
电话	010-56839300
传真	010-56839400
项目经办人	牟晶、李明晟、刘华山、王鹏、李元江、张蓝月、罗浩、许匡吉、吴劳欣、金华东

二、法律顾问

机构名称	北京德恒律师事务所
事务所负责人	王丽
地址	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办律师	张露文、王丹、孙宁

三、审计机构

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	葛徐
地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
电话	0571—88216888
传真	0571—88216999
签字注册会计师	夏均军、翁淑丹

四、审阅机构

机构名称	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	赵焕琪
地址	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
电话	010-68278880
传真	010-68278880
签字注册会计师	夏利忠、余晓炜

五、资产评估机构

机构名称	金证（上海）资产评估有限公司
机构负责人	林立
地址	上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T3 座 7 楼
电话	021-63081130
传真	021-63081131
签字资产评估师	蒋霄骑、冯赛平

第十六章 备查文件

一、备查文件

（一）公司关于本次交易的相关董事会决议；

（二）公司独立董事关于本次交易的独立董事意见；

（三）公司与交易对方签署的相关协议；

（四）华泰联合证券出具的关于本次交易的独立财务顾问报告；

（五）德恒律师出具的关于本次交易的法律意见书；

（六）天健会计师出具的关于本次交易的审计报告；

（七）德皓会计师出具的关于本次交易的备考审阅报告；

（八）金证评估出具的关于本次交易的资产评估报告。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前，于下列地点查阅本报告书和有关备查文件：

苏州锴威特半导体股份有限公司

办公地址：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室

联系人：严泓

电话：0512-58979950

第十七章 声明与承诺

一、上市公司全体董事声明

本公司与全体董事承诺《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

丁国华	罗 寅	陈 锴
严 泓	彭占凯	陈佳庆
秦 舒	朱光忠	张洪发

苏州锴威特半导体股份有限公司

年 月 日

二、上市公司审计委员会声明

本公司全体审计委员会委员承诺《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签名：

张洪发	朱光忠	丁国华

苏州锴威特半导体股份有限公司

年　月　日

三、上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签字：

谭在超	刘娟娟

苏州锴威特半导体股份有限公司

年　月　日

四、独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）及本公司经办人员同意《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

江 禹

财务顾问主办人：

李明晟	刘华山	牟 晶

财务顾问协办人：

王 鹏	李元江	罗 浩
张蓝月	许匡吉	吴劳欣
金华东		

华泰联合证券有限责任公司

年　月　日

五、法律顾问声明

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）及本所经办律师同意苏州锴威特半导体股份有限公司在《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

负 责 人：_____
王 丽

经办律师：_____　_____　_____
张露文　　王 丹　　孙 宁

北京德恒律师事务所

年　月　日

六、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）及其摘要，确认重组报告书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕17359号）和《模拟审计报告》（天健审〔2026〕17360号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州锴威特半导体股份有限公司在重组报告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

夏均军　　翁淑丹

天健会计师事务所负责人：

葛　徐

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年　月　日

七、审阅机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），确认重组报告书与本所出具的《苏州锴威特半导体股份有限公司审阅报告》（德皓核字[2026]00001765 号）等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州锴威特半导体股份有限公司在重组报告书中引用的上述审阅报告的内容无异议，确认重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

赵焕琪

签字注册会计师：

夏利忠　　余晓炜

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇二六年八月　日

八、资产评估机构声明

金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“本公司”）及本公司经办资产评估师同意《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本公司出具的资产评估报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司签字资产评估师审阅，确认《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：_____

林　立

资产评估师：　　_____　　_____

蒋霄骑　　冯赛平

金证（上海）资产评估有限公司

年　月　日

（本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司

年　月　日

附件 交易对方穿透核查情况

截至 2026 年 2 月 28 日（员工持股平台穿透情况为截至本报告书签署日），本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方穿透至最终出资人（含自然人、上市公司、新三板挂牌公司、国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金以及公募资产管理产品等，且直接或间接在标的公司持股比例高于 0.01%）的具体情况如下：

1、成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	易坤	2021-06-24	57.21%	货币	自有或自筹资金
1-2	李伊珂	2021-06-24	11.00%	货币	自有或自筹资金
1-3	李六军	2023-07-13	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-4	薛峰	2023-09-21	6.67%	货币	自有或自筹资金
1-5	陈国栋	2023-07-13	3.33%	货币	自有或自筹资金
1-6	曹红	2021-04-16	1.67%	货币	自有或自筹资金
1-7	郑儒富	2026-03-20	1.83%	货币	自有或自筹资金
1-8	周枭	2026-03-20	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-9	谢攀	2026-03-20	0.97%	货币	自有或自筹资金
1-10	罗君轶	2023-07-13	0.75%	货币	自有或自筹资金
1-11	张旭东	2026-03-20	0.59%	货币	自有或自筹资金
1-12	李冬	2026-03-20	0.58%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-13	朱赫	2023-07-13	0.43%	货币	自有或自筹资金
1-14	谢锦红	2023-07-13	0.67%	货币	自有或自筹资金
1-15	陈坤	2023-07-13	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-16	乔文虎	2025-01-06	0.42%	货币	自有或自筹资金
1-17	李炜	2025-01-06	0.42%	货币	自有或自筹资金
1-18	袁丕根	2025-01-06	0.42%	货币	自有或自筹资金
1-19	康少硕	2023-07-13	0.15%	货币	自有或自筹资金
1-20	廖先强	2023-07-13	0.15%	货币	自有或自筹资金
1-21	杨艺	2023-07-13	0.15%	货币	自有或自筹资金
1-22	邓涛	2023-07-13	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-23	冉滔	2023-07-13	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-24	曹剑峰	2023-07-13	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-25	谢金才	2023-07-13	0.08%	货币	自有或自筹资金
1-26	张德华	2023-07-13	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-27	刘玉娇	2023-07-13	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-28	肖安静	2023-07-13	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-29	邹敏	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-30	赵书琴	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-31	宋鹏	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-32	胡丽娜	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-33	詹磊	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-34	唐杨	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-35	李艳秋	2023-07-13	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-36	王志豪	2025-01-06	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-37	雷雪	2023-07-13	0.04%	货币	自有或自筹资金
1-38	辜巧阳	2023-07-13	0.04%	货币	自有或自筹资金
1-39	李文平	2023-07-13	0.04%	货币	自有或自筹资金
1-40	邓清风	2023-07-13	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-41	郭雨来	2023-07-13	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-42	唐俊菲	2023-07-13	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-43	赵巧凤	2023-07-13	0.02%	货币	自有或自筹资金
1-44	廖燕	2023-07-13	0.02%	货币	自有或自筹资金
1-45	郁中秋	2023-07-13	0.02%	货币	自有或自筹资金

2、成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	成都晶艺众合科技有限公司	2021-02-23	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	易坤	2018-07-16	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	易坤	2025-05-26	25.10%	货币	自有或自筹资金
1-3	曹剑峰	2021-09-02	2.76%	货币	自有或自筹资金
1-4	彭波	2021-09-02	3.11%	货币	自有或自筹资金
1-5	杨斯龙	2021-09-02	3.11%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-6	廖雷	2021-09-02	2.36%	货币	自有或自筹资金
1-7	杨方涵	2021-09-02	2.24%	货币	自有或自筹资金
1-8	吴春燕	2021-09-02	1.73%	货币	自有或自筹资金
1-9	胡磊	2021-09-02	1.76%	货币	自有或自筹资金
1-10	江时龙	2021-09-02	1.65%	货币	自有或自筹资金
1-11	岳佳乐	2021-09-02	1.48%	货币	自有或自筹资金
1-12	刘晓勇	2021-09-02	1.39%	货币	自有或自筹资金
1-13	许世松	2021-09-02	1.38%	货币	自有或自筹资金
1-14	李玉波	2021-09-02	1.39%	货币	自有或自筹资金
1-15	张远军	2021-09-02	1.32%	货币	自有或自筹资金
1-16	李明军	2021-09-02	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-17	张林	2021-09-02	1.14%	货币	自有或自筹资金
1-18	王华美	2021-09-02	1.13%	货币	自有或自筹资金
1-19	杨森	2021-09-02	1.13%	货币	自有或自筹资金
1-20	罗利群	2021-09-02	1.07%	货币	自有或自筹资金
1-21	李金	2021-09-02	1.05%	货币	自有或自筹资金
1-22	黄晓梅	2021-09-02	1.11%	货币	自有或自筹资金
1-23	苏凤英	2021-09-02	0.99%	货币	自有或自筹资金
1-24	周晓瑜	2021-09-02	0.93%	货币	自有或自筹资金
1-25	彭万诚	2021-09-02	0.91%	货币	自有或自筹资金
1-26	周艳玲	2021-09-02	0.91%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-27	包涵	2026-03-19	0.89%	货币	自有或自筹资金
1-28	杨银	2021-09-02	0.74%	货币	自有或自筹资金
1-29	郭瑞	2021-09-02	0.67%	货币	自有或自筹资金
1-30	黄瑶	2021-09-02	0.57%	货币	自有或自筹资金
1-31	唐鑫	2021-09-02	0.38%	货币	自有或自筹资金
1-32	陆文翠	2023-07-13	1.12%	货币	自有或自筹资金
1-33	乐天意	2023-07-13	0.84%	货币	自有或自筹资金
1-34	杨童	2023-07-13	1.07%	货币	自有或自筹资金
1-35	李俊海	2023-07-13	0.89%	货币	自有或自筹资金
1-36	罗皓寰	2023-07-13	0.67%	货币	自有或自筹资金
1-37	杨静	2023-07-13	2.00%	货币	自有或自筹资金
1-38	苏鹏飞	2023-07-13	8.89%	货币	自有或自筹资金
1-39	陈国栋	2023-07-13	8.89%	货币	自有或自筹资金
1-40	李六军	2023-07-13	8.89%	货币	自有或自筹资金

3、成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	成都晶艺众合科技有限公司	2021-02-23	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	易坤	2018-07-16	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	李六军	2023-07-14	35.59%	货币	自有或自筹资金
1-3	易坤	2026-03-13	13.44%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-4	喻尊	2021-09-01	7.58%	货币	自有或自筹资金
1-5	唐锐	2021-09-01	6.42%	货币	自有或自筹资金
1-6	包涵	2021-09-01	6.28%	货币	自有或自筹资金
1-7	李建明	2021-09-01	5.80%	货币	自有或自筹资金
1-8	赵怡	2021-09-01	4.42%	货币	自有或自筹资金
1-9	张旭东	2021-09-01	3.47%	货币	自有或自筹资金
1-10	李莉双	2021-09-01	2.79%	货币	自有或自筹资金
1-11	李冬	2021-09-01	2.56%	货币	自有或自筹资金
1-12	谢攀	2021-09-01	2.42%	货币	自有或自筹资金
1-13	韩晓波	2023-07-14	2.33%	货币	自有或自筹资金
1-14	周枭	2023-07-14	2.33%	货币	自有或自筹资金
1-15	周强	2023-07-14	0.60%	货币	自有或自筹资金
1-16	陈星朋	2023-07-14	0.60%	货币	自有或自筹资金
1-17	何倩	2023-07-14	0.47%	货币	自有或自筹资金
1-18	陈锐	2023-07-14	0.42%	货币	自有或自筹资金
1-19	王倩	2023-09-14	0.42%	货币	自有或自筹资金
1-20	杨晓霞	2023-07-14	0.39%	货币	自有或自筹资金
1-21	崔涛	2023-07-14	0.39%	货币	自有或自筹资金
1-22	曹剑峰	2021-09-01	0.30%	货币	自有或自筹资金

4、成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	成都晶艺众合科技有限公司	2020-11-18	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	易坤	2018-07-16	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	易坤	2023-12-21	37.60%	货币	自有或自筹资金
1-3	李六军	2023-12-21	16.57%	货币	自有或自筹资金
1-4	薛峰	2023-12-21	19.05%	货币	自有或自筹资金
1-5	苏鹏飞	2023-12-21	2.38%	货币	自有或自筹资金
1-6	张斌	2023-12-21	4.76%	货币	自有或自筹资金
1-7	李铭驹	2023-12-21	4.76%	货币	自有或自筹资金
1-8	徐勇	2023-12-21	4.05%	货币	自有或自筹资金
1-9	刘烁	2023-12-21	3.57%	货币	自有或自筹资金
1-10	魏超	2023-12-21	0.24%	货币	自有或自筹资金
1-11	许江华	2023-12-21	0.36%	货币	自有或自筹资金
1-12	张德华	2023-12-21	0.19%	货币	自有或自筹资金
1-13	郁中秋	2023-12-21	0.33%	货币	自有或自筹资金
1-14	李翠	2023-12-21	0.38%	货币	自有或自筹资金
1-15	陈玉曦	2023-12-21	0.14%	货币	自有或自筹资金
1-16	高鹏杰	2023-12-21	0.95%	货币	自有或自筹资金
1-17	李祖勇	2023-12-21	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-18	王梦瑶	2023-12-21	0.14%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-19	孙载略	2023-12-21	0.26%	货币	自有或自筹资金
1-20	刁希森	2023-12-21	0.26%	货币	自有或自筹资金
1-21	杨述添	2023-12-21	0.14%	货币	自有或自筹资金
1-22	伊嘉爽	2023-12-21	0.14%	货币	自有或自筹资金
1-23	阳静	2023-12-21	0.24%	货币	自有或自筹资金
1-24	江威	2023-12-21	0.38%	货币	自有或自筹资金
1-25	罗茂林	2023-12-21	0.29%	货币	自有或自筹资金
1-26	于海伟	2023-12-21	0.71%	货币	自有或自筹资金
1-27	韩晓波	2026-06-24	0.48%	货币	自有或自筹资金

5、成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	成都晶艺众合科技有限公司	2018-08-08	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	易坤	2018-07-16	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	易坤	2021-11-26	74.00%	货币	自有或自筹资金
1-3	凌风	2021-11-26	25.00%	货币	自有或自筹资金

6、成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	喻尊	2026-02-28	10.08%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-2	郑儒富	2026-02-28	19.33%	货币	自有或自筹资金
1-3	李铭驹	2026-02-28	12.00%	货币	自有或自筹资金
1-4	李冬	2026-02-28	10.08%	货币	自有或自筹资金
1-5	周枭	2026-02-28	8.57%	货币	自有或自筹资金
1-6	李建明	2026-02-28	6.67%	货币	自有或自筹资金
1-7	赵怡	2026-02-28	5.34%	货币	自有或自筹资金
1-8	刘玉娇	2026-02-28	3.33%	货币	自有或自筹资金
1-9	廖雷	2026-02-28	2.33%	货币	自有或自筹资金
1-10	周重甫	2026-06-29	2.33%	货币	自有或自筹资金
1-11	李六军	2026-02-28	2.02%	货币	自有或自筹资金
1-12	李金	2026-02-28	2.00%	货币	自有或自筹资金
1-13	曹剑峰	2026-02-28	1.51%	货币	自有或自筹资金
1-14	包涵	2026-02-28	1.51%	货币	自有或自筹资金
1-15	朱赫	2026-02-28	1.51%	货币	自有或自筹资金
1-16	杨斯龙	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-17	廖先强	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-18	张旭东	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-19	黄瑶	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-20	杨婷婷	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-21	杨静	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-22	于海伟	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-23	张林	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-24	许世松	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-25	胡丽娜	2026-02-28	1.00%	货币	自有或自筹资金

7、成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-1	唐锐	2026-02-28	5.34%	货币	自有或自筹资金
1-2	徐勇	2026-02-28	13.33%	货币	自有或自筹资金
1-3	周宗辉	2026-02-28	12.00%	货币	自有或自筹资金
1-4	张斌	2026-02-28	10.08%	货币	自有或自筹资金
1-5	黄晓梅	2026-02-28	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-6	刘烁	2026-02-28	7.56%	货币	自有或自筹资金
1-7	许江华	2026-02-28	6.67%	货币	自有或自筹资金
1-8	李明军	2026-02-28	6.67%	货币	自有或自筹资金
1-9	江时龙	2026-02-28	3.33%	货币	自有或自筹资金
1-10	李佩遥	2026-02-28	3.02%	货币	自有或自筹资金
1-11	彭波	2026-02-28	2.33%	货币	自有或自筹资金
1-12	林秦仪	2026-02-28	2.02%	货币	自有或自筹资金
1-13	胡磊	2026-02-28	1.67%	货币	自有或自筹资金

编号	名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	出资来源
1-14	李六军	2026-02-28	1.54%	货币	自有或自筹资金
1-15	陆文翠	2026-02-28	1.51%	货币	自有或自筹资金
1-16	吴春燕	2026-02-28	1.51%	货币	自有或自筹资金
1-17	张德华	2026-02-28	1.36%	货币	自有或自筹资金
1-18	肖安静	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-19	谢攀	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-20	谢金才	2026-02-28	1.33%	货币	自有或自筹资金
1-21	唐杨	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-22	苏凤英	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-23	魏超	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-24	江威	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-25	罗君轶	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-26	罗利群	2026-02-28	1.01%	货币	自有或自筹资金

8、深圳市融芯科技有限公司

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	王丹荔	2019-01-02	99.00%	货币	自有资金
1-2	刘群英	2019-01-02	1.00%	货币	自有资金

9、天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	天津赛富高鹏和辉股权投资合伙企业（有限合伙）	2021-11-11	99.998%	货币	自有资金
1-1-1	SAIF Eagle Fund Group Ltd.	2021-11-09	99.995%	货币	自有资金
1-1-1-1	SAIF Eagle Suparna Fund L.P.	2021-10-27	50.00%	货币	自有资金
1-1-1-1-1	Cypress Star Holdings	2021-06-09	100.00%	货币	自有资金
1-1-1-1-1-1	Lau Chun Shun	2021-01-04	100.00%	货币	自有资金
1-1-1-1-2	SAIF Eagle Suparna Ltd. /GP	2021-10-27	0.00%	货币	自有资金
1-1-1-1-2-1	唐鹏飞	2021-06-07	50.00%	货币	自有资金
1-1-1-1-2-2	Lau Chun Shun	2021-06-08	50.00%	货币	自有资金
1-1-1-2	SAIF Eagle Fund L.P.	2021-10-27	50.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-1	Candiac Limited	2021-10-20	100.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-1-1	TAN QING	2018-11-13	100.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-2	SAIF Eagle View Ltd./GP	2020-09-04	0.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-2-1	唐鹏飞	2020-07-28	70.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-2-2	Luna Harvest Limited	2020-07-28	30.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-2-2-1	阎焱	2020-07-22	95.00%	货币	自有资金
1-1-1-2-2-2-2	Wan Pak Tao	2018-02-27	5.00%	货币	自有资金
1-1-2	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司/GP	2023-10-27	0.005%	货币	自有资金
1-1-2-1	唐鹏飞	2018-07-02	90.00%	货币	自有资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1-2-2	邓永成	2018-07-02	10.00%	货币	自有资金
1-2	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司/GP（同 1-1-2）	2023-10-27	0.002%	货币	自有资金

10、天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	陈森	2023-12-08	99.96%	货币	自有资金
1-2	宁波梅山保税港区瑞信高鹏投资有限公司	2023-12-08	0.04%	货币	自有资金
1-2-1	唐鹏飞	2018-07-02	90.00%	货币	自有资金
1-2-2	邓永成	2018-07-02	10.00%	货币	自有资金

11、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	阎焱	2024-10-14	98.94%	货币	自有资金
1-2	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）	2016-07-25	1.06%	货币	自有资金
1-2-1	阎安生	2019-02-22	35.00%	货币	自有资金
1-2-2	赵钧	2014-03-10	24.00%	货币	自有资金
1-2-3	金凤春	2014-03-10	20.00%	货币	自有资金
1-2-4	谢学军	2014-03-10	20.00%	货币	自有资金
1-2-5	天津喜玛拉雅投资咨询有限公司	2014-03-10	1.00%	货币	自有资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-2-5-1	赵钧	2014-05-27	50.00%	货币	自有资金
1-2-5-2	李佳	2014-05-27	50.00%	货币	自有资金

12、上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	芯联股权投资（杭州）有限公司	2024-12-23	50.08%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	芯联集成电路制造股份有限公司（上市公司）	2023-07-07	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2025-12-29	12.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1	苏州工业园区元禾耕耔创业投资合伙企业（有限合伙）	2021-02-09	0.35%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1	苏州工业园区辰坤企业管理合伙企业（有限合伙）	2020-12-01	51.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1	上海鼎佑辰坤企业管理合伙企业（有限合伙）	2023-04-20	98.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-1	徐清	2023-04-03	30.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-2	王吉鹏	2023-04-03	20.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-3	李怀杰	2023-04-03	20.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-4	苏州工业园区久坤创业投资有限责任公司	2023-04-03	20.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-4-1	徐清	2023-03-09	70.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-4-2	李永芳	2023-06-02	30.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-1-1-5	喇雅蓉	2023-04-03	10.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-2-1-1-2	苏州工业园区久坤创业投资有限责任公司（同 1-2-1-1-1-4）	2023-04-20	2.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-1-2	苏州元禾控股股份有限公司（国有控股或管理主体）	2020-12-01	49.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-2	苏州元禾控股股份有限公司（同 1-2-1-2）	2021-02-09	34.81%	货币	自有或自筹资金
1-2-3	东吴人寿保险股份有限公司（国有控股或管理主体）	2021-11-15	10.44%	货币	自有或自筹资金
1-2-4	中保投资有限责任公司（国有控股或管理主体）	2024-01-31	9.32%	货币	募集资金
1-2-5	苏州城市建设投资发展集团有限公司	2021-11-15	8.70%	货币	自有或自筹资金
1-2-5-1	苏州市国有资产管理委员会	2024-11-22	94.36%	货币	自有或自筹资金
1-2-5-2	苏州国有资本投资集团有限公司	2024-11-22	5.64%	货币	自有或自筹资金
1-2-5-2-1	苏州市国有资产管理委员会	2023-12-25	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-6	苏州工业园区经济发展有限公司	2021-02-09	8.70%	货币	自有或自筹资金
1-2-6-1	苏州工业园区管理委员会	2019-09-03	90.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-6-2	江苏省财政厅	2020-12-30	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-7	苏州恒泰控股集团有限公司	2021-02-09	8.70%	货币	自有或自筹资金
1-2-7-1	苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司	2025-02-19	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-7-1-1	苏州工业园区管理委员会	2020-08-01	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-8	英大泰和人寿保险股份有限公司（国有控股或管理主体）	2024-01-31	6.96%	货币	自有或自筹资金
1-2-9	利安人寿保险股份有限公司（国有控股或管理主体）	2024-01-31	5.22%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-2-10	招商信诺人寿保险有限公司	2024-01-31	1.74%	货币	自有或自筹资金
1-2-10-1	招商银行股份有限公司（600036.SH）	2015-11-30	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-10-2	信诺健康人寿保险公司	2021-02-26	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-11	广投资本管理集团有限公司	2024-01-31	1.74%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1	广西金融投资集团有限公司	2020-04-20	90.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-1	广西投资集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2020-01-22	68.22%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-2	广西壮族自治区财政厅（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	19.17%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-3	广西出版传媒集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	3.75%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-4	广西柳州钢铁集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	2.39%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-5	广西交通投资集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	2.04%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-6	广西北部湾投资集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	2.04%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-7	广西融资担保集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	1.36%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-8	广西汽车集团有限公司（穿透持	2022-12-13	0.68%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
	有标的公司股权比例小于0.01%）				
1-2-11-1-9	广西林业集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	0.17%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-1-10	广西旅游发展集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2022-12-13	0.17%	货币	自有或自筹资金
1-2-11-2	广西投资集团有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于0.01%）	2023-12-28	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-12	恒安标准人寿保险有限公司	2024-01-31	1.74%	货币	自有或自筹资金
1-2-12-1	天津市泰达国际控股（集团）有限公司（穿透持有标的公司股权比例小于 0.01%）	2013-04-23	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-12-2	ABRDN PLC（穿透持有标的公司股权比例小于 0.01%）	2018-02-26	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-2-13	重庆渝富控股集团有限公司	2024-01-31	1.57%	货币	自有或自筹资金
1-2-13-1	重庆市国有资产监督管理委员会	2020-05-31	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	2025-05-06	8.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1	上海国有资本投资母基金有限公司	2023-08-10	99.94%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-1	上海汽车工业（集团）有限公司	2022-12-14	19.50%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-1-1	上海市国有资产监督管理委员会	2022-02-14	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-2	上海国有资本投资有限公司	2022-12-14	19.50%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-2-1	上海市国有资产监督管理委员会	2024-12-30	100.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-3-1-3	上海临港新片区私募基金管理有限公司	2022-12-14	9.75%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-3-1	上海临港新片区投资控股（集团）有限公司	2025-12-22	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-3-1-1	上海市国有资产监督管理委员会	2026-03-31	85.62%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-3-1-2	上海港城开发（集团）有限公司	2025-01-10	14.38%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-3-1-1-1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	2014-04-11	52.10%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-3-1-1-2	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心	2005-09-16	47.90%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-4	上海国际港务（集团）股份有限公司（600018.SH）	2022-12-14	7.80%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-5	上海上实（集团）有限公司	2022-12-14	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-5-1	上海市国有资产管理办公室	2010-06-29	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-6	上海奉贤投资（集团）有限公司	2022-12-14	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-6-1	上海市奉贤区国有资产监督管理委员会（上海市奉贤区集体资产监督管理委员会）	2024-12-18	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-7	国泰君安证裕投资有限公司	2022-12-14	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-7-1	国泰海通证券股份有限公司（601211.SH）	2023-07-04	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-8	上海北中环科创企业发展（集团）有限公司	2022-12-14	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-8-1	上海市虹口区国有资产监督管理委员会（上海市虹口区集体资产监督管理委员会）	2022-05-10	100.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-3-1-9	上海申能诚毅股权投资有限公司	2022-12-14	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-9-1	申能（集团）有限公司	2016-12-27	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-9-1-1	上海市国有资产监督管理委员会	2017-10-17	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-10	中国太平洋保险（集团）股份有限公司（601601.SH）	2024-06-21	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-11	中国远洋海运集团有限公司	2024-06-21	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-11-1	国务院	2016-02-05	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12	东方国际（集团）有限公司	2022-12-14	3.90%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-1	上海市国资委	2019-01-10	57.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-2	上海国盛（集团）有限公司	2019-01-10	34.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-2-1	上海市国有资产监督管理委员会	2019-02-28	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3	上海临港经济发展（集团）有限公司	2025-12-31	9.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-1	上海市国有资产监督管理委员会	2011-12-29	63.81%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-2	上海电气控股集团有限公司	2023-11-10	18.66%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-2-1	上海市国有资产监督管理委员会	2024-12-30	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-3	上海国盛（集团）有限公司（同1-3-1-12-2）	2017-05-15	9.34%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-4	上海城投兴港投资建设（集团）有限公司	2023-04-12	4.63%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-4-1	上海城投（集团）有限公司	2019-12-18	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-	上海市国有资产监督管理委员会	2014-11-26	100.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
4-1-1					
1-3-1-12-3-5	上海久事（集团）有限公司	2005-12-06	2.67%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-5-1	上海市国有资产监督管理委员会	2015-11-02	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-6	上海浦东发展（集团）有限公司	2025-01-26	0.89%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-12-3-6-1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	2010-04-29	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-13	东浩兰生（集团）有限公司	2022-12-14	2.93%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-13-1	上海市国有资产监督管理委员会	2021-12-28	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-14	上海建工集团股份有限公司（600170.SH）	2022-12-14	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15	上海孚腾私募基金管理有限公司	2022-12-14	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-1	上海国投资本管理有限公司	2022-01-19	35.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-1-1	上海国有资本投资有限公司（同1-3-1-2）	2021-09-28	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-2	上海观睿浦颐企业咨询合伙企业（有限合伙）	2022-01-19	21.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-2-1	上海观钠咨询管理有限公司（同1-3-2-2-1-1）	2024-06-20	60.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-2-2	章锟	2024-01-10	30.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-2-3	马国昕	2024-01-10	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-2-4	上海观睿信息科技咨询有限公司（同 1-3-2-2）	2021-11-15	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-3	上海汽车集团金控管理有限公司	2022-01-19	7.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-3-1-15-3-1	上海汽车集团股份有限公司（600104.SH）	2019-05-09	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-4	上海临创投资管理有限公司	2022-01-19	7.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-4-1	上海临港经济发展（集团）有限公司（同 1-3-1-12-3）	2022-07-27	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-5	中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-5-1	天津跃波投资咨询有限公司	2021-05-24	99.99%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-5-1-1	赵彦	2017-05-22	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-5-1-2	王冉旭	2021-06-28	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-5-2	赵彦	2021-05-24	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-6	上海绘界文化传播有限公司	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-6-1	上海幻电信息科技有限公司	2016-02-02	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-6-1-1	陈睿	2014-03-27	52.30%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-6-1-2	徐逸	2013-04-07	44.31%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-6-1-3	李旎	2014-11-19	3.39%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-7	上海岭投投资管理有限公司	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-7-1	潘建岳	2020-11-18	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-7-2	上海壮辰企业管理咨询有限公司	2024-12-30	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-7-2-1	PING WU	2024-05-10	60.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-3-1-15-7-2-1	JOANN XU WU	2024-05-10	40.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-8	博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-8-1	支汝苇	2017-07-19	54.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-8-2	陶峰	2017-07-19	36.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-8-3	雷春平	2022-08-03	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-9	博裕观山（厦门）投资有限公司	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-9-1	博裕景泰（宁波）投资管理有限公司	2021-11-22	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-9-1-1	陶融	2022-03-31	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-9-1-2	黄爱莲	2022-03-31	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-1-15-10	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）	2022-01-19	5.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2	上海观瑞孚淼企业管理服务合伙企业（有限合伙）	2023-08-10	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-1	马国昕	2023-04-03	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2	上海观睿信息科技咨询有限公司	2023-04-03	50.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1	上海观睿实业合伙企业（有限合伙）	2021-08-11	99.90%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-1	上海观钠咨询管理有限公司	2023-09-13	45.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-1-1	费飞	2023-08-15	99.90%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-1-2	章锟	2023-08-15	0.10%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-3-2-2-1-2	观尚科技（上海）有限责任公司	2021-07-13	33.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-2-1	费飞	2021-08-19	67.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-2-2	章锟	2021-08-19	33.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-1-3	章锟	2021-07-13	22.00%	货币	自有或自筹资金
1-3-2-2-2	费飞	2021-08-11	0.10%	货币	自有或自筹资金
1-3-3	上海孚腾私募基金管理有限公司（同 1-3-1-15）	2023-08-10	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-4	厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合伙企业（有限合伙）	2025-12-29	8.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-1	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	2024-01-05	59.98%	货币	自有或自筹资金
1-4-1-1	厦门建发集团有限公司	2024-12-20	90.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-1-1-1	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	2018-12-17	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-1-2	厦门华益工贸有限公司	2024-12-20	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-1-2-1	厦门建发集团有限公司（同 1-4-1-1）	2000-10-20	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-2	全国社会保障基金理事会	2024-01-05	40.00%	货币	自有或自筹资金
1-4-3	厦门建发新兴创业投资有限公司	2024-01-05	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-4-3-1	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司（同 1-4-1）	2023-08-09	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-5	无锡芯朋微电子股份有限公司（688508.SH）	2025-12-29	8.00%	货币	自有或自筹资金
1-6	嘉兴嘉国叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	2025-12-29	4.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-6-1	浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司	2024-12-31	99.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-1-1	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	2021-08-11	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-1-1-1	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	2007-08-28	95.48%	货币	自有或自筹资金
1-6-1-1-2	浙江省财开集团有限公司	2020-11-30	4.52%	货币	自有或自筹资金
1-6-1-1-2-1	浙江省财政厅	1992-06-30	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2	嘉兴市嘉睿投资管理有限公司	2024-12-31	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2-1	嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	2018-03-15	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2-1-1	浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司（同 1-6-1）	2024-03-07	51.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2-1-2	嘉兴市产业发展集团有限公司	2024-03-07	49.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2-1-2-1	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	2020-07-30	90.00%	货币	自有或自筹资金
1-6-2-1-2-2	浙江省财开集团有限公司（同 1-6-1-1-2）	2020-07-30	10.00%	货币	自有或自筹资金
1-7	上海临港新片区私募基金管理有限公司（同 1-3-1-3）	2024-12-27	4.00%	货币	自有或自筹资金
1-8	安徽富乐德科技发展股份有限公司（301297.SZ）	2025-12-29	2.40%	货币	自有或自筹资金
1-9	宁波江丰电子材料股份有限公司（300666.SZ）	2025-05-06	1.60%	货币	自有或自筹资金
1-10	鑫启源 1 号创业投资基金（契约型基金产品编码 SAYX43）	2025-12-29	1.60%	货币	募集资金
1-10-1	江苏鑫智股权投资管理有限公司	2025-12-29	1.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-1-1	江苏鑫合易家信息技术有限责任	2018-03-20	100.00%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
	公司				
1-10-1-1-1	南京银资物业经营管理有限责任公司	2021-10-20	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-1-1-1-1	南京银行工会委员会	2021-06-18	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-2	鑫沅资产管理有限公司	2025-12-29	99.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-2-1	鑫元基金管理有限公司	2017-12-07	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-2-1-1	南京银行股份有限公司（601009.SH）	2017-12-15	80.00%	货币	自有或自筹资金
1-10-2-1-2	南京高科股份有限公司（600064.SH）	2017-12-15	20.00%	货币	自有或自筹资金
1-11	芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	2024-12-23	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-11-1	袁锋	2023-09-28	45.00%	货币	自有或自筹资金
1-11-2	杭州芯联同行商务咨询合伙企业（有限合伙）	2023-09-28	40.00%	货币	自有或自筹资金
1-11-2-1	袁锋	2023-08-25	72.00%	货币	自有或自筹资金
1-11-2-2	张静之	2025-01-09	28.00%	货币	自有或自筹资金
1-11-3	芯联股权投资（杭州）有限公司	2023-09-28	15.00%	货币	自有或自筹资金
1-11-3-1	芯联集成电路制造股份有限公司（688469.SH）	2023-07-07	100.00%	货币	自有或自筹资金

13、天水华天电子集团股份有限公司

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	肖胜利	2013-04-27	18.63%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-2	肖智成	2017-12-31	17.66%	货币	自有或自筹资金
1-3	刘建军	2013-04-27	4.69%	货币	自有或自筹资金
1-4	张玉明	2013-04-27	3.05%	货币	自有或自筹资金
1-5	宋勇	2013-04-27	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-6	常文瑛	2013-04-27	1.93%	货币	自有或自筹资金
1-7	薛延童	2013-04-27	2.13%	货币	自有或自筹资金
1-8	陈建军	2013-04-27	2.13%	货币	自有或自筹资金
1-9	崔卫兵	2013-04-27	3.55%	货币	自有或自筹资金
1-10	杨前进	2013-04-27	2.13%	货币	自有或自筹资金
1-11	周永寿	2013-04-27	2.03%	货币	自有或自筹资金
1-12	张兴安	2013-04-27	2.43%	货币	自有或自筹资金
1-13	乔少华	2006-12-01	0.77%	货币	自有或自筹资金
1-14	张铁成	2013-04-27	1.01%	货币	自有或自筹资金
1-15	李六军	2013-04-27	2.02%	货币	自有或自筹资金
1-16	蒲鸿鸣	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-17	陈世贵	2013-04-27	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-18	陈建荣	2013-04-27	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-19	于守都	2013-04-27	0.22%	货币	自有或自筹资金
1-20	张照林	2013-04-27	0.49%	货币	自有或自筹资金
1-21	柳源	2013-04-27	0.59%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-22	周勇	2013-04-27	0.26%	货币	自有或自筹资金
1-23	孟郁斌	2013-04-27	0.23%	货币	自有或自筹资金
1-24	王志宏	2013-04-27	0.04%	货币	自有或自筹资金
1-25	姜尔君	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-26	任江林	2006-12-01	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-27	郭建波	2006-12-01	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-28	文世博	2013-04-27	0.37%	货币	自有或自筹资金
1-29	王德举	2013-04-27	0.41%	货币	自有或自筹资金
1-30	杨熹	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-31	刘强	2013-04-27	0.39%	货币	自有或自筹资金
1-32	黄聚宏	2006-12-01	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-33	谢恩桓	2013-04-27	0.16%	货币	自有或自筹资金
1-34	孟永刚	2006-12-01	0.02%	货币	自有或自筹资金
1-35	谢宏安	2013-04-27	0.26%	货币	自有或自筹资金
1-36	吴涛	2013-04-27	0.51%	货币	自有或自筹资金
1-37	吴学峰	2013-04-27	0.26%	货币	自有或自筹资金
1-38	卫晓勇	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-39	梁凤志	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-40	朱和生	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-41	张勇	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-42	宋勤福	2013-04-27	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-43	柳树青	2006-12-01	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-44	高志武	2006-12-01	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-45	张卫东	2013-04-27	0.14%	货币	自有或自筹资金
1-46	张甲义	2013-04-27	0.10%	货币	自有或自筹资金
1-47	马川喜	2013-04-27	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-48	王小勇	2013-04-27	0.19%	货币	自有或自筹资金
1-49	常小平	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-50	郭喜喜	2013-04-27	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-51	施长立	2013-04-27	0.16%	货币	自有或自筹资金
1-52	成军	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-53	常鲲	2013-04-27	0.22%	货币	自有或自筹资金
1-54	杨维新	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-55	牛旺春	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-56	王兴刚	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-57	魏存晶	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-58	刘定斌	2013-04-27	0.11%	货币	自有或自筹资金
1-59	刘吉海	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-60	蒲彦武	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-61	庞金泰	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-62	张武	2013-04-27	0.24%	货币	自有或自筹资金
1-63	徐文亮	2013-04-27	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-64	梁继安	2013-04-27	0.18%	货币	自有或自筹资金
1-65	陶迎九	2013-04-27	0.20%	货币	自有或自筹资金
1-66	郭乔	2013-04-27	0.20%	货币	自有或自筹资金
1-67	胥增良	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-68	李秦生	2013-04-27	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-69	常勇刚	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-70	杨永红	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-71	潘海斌	2006-12-01	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-72	蔺兴江	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-73	王向阳	2006-12-01	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-74	李强	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-75	颉永红	2013-04-27	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-76	徐萌	2006-12-01	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-77	韩朝	2013-04-27	0.16%	货币	自有或自筹资金
1-78	袁雪玲	2013-04-27	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-79	李双龙	2013-04-27	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-80	李广志	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-81	蔡志元	2013-04-27	0.22%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-82	何辛峰	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-83	王永忠	2013-04-27	0.15%	货币	自有或自筹资金
1-84	谈光宗	2013-04-27	0.24%	货币	自有或自筹资金
1-85	王晓春	2013-04-27	0.14%	货币	自有或自筹资金
1-86	高祖光	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-87	李习周	2013-04-27	0.33%	货币	自有或自筹资金
1-88	张自飞	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-89	王彦琼	2013-04-27	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-90	王倩	2006-12-01	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-91	胡超先	2013-04-27	0.47%	货币	自有或自筹资金
1-92	韩冬	2013-04-27	0.20%	货币	自有或自筹资金
1-93	何文海	2013-04-27	0.16%	货币	自有或自筹资金
1-94	刘志强	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-95	高罡	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-96	王荣	2006-12-01	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-97	丁福林	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-98	柴建瑞	2013-04-27	0.30%	货币	自有或自筹资金
1-99	骆菊芬	2013-04-27	0.32%	货币	自有或自筹资金
1-100	索银辉	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-101	马永林	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-102	马昌志	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-103	高峰	2013-04-27	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-104	孙启中	2006-12-01	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-105	曾硕	2013-04-27	0.22%	货币	自有或自筹资金
1-106	王凤武	2013-04-27	0.16%	货币	自有或自筹资金
1-107	马勉之	2013-04-27	0.20%	货币	自有或自筹资金
1-108	郭锦星	2013-04-27	0.04%	货币	自有或自筹资金
1-109	陈庆伟	2013-04-27	0.19%	货币	自有或自筹资金
1-110	杨玉坤	2006-12-01	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-111	张雅迪	2013-04-27	0.10%	货币	自有或自筹资金
1-112	李红伟	2006-12-01	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-113	张宏杰	2013-04-27	0.12%	货币	自有或自筹资金
1-114	姚自明	2013-04-27	0.05%	货币	自有或自筹资金
1-115	李周	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-116	杨海峰	2013-04-27	0.08%	货币	自有或自筹资金
1-117	周秦贤	2006-12-01	0.02%	货币	自有或自筹资金
1-118	南松峰	2006-12-01	0.02%	货币	自有或自筹资金
1-119	李保文	2006-12-01	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-120	陶丽华	2006-12-01	0.01%	货币	自有或自筹资金
1-121	周建春	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-122	何伟	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-123	卜世太	2013-04-27	0.17%	货币	自有或自筹资金
1-124	姜红	2006-12-01	0.06%	货币	自有或自筹资金
1-125	尹文斌	2013-04-27	0.10%	货币	自有或自筹资金
1-126	高红梅	2013-04-27	0.11%	货币	自有或自筹资金
1-127	张永平	2013-04-27	0.07%	货币	自有或自筹资金
1-128	王辉	2013-04-27	0.27%	货币	自有或自筹资金
1-129	牛成启	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-130	窦建奎	2013-04-27	0.13%	货币	自有或自筹资金
1-131	苏守义	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-132	季琳	2013-04-27	0.15%	货币	自有或自筹资金
1-133	邓文利	2013-04-27	0.11%	货币	自有或自筹资金
1-134	苏新越	2013-04-27	0.03%	货币	自有或自筹资金
1-135	李德成	2013-04-27	0.09%	货币	自有或自筹资金
1-136	天水天资微电子产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	3.27%	货币	自有或自筹资金
1-136-1	蔡瑞	2013-04-23	34.57%	货币	自有或自筹资金
1-136-2	张文秀	2015-11-17	13.58%	货币	自有或自筹资金
1-136-3	常红军	2013-04-23	4.94%	货币	自有或自筹资金
1-136-4	李兴旺	2013-04-23	3.70%	货币	自有或自筹资金
1-136-5	万建刚	2013-04-23	2.47%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-136-6	师红兵	2013-04-23	2.47%	货币	自有或自筹资金
1-136-7	焦建东	2013-04-23	2.47%	货币	自有或自筹资金
1-136-8	张瑞琪	2013-04-23	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-9	王晓峰	2024-06-27	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-10	李欣	2013-04-23	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-11	王虎	2013-04-23	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-12	马书英	2024-06-27	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-13	刘艳玲	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-14	王力	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-15	板维恩	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-16	陈永德	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-17	陈兴隆	2021-07-15	3.09%	货币	自有或自筹资金
1-136-18	乔少华	2021-07-15	1.85%	货币	自有或自筹资金
1-136-19	南虎	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-20	林会文	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-21	雷彦云	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-22	刘天宝	2013-04-23	1.23%	货币	自有或自筹资金
1-136-23	刘双福	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-24	王兴业	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-25	李明阔	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-136-26	刘亚军	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-27	张克飞	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-28	李文平	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-29	张希泰	2021-07-15	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-30	郑永富	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-136-31	焦伟宏	2021-07-15	6.17%	货币	自有或自筹资金
1-136-32	张治国	2013-04-23	0.62%	货币	自有或自筹资金
1-137	天水天鑫半导体产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	2.28%	货币	自有或自筹资金
1-137-1	吴树涛	2013-04-23	8.85%	货币	自有或自筹资金
1-137-2	杨德文	2013-04-23	8.85%	货币	自有或自筹资金
1-137-3	叶海珍	2013-04-23	5.31%	货币	自有或自筹资金
1-137-4	于蔚虹	2013-04-23	5.31%	货币	自有或自筹资金
1-137-5	孙莉	2013-04-23	3.54%	货币	自有或自筹资金
1-137-6	汶超	2013-04-23	3.54%	货币	自有或自筹资金
1-137-7	张云超	2013-04-23	10.62%	货币	自有或自筹资金
1-137-8	侯庆春	2013-04-23	2.65%	货币	自有或自筹资金
1-137-9	刘平安	2013-04-23	2.65%	货币	自有或自筹资金
1-137-10	杨永继	2013-04-23	2.65%	货币	自有或自筹资金
1-137-11	彭远光	2013-04-23	2.65%	货币	自有或自筹资金
1-137-12	黄毅	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-137-13	吕向阳	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-14	郭顺吉	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-15	任忠原	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-16	姚子龙	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-17	沈建强	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-18	董婕	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-19	丁晓东	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-20	郑乐和	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-21	霍军军	2013-04-23	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-22	冷飞	2024-06-27	1.77%	货币	自有或自筹资金
1-137-23	宋巧珍	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-24	欧小荣	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-25	李国泉	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-26	滕永恒	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-27	郭成军	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-28	刘红波	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-29	周金成	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-30	候双	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-31	王恒	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-32	李广志	2021-07-15	4.42%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-137-33	乔少华	2021-07-15	3.54%	货币	自有或自筹资金
1-137-34	袁万利	2021-07-15	6.19%	货币	自有或自筹资金
1-137-35	王立军	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-137-36	郭永祥	2013-04-23	0.88%	货币	自有或自筹资金
1-138	天水华资集成电路产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	2.48%	货币	自有或自筹资金
1-138-1	王林	2013-04-23	19.51%	货币	自有或自筹资金
1-138-2	马云	2013-04-23	5.69%	货币	自有或自筹资金
1-138-3	彭成	2013-04-23	5.69%	货币	自有或自筹资金
1-138-4	李燕飞	2013-04-23	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-138-5	严卓亮	2013-04-23	4.88%	货币	自有或自筹资金
1-138-6	张勇	2013-04-23	4.07%	货币	自有或自筹资金
1-138-7	张希泰	2021-07-15	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-138-8	李晓敏	2013-04-23	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-138-9	庾斌	2013-04-23	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-138-10	于守江	2013-04-23	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-138-11	白海霞	2013-04-23	2.44%	货币	自有或自筹资金
1-138-12	曹萍萍	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-13	张浩文	2021-07-15	4.07%	货币	自有或自筹资金
1-138-14	冯岩	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-15	何重明	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-138-16	陈爱芳	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-17	叶军	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-18	李金生	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-19	肖智佩	2021-07-15	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-20	袁万利	2021-07-15	6.50%	货币	自有或自筹资金
1-138-21	郭昌宏	2013-04-23	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-22	赵世荣	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-23	陶永强	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-24	霍伟强	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-25	杨恩江	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-26	王玉熬	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-27	乔少华	2021-07-15	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-28	杨万成	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-29	妥耀华	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-30	李继坤	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-31	陈志祥	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-32	代赋	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-33	陈国岚	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-34	李亚斌	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-138-35	刘卫东	2024-06-27	3.25%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-138-36	马书英	2024-06-27	1.63%	货币	自有或自筹资金
1-138-37	刘小宝	2024-06-27	3.25%	货币	自有或自筹资金
1-138-38	王立国	2013-04-23	0.81%	货币	自有或自筹资金
1-139	天水华辉文化创意产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	2.77%	货币	自有或自筹资金
1-139-1	张利平	2013-04-23	7.30%	货币	自有或自筹资金
1-139-2	刘晓明	2013-04-23	14.60%	货币	自有或自筹资金
1-139-3	张希泰	2021-07-15	4.38%	货币	自有或自筹资金
1-139-4	康鹏	2013-04-23	3.65%	货币	自有或自筹资金
1-139-5	张剑	2013-04-23	3.65%	货币	自有或自筹资金
1-139-6	张铁成	2021-07-15	9.49%	货币	自有或自筹资金
1-139-7	徐文华	2013-04-23	3.65%	货币	自有或自筹资金
1-139-8	樊海国	2013-04-23	2.92%	货币	自有或自筹资金
1-139-9	伏国荣	2013-04-23	2.92%	货币	自有或自筹资金
1-139-10	李敏	2013-04-23	2.92%	货币	自有或自筹资金
1-139-11	赵立新	2013-04-23	2.92%	货币	自有或自筹资金
1-139-12	李东源	2013-04-23	2.92%	货币	自有或自筹资金
1-139-13	张文	2013-04-23	2.19%	货币	自有或自筹资金
1-139-14	杨军	2013-04-23	2.19%	货币	自有或自筹资金
1-139-15	胡东红	2013-04-23	2.19%	货币	自有或自筹资金
1-139-16	岳维武	2013-04-23	2.19%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-139-17	王云莉	2013-04-23	2.19%	货币	自有或自筹资金
1-139-18	张俊	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-19	杨千栋	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-20	姜赞梅	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-21	王国励	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-22	王浩	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-23	李靖	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-24	王治文	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-25	胡志强	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-26	把余全	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-27	王学琨	2013-04-23	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-139-28	王小红	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-29	党建东	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-30	王倩	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-31	孙建文	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-32	刘海江	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-33	贾宇	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-34	党红兰	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-35	李科	2024-06-27	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-36	张勇	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-139-37	李军琪	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-38	于鸿宾	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-39	彭远博	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-40	谢恩昕	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-41	罗君成	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-42	辛黎明	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-43	王增健	2013-04-23	0.73%	货币	自有或自筹资金
1-139-44	冷飞	2024-06-27	1.46%	货币	自有或自筹资金
1-140	天水优润电子产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	1.86%	货币	自有或自筹资金
1-140-1	李生斌	2013-04-24	10.87%	货币	自有或自筹资金
1-140-2	张希泰	2021-07-15	10.87%	货币	自有或自筹资金
1-140-3	陈兴隆	2021-07-15	5.43%	货币	自有或自筹资金
1-140-4	乔少华	2021-07-15	2.17%	货币	自有或自筹资金
1-140-5	徐琴琴	2021-07-15	5.43%	货币	自有或自筹资金
1-140-6	张铁成	2021-07-15	6.52%	货币	自有或自筹资金
1-140-7	张兴安	2021-07-15	16.30%	货币	自有或自筹资金
1-140-8	肖智轶	2013-04-24	7.61%	货币	自有或自筹资金
1-140-9	吕海兰	2013-04-24	6.52%	货币	自有或自筹资金
1-140-10	季金平	2013-04-24	5.43%	货币	自有或自筹资金
1-140-11	郭雁冰	2013-04-24	4.35%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-140-12	赵凯	2013-04-24	3.26%	货币	自有或自筹资金
1-140-13	刘祥明	2013-04-24	3.26%	货币	自有或自筹资金
1-140-14	许丽	2013-04-24	2.17%	货币	自有或自筹资金
1-140-15	赵宝	2013-04-24	2.17%	货币	自有或自筹资金
1-140-16	李大树	2013-04-24	2.17%	货币	自有或自筹资金
1-140-17	韩亚香	2013-04-24	2.17%	货币	自有或自筹资金
1-140-18	蔡建兵	2013-04-24	1.09%	货币	自有或自筹资金
1-140-19	符娟	2013-04-24	1.09%	货币	自有或自筹资金
1-140-20	王振宇	2013-04-24	1.09%	货币	自有或自筹资金
1-141	天水飞泰互联网产业发展中心（有限合伙）	2013-04-27	2.38%	货币	自有或自筹资金
1-141-1	李存德	2013-04-23	8.47%	货币	自有或自筹资金
1-141-2	李建军	2013-04-23	5.93%	货币	自有或自筹资金
1-141-3	牟俊强	2013-04-23	5.93%	货币	自有或自筹资金
1-141-4	巨峰	2013-04-23	5.93%	货币	自有或自筹资金
1-141-5	谢炳轩	2013-04-23	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-6	高华	2013-04-23	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-7	寇雪梅	2013-04-23	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-8	王养民	2013-04-23	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-9	闫景涛	2013-04-23	3.39%	货币	自有或自筹资金
1-141-10	郑江信	2013-04-23	3.39%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-141-11	林维	2013-04-23	3.39%	货币	自有或自筹资金
1-141-12	黄力	2013-04-23	3.39%	货币	自有或自筹资金
1-141-13	李爱华	2013-04-23	2.54%	货币	自有或自筹资金
1-141-14	魏学敏	2024-06-27	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-15	吕兴军	2013-04-23	2.54%	货币	自有或自筹资金
1-141-16	冯鹏燕	2013-04-23	2.54%	货币	自有或自筹资金
1-141-17	王瑞军	2013-04-23	2.54%	货币	自有或自筹资金
1-141-18	马伟	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-19	田聪	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-20	谢文涛	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-21	李会峰	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-22	王雷宁	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-23	刘洪江	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-24	周超峰	2024-06-27	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-25	冯建军	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-26	杜在鹏	2013-04-23	1.69%	货币	自有或自筹资金
1-141-27	李红	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-28	梁旭霞	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-29	南芳琴	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-30	刘文民	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-141-31	郑志仁	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-32	史晓莉	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-33	王志强	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-34	何立军	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-35	周建中	2024-06-27	4.24%	货币	自有或自筹资金
1-141-36	薛建喜	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-37	成军祥	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金
1-141-38	刘继	2013-04-23	0.85%	货币	自有或自筹资金

14、西安天利投资合伙企业（有限合伙）

层级序号	股东姓名/名称	首次入股时间	对直接被投资主体的投资比例	出资方式	资金来源
1-1	华天科技（西安）有限公司	2019-02-19	60.00%	货币	自有或自筹资金
1-1-1	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）	2021-12-31	100.00%	货币	自有或自筹资金
1-2	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）	2019-02-19	37.82%	货币	自有或自筹资金
1-3	西安天启企业管理有限公司	2019-02-19	2.18%	货币	自有或自筹资金
1-3-1	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）	2016-03-31	100.00%	货币	自有或自筹资金